

목 차

분 기 보 고 서	1
【 대표이사 등의 확인 】	2
I. 회사의 개요.....	3
1. 회사의 개요.....	3
2. 회사의 연혁.....	17
3. 자본금 변동사항.....	24
4. 주식의 총수 등.....	24
5. 의결권 현황.....	25
6. 배당에 관한 사항 등.....	26
II. 사업의 내용	28
III. 재무에 관한 사항	53
1. 요약재무정보	53
2. 연결재무제표	54
3. 연결재무제표 주식	58
4. 재무제표	113
5. 재무제표 주식	117
6. 기타 재무에 관한 사항.....	167
IV. 감사인의 감사의견 등	180
V. 이사의 경영진단 및 분석의견.....	182
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항	183
1. 이사회에 관한 사항	183
2. 감사제도에 관한 사항.....	190
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항.....	193
VII. 주주에 관한 사항.....	194
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항.....	200
1. 임원 및 직원의 현황	200
2. 임원의 보수 등	209
IX. 계열회사 등에 관한 사항.....	212
X. 이해관계자와의 거래내용.....	236
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항	238
【 전문가의 확인 】	243
1. 전문가의 확인	243
2. 전문가와의 이해관계	243

분기보고서

(제 71 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 03월 31일 까지

금융위원회

한국거래소 귀중

2018년 5월 15일

제출대상법인 유형 :

주권상장법인

면제사유발생 :

해당사항 없음

회 사 명 :

에스케이하이닉스 주식회사

대 표 이 사 :

박 성 욱

본 점 소 재 지 :

경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091

(전 화) 031-630-4114

(홈페이지) <http://www.skhynix.com>

작 성 책 임 자 :

(직 책) 경영지원 담당 (성 명) 이 명 영

(전 화) 031-8093-4801~6

【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인·검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 내용이 기재 또는 표시사항을 이용하는자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

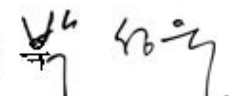
또한 당사는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」 제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.

2018. 05. 15

에스케이하이닉스 주식회사

대 표 이 사

박 성



공시 책임자

이 명



I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말 자산총액	지배관계 근거	주요종속 회사 여부
에스케이하이엔지㈜	2001.04	경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091	사업지원	128,339	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당 (자산총액 750억원 이상)
에스케이하이시스템㈜	2008.03	경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091	사업지원	59,534	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음
행복모아 ㈜	2016.10	충청북도 청주시 흥덕구 화계동 청주테크노폴리스 일반산업단지 예프6-2	사업지원	16,486	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음
SK hynix America Inc.(SKHYA)	1983.03	3101 North First Street, San Jose, CA 95134, U.S.A	반도체판매	2,522,348	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당 (자산총액 750억원 이상)
SK hynix Deutschland GmbH (SKHYD)	1989.03	Am Prime Parc 13, Kelsterbacher Str. 16, D-65479 Raunheim, Germany	반도체판매	108,470	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당 (자산총액 750억원 이상)
SK hynix Asia Pte.Ltd.(SKHYS)	1991.09	8 Temasek Boulevard #11-03, Suntec City Tower3, Singapore 038988	반도체판매	636,286	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당 (자산총액 750억원 이상)
SK hynix Semiconductor HongKong Ltd. (SKHYH)	1995.04	Suite 4401-02 & 11-12, 44/F, One Island East, 18 Westlands Road, Taikoo Place, Quarry Bay, Hong Kong	반도체판매	1,043,889	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당 (자산총액 750억원 이상)
SK hynix U.K. Ltd.(SKHYU)	1995.07	243 Brooklands Road, Weybridge, Surrey KT13 0RH, UK	반도체판매	325,434	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당 (자산총액 750억원 이상)
SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.(SKHYT)	1996.07	Lite-On Technology Building 11F., No. 392, Ruiguang Road, Neihu Dist., Taipei City 11492 Taiwan, R.O.C	반도체판매	566,155	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당 (자산총액 750억원 이상)
SK hynix Japan Inc.(SKHYJ)	1996.09	23F SHIROYAMA TRUST TOWER, 4-3-1 Toranomon, Minatoku, Tokyo	반도체판매	632,590	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당 (자산총액 750억원 이상)
SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co.,Ltd. (SKHYCS)	2001.08	19F, ARCH SHANGHAI Tower 2, No.533 Lou Shan Guan Road, Shanghai, 200051 China	반도체판매	414,850	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당 (자산총액 750억원 이상)
SK hynix Semiconductor India Private Limited (SKHYIS)	2006.11	Unit 10, Level 8, Innovator Building, ITPB (International Technology Park Bangalore), Whitefield Road, Bangalore 560066, India	반도체판매	903	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음
SK hynix(Wuxi) Semiconductor Sales Ltd. (SKHYCW)	2010.08	Lot K7, Wuxi Export Processing Zone in Wuxi New District, Wuxi, Jiangsu Province, China	반도체판매	13,347	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음
SK hynix Semiconductor (China) Ltd. (SKHYCL)	2005.04	Lot K7, Wuxi High-tech Zone Comprehensive Bonded Zone in New District, Wuxi, Jiangsu Province, China(214028)	웨이퍼생산 및 판매	4,043,100	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당 (자산총액 750억원 이상)
SK hynix Semiconductor (Wuxi) Ltd. (SKHYMC)	2006.04	Lot K7, Wuxi Export Processing Zone in Wuxi New District, Wuxi, Jiangsu Province, China	웨이퍼생산 및 판매	269,183	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당 (자산총액 750억원 이상)

SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd. (SKHYCQL)	2013.09	Xiyong Comprehensive Bonded Zone B Block v2-4/02, Shapingba strict, Chongqing, China	웨이퍼생산 및 판매	388,033	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당 (자산총액 750억원 이상)
SK hynix Italy S.r.l. (SKHYIT)	2012.05	V.le Colleoni, 15 20864 Agrate Brianza (MB)	기술샌타	3,462	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음
SK hynix memory solutions Inc. (SKHMS)	2012.08	3103 North First Street, San Jose, CA 95134, U.S.A	기술샌타	97,132	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당 (자산총액 750억원 이상)
SK hynix Flash Solution Taiwan Ltd. (SKHYFST)	2013.08	6F-1. Mo. 6. Taiyuen 1st (Taiyuen Hi-tech Industrial Park) Zhubei City, Hsinchu County 302, Taiwan	기술샌타	8,626	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음
Softeq Flash Solutions LLC. (SOFTEQ)	2014.06	Kalvaryiskaya, 42 Fifth Floor Minsk, Belarus, 220073	기술샌타	5,261	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음
SK APTECH Ltd. (SKAPTECH)	2013.09	Wanchai, Hong Kong	해외투자법인	166,528	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당 (자산총액 750억원 이상)
SK hynix Ventures Hong Kong Limited (SKH Ventures)	2016.03	Suite 4401-02 & 11-12, 44/F, One Island East, 18 Westlands Road, Taikoo Place, Quarry Bay, Hong Kong	해외투자법인	2,957	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음
에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)	2017.05	충청북도 청주시 흥덕구 대신로 215	반도체소재제조	360,254	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당 (자산총액 750억원 이상)
MMT 특정금전신탁	-	-	특정금전신탁	-	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음

* 주요 종속회사 판단기준: 직전 사업연도말 자산총액 750억원 이상 또는 지배회사 자산총액의 10% 이상

[연결대상회사의 변동현황]

사업 연도	연결에 포함된 종속회사	전기대비 연결에 추가된 회사	전기대비 연결에서 제외된 회사	전기대비 연결에서 제외된 사유
제71기 1분기	에스케이하이이앤지(주) 등 23개사	-	(주)실리콘화일	흡수합병
제70기	에스케이하이이앤지(주) 등 24개사	에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)	-	-
제69기	에스케이하이이앤지(주) 등 23개사	SK hynix Ventures Hong Kong Limited (SKH Ventures) 행복모아(주)	Hynix Semiconductor Manufacturing America Inc. (HSMA)	청산
제68기	에스케이하이이앤지(주) 등 22개사	-	-	-

* 연결대상회사의 변동현황은 한국채택국제회계기준임.

* MMT 특정금전신탁은 연결에 포함된 회사수에서 제외하였음.

구분	자회사	사유
신규 연결	-	-
	-	-
연결 제외	(주)실리콘화일	흡수합병
	-	-

나. 회사의 법적·상업적 명칭

당사의 명칭은 에스케이하이닉스 주식회사이며, 영문으로는 SK hynix Inc.라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 SK하이닉스 또는 SK hynix라고 표기합니다.

다. 설립일자

당사는 1949년 10월 국도건설 주식회사로 설립되어 1983년 2월 현대전자산업주식회사로 상호를 변경하였으며, 이후 2001년 3월 주식회사 하이닉스반도체로, 2012년 3월 에스케이하이닉스 주식회사로 상호를 변경하였습니다. 회사가 발행한 주식은 한국거래소에 상장되어 유가증권시장에서 거래되고 있으며, 종목코드는 '000660'입니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

주소: 경기도 이천시 경충대로 2091
전화번호: 031-630-4114
홈페이지: <http://www.skhynix.com>

마. 주요 사업의 내용

현재 당사의 주력 생산제품은 DRAM, NAND Flash 및 MCP(Multi-chip Package)와 같은 메모리 반도체 제품이며, 2007년부터는 시스템 LSI 분야인 CIS(CMOS Image Sensor) 사업에 재진출하여 종합반도체 회사로 그 영역을 넓혀가고 있습니다.

당사 정관에 근거하여 현재 회사가 영위하는 목적사업은 다음과 같습니다.

- 반도체소자 제조 및 판매
- 반도체소자 기타 이와 유사한 부품을 사용하여 전자운동의 특성을 응용하는 기계, 기구 및 이에 사용되는 부품과 재료 등의 제작, 조립 및 판매
- 컴퓨터 활용을 위한 소프트웨어 개발 및 임대업
- 전자 전기, 통신기계, 기구 및 그 부품의 제작, 판매, 임대 및 관련 서비스업
- 기계부분품 제조업 및 금형제조업
- 기술연구 및 용역수탁업
- 전자 전기기계, 기구의 임대업
- 특수통신(위성통신 등) 방송관련 기기 제작, 판매, 임대업 및 서비스업
- 정보서비스업
- 출판업
- 무역업
- 부동산 매매 및 임대업
- 발전업
- 건설업
- 전자관 제조업
- 창고업
- 주차장업
- 위성통신사업
- 전기통신회선설비 임대사업

- 전자상거래 및 인터넷 관련사업
- 전기 각호와 관련되는 사업 및 투자

사업부문별 보다 자세한 사항은 II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

바. 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부

- (1) 기업집단의 명칭 : 에스케이 (독점규제 및 공정거래에 관한 법률)
- (2) 기업집단에 소속된 회사 (2018. 3. 31 기준 계열사 : 100개사)

상장 여부	회사명	법인등록번호
상장사 (18)	SK네트웍스(주)	130111-0005199
	SK디스커버리(주)	130111-0005727
	SKC(주)	130111-0001585
	SK가스(주)	110111-0413247
	SK(주)	110111-0769583
	SK증권(주)	110111-0037112
	SK텔레콤(주)	110111-0371346
	(주)부산도시가스	180111-0039495
	SK디앤디(주)	110111-3001685
	SK이노베이션(주)	110111-3710385
	SKC솔믹스(주)	134711-0014631
	SK하이닉스(주)	134411-0001387
	(주)아이리버	110111-1637383
	SK바이오랜드(주)	110111-1192981
	SK머티리얼즈(주)	190111-0006971
	(주)에스엠코어	110111-0128680
	(주)나노엔텍	110111-0550502
	SK케미칼(주)	131111-0501021
비상장사 (82)	SK건설(주)	110111-0038805
	영남에너지서비스(주)	175311-0001570
	충청에너지서비스(주)	150111-0006200
	엔티스(주)	130111-0021658
	코원에너지서비스(주)	110111-0235617
	SK텔링크(주)	110111-1533599
	SK E&S(주)	110111-1632979
	강원도시가스(주)	140111-0002010
	전남도도시가스(주)	201311-0000503
	전북에너지서비스(주)	214911-0004699
	SK엠앤서비스(주)	110111-1873432

SK와이번스(주)	120111-0217366
SK인포섹(주)	110111-2007858
행복나래(주)	110111-2016940
SK텔레시스(주)	110111-1405897
에프앤유신용정보(주)	135311-0003300
(주)대한송유관공사	110111-0671522
(주)에이앤티에스	110111-3066861
내트릭(주)	110111-3222570
SK유화(주)	135811-0120906
SK모바일에너지(주)	161511-0076070
SK커뮤니케이션즈(주)	110111-1322885
SK에어가스(주)	230111-0134111
SK네트웍스서비스(주)	135811-0141788
SK브로드밴드(주)	110111-1466659
제주유나이티드FC(주)	224111-0015012
비앤엠개발(주)	110111-5848712
피에스앤마케팅(주)	110111-4072338
SK임업(주)	134811-0174045
SK루브리컨츠(주)	110111-4191815
SK신택(주)	131411-0232597
대전맑은물(주)	110111-4273960
SK더블유(주)	154311-0026200
네트웍오앤에스(주)	110111-4370708
서비스에이스(주)	110111-4368688
서비스탑(주)	160111-0281090
SK핀크스(주)	224111-0003760
유베이스매뉴팩처링아시아(주)	230111-0168673
SK에너지(주)	110111-4505967
SK종합화학(주)	110111-4505975
울산아로마틱스(주)	110111-4499954
SK바이오팜(주)	110111-4570720
파주에너지서비스(주)	110111-4629501
SK플래닛(주)	110111-4699794
SK렌터카서비스(주)	160111-0306525
SK하이스택(주)	134411-0037746
SK하이이엔지(주)	134411-0017540
위례에너지서비스(주)	110111-4926006
나래에너지서비스(주)	135711-0092181
SK배터리시스템즈(주)	160111-0337801

지허브(주)	230111-0205996
SK인천석유화학(주)	120111-0666464
SK트레이딩인터내셔널(주)	110111-5171064
보령LNG터미널(주)	164511-0021527
이니츠(주)	230111-0212074
(주)엔에스오케이	110111-3913187
SK어드밴스드(주)	230111-0227982
당진에코파워(주)	165011-0035072
미쓰이케미칼앤에스케이씨폴리우레탄(주)	230111-0233880
SK바이오텍(주)	160111-0395453
SK플라즈마(주)	131111-0401875
한국빅슬렌(유)	230114-0003328
SKC인프라서비스(주)	134111-0414065
SK티엔에스(주)	110111-5833250
금호미쓰이화학(주)	110111-0612980
SK테크엑스(주)	110111-5990547
원스토어(주)	131111-0439131
SK트리켄(주)	164711-0060753
에프에스케이엘앤에스(주)	131111-0462520
행복모아(주)	150111-0226204
SK매직(주)	110111-5125962
SK매직서비스(주)	134811-0039752
(주)헬로네이처	110111-4867898
목감휴게소서비스(주)	110111-6257954
(주)포인트코드	110111-1888548
SK쇼와덴코(주)	175611-0018553
SK하이닉스시스템IC(주)	150111-0235586
SK해운(주)	110111-6364212
홈앤서비스(주)	110111-6420460
SKC하이테크앤마케팅(주)	161511-0225312
SK스토아(주)	110111-6585884
SK실트론(주)	175311-0001348

(*) 사명 변경 : SK(주) (舊 SK C&C(주)), 엔티스(주) (舊 SK사이텍(주)), SK인포섹(주) (舊 인포섹(주)), SK배터리시스템 (주) (舊 SK컨티넨탈이모션코리아(주)), 나래에너지서비스(주) (舊 하남에너지서비스(주)), 비엔엠개발(주) (舊 엠 케이에스개런티(유)), 미쓰이케미칼앤에스케이씨폴리우레탄(주) (舊 에스엠피씨(주)), SK에어가스(주) (舊 SK C에어가스(주)), SK바이오랜드(주) (舊 (주)바이오랜드), 파주에너지서비스(주) (舊 피엠피(주)), SK엠앤서비스(주) (舊 엠앤서비스(주)), SK매직서비스(주) (舊 매직서비스(주)), (주)엔에스오케이 (舊 (주)노에스네트웍스), SK디스 커버리(주) (舊 SK케미칼(주)), SKC하이테크앤마케팅(주) (舊 SKC하이테크앤마케팅(유)), SK렌터카서비스(주) (舊 카라이프서비스(주))

※ 해외계열사 현황

(2018년 3월 31일 기준)

No.	해외계열사명
1	SK Gas America Ltd.
2	SK Gas International Pte. Ltd.
3	SK Gas USA Inc.
4	SK Gas Trading LLC
5	Avrasya Tuneli Isletme Insaat Ve Yatirim A.S.
6	SK Holdco PTE. LTD.
7	BT RE Investments, LLC
8	Hi Vico Construction Company Limited
9	Irunex Construction and Management Co., Ltd.
10	Jurong Aromatics Corporation Pte. Ltd.
11	Mesa Verde RE Ventures, LLC
12	SBC General Trading & Contracting Co. W.L.L.
13	SK E&C BETEK Corp.
14	SK E&C Consultores Ecuador S.A.
15	SK E&C India Private Ltd.
16	SK E&C Jurong Investment Pte. Ltd.
17	SK E&C Saudi Company Limited
18	SK Engineering&Construction(Nanjing)Co.,Ltd.
19	SK International Investment Singapore Pte. Ltd.
20	SKEC Anadolu LLC
21	SKEC(Thai) Limited
22	Sunlake Co., Ltd.
23	Thai Woo Ree Engineering Co., Ltd
24	SK Networks (Liaoning) Logistics Co., Ltd
25	Daiyang-SK Networks Metal SAN. VE TIC. Ltd. STI.
26	Dandong Lijiang Estate Management co.,LTD
27	SK Networks(Dandong) Energy Co.,Ltd.
28	Liaoning SK Industrial Real Estate Development Co., Ltd.
29	Novoko B.V.
30	P.T. SK Networks Indonesia
31	POSK(Pinghu) Steel Processing Center Co.,Ltd.
32	Shenyang SK Bus Terminal Co., Ltd.
33	Shenyang SK Networks Energy Co., Ltd.
34	SK (Guangzhou) Metal Co., Ltd.

35	SK (GZ Freezone) Co.,Ltd.
36	SK BRASIL LTDA
37	SK Networks (Xiamen) Steel Processing Center Co., Ltd.
38	SK Networks Deutschland GmbH
39	SK Networks HongKong Ltd.
40	SK Networks Japan Co., Ltd.
41	SK Networks Middle East FZE
42	SK Networks Resources Australia (Wyong) Pty Ltd.
43	SK Networks Resources Australia Pty Ltd.
44	SK Networks Resources Pty Ltd.
45	SK Networks Trading Malaysia Sdn Bhd
46	SK Networks(Shanghai) Co.,Ltd.
47	SK Networks(China) Holdings Co.,Ltd.
48	Springvale SK Kores Pty Ltd.
49	IBERIAN LUBE BASE OILS COMPANY, S.A.
50	PT. Patra SK
51	SK Energy Lubricants (Tianjin) Co., Ltd.
52	SK Lubricants & Oils India Pvt. Ltd.
53	SK Lubricants Americas, Inc.
54	SK Lubricants Europe B.V.
55	SK Lubricants Japan Co., Ltd.
56	SK Lubricants Rus Limited Liability Company
57	SK Life Science, Inc.
58	SK Bio-pharm Tech(Shanghai) Co., Ltd
59	Solmics Shanghai International Trading Co., Ltd.
60	Solmics Taiwan Co., Ltd.
61	SKC (Jiangsu) High Tech Plastics
62	SKC Europe GmbH
63	SKC International Shanghai Trading Co., Ltd.
64	SKC, Inc.
65	SKC PU Specialty Co., Ltd.
66	SKC (Nantong) PU Specialty Co., Ltd.
67	SKC-ENF Electronic Materials Ltd.
68	SKC (Nantong) Semiconductor Materials Technology Co., Ltd.
69	SKC Hi-Tech&Marketing(Suzhou) Co., Ltd.
70	SKC Hi-Tech&Marketing Taiwan Co., Ltd.
71	SKC Hi-Tech&Marketing Japan Co., Ltd.
72	SKC Hi-Tech&Marketing Polska SP.Z O.O.
73	SKC Hi-Tech&Marketing USA LLC

74	Asia Bitumen Trading Pte., Ltd.
75	Chongqing SK Asphalt Co., Ltd.
76	Hefei SK Baoying Asphalt Co., Ltd.
77	Netruck Franz Co., Ltd.
78	Ningbo SK Baoying Asphalt Storage Co., Ltd.
79	Shandong SK Hightech Oil Co., Ltd.
80	SK Shanghai Asphalt Co., Ltd.
81	SK Energy Hong Kong Co., Ltd.
82	SK Energy Road Investment Co., Ltd.
83	SK Energy Road Investment(HK) Co., Ltd.
84	SK E&P America, Inc.
85	SK E&P Company
86	SK Innovation Insurance (Bermuda), Ltd.
87	SK Permian, LLC
88	SK Plymouth, LLC
89	SK USA, Inc.
90	SK Battery Hungary Kft.
91	SK Battery China Holdings Co.,Ltd
92	CAILIP Gas Marketing, LLC
93	China Gas-SK E&S LNG Trading Ltd.
94	DewBlaine Energy, LLC
95	PT SK E&S Nusantara
96	SK E&S Americas, Inc.
97	SK E&S Australia Pty Ltd.
98	SK E&S Hong Kong Co., Ltd
99	SK E&S LNG, LLC
100	Fajar Energy International Pte., Ltd
101	Prism Energy International Pte., Ltd.
102	Prism Energy International Hong Kong Limited
103	SK E&S Dominicana S.R.L.
104	Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.
105	SABIC SK Nexlene Company Pte.Ltd.
106	Shanghai-GaoQiao SK Solvent Co., Ltd.
107	SK GC Americas, Inc.
108	SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd.
109	SK Global Chemical International Trading (Shanghai) Co., Ltd.
110	SK Global Chemical International Trading (Guangzhou) Co., Ltd.
111	SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd.
112	SK Global Chemical Japan Co., Ltd.

113	SK Global Chemical Singapore Pte.Ltd.
114	SK Golden Tide Plastics (Yantai) Co., Ltd.
115	SK Hualun Specialty Chemical Co., Ltd.
116	SK-SVW (Chongqing) Chemical Co., Ltd.
117	Zhejiang Shenxin SK Packaging Co., Ltd.
118	Huizhou SK TCL Taidong Chemical Co.,Ltd.
119	SK Primacor Americas LLC
120	SK Primacor Europe, S.L.U.
121	SK Saran Americas LLC
122	SK S.E. Asia Pte. Ltd.
123	ESSENCORE Limited
124	Essencore Microelectronics (ShenZhen) Limited
125	SK C&C India Pvt., Ltd.
126	SK C&C Beijing Co., Ltd.
127	SK C&C Chengdu Co., Ltd
128	ShangHai YunFeng Encar Used Car Sales Service Ltd.
129	S&G Technology
130	SK computer and communication L.L.C.
131	SK GI Management
132	Saturn Agriculture Investment Co., Limited
133	SOCAR MOBILITY MALAYSIA SDN. BHD.
134	Plutus Capital NY, Inc.
135	Hudson Energy NY, LLC
136	Gemini Partners Pte. Ltd
137	Solaris Partners Pte. Ltd
138	Beijing SK Magellan Capital Advisors Co., Ltd.
139	CFC-SK El Dorado Capital Partners, Ltd.
140	CFC-SK El Dorado Management Company, Ltd.
141	CFC-SK El Dorado Latam Fund, L.P.
142	Dogus SK Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi A.S.
143	Prostar Capital Ltd.
144	Prostar Capital Management Ltd.
145	Solaris GEIF Investment
146	Prostar Asia Pacific Energy Infrastructure SK Fund L.P.
147	Hermed Capital
148	Hermed Capital Health Care GP Ltd
149	Hermed Capital Health Care (RMB) GP Limited
150	Hermed Equity Investment Management (Shanghai) Co., Ltd.
151	Hermed Capital Health Care Fund L.P.

152	Shanghai Hermed Equity Investment Fund Enterprise
153	Hermeda Industrial Co.
154	Plutus Fashion NY, Inc
155	Wonderland NY, LLC
156	SK Investment Management Co., Limited.
157	SK China Company, Ltd.
158	SK China(Beijing) Co.,Ltd.
159	SK BeiJing Investment Management Limited
160	Sky Yunjian Investment Management Limited
161	SKY Property Mgmt(Beijing) Co.Ltd.
162	SK Auto Service Hong Kong Ltd.
163	SK (Beijing) Auto Rental Co.,Ltd
164	SK (Shenyang) Auto Rental Co.,Ltd
165	SK (Qingdao) Auto Rental Co.,Ltd
166	SK (Suzhou) Auto Rental Co.,Ltd
167	SK (Guangzhou) Auto Rental Co.,Ltd
168	SK (Shenzhen) Auto Rental Co.,Ltd
169	Skyline Auto Financial Leasing Co, Ltd.
170	SK Financial Leasing Co, Ltd.
171	SK Bio Energy HongKong Co.,Limited
172	SK China Investment Management Company Limited
173	SK International Agro-Products Logistics Development Co., Ltd.
174	SK International Agro-Sideline Products Park Co.,Ltd.
175	SK Property Investment Management Company Limited
176	SK Industrial Development China Co., Ltd.
177	Shanghai SKY Real Estate Development Co.,Ltd.
178	SKY Property Mgmt. Ltd.
179	SK China Real Estate Co., Limited
180	SK China Creative Industry Development Co., Ltd
181	SKY Investment Co., Ltd
182	FSK L&S (Shanghai) Co., Ltd.
183	PT Sinar Timuran Green Energi
184	SK Chemicals America, Inc.
185	SK Chemicals GmbH
186	SK Chemicals (Suzhou) Co., Ltd
187	SK Chemicals (Qingdao) Co., Ltd.
188	ST Green Energy Pte, Ltd
189	SE(Jiangsu) Electronic Materials Co., LTD
190	SK Telesys Corp.

191	TechDream Co. Limited
192	Atlas Investment Ltd.
193	Axess II Holdings
194	CYWORLD China Holdings
195	Global Opportunities Breakaway Fund
196	Global opportunities Fund
197	Harbinger China Dragon Fund
198	SK Global Healthcare Business Group Ltd.
199	SK Healthcare China Holding Co.
200	SK Healthcare Co.,Ltd.
201	SK Latin America Investment S.A.
202	SK MENA Investment B.V.
203	SK Technology Innovation Company
204	SK Telecom (China) Holding Co.,Ltd.
205	SK Telecom Americas, Inc.
206	SK Telecom China Fund 1 L.P.
207	SK Telecom Smart City Management Co., Ltd
208	SK Telecom Venture Capital, LLC
209	SK Telecom Vietnam PTE.,Ltd.
210	SKCREGC(Sichuan)Smart City Management Co.
211	SKTA Innopartners, LLC
212	Tianlong-Suzhou
213	Tianlong-Xian
214	ULand Company Limited
215	Westly Capital Partners Fund II
216	YTK Investment Ltd.
217	SK Healthcare(Wuxi) Co., Limited
218	SK Telecom Innovation Fund, L.P.
219	Fitech Global Opportunities Limited
220	Immersive Capital, L.P.
221	Magic Tech Network Co., Ltd.
222	12CM Global PTE. LTD.
223	SK telecom Japan Inc.
224	AI ALLIANCE, LLC
225	Celcom Planet Sdn Bhd
226	Dogus Planet Inc.
227	11street (Thailand) Co., Ltd.
228	Shopkick GmbH
229	Shopkick, Inc.

230	Shopkick Management Company, Inc.
231	SK Planet Global Holdings Pte. Ltd.
232	SK Planet Global Pte. Ltd.
233	SK Planet, Inc.
234	SK Planet Japan K.K.
235	SKP America, LLC
236	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
237	SK APTECH Ltd.
238	SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.
239	SK hynix America Inc.
240	SK hynix Asia Pte. Ltd.
241	SK hynix Deutschland GmbH
242	SK hynix Flash Solution Taiwan Ltd.
243	SK hynix Italy S.r.l
244	SK hynix Japan Inc.
245	SK hynix memory solutions Inc.
246	SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.
247	SK hynix Semiconductor (Wuxi) Ltd.
248	SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd.
249	SK hynix Semiconductor India Private Ltd.
250	SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.
251	SK hynix Semiconductor(China) Ltd.
252	SK hynix Semiconductor(Shanghai) Co., Ltd.
253	SK hynix U.K Ltd.
254	SK hynix Ventures Hong Kong Limited
255	Softeq Flash Solutions LLC.
256	Great Shale LNG Transport S.A.
257	MILESTONE LNG TRANSPORT S.A.
258	OCEAN MARITIME HONGKONG LIMITED
259	S&Y Shipping S.A.
260	SK B&T PTE. LTD.
261	SK shipping Europe Plc.
262	SK shipping Hongkong Ltd.
263	SK shipping Japan Co., Ltd.
264	SK shipping Singapore Pte. Ltd.
265	Dalian Sea Oil Petroleum Chemicals Co.,Ltd
266	HBNG Logitics Co., Ltd.
267	SUZHOU HAPPYNARAE Co., Ltd.
268	Chongqing Happynarae Co., Ltd.

269	SK Energy International Pte, Ltd.
270	SK Energy Americas Inc.
271	SK Energy Europe, Ltd.
272	SK Terminal B.V.
273	Iriver Enterprise Ltd.
274	Iriver China Co., Ltd.
275	Dongguan Iriver Electronics Co., Ltd.
276	Iriver Inc.
277	groovers Japan Co., Ltd.
278	S.M. LIFE DESIGN COMPANY JAPAN INC.
279	SM Mobile Communications Japan Inc.
280	Bioland Biotec Co.,Ltd
281	Bioland Haimen Co.,Ltd
282	Beijing Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Co., Ltd.
283	Foshan Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Co., Ltd.
284	MCNS Polyurethanes Europe Sp. zo.o.
285	MCNS Polyurethanes India Pvt. Ltd.
286	MCNS Polyurethanes Malaysia Sdn Bhd
287	MCNS Polyurethanes Mexico, S. de R.L. de C.V
288	MCNS Polyurethanes USA Inc.
289	Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Inc.
290	PT. MCNS Polyurethanes Indonesia
291	SMART Technology Polyurethanes P.J.S. Co.
292	Thai Mitsui Specialty Chemicals Co., Ltd.
293	Tianjin Cosmo Polyurethanes Co., Ltd.
294	SK Materials (Jiangsu) Co., Ltd.
295	SK Materials (Xian) Co., Ltd.
296	SK Materials Japan Co., Ltd.
297	SK Materials Taiwan Co., Ltd.
298	SK Securities Investment Asia Limited
299	SMC US, INC
300	SK TNS Myanmar Co.,Ltd
301	SK BIOTEK IRELAND LIMITED
302	SK Biotek USA, Inc.
303	Nanoentek USA Inc.
304	SK Siltron America, Inc.
305	SK Siltron Japan, Inc.

사. 신용평가에 관한 사항

본 보고서 제출일 현재 당사의 신용등급은 아래와 같습니다.

구분	평가기관	현등급	최종평가일
국내	NICE신용평가	AA	2018.04.26
	한국기업평가	AA-	2017.11.09
	한국신용평가	AA-	2017.11.07
해 외	Moody's	Baa3	2017.11.06
	S&P	BBB-	2017.11.23

2. 회사의 연혁

가. 설립 이후의 중요한 변동사항

(1) 회사의 주된 변동내용

- 1949. 10 국도건설 주식회사 설립
- 1983. 02 현대전자산업주식회사로 상호 변경
- 1996. 12 기업공개 및 상장
- 1997. 03 대표이사 김영환 외 이사 5인 변경 선임
 이사 5인, 감사 1인 변경 선임
- 1999. 05 LG그룹과 LG반도체 주식 양수도 계약 체결
- 1999. 07 LG반도체 대주주 지분 인수
- 1999. 10 현대반도체(주)(구, (주)LG반도체) 흡수합병
- 2000. 03 박종섭 대표이사 외 이사 1인, 감사위원 2인 변경 선임
- 2000. 05 전장사업부문 (주)현대오토넷으로 분사
- 2000. 08 모니터사업부문 "현대이미지퀘스트(주)"로 분사
- 2001. 03 주식회사 하이닉스반도체로 상호 변경
 박상호 대표이사 선임 외 이사 2인, 감사위원 2인 변경 선임
- 2001. 05 통신단말기 사업부문 "현대큐리텔"로 분사
 통신 ADSL 사업부문 "현대네트웍스"로 분사
- 2001. 07 통신 네트워크 사업부문 "현대시스콤"으로 분사
- 2001. 08 현대그룹으로부터 계열분리
- 2001. 10 채권금융기관 공동관리 시작
- 2001. 12 현대큐리텔, '팬텍 컨소시엄'에 지분 매각
- 2002. 01 현대시스콤, '쓰리알'에 지분 매각
- 2002. 05 시러스 로직社와 파운드리 전략적 장기공급 계약체결
 박종섭 대표이사 사임
- 2002. 06 최대주주 변경(현대상선(주) → (주)한국외환은행)

- 2002. 07 우의제 대표이사 선임 외 이사 2인, 감사위원 2인 변경 선임
- 2002. 12 현대네트웍스, '엠비엔'에 지분 매각
- 2003. 02 박상호 대표이사 사임
- 2003. 04 STMicro社와 낸드플래시 메모리 공동 개발 및 파운드리 공급 계약 체결
- 2003. 06 환경/안전/보건 기술연구소 설립
- 2004. 06 매그나칩반도체 유한회사와 비메모리 사업부문 영업양도계약 체결
- 2004. 08 중국 장쑤(江蘇)성 우시(無錫)시와 중국 현지공장설립 협력계약 체결
- 2004. 10 비메모리 사업부문 영업양도
- 2004. 11 STMicro社와 중국 현지 합작공장설립을 위한 협력계약 체결
- 2005. 03 황학중, 김덕수, 민형욱, 이준호 사외이사 선임
박시룡, 장윤중 사외이사 임기만료 퇴임
- 2005. 07 채권금융기관 공동관리 조기종료
현대이미지퀘스트(주), (주)빅터스캐피탈코리아에 지분 매각
- 2005. 10 (주)현대오토넷 지분매각 완료
출자전환주식 공동관리협의회 1차 공동 지분매각(해외유통GDR발행 및 국내 블록세일)
- 2006. 03 권오철 이사, 손방길 사외이사 선임, 정형량 이사 임기만료 퇴임
- 2006. 04 중국 현지생산법인(HSMC) 설립
- 2006. 06 출자전환주식 공동관리협의회 2차 공동 지분매각(해외유통GDR발행 및 국내 블록세일)
- 2006. 09 300mm 연구소(R3 R&D Fab) 개소
- 2007. 03 김종갑 대표이사 외 이사 1인 신규 선임, 사외이사 8인(감사위원회 위원 4인 포함) 선임
- 이사 선임: 김종갑, 최진석
- 사외이사 선임: 박종선, 김경한, 조동성, 김형준
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 황학중, 민형욱, 손방길, 손성호
우의제 대표이사 임기만료 퇴임
이사 1인(오춘식), 사외이사 4인(김범만, 김수창, 이선, 이준호) 임기만료 퇴임
- 2007. 04 청주 신규 M11(300mm) 공장 착공
- 2007. 07 공정거래 자율준수프로그램 도입
- 2007. 10 환경운동연합과 '환경경영검증위원회' 협약 체결
- 2007. 11 '일하는 이사회'를 위한 신(新)이사회 제도 도입
- 2008. 02 김경한 사외이사 중도 퇴임
- 2008. 03 사외이사 8인(감사위원회 위원 3인 포함) 선임
- 사외이사 선임: 박종선, 조동성, 김형준, 정홍원, 최장봉
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 손성호, 홍형표, 백경훈
사외이사 3인(황학중, 민형욱, 손방길) 임기만료 퇴임
- 2008. 06 정홍원 사외이사 중도 퇴임
- 2009. 03 권오철 이사 재선임 외 이사 1인 신규 선임, 사외이사 8인(감사위원회 위원 3인 포함) 선임

- 이사 선임: 권오철, 박성욱
- 사외이사 선임: 박종선, 조동성, 김형준, 최장봉, 한부환
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 손성호, 홍형표, 백경훈
- 2009. 11 중국 후공정 합작사 HITECH 설립
- 2010. 03 최대주주 변경((주)한국외환은행 → 한국정책금융공사)
- 최대주주 변경(한국정책금융공사 → 미래에셋자산운용투자자문(주))
- 권오철 대표이사외 이사 1인 신규 선임, 김종갑 이사 재선임
- 사외이사 9인(감사위원회 위원 3인 포함) 선임
- 이사 선임: 김종갑, 권오철, 김민철
- 사외이사 선임: 박종선, 전인백, 한부환, 최장봉, 정병태, 김형준
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 백갑중, 송재용, 김창호
- 2010. 06 중국 후공정 합작공장 HITECH 준공
- 2010. 08 최대주주 변경(미래에셋자산운용투자자문(주) → 한국정책금융공사)
- 2010. 10 최대주주 변경(한국정책금융공사 → 국민연금공단)
- 2011. 03 사외이사 9인(감사위원회 위원 3인 포함) 선임
- 사외이사 선임: 한부환, 전인백, 정병태, 이달곤, 김갑희, 정상환
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 백갑중, 송재용, 조현명
- 2011. 09 정상환 사외이사 중도 퇴임
- 2012. 02 최대주주 변경(국민연금공단 → 에스케이텔레콤(주))
- 사외이사 5인(감사위원회 위원 3인 포함) 선임
- 이사 선임: 최태원, 하성민, 박성욱
- 사외이사 선임: 김두경, 박영준, 윤세리, 김대일, 이창양
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 김두경, 김대일, 이창양
- 2012. 06 미 컨트롤러 업체 LAMD(Link_A_Media Devices) 인수 본계약 체결
- 2012. 09 플래시 솔루션 디자인 센터 설립
- 2013. 03 김준호 사내이사 1인 신규 선임
- 2014. 03 이사 2인(감사위원회 위원 1인 포함) 선임
- 이사 선임: 임형규
- 사외이사 선임: 최종원
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 최종원
- 2014. 09 중국 총칭 후공정 생산법인 (SKHYCQL) 준공
- 이사 5인(감사위원회 위원 3인 포함) 선임
- 이사 선임: 박성욱
- 2015. 03 - 사외이사 선임: 김두경, 박영준, 김대일, 이창양
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 김두경, 김대일, 이창양
- 2016.03 이사 2인(사내이사) 선임
- 이사 선임: 김준호, 박정호
- 이사 4인(감사위원회 위원 2인 포함) 선임
- 이사 선임: 이석희
- 2017.03 - 기타비상무이사 선임: 박정호
- 사외이사 선임 : 최종원, 신창환
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 최종원, 신창환

- 2017.07 에스케이하이닉스 시스템아이씨(주) 공식 출범
이사 4인(감사위원회 위원 1인 포함) 선임
- 2018.03 -. 이사 선임: 박성욱
-. 사외이사 선임 : 송호근, 조현재, 윤태화
-. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 윤태화
- 2018.03 선임사외이사 제도 도입

(2) 종속회사의 주된 변동내용

- 1983. 03 미국 현지법인(HSA) 설립
- 1989. 03 독일 현지법인(HSD) 설립
- 1991. 08 싱가포르 현지법인(HSS) 설립
- 1995. 04 홍콩 현지법인(HSH) 설립
- 1995. 07 영국 현지법인(HSE) 설립
영국 현지판매법인(HSU) 설립
- 1995. 08 미국 생산법인(HSMA) 설립
- 1996. 07 대만 현지법인(HST) 설립
- 1996. 09 일본 현지법인(HSJ) 설립
- 2001. 05 사업지원 서비스부문 "(주)현대아스텍" 분사
- 2001. 07 LCD 사업부문 "(주)현대디스플레이테크놀로지"로 분사
- 2001. 08 중국 현지판매법인(HSCS) 설립
- 2001. 12 "에스알씨(주)" 분사
- 2002. 11 "(주)현대디스플레이테크놀로지" TFT-LCD 사업부문 매각
- 2005. 04 중국 합작법인(HSSL) 설립
에스알씨(주)→(주)큐알티반도체 사명 변경
(주)현대아스텍→(주)아스텍 사명 변경
- 2006. 04 중국 현지생산법인(HSMC) 설립
- 2006. 10 중국 현지생산법인(HSMC) 준공
- 2007. 01 인도 현지법인(HSIS) 설립
- 2008. 03 (주)아스텍에서 (주)하이닉스인재개발원 분할
(주)아스텍에서 (주)하이텍으로 분할
(주)아스텍에서 (주)하이로지텍으로 분할
(주)아스텍에서 (주)하이닉스엔지니어링으로 분할
- 2010. 01 (주)하이닉스엔지니어링에서 (주)아미파워로 분할
- 2010. 08 중국 현지판매법인(HSCW) 설립
- 2011. 09 "(주)현대디스플레이테크놀로지" 청산, 주요종속회사 제외
"프로모스엔에이치유한회사, 티와이프로주식회사, 외환은행특정금전신탁" 청산, 주요종속회사 제외
- 2012. 06 낸드플래시 개발업체 아이디어플래시(Ideaflash S.r.l.) 인수,
이탈리아 기술센터(SK Hynix Italy S.r.l.) 전환 설립

- 2012. 10 (주)하이닉스엔지니어링, (주)큐알티반도체 흡수합병
(주)하이스텍, (주)하이로지텍/(주)하이닉스인재개발원 흡수합병
- 2012. 10 (주)하이닉스엔지니어링→에스케이하이이엔지(주) 사명 변경
(주)하이스텍→에스케이하이스텍(주) 사명 변경
- 2013. 09 아미파워(주) 청산, 주요종속회사 제외
중국 총칭 후공정 생산법인 (SKHYCQL) 설립
- 2014. 04 에스케이하이이엔지(주) 에서 큐알티(주) 분할 설립
주식교환으로 실리콘화일(주) 인수
- 2014. 06 벨라루스 소재 연구개발법인 Softeq Flash Solutions LLC. 인수
- 2014. 07 SK hynix Europe Holding Ltd.(SKHYE) 청산, 종속기업 제외
- 2014. 09 큐알티(주) 지분 전량 매각
- 2016. 03 SK hynix Ventures Hong Kong Ltd. 설립
Hynix Semiconductor Manufacturing America Inc. (HSMA) 청산, 종속기업 제외
- 2016. 10 행복모아(주) 설립
- 2017. 05 에스케이하이닉스 시스템아이씨(주) 설립
- 2018. 03 에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)가 (주)실리콘화일을 흡수합병

나. 상호의 변경

- 1983. 02 현대전자산업주식회사로 상호 변경
- 2001. 03 주식회사 하이닉스반도체로 상호 변경
- 2012. 03 에스케이하이닉스 주식회사로 상호 변경

다. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환·이전, 중요한 영업의 양수·양도 등

- 1999. 10 현대반도체(주)(구, ㈜LG반도체) 흡수합병
- 2004. 10 비메모리 사업부문 영업양도
- 2011. 11 에스케이텔레콤, 하이닉스반도체 지분인수계약
- 2014. 01 ㈜실리콘화일과 포괄적 주식교환계약
- 2016. 10 ㈜실리콘화일과 CIS영업부문에 대한 영업양수
- 2017. 07 에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)에 Foundry사업과 관련된 자산 등 포괄적 양도

라. 생산설비의 변동

- 2006. 10 중국 장쑤(江蘇)성 우시(無錫)시에 C2(300mm), C1(200mm)공장 준공
- 2008. 07 미국 유진 공장 E1(200mm) 가동 중단
- 2008. 08 청주 신규 NAND Flash 전용 M11공장(300mm) 준공
- 2008. 09 이천 M7(200mm) 및 청주 M9(200mm) 공장 가동 중단
- 2008. 12 중국 C1(200mm) 공장 가동 중단
- 2010. 06 중국 후공정 합작공장 HITECH 준공

2012. 06 청주 신규 NAND Flash 전용 M12공장(300mm) 준공
 2014. 09 중국 후공정 생산법인 (SKHYCQL) 준공
 2015. 08 이천 M14(300mm) 준공

마. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

2005. 01 전력 소모 30% 줄인 서버용 메모리 모듈 개발
 2005. 01 대만 프로모스사와 전략적 제휴를 위한 본계약 체결
 2005. 07 2GB DDR2-667 노트북용 모듈 업계 최초 인텔사 인증 획득
 2005. 07 당사 출자전환 주식 공동관리 협의회와 '특별 약정' 체결
 2005. 11 JEDEC 표준형 8GB DDR2 R-DIMM과 2GB DDR VLP R-DIMM 개발
 2005. 12 512Mb GDDR4 DRAM 개발
 2006. 03 80나노 512Mb DDR2 DRAM 인텔사 인증 획득
 2006. 12 200Mbps 512Mb 모바일 DRAM 개발
 60나노급 1Gb DDR2 기반 1GB DDR2 800Mbps 모듈 개발
 2007. 03 ECC회로 적용한 185Mbps 512Mb 모바일 DRAM 개발
 2007. 04 퓨전메모리 제품 DOC(Disk On Chip) H3 양산
 2007. 05 80나노 DDR3 1Gb DRAM 단품 및 모듈 인텔사 인증 획득
 초박형(25 μ m) 20단 낸드플래시 MCP(Multi-chip Package) 개발
 2007. 08 200Mbps 1Gb 모바일 DRAM 개발
 이노베이티브 실리콘사와 신개념 메모리 'ZRAM' 라이선스계약 체결
 2007. 09 초박형(25 μ m) 24단 낸드플래시 MCP(Multi-chip Package)개발
 2007. 10 오보닉스사와 차세대 메모리 'PRAM' 기술 라이선스 계약 체결
 2007. 11 1Gb GDDR5 개발
 50나노급 1Gb DDR2 DRAM 인텔사 인증 획득
 실리콘화일사와 CMOS 이미지 센서(CIS) 사업 추진을 위한 협력 계약 체결
 2008. 01 50나노급 1GB/2GB DDR2 모듈 인텔사 인증 획득
 2008. 03 피델릭스사와 전략적 제휴를 위한 협력계약 체결
 2008. 04 그란디스사와 'STT-RAM' 라이선스 및 공동개발계약 체결
 2008. 05 프로모스사와 포괄적 제휴 협력 계약 체결
 2008. 06 파이슨사와 낸드플래시 응용제품 기술에 대한 사업협력계약 체결
 실리콘화일사 지분취득 결정 및 기존 파운드리 계약범위 확대
 3중셀(X3) 기술 기반 32Gb 낸드플래시 개발
 2008. 07 씨엔에스테크놀로지사와 시스템반도체 공동개발 및 파운드리 협력계약 체결
 2008. 08 뉴모닉스사와 낸드플래시 기술 및 제품 공동 개발 협력계약 체결
 16GB 서버용 모듈 개발
 2008. 12 8단 적층 낸드플래시 개발
 50나노급 2Gb 고용량 모바일 DRAM 개발
 2009. 01 DDR3 서버용 모듈 4GB ECC UDIMM 인텔사 인증 획득

- 2009. 02 40나노급 DDR3 DRAM 개발
- 2009. 05 뉴모닉스社 및 파이슨社와 낸드플래시 응용제품용 컨트롤러 3자 공동개발 계약 체결
중국 장쑤(江蘇)성 우시(無錫)시에 무석산업발전집단유한공사와 합작 반도체 후공정 전문회사 설립을 위한 본계약 체결
- 2009. 06 4GB 1333Mbps 노트북용 모듈 외 10건 인텔社 DDR3 전용 플랫폼 인증 획득
- 2009. 07 대만 프로모스社와 전략적 제휴 협력계약 종결
- 2009. 08 50나노급 4Gb 모바일 DRAM 인텔社 인증 획득
- 2009. 10 2세대 1Gb DDR3 개발
- 2009. 12 40나노급 2Gb GDDR5 개발
- 2010. 01 40나노급 2Gb 모바일 DRAM 개발
- 2010. 02 20나노급 64Gb 낸드플래시 개발
- 2010. 09 휴렛팩커드(HP)社와 Re램 공동개발 계약 체결
- 2010. 12 30나노급 4Gb DDR3 개발
- 2011. 03 30나노급 2Gb DDR4 개발
- 2011. 07 도시바社와 STT-MRAM 공동개발 및 합작사 설립을 위한 공동생산 계약 체결
- 2012. 03 30나노급 2Gb DDR3 저탄소제품 인증 획득
- 2012. 04 스펀션社와 특허사용 크로스라이선스 및 SLC낸드플래시 공급계약 체결
- 2012. 06 IBM社와 PC램 공동개발 및 기술 라이선스 계약 체결
- 2012. 08 20나노급 64Gb 낸드플래시 저탄소제품 인증 획득
- 2012. 09 20나노급 4Gb 그래픽 DDR3 개발
- 2013. 06 20나노급 8Gb LPDDR3 개발
램버스社와 포괄적 특허 라이선스 계약 체결
- 2013.07 삼성전자와 반도체 특허 크로스라이선스 계약 체결
- 2013.10 20나노급 6Gb LPDDR3 개발
- 2013.12 20나노급 8Gb LPDDR4 개발
- 2014.04 20나노급 8Gb DDR4기반 128GB 모듈 개발
- 2014.05 20나노급 모바일 DRAM 저탄소 제품 인증 획득
- 2014.09 차세대 와이드 IO2 모바일 DRAM 개발
- 2014.10 최대용량 비휘발성 하이브리드 DRAM 모듈 개발
- 2015. 02 도시바와 NIL 기술 공동 개발 계약 체결
- 2015. 02 사업연속성경영시스템(ISO22301) 인증 획득
- 2015. 08 샌디스크와 특허 라이선스 연장 및 공급 계약 체결
- 2017. 01 16Gb 기반 8GB LPDDR4X 출시
- 2017. 04 72단 256Gb TLC 3D 낸드플래시 개발
- 2017. 04 20나노급 8Gb 기반 GDDR6 DRAM 개발
- 2017. 07 20나노급 8Gb HBM2 Gen 1 개발
- 2017. 09 도시바 반도체 사업 지분 인수를 위한 타법인 지분 출자 결의
- 2018. 02 72단 3D 낸드 기반 4TB Enterprise SATA SSD 및 1TB Enterprise PCIe SSD 개발

3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 03월 31일)

(단위 : 원, 주)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				비고
		주식의 종류	수량	주당 액면가액	주당발행 (감소)가액	
2012년 01월 27일	전환권행사	보통주	855	5,000	23,328	2012.01.27~2012.02.13
2012년 02월 14일	유상증자(제3자배정)	보통주	101,850,000	5,000	23,000	
2012년 02월 15일	전환권행사	보통주	4,159	5,000	23,328	2012.02.15~2012.02.23
2012년 04월 06일	전환권행사	보통주	3,000	5,000	23,328	
2012년 05월 02일	주식매수선택권행사	보통주	93,500	5,000	22,800	우리사주매수선택권행사
2012년 05월 04일	전환권행사	보통주	428	5,000	23,328	
2012년 08월 20일	전환권행사	보통주	21	5,000	23,328	
2012년 10월 30일	주식매수선택권행사	보통주	30,300	5,000	22,800	우리사주매수선택권행사
2012년 12월 07일	전환권행사	보통주	3,016	5,000	23,328	2012.12.07~2012.12.18
2013년 02월 13일	전환권행사	보통주	9,527	5,000	23,328	2013.02.13~2013.03.28
2013년 04월 01일	전환권행사	보통주	551,689	5,000	23,328	2013.04.01~2013.06.27
2013년 07월 02일	전환권행사	보통주	15,483,908	5,000	23,328	2013.07.02~2013.08.05
2014년 04월 22일	-	보통주	1,358,537	5,000	-	주식교환
2014년 05월 27일	전환권행사	보통주	4,562,354	5,000	34,394	2014.05.27~2014.06.26
2014년 07월 01일	전환권행사	보통주	10,285,078	5,000	34,394	2014.07.01~2014.09.29
2014년 10월 01일	전환권행사	보통주	1,595,505	5,000	34,394	2014.10.01~2014.10.06

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

2018년 3월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 발행할 주식의 총수는 9,000,000,000주이며, 발행한 주식의 총수는 보통주 5,721,980,209주입니다. 보통주 이외에 발행한 다른 종류의 주식은 없습니다. 당기말 현재의 유통주식수는 보통주 706,001,795주 입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일)

(단위 : 주)

구 분	주식의 종류			비고	
	보통주	우선주	합계		
I. 발행할 주식의 총수	9,000,000,000	-	9,000,000,000	-	
II. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,721,980,209	-	5,721,980,209	-	
III. 현재까지 감소한 주식의 총수	4,993,977,844	-	4,993,977,844	-	
	1. 감자	4,990,449,799	-	4,990,449,799	2003.03.31, 주식병합(21:1)
	2. 이익소각	3,528,045	-	3,528,045	2000.03.31, 이익소각
	3. 상환주식의 상환	-	-	-	-
	4. 기타	-	-	-	-
IV. 발행주식의 총수 (II-III)	728,002,365	-	728,002,365	-	
V. 자기주식수	22,000,570	-	22,000,570	2014.04.22 주식교환 및 2015.07.23~10.01 장내취득	
VI. 유통주식수 (IV-V)	706,001,795	-	706,001,795	-	

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일)

(단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량			기말수량	비고		
			취득(+)	처분(-)	소각(-)				
배당 가능 이익 범위 이내 취득	직접 취득	장내 직접 취득	보통주	22,000,000	-	-	-	22,000,000	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
		장외 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
		공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
	소계(a)	보통주	22,000,000	-	-	-	22,000,000	-	
		우선주	-	-	-	-	-	-	
	신탁 계약에 의한 취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
		현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
소계(b)		보통주	-	-	-	-	-	-	
		우선주	-	-	-	-	-	-	
기타 취득(c)	보통주	570	-	-	-	570	주식교환		
	우선주	-	-	-	-	-	-		
총 계(a+b+c)	보통주	22,000,570	-	-	-	22,000,570	-		
	우선주	-	-	-	-	-	-		

5. 의결권 현황

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)	보통주	728,002,365	-
	우선주	-	-
의결권없는 주식수(B)	보통주	22,000,570	-
	우선주	-	-
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-
	우선주	-	-
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-
	우선주	-	-
의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-
	우선주	-	-
의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E)	보통주	706,001,795	-
	우선주	-	-

6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

정관에 의거한 배당에 관한 당사의 중요한 정책은 다음과 같습니다.

(1) 제52조(이익배당)

- ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
- ② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
- ③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 배당 할 수 있다.

(2) 제54조(중간배당)

- ① 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법의 규정에 의한 중간배당을 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
- ② 제1항의 중간배당은 이사회 결의로 하되, 중간배당의 구체적인 방법, 한도 등에 대해서는 상법 등 관련 법령에서 정하는 바에 따른다.
- ③ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사를 포함한다) 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다.
- ④ 중간배당을 할 때에는 종류주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
- ⑤ 제53조(배당금 지급청구권의 소멸시효)는 중간배당의 경우에 준용한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
		제71기 1분기	제70기	제69기
주당액면가액(원)		5,000	5,000	5,000
(연결)당기순이익(백만원)		3,120,254	10,641,512	2,953,774
(별도)당기순이익(백만원)		3,194,653	10,110,797	2,655,022
(연결)주당순이익(원)		4,420	15,073	4,184
현금배당금총액(백만원)		-	706,002	423,601
주식배당금총액(백만원)		-	-	-
(연결)현금배당성향(%)		-	6.6	14.3
현금배당수익률(%)	보통주	-	1.3	1.3
	우선주	-	-	-
주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-
	우선주	-	-	-
주당 현금배당금(원)	보통주	-	1,000	600
	우선주	-	-	-
주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-
	우선주	-	-	-

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

반도체는 모든 IT제품의 필수불가결한 핵심 부품으로서, 컴퓨터를 비롯해 통신장비 및 통신 시스템, 자동차, 디지털 가전제품, 산업기계 그리고 컨트롤 시스템 등 그 적용 분야가 매우 광범위 합니다. 시장 조사기관인 가트너(Gartner, 2018년 3월, 금액 기준)에 따르면, 지난 2017년도 세계 반도체 시장 규모는 \$4,204억에 이르렀으며, 이 중 메모리 제품은 \$1,303억의 시장 규모로 전체 반도체 시장의 약 31% 수준에 달하였습니다. 메모리 제품 중 DRAM은 전체 메모리 반도체 시장의 55%를 차지하는 \$721억을 기록하였으며, 그 뒤를 이어 낸드플래시가 \$537억으로 41%, 기타 메모리가 US\$44억으로 3%의 비중을 차지하였습니다.

아래 표에 나타난 바와 같이 반도체 산업은 우리 나라 수출에 있어서 17.1%의 비중을 차지하는 매우 중요한 기간 산업 중 하나입니다. 2017년 반도체 수출은 DRAM 시장 가격 상승 등으로 인해 전년 대비 57.4% 성장하였습니다.

[전체 수출 중 반도체 비중]

(단위: 백만USD, %)

구분	2017	2016	2015	2014	2013	2012
총수출	573,694	495,426	526,757	572,665	559,632	547,870
반도체	97,937	62,228	62,917	62,647	57,144	50,431
전년비 증감률	57.4%	-1.1%	0.4%	9.6%	13.3%	0.6%
비중	17.1%	12.6%	11.9%	10.9%	10.2%	9.2%

※ 출처 : 한국무역협회, 2018년 4월

이러한 반도체는 메모리 반도체와 비메모리 반도체로 구분됩니다.

가) 메모리 반도체

정보를 저장하고 기억하는 기능을 하는 메모리 반도체는 일반적으로 '휘발성(Volatile)' 과 '비휘발성(Non-volatile)'으로 분류됩니다. 휘발성 메모리 제품은 전원이 끊어지면 정보가 지워지는 반면, 비휘발성 제품은 휴대전화에 전화번호가 저장되는 것처럼 전원이 끊겨도 저장된 정보가 계속 남아 있습니다. 당사는 휘발성 메모리인 DRAM과 비휘발성 메모리인 플래시메모리를 생산하고 있습니다.

메모리 반도체 산업은 제품 설계 기술, 공정 미세화 및 투자효율성 제고에 의한 원가 경쟁력 확보가 매우 중요한 산업으로서 기술력 및 원가경쟁력을 갖춘 소수의 IDM(Integrated Device Manufacturer)업체 중심으로 점차 과점화되고 있는 추세입니다.

[DRAM(Dynamic Random Access Memory)]

DRAM은 전원이 켜져 있는 동안에만 정보가 저장되는 휘발성(Volatile) 메모리로 주로 컴퓨터의 메인 메모리(Main Memory), 동영상 및 3D 게임 구현을 위한 그래픽 메모리(Graphics Memory)로 사용되고 있으며, 가전제품의 디지털화에 따라 스마트 TV, 스마트 냉장고 그리고 프린터 등에도 사용이 확대되고 있습니다. 또한 각종 이동통신 기기의 폭발적 성장에 따라 스마트폰 및 태블릿 PC 등에도 모바일용 DRAM의 채용량이 급증하고 있습니다.

[플래시메모리(Flash Memory)]

플래시메모리는 전원이 공급되지 않아도 저장된 데이터가 지워지지 않는 비휘발성 메모리로 크게 노어(NOR)형(Code저장형)과 낸드(NAND)형(Data저장형)으로 나눌 수 있습니다. 이 중 당사가 생산하는 낸드플래시는 순차적(Sequential) 정보 접근이 가능한 비휘발성 메모리 칩으로서, 디지털 비디오나 디지털 사진과 같은 대용량 정보를 저장하는데 매우 적합합니다. 낸드플래시 제품이 적용되는 분야는 디지털 카메라, USB드라이브, MP3플레이어, 차량용 내비게이션, SSD(Solid State Drive), Flash Array 그리고 스마트폰, 태블릿 PC와 같은 모바일 기기 등입니다. 한편, 최근 플래시 메모리는 일반적인 범용 메모리 보다는 고객지향적인 제품의 수요가 늘어나고 있어 이런 추세에 부합하는 적극적인 응용 제품개발 및 철저한 고객대응의 중요성이 커지고 있습니다.

나) 비메모리 반도체

비메모리 반도체는 정보 처리를 목적으로 제작되는 반도체로 특성에 따라, 아날로그, 로직, 마이크로, 디스크리트, 센서로 분류가 되며, 자사는 이중 CIS를 생산하고 있습니다.

[CIS(CMOS Image Sensor)]

계산과 추론 등 정보처리기능을 담당하는 비메모리 반도체 중에서도, 이미지 센서는 빛 에너지를 감지하여 그 세기의 정도를 영상 데이터로 변환해 주는 반도체 소자로서 디지털 촬영 기기에서 필름 역할을 하고 있습니다. 이미지센서는 제조 과정과 신호를 읽는 방법에 따라 CCD(Charge Coupled Device)와 CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor) 두 가지 타입으로 나뉩니다. 최근 CMOS 이미지센서의 기술이 크게 향상되고 디지털 촬영기가 소형화됨에 따라, 크기가 작고 전력 소모가 적은 CMOS 이미지 센서의 활용 범위가 점차 확대되고 있으며, 특히, CIS의 사용 분야 중 스마트폰과 태블릿 PC향의 출하량과 매출 비중이 각각 50%를 넘어 고성장 추세입니다.

(2) 산업의 성장성

반도체 산업을 둘러싼 환경은 디지털 기기가 모바일화, 스마트化되고 자동차, 의료기기, 산업기기 등이 인터넷을 기반으로 발전함에 따라 우호적인 시장 여건이 지속되고 있습니다.

2015년 전체 반도체는 -2.2%, 메모리 반도체 분야는 -1.4% 성장하였으나, 2016년은 전체 반도체 시장이 3.3%의 성장을 보였으며 NAND Flash 매출 증가로 인해 메모리 반도체 시장도 1.6% 성장하였습니다. 2017년에도 전체 반도체 시장은 21.6%의 높은 성장을 기록하였으며, 메모리 반도체 분야 역시 61.8%의 높은 성장을 달성하였습니다. (Gartner, 2018년 3월, 금액기준).

메모리 반도체 시장의 생산(공급) 측면은 점진적 둔화가 예상됩니다. 공정 미세화 기술은 한계에 다다르고 있으며, 생산 및 연구 개발을 위한 투자 비용이 급증하고 있는 반면, 고객들의 요구 성능과 품질 수준은 더욱 다양화, 고도화되고 있습니다. 이에 기존과 같은 외형 경쟁을 위한 무리한 공급 확대는 제한적일 것으로 전망됨에 따라, 향후 메모리 반도체 산업은 안정적인 수요와 제한적인 공급으로 인해 메모리 시장 성장의 기회가 더욱 증대할 것으로 예상됩니다.

다.

[DRAM]

시장 조사기관인 가트너(Gartner, 2018년 3월, 금액기준)에 따르면, DRAM 시장은 세계 경제의 점진적 회복 및 모바일 시장 확대, 공급 안정 등의 요인으로 2014년 \$461억(+32%), 2015년 \$446억(-3.3%)의 매출을 기록하였습니다. 이어서 2016년에는 과잉공급으로 인한 평균 판매 가격(ASP: Average Selling Price) 하락으로, \$414억(-7.1%)의 매출을 기록하였습니다. 그러나 DRAM 평균 판매 가격 상승으로 인해 2017년 매출은 큰 폭으로 성장하여 \$721억(+74.1%)을 기록하였습니다. 분야별로 살펴 보면, PC 시장은 수요 정체로 인한 저성장 기조가 유지되어 DRAM 수요를 견인하는데 어려움을 겪고 있으나, 개인용 컴퓨터의 이동성(Mobility)에 대한 요구가 증가함에 따라 울트라북 등 노트북 컴퓨터로의 교체 및 신규 수요가 확대될 전망입니다. 한편, 수요가 지속적으로 증가하고 있는 모바일 기기는 DRAM 수요를 견인하는 주요 분야로서, 스마트폰과 태블릿 PC에서 채용하는 DRAM 용량은 2018년 각각 3.0GB와 2.4GB에서 2022년에는 5.2GB와 3.1GB으로 증가될 것(Gartner, 2018년 3월)으로 예상됩니다. 또한, 고화질 콘텐츠 유통 증가와 주요 게임 콘솔의 출시에 따라 이를 빠르게 처리할 수 있는 그래픽 메모리의 수요도 증가할 전망입니다. 이와 더불어 가상화, Big Data 등 기술고도화로 인해 고용량 Server 중심의 메모리 수요 확대가 이어지고 있습니다. 상기와 같이 디지털 기기의 증가에 따른 DRAM 수요 증가뿐만 아니라, 대용량 콘텐츠 처리를 위한 기기당 탑재량 증가에 따라 DRAM 수요는 앞으로도 지속 증가할 것으로 예상됩니다.

[낸드플래시(NAND Flash)]

낸드플래시는 디지털 미디어의 성장과 더불어 스마트폰, 태블릿 PC, 디지털 카메라, MP3 플레이어 그리고 기타 멀티미디어 가전에 사용되는 플래시카드와 USB 드라이브, SSD와 같은 정보저장장치(Storage Devices)등에 널리 사용되고 있습니다.

가트너(Gartner, 2018년 3월 금액기준)의 전망에 따르면 낸드플래시 시장은, 모바일 및 SSD 등 스토리지 분야 적용 확대를 통해 2015년 3.5%(\$308억), 2016년 14.9%(\$354억)의 꾸준한 성장을 이어가고 있습니다. 또한, 평균 가격 상승으로 인하여 2017년은 51.9%(\$537억)의 높은 성장을 기록하였습니다. 이는 스마트폰, 태블릿 PC를 포함한 휴대용 기기 및 PC용 SSD, 기타 응용복합 제품 등 향후 낸드플래시의 수요를 견인할 제품 시장의 지속적 성장 전망에 기반한 것입니다.

향후에는 Cloud Computing 및 IoT 시대가 전개되며 Data Center의 Storage 용량 확대와 실시간 정보처리의 필요성이 높아질 것이며, 이에 따라 Enterprise용 SSD가 일부 HDD를 대체하고 NAND 시장은 또 다른 도약을 할 수 있을 것으로 예상됩니다.

[CIS (CMOS Image Sensor)]

이미지센서는 1990년대 중반 디지털 카메라에 장착되어 일반 소비자에게 선보인 이후 PC 카메라, 자동차 블랙박스, 휴대폰카메라, 감시카메라 등 다양한 분야에 활용되어 시장 규모도 크게 증가하는 추세입니다. 특히 스마트폰, 태블릿 PC의 카메라 시장의 수요 증가로 시장이 지속 성장할 것으로 보입니다. 가트너(Gartner, 2018년 3월, 금액기준)의 전망에 따르면 이미지센서 시장은 2018년 US\$130억에서 2022년 US\$165억 규모로 연평균 6.1%의 성장이 예상되며, 특히 당사가 생산 중인 CMOS이미지센서 시장은 다양한 응용기기로의 확대 적용과 수요 증가로 전체 이미지 센서 시장에서의 비중이 2018년 95%에서 2022년 98%까지 확대되며 연평균 7.0%의 성장이 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성

세계 반도체 시장은 제품 수명 주기가 매우 짧으며, 새로운 제품의 생산을 위해서는 대규모 투자가 필요한 장치 산업의 특성을 가지고 있습니다. 아울러, 과거에는 실리콘 사이클의 순환에 따라 호황과 불황을 반복해 왔으며, 이는 주요 수요처인 미구주의 거시경제 순환 사이클(Business Cycle)과의 연관성이 매우 컸습니다. 그러나 최근에는 중국 및 인도 등 신흥시장의 비중이 확대되고 경쟁력이 부족한 업체들이 일부 구조조정 되어 반도체 산업 경기 변동 폭은 전과 비교하여 많이 줄었습니다.

[DRAM]

DRAM은 PC 수요에 상당 부분 의존하여 기업의 PC교체 사이클의 영향을 크게 받아왔습니다. 그러나 최근에는 스마트폰 및 태블릿 PC 등 모바일 기기의 폭발적 성장에 따라 DRAM의 주요 수요처가 PC에서 서버와 모바일로 분산되고 있어, 경기 변동성이 과거에 비해 약화되는 모습을 보이고 있습니다.

한편, 수요의 계절성으로서는 미구주 지역의 신학기, 크리스마스 특수 등 하반기 수요 증가가 뚜렷했으나, 최근에는 아시아 시장의 성장과 스마트폰 신제품 출시 시기의 분산으로 인한 판매시장의 다변화로 이 같은 전통적인 수요의 계절성이 일부 약화되는 모습도 나타나고 있습니다.

[낸드플래시(NAND Flash)]

낸드플래시는 과거 MP3 플레이어, 메모리카드 등의 수요증가에 힘입어 급속한 성장을 해왔습니다. 또한 최근에는 IT 기기가 스마트화되고 고성능화 됨에 따라 낸드플래시의 주 소비형태가 Controller와 Raw NAND가 결합되는 eMMC와 SSD 등으로 바뀌고 있으며 보다 높은 부가가치를 가지게 되었습니다. 아울러, 이들 eMMC와 SSD제품도 DRAM과 같이 스마트폰, 태블릿 PC, 노트북/PC/Server/Storage/Flash Array 등의 다양한 제품에 장착되기 시작하며, 과거에 비해 경기변동성은 줄어들 것으로 예상됩니다.

[CIS (CMOS Image Sensor)]

이미지 센서 시장은 스마트폰, DSLR 등 전통적인 수요처의 강세가 지속되는 가운데, 자동차용 블랙박스/후방카메라, 스마트TV 등 다양한 산업군과의Convergence를 통해 시장이 더욱 확대되고 있습니다. 또한 이미지 센서 중 자사가 생산중인CMOS 이미지센서는 휴대폰, 캠코더, PC 등 멀티미디어 기기 시장의 영향을 크게 받는 제품으로서 소비재의 특성상 경기변동과 기술변화에 민감할 뿐만 아니라 라이프 사이클이 짧은 특징을 가지고 있습니다.

(4) 경쟁요소

반도체 사업의 핵심 경쟁력은 1. 기술 및 원가 경쟁력, 2. 시장 대응 능력(고객확보, 제품 포트폴리오) 3. 설비투자 능력 등이 있습니다.

최근 대량생산이 용이한 표준제품 위주에서 응용분야가 점차 다양화, 융복합화 됨에 따라 시설투자와 생산성 향상을 통한 원가경쟁력 중심에서 제품 가치 증대를 통한 수익성 중심으로 경쟁의 패러다임이 빠르게 전환되고 있습니다.

지금까지는 적극적 투자에 의한 생산능력 확대와 생산원가 절감이 핵심 경쟁 요소였지만, 공정 미세화의 난이도 증가와 투자 대비 수익에 대한 불확실성 증대 등 사업환경이 변화하였습

니다. 따라서, 앞으로는 생산기술의 고도화를 통한 투자 절감과 제품의 부가가치 증대를 위해 다양한 선행기술 및 응용기술 개발, 메모리 컨트롤러와 펌웨어가 결합된 응용복합제품의 개발이 중요한 사업 경쟁력이 될 것입니다. 아울러 DRAM분야에서의 TSV(Through Silicon Via) 및 New Memory의 원활한 초기시장진입과 eMMC나 SSD 제품의 시장확대를 위해서는 관련 기술업체와의 협업과 더불어 고객 만족도가 중요해짐에 따라 마케팅 및 고객 지원 활동도 핵심 경쟁 요소로 부각되고 있습니다.

이외에도 적기에 시장요구에 부합하는 제품을 출시(Time to Market)할 수 있는 시장 대응력 및 재무 건전성 확보 등이 요구되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2018년 1분기는 우호적인 시장 환경이 지속되는 가운데, 기술 경쟁력과 수익성 강화를 통해 견조한 실적을 기록하였습니다. 당사의 연결 기준 매출은 전년 동기 대비 약 39% 증가한 약 8조 7천 1백 9십 7억원을 기록하였으며, 연결 기준 영업이익은 전년 동기 대비 약 77% 증가한 약 4조 3천 6백 7십 3억 원을 기록하였습니다. 연결 기준 당기순이익은 전년 동기 대비 약 64% 증가한 약 3조 1천 2백 1십 3억 원을 기록하였습니다.

(단위 : 백만원)

구분	제71기 1분기 (2018.01.01~ 2018.03.31)	제70기 4분기 (2017.10.01~ 2017.12.31)	전분기 대비 증감	제70기 1분기 (2017.01.01~ 2017.03.31)	전년 동기 대비 증감
매출액	8,719,691	9,027,553	-3%	6,289,518	+39%
누계실적	8,719,691	30,109,434	-	6,289,518	-
영업이익	4,367,338	4,465,834	-2%	2,467,598	+77%
누계실적	4,367,338	13,721,326	-	2,467,598	-
당기순이익	3,121,329	3,219,499	-3%	1,898,679	+64%
누계실적	3,121,329	10,642,219	-	1,898,679	-

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결기준 실적입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[제71기 1분기 누계]

(단위: 백만원)

구분	매출액	매출액 비중 (%)	주요 제품
반도체 부문	8,719,691	100.0%	DRAM, NAND Flash, MCP 등
합계	8,719,691	100.0%	-

※ 당사는 한국표준산업분류표상의 소분류에 의한 '반도체 및 기타 전자부품 제조업 (분류번호: 321)'에 해당하며, 반도체부문의 매출액이 총매출액의 90%를 초과하므로

반도체부문으로 기재함.

(2) 시장점유율

구 분	'17년	'16년	'15년	'14년	'13년	'12년	'11년
DRAM	27.8%	26.0%	27.3%	27.1%	26.6%	24.7%	22.8%
NAND Flash	12.2%	11.8%	12.6%	10.8%	10.7%	9.9%	11.7%

출처: IDC 2018년 3월, 매출액 기준

(3) 시장 경쟁요소 및 회사의 경쟁력

(가) 메모리반도체 사업

[DRAM]

피씨 메모리(PC Memory)는 게이밍 피씨(Gaming PC), 울트라북(Ultrabook), 크롬북(Chromebook)이 판매 증가를 도모하고 있으며 특히, 게이밍 피씨와 울트라북의 평균 메모리 탑재량이 점차 높아지고 있어 지속적인 메모리 수요 증대를 이끌고 있습니다. 게이밍 피씨의 경우, 고사양 게임을 즐기기 위한 사용자의 수요 증가, HMD(Head Mount Device) 및 VR(Virtual Reality) 등의 신규 장비 등장과 함께 피씨 내 작지만 확고한 위치를 자리잡아 가고 있습니다. 울트라북 제품군 내 2-in-1 노트북의 경우는 기능성과 편리성을 갖추고 있어 전체 울트라북의 판매를 촉진하고 있습니다. 크롬북은 북미 교육용으로 판매가 증가하고 있으며, 이는 저렴한 가격, 무료 OS, 다양한 교육용 프로그램 제공을 주요 원인으로 꼽을 수 있습니다. 게이밍 피씨는 상대적으로 높은 판매가격, 크롬북은 공공기관 대량 납품을 통해 수익이 창출됨에 따라 주요 피씨 제조사들은 해당 제품 판매에 주력하고 있습니다. '18년 1분기는 전통적으로 피씨 메모리 비수기 기간이었으나, 피씨 제조사들의 낮아진 메모리 재고를 높이기 위해 전년도에 비해 상대적으로 높은 수요를 보였습니다.

서버 메모리(Server Memory)는 클라우드 컴퓨팅(Cloud Computing) 분야의 성장세 유지로 지속적인 수요 증대가 전망됩니다. 특히, Enterprise향 Workload 중 Public Cloud로의 전환 추세 및 Cloud Native Workload 증가 등에 따라 대형 클라우드 서비스 업체들은 Data Center 확장을 위한 투자에 집중하고 있습니다. 또한, 중국 지역 클라우드 업체들도 높은 성장률을 보이고 있습니다. 이러한 흐름은 서버 수요를 견인하고 있으며 동시에 단일 서버의 가상화 집적도 증가로 인한 서버 DRAM 용량(Content per Box) 상승세 유지에 일조하고 있습니다. 또한, AI(Artificial Intelligence)와 ML(Machine Learning) 등을 기반으로 한 Analytics Application의 성장이 본격화되면서 High Bandwidth 및 High Density 메모리 수요가 증가할 것으로 전망합니다. 이에 자사는 해당 수요에 대응할 수 있는 고속, 고용량 서버 모듈(Module) 제품을 공급하며 시장 수요에 적극적으로 대응하고 있습니다.

그래픽스 메모리(Graphics Memory)는 게임, 동영상 및 3D 그래픽 기술의 발전과 함께 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 특히, 그래픽스 가속 기능을 기반으로 한 인공지능 분야는 IT 기업의 중요한 성장 전략 분야로 발전하고 있으며, 당사는 데이터 처리 속도를 혁신적으로 향상시킨 HBM(High Bandwidth Memory) 2세대 제품 개발을 마치고 '18년 하반기부터 본격적인 시장 진입 예정입니다. 또한, 세계 최고 속도의 20나노급 8Gb(기가비트) GDDR6 그

래픽 DRAM을 개발하여 고객의 최고급 그래픽 카드 예상 출시 시점인 '18년 하반기에 맞춰 제품을 양산할 계획입니다. 당사는 주요 그래픽 칩셋 업체들과의 전략적 관계 강화를 통하여 데스크탑, 노트북, HPC용 등 피씨 그래픽 및 차세대 Game Console 분야에서도 주도적인 위치를 공고히 하고 있습니다.

컨슈머 메모리(Consumer Memory)는 기존 시장의 고용량화, 신규 시장의 수요(Set) 증가로 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 컨슈머 시장의 주요 응용분야인 DTV/STB의 고사양화로 인해 메모리 탑재 용량은 지속 증가 추세이며, 기존 4G에서 5G로의 네트워크 전환과 오토모티브(자율주행) 및 고성장이 예상되는 IoT(Smart Speaker 등)의 신규 시장은 향후 컨슈머 메모리 수요의 모멘텀이 될 것으로 전망됩니다. 이에, 당사는 컨슈머의 다양한 응용분야 대응을 위해 저용량에서부터 고용량(2Gb~32Gb), 범용 제품인 DDR3/DDR4 및 저전압/고속의 LPDDR4(X), IT(Industrial Temperature)/AT(Automotive Temperature) 등 Specialty 제품까지의 Full Line-up 운영으로 적극적인 고객 대응 및 당사 입지를 강화하고 있습니다.

모바일 메모리(Mobile Memory)는 스마트폰과 Tablet 등 모바일 기기를 중심으로 채용되고 있으며, 무선통신 환경 발전과 정보통신 Convergence 가속화에 따라 다양한 Connected Device에 채용이 확대되고 있습니다. 모바일 Device 시장은 '15년 이후 성숙기에 진입하여 연간 Set 성장률은 둔화되고 있으나, DRAM 채용량은 연간 두 자리 수의 높은 성장률을 유지하며 모바일 메모리 수요 성장을 견인할 것으로 전망되고 있습니다. 이는 소비자들의 고사양 제품으로의 교체 수요 증가에 따른 High/Mid-end 제품군의 성장 및 스마트폰 제조업체간 Display, 3D Camera 같은 H/W Spec. 경쟁 심화에 따른 고용량 메모리 채용 증가에 기인하는 것으로 분석됩니다. 또한, 향후 사용자의 다양한 Contents/Service 이용 확대 및 IoT 등 개인 보유기기 증가에 따라 Hub Device인 스마트폰의 높은 성능이 요구되어 고성능/저전력의 모바일 메모리 수요가 지속될 것으로 전망됩니다.

[낸드플래시(NAND Flash)]

낸드플래시는 데이터 저장 용도로 쓰이는 대표적인 메모리 반도체로서, 빠른 테크놀로지의 진화로 매년 높은 성장률을 기록하였습니다. 낸드플래시 시장이 가파른 성장세를 지속하는 이유는 최첨단 IT기기 및 다양한 소비자 가전에서 낸드플래시 채용률 및 채용 용량이 지속적으로 높아지고 있기 때문입니다.

과거에는 플래시카드, USB 드라이브, MP3 플레이어, PMP 등이 낸드플래시 메모리의 주요 수요처였으나, 최근에는 스마트폰, 태블릿 PC 등의 모바일 분야에서 멀티 미디어 기능의 확대에 따른 채용량 증가로 낸드플래시 메모리에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 스마트 TV, 스마트 카 등의 신개념 도입으로 인하여 과거에 저용량의 낸드플래시 메모리만 사용했던 분야에서도 고용량 낸드플래시 메모리에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

그리고, 낸드플래시를 기반으로 한 SSD(Solid State Drive)와 같은 다양한 형태의 Storage Solution이 노트북은 물론이고 서버 시장에서도 주요 제품군으로 자리잡고 있어, 향후 낸드플래시 메모리 시장의 지속적인 성장을 견인할 것으로 전망되고 있습니다.

이와 같은, 낸드플래시 시장에서 당사는 저용량부터 고용량까지 다양한 단품 및 응용 복합 제품을 기반으로 고객의 수요에 보다 적극적으로 대응하고 있으며, 응용 분야별 선택과 집중을 통하여 낸드플래시 경쟁력을 확보하고 시장 지배력을 높여 가고 있습니다. 또한, 높은 기술력을 바탕으로 Floating Gate 방식의 10nm대 Planar NAND 및 3D NAND를 개발, 빠른 NAND 시장 변화에 발 맞추어 대응하고 있습니다.

[CIS(CMOS Image Sensor)]

CIS는 모바일 폰, 노트북, 태블릿, 디지털 카메라 등 다양한 디지털 기기에서 필름 역할을 하는 반도체 소자이며, 2016년부터 2021년까지 연평균 약 8.2%의 성장률을 보일 것으로 예상하고 있습니다. (출처: Techno-Systems Research 2H.2017, 출하량 기준)

모바일 폰, 노트북, 태블릿, 보안 카메라등에 많이 채용되고 있으며, 화질이 크게 향상되면서 의료 기기, DSLR 및 캠코더, 자동차, 게임기, 가전 제품 등으로 응용 범위가 점점 확대되고 있습니다. 전체 Application 중 수량 및 매출 비중이 가장 큰 모바일의 경우, 화상 통신 및 Selfie를 위한 전면 카메라(Front Facing Camera)와 사진 촬영을 위한 후면 카메라(Rear View Camera)용으로 두 개의 이미지 센서가 장착되고 있으며, 2016년부터는 후면 카메라에 듀얼 카메라 채택이 증가되면서 기기당 이미지 센서 탑재 비율이 더욱 증가하고 있는 추세입니다.

최근 스마트폰 시장에서는 전면 카메라에 5M/8M 제품, 후면 카메라에는 13M/16M 제품이 보편화 되고 있으며, Flagship model에는 Pixel Size를 늘려 화질을 더욱 개선한 12M제품과 20M이상의 초고해상도 제품이 채용되고 있습니다. 한편, 노트북용 이미지센서 시장은 HD 제품이 주류를 이루고 있으며, 태블릿 역시 5M~13M의 제품이 전면 카메라와 후면 카메라에 채용되고 있습니다.

당사는 이미지센서 시장 중 가장 많은 비중을 점유하고 있는 모바일폰 시장과 이와 유사한 성능을 요구하고 있는 노트북, Tablet 시장에 집중하고 있으며, 2012년 4분기에 BSI(Back-Side Illumination) 기술을 개발 완료하여 2013년부터 BSI를 적용한 5M, 8M 제품의 안정적인 생산과 고객 대응으로 마켓 포지션을 강화하고 있습니다. 2016년에는 advanced BSI 기술을 적용한 13M 제품 개발을 완료하여 시장에 성공적으로 진입함으로써 제품 라인업을 13M까지 확대하였고, 2017년부터는 고화소 시장으로의 진입을 위해 300mm 공정 Setup과 16M 이상 제품 라인업 구축을 위한 1.0um Pixel 개발에 집중하고 있습니다. 2018년 하반기 300mm 첫 제품인 13M 제품 출시와 더불어 1.0um 16M 제품 샘플 출시를 통해 고화소 시장 확대를 위한 제품 Line-up 준비에 박차를 가하고 있습니다.

향후 점유율 확대를 위하여 시장의 니즈에 맞추어 제품을 개발하는 것 이외에도, 자동차 및 보안 카메라등과 같이 새로운 시장 진입을 통한 애플리케이션 다양화로 CIS시장에서의 입지를 더욱 강화해 나갈 계획입니다.

다. 사업부문별 재무정보

당사는 반도체제조업부문의 매출액과 자산총액이 전체부문의 90%를 초과하는 지배적 단일사업부문으로서 부문별 기재를 생략합니다.

2. 주요 제품, 서비스 등

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)
반도체 부문	제품 외	DRAM, NAND Flash, MCP 등	산업용 전자기기	SK하이닉스	8,719,691 (100%)
합계					8,719,691 (100%)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

2018년 1분기에는 작년 연간 지속된 서버를 필두로 하는 안정적 수요가 계속되었습니다. DRAM의 1분기 판매가격은 상승하였으며, 2분기에도 안정적인 상황이 지속될 것으로 기대하고 있습니다. NAND는 1분기 가격이 소폭 하락하였으며, 업계의 3D 전환으로 공급이 증가하며 2분기부터 일정 수준의 가격 하락이 예상되고 있습니다.

3. 주요 원재료에 관한 사항

당사의 메모리반도체 부문 생산공정에 투입되는 원재료는 크게 웨이퍼(Wafer), 리드프레임(Lead Frame) 및 섭스트레이트(Substrate), PCB(Printed Circuit Board) 그리고 기타 재료등으로 구성됩니다.

웨이퍼는 집적회로(Integrated Circuit, IC)를 제작하기 위해 반도체 물질의 단결정을 성장시킨 기둥 모양의 규소(Ingot)를 얇게 절단하여 원판모양으로 만든 것으로서 반도체 소자를 만드는 데 사용되는 핵심 재료입니다.

Lead Frame은 반도체 IC를 구성하는 또 다른 주요 요소이며 반도체 칩과 PCB 기판간의 전기신호를 전달하면서 외부의 습기, 충격 등으로부터 칩을 보호하고 지지해주는 골격 역할을 하는 부품입니다.

Substrate는 리드프레임과 같은 기능을 하지만 전기신호를 전달하는 역할을 하는 다리를 기존의 금속 다리가 아닌 공(Ball) 모양의 연결부분을 이용한 부품입니다.

PCB는 그 위에 저항, 콘덴서, 코일, 트랜지스터, 집적회로, 대규모 집적회로(Large-Scale Integration), 스위치 등의 부품을 장치하고 납땀하여 회로기능을 완성시키는 인쇄 배선판입니다. 그 외 가스 및 화학약품 등이 반도체 제조 공정에 투입되는 원재료로 소요됩니다.

가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	투입액	비율	비고
반도체 부문	원재료	Wafer	fab 생산	186,291	14%	-
		Lead Frame& Substrate	package	41,940	3%	-
		PCB	module	32,172	2%	-

		기타	-	509,549	37%	-
		소계		769,952	56%	-
	저장품	S/P, 부재료	-	601,902	44%	-
		합계		1,371,854	100%	-

나. 주요 원재료의 매입처 및 원재료 공급시장과 공급의 안정성

당사는 일본, 독일, 미국, 한국 등에 생산시설을 보유한 4개사로부터 반도체 공정의 주요 원자재인 300mm 웨이퍼 완제품을 수입하고 있습니다. 당사는 당사와 거래하는 매입처 등과 일상적인 영업활동 이외의 특수한 관계를 갖고 있지 않습니다. 당사가 거래하고 있는 상기 4개사는 전체 300mm 웨이퍼 시장의 80% 이상을 차지하고 있습니다.

최근 반도체 산업의 호황에 따라 웨이퍼 수요는 지속적으로 증가하는 추세이나, 공급처의 제한적 투자로 공급이 제한되며 가격이 상승하는 추세입니다. 일부 공급처의 소규모 보완 투자로 공급이 일부 증가할 것으로 예상되고 있으나, 공급 증가가 제한적임에 따라 가격 상승 추세는 향후 2~3년간 지속될 것으로 예상됩니다.

당사는 웨이퍼 시장의 수급 동향을 지속적으로 모니터링하고 있으며, 당사 주요 매입처와의 중장기적 협력 관계를 통해 안정적 생산 지원 및 대응력을 강화해 나갈 것입니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

당사는 4조3교대로 운영되고 있으며, 휴일(공휴일 포함)을 포함하여 2018년 1분기 총 가동일은 90일로, 각 지역별 FAB의 가동인원 및 가동율을 고려하여 계산한 당사의 평균가동시간은 월 13,865,040시간입니다.

생산능력은 "해당 기간 최대생산 일의 생산량 x 누적일수 x 평균원가"의 방법으로 산출하고 있으며, 2018년 1분기 생산능력은 3,943,165 백만원 입니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	제71기 1분기	제70기	제69기
반도체 부문	3,943,165	14,063,811	12,054,238

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

나. 생산실적 및 가동률

당사의 2018년 1분기 생산실적은 3,943,165백만원으로 집계되었으며, 동 기간 생산설비의 평균가동률은 100%를 유지하였습니다.

(1) 생산실적

(단위 : 백만원)

사업부문	제71기 1분기	제70기	제69기
반도체 부문	3,943,165	14,063,811	12,054,238

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

(2) 가동률

(단위 :시간, %)

사업부문	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률
반도체 부문	41,595,120	41,595,120	100%

※가동률은 각 지역별 제조 인원을 고려하여 계산함.

다. 생산설비의 현황

당사의 시설 및 설비의 장부가액은 작성기준일 현재 24조 626억 원이며, 상세 내역은 다음과 같습니다.

(단위

:백만 원)

구 분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	기타의유형자산	건설중인자산	합계
2018.01.01								
취득원가	581,541	3,807,323	1,262,927	46,463,886	3,081	1,217,216	3,137,621	56,473,596
감가상각누계액		(851,655)	(404,204)	(30,163,696)	(2,304)	(774,959)		(32,196,818)
손상차손누계액		(23,699)	(19,104)	(165,509)		(35)		(208,346)
정부보조금		(1,217)		(4,613)		(2)		(5,831)
기초순장부금액	581,541	2,930,753	839,620	16,130,068	777	442,221	3,137,621	24,062,601
기중변동액								
취득	18,245	18,019	99,276	1,627,538	10,959	33,327	2,713,757	4,521,120
처분			(234)	(1,877)		(975)		(3,086)
손상차손								
감가상각		(32,748)	(14,949)	(1,228,980)	(146)	(42,006)		(1,318,830)
대체	2,289	282,522	19,411	1,204,889		9,396	(1,518,506)	
환율변동 등	(51)	8,301	6,977	72,750	1	1,838	13,147	102,963
기말순장부금액	602,024	3,206,846	950,101	17,804,389	11,590	443,800	4,346,019	27,364,769
2018.03.31								
취득원가	602,024	4,120,833	1,391,242	49,288,245	14,062	1,260,482	4,346,019	61,022,906
감가상각누계액		(889,076)	(422,038)	(31,313,809)	(2,471)	(816,649)		(33,444,043)
손상차손누계액		(23,699)	(19,104)	(165,663)		(32)		(208,498)
정부보조금		(1,213)		(4,384)				(5,597)
기말순장부금액	602,024	3,206,846	950,101	17,804,389	11,590	443,800	4,346,019	27,364,769

라. 투자계획

2018년 1분기 당사의 입고 기준 투자집행 실적은 다음과 같습니다.

[입고기준]

(단위 : 십억원)

구 분	투자대상자산	투자효과	투자 기간	기투자액 (누적)	비 고
-----	--------	------	-------	-----------	-----

보완투자 등	기계장치 외	생산능력증가	2018.01.01~ 2018.03.31	4,618	-
합 계				4,618	-

5. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제71기 1분기	제70기	제69기
반도체 부문	제품 외	DRAM, 낸드플래시, MCP 등	8,719,691	30,109,434	17,197,975
합 계			8,719,691	30,109,434	17,197,975

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직

국내에서는 마케팅부문 관할 하에 대리점 6개사를 운영하고 있습니다. 해외 판매법인은 미국, 독일, 영국, 일본, 싱가포르, 인도, 대만, 중국 등 총 8개 국가에 10개 법인이 소재하고 있으며 산하에 14개 사무소 및 17개 대리점을 두고 있습니다.

(2) 판매경로

당사의 판매 경로는 크게 직판 거래와 대리점 거래로 나눌 수 있습니다. 직판 거래는 당사에서 일반 기업체 등 실 수요자에게 직접 판매를 하는 것이고, 대리점 거래는 당사가 대리점을 통해서 일반 기업체 등의 실 수요자에게 판매하는 것입니다.

(3) 판매방법 및 조건

내수 판매는 국내 대리점 등의 수주 현황에 의거하여 현금 또는 어음 결제조건으로 납품하고 있으며, 수출은 MASTER L/C 및 LOCAL L/C에 의거하여 신용장 또는 D/A, D/P 거래 등으로 납품하고 있습니다.

(4) 판매전략

당사 판매 전략은 비즈니스 포트폴리오 최적화, 수익 구조 개선, 고객 관계 유지, 지역별 포지셔닝 등 4가지를 근간으로 하고 있습니다.

비즈니스 안정성을 위해서 포트폴리오의 최적화를 추진하고 있으며 매출 확대를 위해 제품 구성을 다양화 하고 있습니다. 수익 구조 개선을 위해서 고부가가치 제품 판매를 확대하고 시장 통찰 능력

을 강화하여 미래 시장 발굴을 추진하고 하고 있습니다. 고객 관계 유지를 위해서 고객 가치 제안 활동을 강화하고 특화된 제품을 제공하여 고객 만족 제고를 추진하고 있습니다. 지역별 특성을 고려하여 차별화된 제품 전략으로 지역별 전략 고객 매출 확대를 추진하고 있습니다.

(5) 주요 매출처

반도체는 IT 제품군 전체에 걸쳐 그 수요처가 다양하며, 당사는 세계 유수의 모바일 및 컴퓨팅 관련 전자업체에 제품을 공급하고 있으며, SSD와 같은 대용량 저장장치와 메모리 카드 생산업체 등을 고객으로 확보하고 있습니다.

6. 수주상황

당사는 주요 고객사들과 월별/분기별 상호 합의에 따른 공급 물량 및 가격을 결정하고 있으며, 장기 공급 계약에 따른 수주 현황은 없습니다.

7. 시장위험과 위험관리

가. 시장위험

(1) 환율변동위험

연결실체는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화, 유로화 및 엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채 및 해외사업장에 대한 순투자가 기능통화 외의 통화로 표시될 때발생합니다.

당분기말 현재 연결실체의 화폐성 외화자산 및 외화부채의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 백만단위)				
구 분	자 산		부 채	
	현지통화	원화환산	현지통화	원화환산
USD	12,559	13,394,603	5,102	5,441,469
EUR	21	28,107	129	169,047
JPY	458	4,590	113,402	1,135,675

당분기말 현재 각 외화에 대한 환율 10% 변동을 가정한 화폐성 외화자산 및 외화부채의 환율변동위험은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	10% 상승시	10% 하락시
USD	795,313	(795,313)
EUR	(14,094)	14,094
JPY	(113,109)	113,109

(2) 이자율위험

연결실체의 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 차입금에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하고 있습니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결실체는 이자율위험에 노출되어 있으며 동 이자율위험의 일부는 변동이자부 현금성자산으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다.

연결실체는 당분기말 현재 이자율 변동에 따라 순이자비용이 변동할 위험에 일부 노출되어 있습니다. 당분기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 하락 또는 상승시 향후 3개월간 연결실체의 변동금리부 차입금 및 금융자산으로부터의 이자비용과 이자수익으로 인한 법인세비용차감전순이익은 3,813백만원 만큼 증가 또는 감소하였을 것입니다.

(3) 가격위험

연결실체는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 지분증권 및 채무증권에 투자하고 있습니다. 당분기말 현재 해당 지분증권 및 채무증권은 가격위험에 노출되어 있습니다.

나. 회사의 위험관리 정책

(1) 위험관리의 일반적 전략

[주요 시장위험요소]

당사는 외화표시 자산 및 부채에 대해 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 경영 안정성 제고를 목표로 환 리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 또한 당사는 영업 측면에서 매출의 90% 이상이 USD로 이뤄져 있어, USD 수입이 지출보다 많은 현금을 가지고 있으므로 수입에서 지출을 차감한 잔존 외화 현금흐름이 환리스크 관리의 주 대상입니다.

[위험관리규정]

당사는 보다 체계적이고 효율적인 환리스크 관리를 위하여 환위험 관리규정 제정, 외환관리위원회 구성 및 환리스크 관리를 위한 별도의 전담 인원을 배정하여 운영하고 있습니다. 그 주요 내용은 ①외환거래는 환 리스크를 회피하고 안정적 경영 수익을 확보하기 위해 실행되어야 하며, ②실수요와 공급에 의한 거래를 원칙으로 하고, ③환위험 관리의 정책은 자연적 헤지(Natural Hedge)를 기본으로 하되 필요시 선물환 등 외부적 관리기법을 일부 시행하고, ④회사의 환위험 관리는 주관부서에서 집중하여 관리하며, 주관부서는 환포지션을 파악하여 외환관리위원회가 설정한 지침에 따라 관리하고 있습니다.

(2) 위험관리조직 및 운영 현황

당사는 외환관리에 관한 의사결정기구로서 외환관리위원회를 운영하고 있으며, 외환관리위원회의 주요 업무는 다음과 같습니다.

- ① 외환 관리 정책, 전략 심의 및 의결
- ② 외환 관리 규정의 제정 및 개정
- ③ 외환관리 목표와 허용 손실한도의 설정
- ④ 외환위험 헤지 범위 및 헤지 비율, 관리수단 등의 조정
- ⑤ 외환포지션, 환율 변동 영향, 환율 전망 등 환관련 정보의 공유

8. 파생상품 거래현황

(1) 당분기말과 전기말 현재 재무상태표에 인식된 파생상품은 없습니다.

(2) 당분기 중 파생상품 거래와 관련하여 금융수익 및 금융비용으로 인식한 평가손익 및 거래손익은 없으며, 전분기 중 인식한 평가손익 및 거래손익은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	평가이익	평가손실	거래이익	거래손실
이자율스왑	99	-	203	308

9. 경영상의 주요계약 등

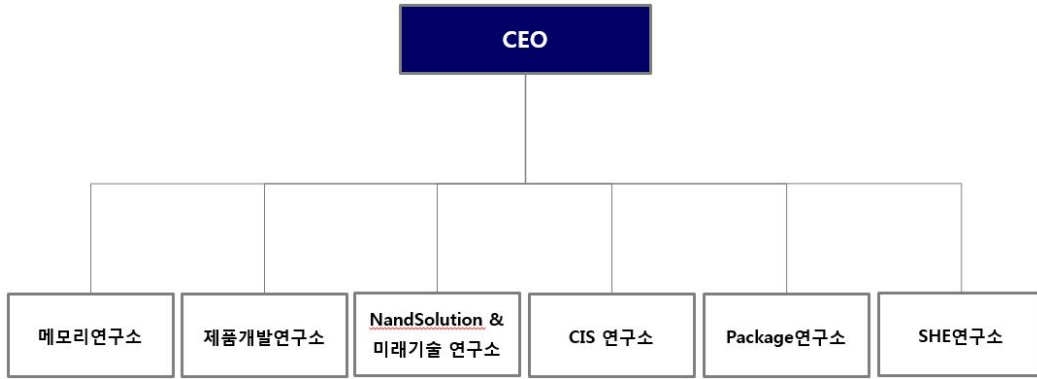
계약 상대방	항목	내용	비고
삼성전자	계약 유형	특허 크로스 라이선스 계약	-
	계약 기간	2013년 6월 1일 이후	
	목적 및 내용	삼성전자가 보유하고있는 반도체 관련 모든 특허에 대한 사용권을 확보하여 향후 잠재적 분쟁 가능성 원천적 해소	
	기타 주요내용	-	
Rambus Inc.	계약 유형	특허 크로스 라이선스 계약	-
	계약 기간	2013년 7월 1일 ~ 2024년 6월 30일	
	목적 및 내용	라이선스 계약을 통해 반도체 전 제품 기술 관련 램버스 보유 특허에 대한 사용권한을 확보하여 향후 분쟁 가능성 해소	
	기타 주요내용	특허 및 반독점 소송 등 램버스와 진행중인 모든 소송 취하	
실리콘화일	계약 유형	주식교환계약	-
	계약 체결일	2014년 1월 28일	
	목적 및 내용	주식의 포괄적 교환을 통해 실리콘화일을 완전자회사로 편입하여 CIS 사업의 경영 효율성 증대	
	기타 주요내용	주식교환일: 2014년 4월 22일 주식교환비율: 에스케이하이닉스 보통주 : 실리콘화일 보통주 =1 : 0.2232438	
Softeq Flash Solutions LLC	계약 유형	주식 인수	-
	계약 체결일	2014년 5월 15일	
	목적 및 내용	NAND Flash 개발 역량 향상을 위해 인수	
	기타 주요내용	-	
Violin Memory	계약 유형	자산 인수	-
	계약 체결일	2014년 5월 29일	
	목적 및 내용	NAND 솔루션 역량 강화를 위해, Violin사의 PCIe Card 부문 자산 및 인력을 인수	

	기타 주요내용	PCIe Card 관련 특허에 대한 Cross-License 체결	
Toshiba	계약 유형	공동 개발 계약	-
	계약 기간	2015년 2월 5일 이후	
	목적 및 내용	차세대 노광기술(Nano Imprint Lithography) 개발	
	기타 주요내용	-	
Sandisk Corporation	계약 유형	특허 크로스 라이선스 계약 등	-
	계약 기간	2015년 8월 ~ 2023년 3월	
	목적 및 내용	1) 기존 특허 cross license 계약 연장 2) 동 기간 동안 당사의 DRAM 제품을 판매하는 장기 공급계약 체결 3) 양사간 진행 중인 영업비밀 소송은 취하하기로 합의함	
	기타 주요내용	-	
에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)	계약 유형	영업 양도	-
	계약 기간	2017년 7월 1일 (영업/자산 양도 시점)	
	목적 및 내용	Foundry 사업의 책임 경영을 통한 수익성 및 사업가치 제고	
	기타 주요내용	1) Foundry 사업과 관련된 자산 등의 포괄적 양도 2) 이사회 의결일 : 2017년 5월 24일	
BCPE Pangea Intermediate Holdings Cayman, LP	계약 유형	특수목적법인(SPC)에 대한 출자 (신규 설립)	-
	계약 기간	2017년 9월 28일 이후	
	목적 및 내용	Bain Capital이 General Partner로서 구성한 특수목적법인(SPC)이 도시바의 반도체 사업 지분을 인수하며, 당사는 이에 대한 Limited Partner로서 투자에 참여	
	기타 주요내용	Anti-trust Filing 승인 등 선행조건을 충족 시 계약 완료	
BCPE Pangea Cayman2 Limited	계약 유형	특수목적법인(SPC)이 발행한 전환사채 취득	-
	계약 기간	2017년 9월 28일 이후	
	목적 및 내용	Bain Capital과의 특수목적법인(SPC)의 전환사채를 취득하고, 향후 적법한 절차를 거쳐 전환 시 최종적으로 도시바 반도체 사업 지분의 15% 확보 가능	
	기타 주요내용	Anti-trust Filing 승인 등 선행조건을 충족 시 계약 완료	

10. 연구개발활동

가. 연구개발 담당조직

당사는 보고서 제출일 현재, 미래기술연구원과 DRAM개발사업부문(DRAM설계본부), NAND개발사업부문(NAND개발본부, NAND Solution개발본부) 및 CIS사업부에서 연구개발 활동에 주력하고 있습니다.



나. 연구개발비용

(단위 : 백만원)

과 목		제71기 1분기	제70기	제69기	비 고
연구개발비용	원 재 료 비	25,193	87,617	78,024	-
	인 건 비	217,083	836,729	586,745	-
	감 가 상 각 비	78,508	295,672	252,648	-
	위 탁 용 역 비	53,623	225,842	227,589	-
	기 타	215,063	1,041,174	953,648	-
	연구개발비용 합계	589,469	2,487,033	2,098,654	-
회계처리	판매비와 관리비	512,389	1,975,386	1,747,721	-
	제조경비	-	-	-	-
	개발비(무형자산)	129,083	511,647	350,932	-
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100]		7.4%	8.3%	12.2%	-
매출액		8,719,691	30,109,434	17,197,975	-

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

다. 연구개발 실적

구 분	연구과제명	기대효과
제71기	1) 72단 Enterprise SSD (SATA / PCIe)	72단 512Gb 3D NAND 기반으로 자체 개발한 컨트롤러와 펌웨어를 탑재한 기업용 SSD 개발

구 분	연구과제명	기대효과
제70기	1) 3D 256Gb TLC	업계 최초로 개발한 72단 3D NAND FLASH로, 기존 48단 제품 대비 동위 단위면적당 셀의 수가 많아 고용량 확보에 유리함. SSD와 모바일 기기에 적용 예정이며 향후 매출 기여 예상됨.
	2) 2znm 8Gb GDDR6	2znm Tech. 기반의 GDDR6 제품으로 384개의 정보입출구(I/O)를 활용해 초당 최대768GB의 그래픽 데이터 처리가 가능.

		향후 인공지능 및 가상 현실 등의 솔루션 등에 활용되며 매출 확대 효과 발생 예상됨.
	3) 3D PCIe NVMe Client SSD	72단 3D NAND를 적용한 PCIe Client SSD 제품으로, 기존 36단 제품을 72단으로 전환함으로써 수익성 개선에 기여 전망
	4) 3D UFS 2.1	원가와 성능을 개선한 2세대 UFS 컨트롤러를 탑재하고, 기존 적용하던 36단 3D NAND를 48단으로 전환해 향후 수익성 개선에 기여 전망
	5) 3D eMMC 5.1	기존 적용하던 36단 3D NAND를 72단으로 전환하고, 자체 개발한 eMMC 컨트롤러를 적용해 매출 확대에 기여 예상
	6) 2znm 8Gb HBM2 Gen1	TSV 기술을 활용해 대역폭을 크게 늘림으로써 초당 204GB의 Data 처리가 가능한 초고속/저전력 제품. 고객과의 협업체계 구축으로 향후 매출 확대 기여 예상

구분	연구과제명	기대효과
제69기	1) 2znm 4Gb LPDDR4	2znm Tech. 파생제품 첫번째로 개발 완료한 프로젝트이며, 2ynm 제품 대비 원가 경쟁력을 갖춘 제품으로 2016년 High End Mobile Phone 시장에서 자사 수익성에 기여할 예정이며, Automobile/Consumer/Computing 등 LPDDR4제품을 활용한 타 어플리케이션 신규 시장 진입으로 향후 매출 확대 효과 발생 예상됨.
	2) 2znm 6Gb LPDDR4	2ynm 6Gb LPDDR4 후속 공정 제품으로 2016년부터 Premium Mobile Phone 시장대응으로 자사 수익성 향상 및 '16년 LPDDR4X 신규 시장 SoC Validation 및 고객샘플 적기 대응으로 향후 매출 기여 예상됨.
	3) 3D eMMC5.1	3D NAND를 사용한 첫 번째 eMMC 솔루션 개발 완료 프로젝트로, 2D 대비 원가 경쟁력 확보한 3D NAND 통해 수익성 개선 예상함.
	4) 1xnm SATA Enterprise SSD	1xnm NAND 적용한 Enterprise향 SSD 제품 개발 완료. Enterprise SSD 시장 확대 통한 매출 및 수익성 확보할 것으로 기대함.
	5) 3D PCIe Enterprise SSD	3D NAND를 사용한 Enterprise향 PCIe SSD 제품 개발 완료. 3D NAND 및 PCIe NVMe 적용한 첫 제품이기에 매출 확대와 수익성 개선 예상함.
	6) 8MP, 1/4" (90nm BSI, 1.12um, Raw Sensor)	Hi-842 대비 픽셀특성향상, Analog 성능향상, 기능추가(2D-LSC)개선 제품으로 Smartphone의 front & main camera 시장 진입으로 2016년 1Q부터 고객사 양산물량 공급으로 매출 확대 기여할 것으로 예상함.
	7) 5MP, 1/5"(90nm BSI, 1.12um, Raw Sensor)	대형고객 진입을 목표로 픽셀성능 및 센서성능을 개선한 제품으로 1분기부터 매출 확대에 기여할 것으로 예상함.
	8) 2znm 8Gb DDR4	컴퓨팅 시장에서 DDR4의 고용량 DIMM(32GB, 64GB) 및 High Speed 제품 (2666Mbps)에 대한 수요가 커지는 시점에서 수익성 극대화 및 시장 적기대응을 위한 제품 개발로, 서버 및 PC향 대응 및 수익성 기대
	9) 2znm 8Gb GDDR5	게임 콘솔향 GDDR5 판매 확대 및 안정적 시장 확보 및 Graphics High Density / High Speed 수요 전환 대응을 통한 수

		익성 확보 기대
10) 2znm 4Gb DDR3x16		2ynm 4Gb DDR3x16 의 후속 공정 개선을 통한 디지털TV/셋톱박스 등의 시장 장기 공급 대응으로 수익성 확보 기대
11) 2znm 8Gb LPDDR3N		2ynm 8Gb LPDDR3 후속 Tech Version 제품. Net Die 극대화에 따른 Cost 경쟁력을 바탕으로 자사 수익성 극대화에 기여가 예상됨. 또한 Speed Target 2133Mbps 확보로 주요 PC 업체향 대응이 가능하여 2ynm 8Gb LPDDR3 대비 매출 확대가 예상됨.
12) 3D UFS 2.0		3D NAND(36단)를 적용한 UFS2.0 제품 개발 완료. 기존 2D 탑재 제품 대비 성능과 특성이 개선되어 모바일 시장에서 High performance 요구 고객 중심으로 매출 확대 예상
13) 3D SATA Client SSD		3D NAND(48단)을 적용한 SATA Client SSD 제품으로, 3D TLC NAND를 적용한 자사 최초 SATA Client SSD 제품. 주요 PC업체 진입을 통한 매출 확대 및 수익성 개선 예상
14) 1ynm 128Gb TLC		기존 1xnm급 NAND제품의 미세화를 통해 원가경쟁력을 극대화한 제품. 개선된 성능과 특성으로 Mobile / SSD등에 널리 채용될 예정
15) 8MP, 1/4" (90nm BSI, 1.12um, Raw Sensor)		Hi-843 대비 픽셀, Analog/Digital 성능 향상 및 die size 축소로 품질/가격 경쟁력 향상한 제품. 모바일 폰의 전/후방 카메라 시장 진입으로 내년 초부터 매출 확대 기여 예상
16) 5MP, 1/5"(90nm BSI, 1.12um, Raw Sensor)		Hi-553 대비 픽셀, Analog/Digital 성능 향상 및 net die 증가로 품질/가격 경쟁력 향상한 제품. 모바일 시장 진입으로 향후 매출 확대에 기여 예상
17) 5MP, 1/4"(90nm BSI, 1.4um, Raw Sensor)		Hi-545대비 성능은 동등 수준 이상을 유지하며 net die를 극대화한 제품으로 향후 매출 기여 기대
18) 13MP, 1/3"(90nm BSI, 1.12um, Raw Sensor)		13M 고화소 제품으로, Hi-1331대비 성능이 향상되었으며올 하반기에 고객사들의 인증을 거쳐 향후 매출 발생 예상
19) 2zm 4Gb DDR4		2ym 4Gb DDR4 의 후속 공정 미세화 제품으로 '17년 이후 DDR4 기반의 디지털TV, 셋톱박스 등의 시장 확대로 매출 확대 예상
20) 2znm 8Gb LPDDR4X		고용량, 고속, 저전력 특성의 LPDDR4 파생제품으로서 플래그십 스마트폰 모델 탑재를 통한 매출 기여 예상. 향후 그래픽 등 다른 응용처에 대한 대응도 예상 중
21) 2znm 2Gb LPDDR4		DRAM 양산 제품 최소로 2znm 기술에서 On-die ECC (Error Correction Code) Scheme 탑재한 제품으로, 모뎀과 오토모티브 등의 응용처를 통한 매출 예상
22) 2znm 6Gb LPDDR4E		2znm 6Gb LPDDR4 의 파생제품으로 '17년 상반기부터 고사양 스마트폰에 대한 양산물량 공급으로 매출 확대 기여
23) 3D PCIe NVMe Client SSD		3D NAND(36단)을 적용한 PCIe Client SSD 제품으로 제품 판매를 통한 매출 기여와 함께 2D에서 3D로 NAND 기술 전환 통해 수익성 개선 예상

구 분	연구과제명	기대효과
제68기	1) 2y나노급 6Gb LPDDR3	미세공정 전환을 통한 수익성 개선 제품으로 High-end Smartphone & Tablet 向 LPDDR3 제품 개발을 통한 매출 확대

	에 기여할 것으로 예상
2) 1x나노급 64Gb TLC	3 bit cell 기술을 기반으로 개발된 저가 시장 대응용 제품임, 우수한 원가 경쟁력을 바탕으로 USB, Card 시장부터 Mobile시장 까지 진입할 예정임
3) 1x나노급 1st PCIe Client SSD	1x나노급 NAND를 채용한 PCIe 컨트롤러 탑재 1st Client SSD 제품으로 SATA에 이은 PCIe SSD 시장 진출 기반을 마련하였고, SSD 라인업이 보강되어 고객 확대에 기여할 것으로 예상됨.
4) 1x나노급 2nd eMMC5.0	1x나노급 NAND를 채용한 eMMC 5.0 제품 개발 완료. 기존 제품 대비 Sequential Write(연속 쓰기)와 Sustain Performance를 개선하였으며, 차세대 eMMC5.1 기능 일부를 추가 반영하여 Mid-high 시장의 수익성 개선에 기여 할 것으로 예상됨.
5) 2M, 1/5" (130nm, 1.75um, Raw Sensor)	기존 2M SoC Sensor에서 Image Signal Processor를 제외한 Raw Sensor 제품으로서 보급형 스마트폰 시장의 Low Cost Solution 요구를 만족시킴으로서 2M SOC 시장을 대체해 갈 것으로 예상됨.
6) 2y나노급 2Gb DDR3(x16)	Embedded Application 4Gb 수요의 점진적 확대에도 불구하고 2015년 이후에도 DTV/STB 2Gb 수요가 견조할 것으로 예상되며, 미세공정 전환을 통한 수익성 개선이 예상됨
7) 1x나노급 1st eMMC5.1	1x나노급 NAND를 채용한 eMMC5.1 제품으로 eMMC5.1 초기 시장에 진입할 제품이 준비됨에 따라 모바일 솔루션 시장에서의 매출과 수익성 확보에 기여할 것으로 예상함
8) 1x나노급 2nd Client SSD	1x나노급 NAND를 채용한 Client SSD로 TLC NAND를 적용한 채널향 제품으로 기존 MLC NAND를 활용한 SSD 대비 원가 경쟁력 확보하였으며, OEM 시장에 이어 Channel 시장 매출 확대 로 SSD 수익성이 개선될 것으로 예상됨
9) 8MP, 1/4" (90nm BSI, 1.12um, Raw Sensor)	설계 개선을 통해 원가경쟁력을 증대시킨 수익성 개선 제품으로 중국 등 Mid-end 스마트폰의 전후방 카메라와 태블릿 시장 진입으로 하반기 이후 매출 확대에 기여할 것으로 예상
10) 2z나노급 4Gb DDR3	2z나노급 DRAM 제품으로 원가경쟁력 증대로 수익성 개선이 예상되며 4Gb DDR3 시장 지속 대응 예정.
11) 1x나노급 1st UFS2.0	1x나노급 NAND를 채용한 UFS2.0 제품 개발 완료. UFS 시장 초기에 제품 출시하여 High-end 시장에서의 경쟁력 강화될 것으로 예상됨.
12) 36단 128Gb MLC	NAND 차세대 기술로 주목받고 있는 3D 적층 기술을 적용한 자사의 첫 상용화 제품으로, 우수한 특성과 신뢰성을 가졌으며 향후 모바일 시장을 중심으로 매출에 기여할 것으로 예상됨.
13) 1xnm급 PCIe NVMe Client SSD	PCIe NVMe 인터페이스 적용한 Client SSD 개발 완료. Client 시장이 SATA에서 NVMe 시장으로 전환되고 있어 Client 시장 점유율 확대에 기여할 것으로 기대함.
14) 1xnm급 SATA Client SSD	1xnm급 NAND 채용한 3번째 SATA Client SSD 개발 완료. 기존 SATA 컨트롤러 대비 여러 정정능력 개선한 컨트롤러 사용. TLC NAND 비즈니스 규모 확대하여 수익성 개선될 것으로 예상함.
15) 5MP, 1/5" (90nm BSI, 1.12um, Raw Sensor)	Hi-551 대비 설계 개선을 통해 원가경쟁력을 증대시킨 수익성 개선 제품으로 중국 및 국내 Mid-end 스마트폰의 front & main 카메라 시장 진입으로 4분기부터 매출 확대 기여.

11. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. 최근 3년간 신용등급

[국내]

평가일	평가대상 유가증권 등	신용등급	평가회사	신용평가 등급범위	평가구분
15.05.27	회사채	AA-	한기평	AAA ~ D	정기평가
15.05.27	회사채	AA-	한신평	AAA ~ D	정기평가
15.05.28	회사채	AA-	NICE신평	AAA ~ D	정기평가
15.06.25	기업어음	A1	한기평	A1~D	본평가
15.06.25	기업어음	A1	한신평	A1~D	본평가
15.06.26	기업어음	A1	NICE신평	A1~D	본평가
15.08.13	회사채	AA-	한기평	AAA ~ D	본평가
15.08.13	회사채	AA-	한신평	AAA ~ D	본평가
15.08.13	회사채	AA-	NICE신평	AAA ~ D	본평가
15.11.13	기업어음	A1	한기평	A1~D	정기평가
15.11.13	기업어음	A1	한신평	A1~D	정기평가
15.11.13	기업어음	A1	NICE신평	A1~D	정기평가
15.11.13	회사채	AA-	한기평	AAA ~ D	본평가
15.11.13	회사채	AA-	한신평	AAA ~ D	본평가
15.11.13	회사채	AA-	NICE신평	AAA ~ D	본평가
16.02.03	회사채	AA-	한신평	AAA ~ D	본평가
16.02.04	회사채	AA-	한기평	AAA ~ D	본평가
16.02.04	회사채	AA-	NICE신평	AAA ~ D	본평가
16.05.17	기업어음	A1	한기평	A1~D	본평가
16.05.16	기업어음	A1	한신평	A1~D	본평가
16.05.17	기업어음	A1	NICE신평	A1~D	본평가
16.05.17	회사채	AA-	한기평	AAA ~ D	본평가
16.05.16	회사채	AA-	한신평	AAA ~ D	본평가
16.05.17	회사채	AA-	NICE신평	AAA ~ D	본평가
16.12.15	기업어음	A1	한기평	A1~D	정기평가
16.12.08	기업어음	A1	한신평	A1~D	정기평가
16.12.16	기업어음	A1	NICE신평	A1~D	정기평가
17.05.19	회사채	AA-	한신평	AAA ~ D	정기평가
17.06.08	회사채	AA-	한기평	AAA ~ D	정기평가
17.06.30	회사채	AA-	NICE신평	AAA ~ D	정기평가
17.11.07	회사채	AA-	한신평	AAA ~ D	수시평가
17.11.09	회사채	AA-	한기평	AAA ~ D	수시평가
17.11.15	회사채	AA-	NICE신평	AAA ~ D	수시평가
18.04.26	회사채	AA	NICE신평	AAA ~ D	정기평가

[해외]

평가일	평가대상 유가증권등	평가대상 유 가증권의 신용등급	평가회사	신용평가등급 범위	평가구분
16.05.13	발행회사	BB+	S & P	AAA ~ D	수시평가
16.11.07	발행회사	Ba1	Moody's	Aaa ~ C	수시평가
17.01.20	발행회사	BBB-	S & P	AAA ~ D	수시평가
17.11.06	발행회사	Baa3	Moody's	Aaa ~ C	수시평가
17.11.23	발행회사	BBB-	S & P	AAA ~ D	수시평가

[참고] 국내 신용평가사 (NICE신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가) 등급정의

신용등급	등급의 정의
AAA	원리금 지급확실성이 최고 수준임
AA	원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있음
A	원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음
BBB	원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있음
BB	원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음
B	원리금 지급능력이 부족하여 투기적임
CCC	원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있음
CC	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높음
C	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높음
D	현재 채무불이행 상태에 있음

※ AA ~ B등급까지는 상대적 우열에 따라 "+" 또는 "-"기호를 부여함.

[참고] 국내 신용평가사(NICE신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가) 기업어음의 등급정의

신용등급	등급의 정의
A1	적기상환능력이 최상이며, 상환능력의 안정성 또한 최상임
A2	적기상환능력이 우수하나, 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임
A3	적기상환능력이 양호하며, 그 안정성도 양호하나 A2에 비해 열위임
B	적기상환능력이 적정시되나, 단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음
C	적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼
D	상환 불능상태임

※ A2 ~ B등급까지는 상대적 우열에 따라 "+" 또는 "-"기호를 부여함.

[참고] 해외 신용평가사 Moody's 등급 정의

신용등급	등급의 정의
Aaa	최소한의 신용 리스크를 보이며, 최고의 신용상태를 가진 것으로 판단됨.
Aa	신용상태가 우수한 것으로 판단되며 신용리스크가 매우 낮음.
A	중상위 등급으로 간주되며 신용 리스크가 낮음.
Baa	신용 리스크가 보통 수준임. 이들은 중위 등급으로 간주되며 그에 따라 일부 투기적 특징을 가질 수 있음.
Ba	투기적 요소가 있는 것으로 판단되며 신용 리스크가 상당한 수준임.
B	투기적인 것으로 간주되며 신용 리스크가 높음.
Caa	신용상태가 불량한 것으로 판단되며 신용 리스크가 매우 높음.
Ca	투기성이 매우 높고 부도상태이거나 부도에 매우 근접해 있을 가능성이 높으며 원리금 회수 가능성이 어느 정도 있음.
C	채권의 최하 등급. 일반적으로 부도상태이고 원리금 회수 가능성이 거의 없음.

※ Aa부터 Caa까지 각 일반 등급 분류에 1,2,3의 숫자를 부여함. 숫자 1은 해당 등급 분류 내에서 상위에 있음을, 숫자 2는 중위에, 숫자 3은 하위에 있음을 나타냄.

[참고] 해외 신용평가사 S&P 등급 정의

신용등급	등급의 정의
AAA	채무상환능력이 극히 높음. 최상 등급임.
AA	채무상환능력이 매우 높음, 상위 등급과 크게 차이는 없으나 최고 수준은 아님.
A	채무상환능력이 높음, 상위 등급의 기업에 비해서는 경기침체와 시장환경변화의 영향을 받기 쉬움.
BBB	채무상환능력은 충분하나, 상위 등급의 기업에 비해서는 경기침체와 시장환경변화의 영향을 받기 쉬움.
BB	가까운 장래에 채무불이행이 발생할 가능성은 비교적 적으나, 경영상태, 재무상황, 경제상황이 악화될 경우 채무불이행 가능성이 충분히 고려됨
B	현재로서는 채무상환능력이 있으나, 상위 등급의 기업에 비해 경영상태, 재무상황, 경제상황이 악화될 경우 채무불이행 가능성이 높음.
CCC	현재 채무불이행 가능성이 있으며, 채무이행 능력은 경영, 재무, 경제 상황이 호의적일 경우에만 있다고 보여짐.
CC	채무불이행 가능성이 현재로서 상당히 높음.
D	채무만기시 1건 이상의 채무를 상환하지 못한 기업을 의미함.

※ AA등급에서 CCC등급까지는 해당 등급에서의 상대적인 위치에 따라 '+', '-'를 추가로 부여할 수 있음.

나. 회사의 고객관리 정책

당사는 IT 산업을 대표하는 글로벌 기업으로서 당사 매출기여도가 매우 높고 당사 판매 전략과 부합하는 고객을 '전략 고객(Strategic Account, S/A)'으로 정하여 관리하고 있으며, 각 응용 분야별 전략 고객의 관리를 통하여 안정적인 매출 기반을 확보함은 물론 제품 구성을 다양화하여 수익성을 극대화하고 있습니다.

다. 지식재산권 보유현황

2018년 3월 31일 현재 당사는 반도체와 관련하여 총 12,502건(특허 12,303건/상표 199건)의 지식재산권을 보유하고 있습니다. 통상적으로 등록권리는 해마다 증가하나, 매분기 기 등록된 권리를 평가하여 등록유지 또는 포기여부를 결정하고 있어 포기된 권리로 인해 그 수치가 다소 변동할 수 있습니다.

당사 지식재산권은 전문인력으로 구성된 전담조직에 의해 관리되고 있으며, 당해 전문인력은 지식재산권 개발, 출원/등록, 사후관리 및 관련 분쟁 대응 등을 담당하고 있습니다.

특허권 및 상표권은 각국 특허법 및 상표법에 근거하여 보호되고 있습니다. 특허권의 존속기간은 출원일로부터 20년이고, 상표권은 등록일로부터 10년이며 상표권은 갱신등록절차를 통해 존속기한을 연장할 수 있습니다.

라. 정부나 지방자치단체의 법률 규정 등에 의한 규제사항

'산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률 제11조'에 의하여 국가핵심기술로 지정된 반도체 제조기술을 해외로 이전하는 경우, 수출자는 산업통상자원부에 신고할 의무를 지니고 있습니다. 이에 당사는 제품개발 경쟁력 강화를 위한 해외 생산공장 및 기술센터에 반도체 기술 이전 시 관련법 및 절차를 준수 이행하고 있습니다.

마. 환경보호 정책 및 현황

(1) SHE경영시스템 인증

당사는 국제 인증규격인 OHSAS18001(안전보건경영시스템) 및 ISO14001(환경경영시스템)과 국내 인증규격인KOSHA18001(안전보건경영시스템)을 취득하여 유지관리하고 있으며, 이를 통해 SHE경영활동의 객관성 확보 및 효과를 극대화하기 위한 활동들을 수행하고 있습니다. SHE 경영시스템 내부 전문심사원을 양성하여 기업활동으로 인해 발생하는 안전보건환경 영향요인을 모니터링하고, 또한 이를 효율적으로 관리하기 위해 전담조직을 구성하여 체계적으로 관리하고 있습니다. 당사는 안전보건 및 환경 분야의 지속적인 개선을 추구하고, 환경영향을 최소화하고 건강하고 안전한 사업장을 구축하기 위한 노력을 지속적으로 수행해 나갈 것입니다.

(2) 기후변화 협약 대응

당사는 기후변화와 관련된 유무형의 위험과 기회 관리를 위해 기후변화 관련 규제를 준수하며 적극적으로 대응하고 있습니다. 또한 기후변화로 인해 발생할 수 있는 비용 및 제품 품질 관리를 위한 전략을 마련하고 고객 및 정부의 신뢰도를 지속적으로 확보하여 환경에 대한 새로운 가치를 창출할 수 있도록 전사적 수준의 대응을 하고 있습니다.

[온실가스 배출권거래제 대응]

SK하이닉스는 2015년부터 시행되고 있는 온실가스 배출권거래제에서 할당된 목표량을 달성하기 위해 온실가스 저감 활동을 펼치고 있습니다. 온실가스 배출권거래제는 정부가 각 기업에게 온실가스를 배출할 수 있는 배출권을 부여하고 기업들은 시장원리에 의해 형성된 배출권 가격을 토대로 각 기업별 한계저감비용에 따라 배출권을 매입하거나 매도하는 제도입니다. SK하이닉스는 배출권 부족분(초과 배출량)의 구매 비용을 최소화하기 위해 온실가스 저감장치(스크러버) 측정 기술을 개발/운영하여 배출량 저감을 유도하고 있으며, 배출권 거래를 포함한 배출권 관리, 배출권 감축 등의 전사 TF 활동을 추진하고 있습니다.

[CDP(탄소정보 공개 프로젝트) 탄소경영 최우수기업 5년 연속 선정, 명예의 전당 5년차 유지]

당사는 탄소정보 공개 프로젝트(CDP: Carbon Disclosure Project) 한국위원회가 선정하는 탄소경영 최우수 그룹인 '탄소경영 글로벌 리더스 클럽'에 6년 연속 편입되어 국내 최초, 국내 유일 기업으로 명예의 전당에 입성, 2017년 명예의 전당 5년차를 유지하였습니다.

(3) 친환경제품을 위한 노력

[전과정 평가(Life Cycle Assessment, LCA)/물발자국/탄소성적]

당사는 매년 DRAM 및 NAND Flash 메모리의 주요 제품에 대하여 전과정평가를 수행하고 있습니다. 회사는 2013년 환경부로부터 20나노급 4G DDR3 제품에 대하여 업계 최초 환경성적표지 인증을 획득하였으며, 2014년에는 20나노급 64Gb NAND Flash 제품까지 인증을 확대 하는 등 지속적으로 LCA 평가결과에 대한 제 3자 인증을 확대하고 있습니다. 특히 2016년에는 국내 최초로 20나노급 4Gb DDR3 제품에 대하여 미국 UL社로부터 물발자국 인증을 획득하였습니다.

2017년에는 정부에서 주도하는 물발자국 시범사업에 참여하여 8Gb LPDDR3 제품을 통해 반도체 최초 인증을 획득하였습니다. 이번 물발자국 인증 뿐만 아니라 향후 지속적인 추진을 통해 단계적으로 인증 제품을 확대하여 당사의 주요 제품군에 대해 물발자국 인증을 받을 수 있도록 할 계획입니다.

(4) 기타 환경보호 정책

2009년 5월, 환경경영에 대한 투명성 및 진정성을 확보하기 위해 국내 대표적 NGO인 환경운동연합 및 환경경영 전문가로 환경경영검증위원회를 구성하여, 당사 환경경영성과에 대한 검증을 진행하여 환경경영검증위원회 보고서를 발행하였습니다. 2010년도부터는 검증위원회를 자문위원회로 변경, 환경경영자문위원회를 개최하고 있으며, 당사의 전반적인 환경경영 및 환경전략 관련 의견을 수렴하여 경영활동에 반영하고 있습니다.

또한 2015년도에는 외부 전문가로 구성된 산업보건검증위원회를 발족하여 당사의 작업환경 및 복지제도 등 보건분야 진단을 통해 127개 개선과제를 도출하였고 현재 검증위 개선과제 127개 중 127건을 모두 완료하였습니다. 2018년 4월에 산업보건검증위원회로부터 최종 검증 완료보고서를 수취하였으며, 127개 과제 중 5개(개선부족)를 제외한 122개 과제가 완료 또는 진행 중으로 검증되어 최종 개선률은 약 96% 수준으로 확인되었습니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

(단위 :백만원)

구 분	제71기 1분기	제70기	제69기
[유동자산]	17,632,878	17,310,444	9,838,982
· 현금및현금성자산	3,477,358	2,949,991	613,786
· 단기금융상품	3,312,376	4,674,862	1,951,721
· 단기투자자산	1,476,079	929,801	1,570,172
· 매출채권	5,574,098	5,552,795	3,251,652
· 재고자산	3,103,142	2,640,439	2,026,198
· 기타	689,825	562,556	425,453
[비유동자산]	31,492,245	28,108,020	22,377,044
· 관계기업 및 조인트벤처투자	350,031	359,864	131,016
· 장기투자자산	56,120	43,226	147,779
· 유형자산	27,364,769	24,062,601	18,777,402
· 무형자산	2,304,852	2,247,290	1,915,591
· 기타	1,416,473	1,395,039	1,405,256
자산총계	49,125,123	45,418,464	32,216,026
[유동부채]	9,352,773	8,116,133	4,160,849
[비유동부채]	3,393,864	3,481,412	4,031,647
부채총계	12,746,637	11,597,545	8,192,496
[지배기업 소유주지분]	36,371,828	33,815,280	24,016,955
· 자본금	3,657,652	3,657,652	3,657,652
· 자본잉여금	4,143,736	4,143,736	4,143,736
· 기타포괄손익누계액	-342,468	-502,264	-79,103
· 기타자본항목	-770,825	-771,100	-771,913
· 이익잉여금	29,683,733	27,287,256	17,066,583
[비지배지분]	6,658	5,639	6,575
자본총계	36,378,486	33,820,919	24,023,530
매출액	8,719,691	30,109,434	17,197,975
영업이익	4,367,338	13,721,326	3,276,746
연결총당기순이익	3,121,329	10,642,219	2,960,483
지배기업의 소유주지분	3,120,254	10,641,512	2,953,774
비지배지분	1,075	707	6,709
기본주당순이익	4,420 원	15,073 원	4,184 원
연결에 포함된 회사수	23개사	24개사	23개사

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

※ 제71기 1분기의 재무상태표에 해당하는 부분은 2018년 3월 31일 기준이며, 포괄손익계산서에 해당하는 부

분은 2018년 3월 31일까지의 누계 기준으로 작성되었습니다.

※ MMT 특정금전신탁은 연결에 포함된 회사수에서 제외하였습니다.

나. 요약 별도재무정보

(단위 : 백만원)

구분	제71기 1분기	제70기	제69기
[유동자산]	15,459,529	15,338,930	7,933,301
· 현금및현금성자산	2,836,259	2,270,036	476,917
· 단기금융상품	3,163,900	4,528,880	1,917,500
· 단기투자자산	815,835	580,449	570,442
· 매출채권	5,436,158	5,259,052	2,896,443
· 재고자산	2,605,151	2,224,740	1,698,723
· 기타	602,226	475,773	373,276
[비유동자산]	32,467,903	28,973,916	23,465,792
· 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자	5,231,481	4,778,280	4,588,062
· 장기투자자산	46,064	37,593	143,590
· 유형자산	24,285,654	21,322,943	16,071,281
· 무형자산	1,977,835	1,918,259	1,546,733
· 기타	926,869	916,841	1,116,126
자산총계	47,927,432	44,312,846	31,399,093
[유동부채]	9,295,372	8,076,214	4,351,661
[비유동부채]	3,378,294	3,464,757	3,955,919
부채총계	12,673,666	11,540,971	8,307,580
[자본금]	3,657,652	3,657,652	3,657,652
[자본잉여금]	4,183,564	4,183,564	4,183,564
[기타포괄손익누계액]	0	-10,735	-
[기타자본항목]	-770,825	-771,100	-771,913
[이익잉여금]	28,183,375	25,712,494	16,022,210
자본총계	35,253,766	32,771,875	23,091,513
종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법
매출액	8,745,834	29,718,939	16,733,111
영업이익	4,365,063	13,340,791	3,012,419
당기순이익	3,194,653	10,110,797	2,655,022
기본주당순이익	4,525 원	14,321 원	3,761 원

※ 한국채택국제회계기준에 따라 별도기준으로 작성되었습니다.

※ 제71기 1분기의 재무상태표에 해당하는 부분은 2018년 3월 31일 기준이며, 포괄손익계산서에 해당하는 부분은 2018년 3월 31일까지의 누계 기준으로 작성되었습니다.

2. 연결재무제표

연결 재무상태표

제 71 기 1분기말 2018.03.31 현재

제 70 기말 2017.12.31 현재

(단위 : 백만원)

	제 71 기 1분기말	제 70 기말
자산		
유동자산	17,632,878	17,310,444
현금및현금성자산	3,477,358	2,949,991
단기금융상품	3,312,376	4,674,862
단기투자자산	1,476,079	929,801
매출채권	5,574,098	5,552,795
기타수취채권	53,127	37,613
재고자산	3,103,142	2,640,439
당기법인세자산	421	1,305
기타유동자산	636,277	523,638
비유동자산	31,492,245	28,108,020
관계기업 및 공동기업투자	350,031	359,864
장기투자자산	56,120	43,226
기타수취채권	46,571	42,410
기타금융자산	283	273
유형자산	27,364,769	24,062,601
무형자산	2,304,852	2,247,290
투자부동산	2,442	2,468
이연법인세자산	610,667	599,783
기타비유동자산	756,510	750,105
자산총계	49,125,123	45,418,464
부채		
유동부채	9,352,773	8,116,133
매입채무	779,527	758,578
단기미지급금	4,622,901	2,724,547
기타지급채무	670,845	1,340,225
차입금	598,104	773,780
총당부채	63,540	81,351
당기법인세부채	2,508,545	2,385,876
기타유동부채	109,311	51,776
비유동부채	3,393,864	3,481,412
기타지급채무	3,562	3,412

장기차입금	3,268,605	3,397,490
확정급여부채	49,644	6,096
이연법인세부채	2,708	5,554
기타비유동부채	69,345	68,860
부채총계	12,746,637	11,597,545
자본		
지배기업의 소유지분	36,371,828	33,815,280
자본금	3,657,652	3,657,652
자본잉여금	4,143,736	4,143,736
기타자본	(770,825)	(771,100)
기타포괄손익누계액	(342,468)	(502,264)
이익잉여금	29,683,733	27,287,256
비지배지분	6,658	5,639
자본총계	36,378,486	33,820,919
자본과부채총계	49,125,123	45,418,464

연결 포괄손익계산서

제 71 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지

제 70 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 71 기 1분기		제 70 기 1분기	
	3개월	누적	3개월	누적
매출액	8,719,691	8,719,691	6,289,518	6,289,518
매출원가	3,383,214	3,383,214	2,984,822	2,984,822
매출총이익	5,336,477	5,336,477	3,304,696	3,304,696
판매비와관리비	969,139	969,139	837,097	837,097
영업이익	4,367,338	4,367,338	2,467,599	2,467,599
금융수익	240,135	240,135	377,849	377,849
금융비용	313,278	313,278	467,249	467,249
지분법투자 관련 손익	4,526	4,526	(227)	(227)
기타영업외수익	7,066	7,066	5,592	5,592
기타영업외비용	14,977	14,977	13,421	13,421
법인세비용차감전순이익	4,290,810	4,290,810	2,370,143	2,370,143
법인세비용	1,169,481	1,169,481	471,465	471,465
당기순이익	3,121,329	3,121,329	1,898,678	1,898,678
법인세차감후 기타포괄손익	141,965	141,965	(329,711)	(329,711)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익				
확정급여제도의 재측정요소	(7,040)	(7,040)	(4,170)	(4,170)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)				
해외사업장환산외환차이	150,244	150,244	(315,967)	(315,967)
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	(1,239)	(1,239)	(9,574)	(9,574)
총포괄이익	3,263,294	3,263,294	1,568,967	1,568,967
당기순이익의 귀속				
지배기업의 소유주지분	3,120,254	3,120,254	1,897,969	1,897,969
비지배지분	1,075	1,075	709	709
총 포괄손익의 귀속				
지배기업의 소유주지분	3,262,275	3,262,275	1,568,951	1,568,951
비지배지분	1,019	1,019	16	16
주당이익				
기본주당순이익 (단위 : 원)	4,420	4,420	2,688	2,688
희석주당순이익 (단위 : 원)	4,419	4,419	2,688	2,688

연결 자본변동표

제 71 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지

제 70 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지

(단위 : 백만원)

	자본							
	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	자본 합계
	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계		
2017.01.01 (기초자본)	3,657,652	4,143,736	(771,913)	(79,103)	17,066,583	24,016,955	6,575	24,023,530
당기순이익					1,897,969	1,897,969	709	1,898,678
확정급여제도의 재측정요소					(4,170)	(4,170)		(4,170)
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분				(9,574)		(9,574)		(9,574)
해외사업장환산외환차이				(315,274)		(315,274)	(693)	(315,967)
배당금지급					(423,601)	(423,601)		(423,601)
주식선택권 부여			23			23		23
2017.03.31 (기말자본)	3,657,652	4,143,736	(771,890)	(403,951)	18,536,781	25,162,328	6,591	25,168,919
2018.01.01 (기초자본)	3,657,652	4,143,736	(771,100)	(491,529)	27,276,521	33,815,280	5,639	33,820,919
당기순이익					3,120,254	3,120,254	1,075	3,121,329
확정급여제도의 재측정요소					(7,040)	(7,040)		(7,040)
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분				(1,239)		(1,239)		(1,239)
해외사업장환산외환차이				150,300		150,300	(56)	150,244
배당금지급					(706,002)	(706,002)		(706,002)
주식선택권 부여			275			275		275
2018.03.31 (기말자본)	3,657,652	4,143,736	(770,825)	(342,468)	29,683,733	36,371,828	6,658	36,378,486

연결 현금흐름표

제 71 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지

	제 71 기 1분기	제 70 기 1분기
영업활동현금흐름	4,523,576	2,820,020
영업으로부터 창출된 현금흐름	5,575,680	3,007,646
이자의 수취	28,192	2,619
이자의 지급	(30,195)	(29,920)
배당금의 수취	346	
법인세의 납부	(1,050,447)	(160,325)
투자활동현금흐름	(3,709,452)	(1,396,667)
단기금융상품의 순증감	1,301,927	130,000
단기투자자산의 순증감	(491,621)	685,229
기타수취채권의 감소	2,189	3,559
기타수취채권의 증가	(6,033)	(3,362)
장기투자자산의 처분	558	452
장기투자자산의 취득	(12,994)	(1,799)
기타금융자산의 감소		1
기타금융자산의 증가		
파생상품거래로 인한 현금유입		203
파생상품거래로 인한 현금유출		(308)
유형자산의 처분	5,971	2,125
유형자산의 취득	(4,317,223)	(2,018,470)
무형자산의 처분		
무형자산의 취득	(192,226)	(194,297)
재무활동현금흐름	(301,005)	177,535
차입금의 차입	298,732	344,893
차입금의 상환	(599,737)	(167,358)
배당금의 지급		
현금및현금성자산의 환율변동효과	14,248	(51,888)
현금및현금성자산의 순증감	527,367	1,549,000
기초 현금및현금성자산	2,949,991	613,786
기말 현금및현금성자산	3,477,358	2,162,786

3. 연결재무제표 주석

1. 회사의 개요

(1) 지배기업의 개요

에스케이하이닉스 주식회사(이하 "지배기업")는 1996년에 주식을 한국거래소에 상장한 공개법인으로, 1949년 10월 15일에 설립되어 메모리반도체의 제조 및 판매업을 주업으로 하고 있습니다. 지배기업은 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091에 본사와 경기도 성남시 등에 사무소를 두고 있습니다. 지배기업과 그 종속기업(이하 "연결실체")은 경기도 이천시와 충청북도 청주시, 중국 우시(Wuxi)와 충칭(Chongqing)에 생산공장을 설치·가동하고 있습니다.

한편, 2018년 3월 31일 현재 지배기업의 주주현황은 다음과 같습니다.

구 분	소유주식수(주)	지분율(%)
SK텔레콤(주)	146,100,000	20.07
국민연금공단 및 기타주주	559,901,795	76.91
자기주식	22,000,570	3.02
합 계	728,002,365	100.00

당분기말 현재 지배기업의 주식은 한국거래소가 개설하는 유가증권시장에, 주식예탁증서는 룩셈부르크 증권거래소에 상장되어 있습니다.

(2) 당분기말과 전기말 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

종속기업명	소재지	주요영업활동	결산월	소유지분율(%)	
				당분기말	전기말
에스케이하이이엔지㈜	국 내	사업지원 및 서비스	12월	100	100
에스케이하이텍㈜	국 내	사업지원 및 공사 등	12월	100	100
㈜실리콘화일(*1)	국 내	전자·전기부품 개발 및 제조	12월	-	100
행복모아㈜	국 내	사업지원 및 제조	12월	100	100
에스케이하이닉스 시스템아이씨㈜	국 내	파운드리 사업	12월	100	100
SK hynix America Inc.(SKHYA)	미 국	해외판매법인	12월	97.74	97.74
SK hynix Deutschland GmbH(SKHYD)	독 일	해외판매법인	12월	100	100
SK hynix Asia Pte. Ltd.(SKHYS)	싱가포르	해외판매법인	12월	100	100
SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd.(SKHYH)	홍 콩	해외판매법인	12월	100	100
SK hynix U.K. Ltd.(SKHYU)	영 국	해외판매법인	12월	100	100
SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.(SKHYT)	대 만	해외판매법인	12월	100	100
SK hynix Japan Inc.(SKHYJ)	일 본	해외판매법인	12월	100	100
SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.(SKHYCS)	중 국	해외판매법인	12월	100	100
SK hynix Semiconductor India Private Ltd.(SKHYIS)(*2)	인 도	해외판매법인	12월	100	100
SK hynix(Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.(SKHYCW)	중 국	해외판매법인	12월	100	100
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.(SKHYCL)	중 국	해외제조법인	12월	100	100
SK hynix Semiconductor (Wuxi) Ltd.(SKHYMC)	중 국	해외제조법인	12월	100	100
SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.(SKHYCQL)(*3)	중 국	해외제조법인	12월	100	100
SK hynix Italy S.r.l.(SKHYIT)	이탈리아	해외연구개발법인	12월	100	100
SK hynix memory solutions Inc.(SKHMS)	미 국	해외연구개발법인	12월	100	100
SK hynix Flash Solution Taiwan(SKHYFST)	대 만	해외연구개발법인	12월	100	100
Softeq Flash Solutions LLC.(SOFTEQ)	벨라루스	해외연구개발법인	12월	100	100
SK APTECH Ltd.(SKAPTECH)	홍 콩	해외투자법인	12월	100	100
SK hynix Ventures Hong Kong Limited(SKH Ventures)	홍 콩	해외투자법인	12월	100	100
MMT(특정금전신탁)	국 내	특정금전신탁	12월	100	100

(*1) 당분기 중 에스케이하이닉스 시스템아이씨㈜가 ㈜실리콘화일을 흡수합병하였습니다.

(*2) 종속기업인 SK hynix Asia Pte. Ltd.(SKHYS)의 종속기업입니다.

(*3) 종속기업인 SK APTECH Ltd.(SKAPTECH)의 종속기업입니다.

(3) 당분기 중 연결대상 종속기업의 변동내역은 다음과 같습니다.

구 분	기업명	사 유
종속기업 제외	㈜실리콘화일	합병으로 인한 소멸

(4) 당분기말과 전기말 현재 주요 종속기업의 요약 재무상태표는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)						
종속기업명	당분기말			전기말		
	총자산	총부채	총자본	총자산	총부채	총자본
SK hynix America Inc.(SKHYA)	2,486,416	2,178,243	308,173	2,522,348	2,259,210	263,138
SK hynix Deutschland GmbH(SKHYD)	114,017	75,693	38,324	108,470	70,430	38,040
SK hynix Asia Pte. Ltd.(SKHYS)	629,164	554,446	74,718	636,286	559,400	76,886
SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd.(SKHYH)	867,902	769,217	98,685	1,043,889	918,305	125,584
SK hynix U.K. Ltd.(SKHYU)	326,364	311,370	14,994	325,434	308,999	16,435
SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.(SKHYT)	622,899	591,346	31,553	566,155	536,592	29,563
SK hynix Japan Inc.(SKHYJ)	1,116,029	1,052,459	63,570	632,590	569,810	62,780
SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.(SKHYCS)	805,886	765,384	40,502	414,850	379,888	34,962
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.(SKHYCL)	4,436,399	533,489	3,902,910	4,043,100	322,545	3,720,555
SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.(SKHYCQL)	458,039	155,612	302,427	388,033	195,849	192,184

(5) 당분기와 전분기 중 주요 종속기업의 요약 포괄손익계산서는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)						
종속기업명	당분기			전분기		
	매출액	분기순손익	총포괄손익	매출액	분기순손익	총포괄손익
SK hynix America Inc.(SKHYA)	2,997,192	46,490	46,490	2,102,429	24,718	24,718
SK hynix Deutschland GmbH(SKHYD)	121,872	(690)	(690)	111,530	(1,352)	(1,352)
SK hynix Asia Pte. Ltd.(SKHYS)	716,691	(1,829)	(1,829)	515,220	(576)	(576)
SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd.(SKHYH)	1,451,249	(26,026)	(26,026)	2,162,477	(1,112)	(1,112)
SK hynix U.K. Ltd.(SKHYU)	290,593	(1,373)	(1,373)	220,478	(946)	(946)
SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.(SKHYT)	759,872	1,405	1,405	594,164	(11,847)	(11,847)
SK hynix Japan Inc.(SKHYJ)	275,260	(2,638)	(2,638)	179,439	(3,676)	(3,676)
SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.(SKHYCS)	1,765,629	4,223	4,223	44,504	(1,569)	(1,569)
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.(SKHYCL)	575,533	44,964	44,964	513,122	7,457	7,457
SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.(SKHYCQL)	92,511	6,581	6,581	77,076	1,826	1,826

(6) 당분기말과 전기말 현재 연결실체에 대한 중요한 비지배지분은 없습니다.

2. 재무제표 작성기준

(1) 회계기준의 적용

연결실체의 분기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약 연결중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.

연결실체의 분기연결재무제표에는 기업회계기준서 제1109호와 기업회계기준서 제 1115호가 처음 적용되었으며, 유의적인 회계정책의 변경은 주석 3에서 설명하고 있습니다.

(2) 추정과 판단

① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성

한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.

분기연결재무제표에서 사용된 연결실체의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 주석 3에서 설명하고 있는 기업회계기준서 제1109호와 기업회계기준서 제1115호 적용 관련 새로운 중요한 판단과 추정 불확실성의 주요 원천을 제외하고는, 2017년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

② 공정가치 측정

연결실체의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치 측정을 요구하고 있는 바, 연결실체는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있습니다.

평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.

자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 연결실체는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.

- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격
- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수
- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 연결실체는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.

공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 금융위험관리 주석 등에 포함되어 있습니다.

3. 유의적인 회계정책

연결실체는 다음에서 설명하고 있는 사항을 제외하고 2017년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차연결재무제표를 작성할 때 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다. 다음에서 설명하고 있는 회계정책의 변경사항은 2018년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표에도 반영될 것입니다.

(1) 회계정책의 변경

연결실체는 2018년 1월 1일부터 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'과 제1109호 '금융상품'을 최초 적용하였습니다. 2018년 1월 1일 이후 적용되는 다른 기준서들은 연결실체의 분기연결재무제표에 미치는 유의적인 영향이 없습니다.

1) 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'

기업회계기준서 제1115호는 수익을 언제, 얼마나 인식할지를 결정하기 위한 포괄적인 체계입니다. 동 기준서는 현행 기업회계기준서 제1018호 '수익', 제1011호 '건설계약', 기업회계기준해석서 제2031호 '수익: 광고용역의 교환거래', 제2113호 '고객충성제도', 제2115호 '부동산건설약정', 제2118호 '고객으로부터의 자산이전'을 대체하였습니다.

연결실체는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하였습니다. 개정기준서 도입으로 인하여 연결실체에 재무적 영향이 있는 항목은 다음과 같습니다.

① 반품권이 있는 판매 회계처리

연결실체는 고객에게 반도체 제품을 공급하는 계약에 있어 품질하자 등에 따른 반품을 허용하기 때문에 고객으로부터 수령하는 대가가 변동될 수 있습니다. 기업회계기준서 제1115호 적용시 연결실체는 고객으로부터 수령할 대가를 보다 적절하게 예측할 것으로 예상하는 기대값 방법을 사용하여 변동대가를 추정하고, 반품기한이 경과할 때 이미 인식한 누적 수익금액 중 유의적인 부분을 되돌리지 않을 가능성이 매우 높은 금액까지만 변동대가를 거래가격에 포함하여 수익을 인식합니다. 한편, 연결실체가 수령하였거나 수령할 대가 중 권리를 갖게 될 것으로 예상하지 않는 금액은 환불부채(계약부채)로 인식합니다.

② C조건 운송용역 회계처리

기업회계기준서 제1115호 적용시 고객과의 계약에서 제품판매와 제품운송의 수행의무가 식별되었으나 연결실체의 일반적인 거래형태인 도착지인도조건의 매출거래는 제품 운송이 완료된 후 제품의 통제가 이전되므로 두 개의 수행의무가 별도로 구별되지 않는 것으로 판단하였습니다. 하지만 고객이 운송료 또는 보험료를 부담하는 선적지인도조건(이하, "C조건")으로 체결된 수출거래의 경우에는 제품운송 수행의무가 제품에 대한 통제가 고객에게 이전된 이후에 수행되므로 이를 별도의 수행의무로 식별하였으며, C조건 운송용역 매출과 관련된 운송비용을 매출원가로 인식하였습니다.

- 최초 적용일(당기초) 현재 연결재무상태표에 반영한 수정 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)			
계정과목	2017.12.31 수정전	조정	2018. 1. 1 수정후
I. 유동자산			
기타유동자산	523,638	17,884	541,522
기타	16,786,806	-	16,786,806
유동자산 계	17,310,444	17,884	17,328,328
II. 비유동자산	28,108,020	-	28,108,020
자 산 총 계	45,418,464	17,884	45,436,348
I. 유동부채			
총당부채	81,351	(30,672)	50,679
기타유동부채	51,776	48,556	100,332
기타	7,983,006	-	7,983,006
유동부채 계	8,116,133	17,884	8,134,017
II. 비유동부채	3,481,412	-	3,481,412
부 채 총 계	11,597,545	17,884	11,615,429
자 본			
I. 지배기업의 소유지분	33,815,280	-	33,815,280
II. 비지배지분	5,639	-	5,639
자 본 총 계	33,820,919	-	33,820,919
부 채 및 자 본 총 계	45,418,464	17,884	45,436,348

- 2018년 3월 31일 기준 연결실체의 분기연결재무상태표에서 기업회계기준서 제 1115호 적용효과는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)			
계정과목	기업회계기준서 제1115호에 따른 금액	조정	기업회계기준서 제1018호에 따른 금액
I. 유동자산			
기타유동자산	636,277	(18,638)	617,639
기타	16,996,601	-	16,996,601
유동자산 계	17,632,878	(18,638)	17,614,240
II. 비유동자산	31,492,245	-	31,492,245
자 산 총 계	49,125,123	(18,638)	49,106,485
I. 유동부채			
총당부채	63,540	32,351	95,891
기타유동부채	109,311	(50,989)	58,322
기타	9,179,922	-	9,179,922
유동부채 계	9,352,773	(18,638)	9,334,135
II. 비유동부채	3,393,864	-	3,393,864
부 채 총 계	12,746,637	(18,638)	12,727,999
자 본			
I. 지배기업의 소유지분	36,371,828	-	36,371,828
II. 비지배지분	6,658	-	6,658
자 본 총 계	36,378,486	-	36,378,486
부 채 및 자 본 총 계	49,125,123	(18,638)	49,106,485

- 2018년 3월 31일 기준 연결실체의 분기연결포괄손익계산서에서 기업회계기준서 제 1115호 적용효과는 다음과 같으며, 분기연결현금흐름표에 미치는 영향은 중요하지 않습니다.

(단위 : 백만원)			
계정과목	기업회계기준서 제1115호에 따른 금액	조정	기업회계기준서 제1018호에 따른 금액
I. 매출액	8,719,691	-	8,719,691
II. 매출원가	3,383,214	(5,454)	3,377,760
III. 매출총이익	5,336,477	5,454	5,341,931
판매비와관리비	969,139	5,454	974,593
IV. 영업이익	4,367,338	-	4,367,338
금융수익	240,135	-	240,135
금융비용	313,278	-	313,278
지분법투자 관련 손익	4,526	-	4,526
기타영업외수익	7,066	-	7,066
기타영업외비용	14,977	-	14,977
V. 법인세비용차감전순이익	4,290,810	-	4,290,810
법인세비용	1,169,481	-	1,169,481
VI. 분기순이익	3,121,329	-	3,121,329
VII. 법인세차감후 기타포괄손익	141,965	-	141,965
VIII. 총포괄이익	3,263,294	-	3,263,294

2) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'

기업회계기준서 제1109호는 금융자산, 금융부채 및 비금융항목을 매입하거나 매도할 수 있는 일부 계약의 인식과 측정을 규정합니다. 이 기준서는 기업회계기준서 제 1039호 '금융상품: 인식과 측정'을 대체합니다. 연결실체는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1109호를 적용하였으며, 경과규정에 따라 전기 연결재무제표를 재작성하지 않았습니다.

금융상품의 분류와 측정으로 인해 변경된 기초 자본내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
조정내역	기타포괄손익누계액	이익잉여금
기업회계기준서 제1039호에 따른 기초 자본	(502,264)	27,287,256
매도가능금융자산에서 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 재분류	10,735	(10,735)
기업회계기준서 제1109호에 따른 기초 자본	(491,529)	27,276,521

① 금융자산과 금융부채의 분류

기업회계기준서 제1109호는 금융부채의 분류와 측정에 대한 기업회계기준서 제 1039호의 기존 요건을 대부분 유지하였습니다. 그러나 만기보유금융자산, 대여금 및 수취채권과 매도가능금융자산의 금융자산 기존 분류를 삭제하였습니다.

기업회계기준서 제1109호에 의하면, 최초 적용 시에 금융자산은 상각후원가측정 금융자산, 기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품, 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품, 당기손익-공정가치 측정 범주로 분류됩니다. 기업회계기준서 제1109호에 따른 금융자산의 분류는 일반적으로 금융자산이 관리되는 방식인 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름의 특성에 근거하여 결정됩니다. 주계약이 이 기준서의 적용범위에 해당하는 금융자산인 계약에 내재된 파생상품은 분리되지 않습니다.

금융자산은 다음 두 가지 조건을 모두 충족하고, 당기손익-공정가치 측정 항목으로 지정되지 않은 경우 상각후원가로 측정됩니다.

- 계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이 목적인 사업모형 하에서 금융자산이 보유된다.
- 계약 조건에 따라 특정일에 이자와 원금 잔액에 대한 이자 지급만으로 구성되어 있는 현금흐름이 발생한다.

채무상품은 다음 두 가지 조건을 모두 충족하고 당기손익-공정가치 측정 항목으로 지정되지 않은 경우 기타포괄손익-공정가치로 측정됩니다.

- 계약상 현금흐름의 수취와 금융자산의 매도 둘 다를 통해 목적을 이루는 사업모형 하에서 금융자산이 보유된다.
- 계약 조건에 따라 특정일에 이자와 원금 잔액에 대한 이자 지급만으로 구성되어 있는 현금흐름이 발생한다.

단기매매항목이 아닌 지분상품의 최초 인식일에 연결실체는 그 투자지분의 후속적인공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 수 있으며, 그러한 선택을 취소할 수 없습니다. 이러한 선택은 금융상품 별로 이루어집니다.

위에서 설명된 상각후원가, 기타포괄손익-공정가치로 측정되지 않는 모든 금융상품은 모든 파생 금융자산을 포함하여 당기손익-공정가치로 측정됩니다. 연결실체는 상각후원가 또는 기타포괄손익-공정가치로 측정되어야 하는 금융자산을 회계불일치를 제거하거나 유의적으로 줄일 목적으로 해당 금융자산의 최초 인식시점에 당기손익-공정가치 측정 항목으로 지정할 수 있습니다. 다만, 이러한 지정은 취소할 수 없습니다.

최초에 거래가격으로 측정되는 유의적인 금융요소가 없는 매출채권이 아닌 금융자산은 당기손익-공정가치 측정 항목이 아니라면 최초에 공정가치에 취득에 직접 관련되는 거래원가를 가산하여 측정합니다.

다음 회계정책은 금융자산의 후속측정에 적용합니다.

당기손익-공정가치 측정 금융자산	이러한 자산은 후속적으로 공정가치로 측정합니다. 이자와 배당수익을 포함한 순손익은 당기손익으로 인식합니다.
상각후원가 측정 금융자산	이러한 자산은 후속적으로 유효이자율법을 사용하여 상각후원가로 측정합니다. 상각후원가는 손상손실에 의해 감소됩니다. 이자수익, 외화환산손익 및 손상은 당기손익으로 인식합니다. 제거에 따르는 손익도 당기손익으로 인식합니다.
기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품	이러한 자산은 후속적으로 공정가치로 측정합니다. 유효이자율법을 사용하여 계산된 이자수익, 외화환산손익과 손상은 당기손익으로 인식합니다. 다른 순손익은 기타포괄손익으로 인식합니다. 제거시에 기타포괄손익에 누적된 손익은 당기손익으로 재분류합니다.
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품	이러한 자산은 후속적으로 공정가치로 측정합니다. 배당은 배당금이 명확하게 투자원가의 회수를 나타내지 않는다면 당기손익으로 인식합니다. 다른 순손익은 기타포괄손익으로 인식하고 절대로 당기손익으로 재분류되지 않습니다.

최초적용일인 2018년 1월 1일 현재 기업회계기준서 제1109호의 도입으로 인한 금융자산 범주의 재분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)					
구 분	측정범주		장부금액		
	도입 전	도입 후	도입 전	도입 후	차이
현금및현금성자산	대여금및수취채권	상각후원가	2,949,991	2,949,991	-
단기금융상품	대여금및수취채권	상각후원가	929,801	929,801	-
단기투자자산	당기손익인식금융자산	당기손익-공정가치	4,674,862	4,674,862	-
매출채권	대여금및수취채권	상각후원가	5,552,795	5,552,795	-
기타수취채권	대여금및수취채권	상각후원가	80,023	80,023	-
기타금융자산	대여금및수취채권	상각후원가	273	273	-
장기투자자산(*)	매도가능금융자산	당기손익-공정가치	43,226	43,226	-
금융자산 합계			14,230,971	14,230,971	-

(*) 당기초 현재 출자금 등을 포함한 43,226백만원은 매도가능금융자산에서 당기손익-공정가치측정 금융자산으로 재분류되었습니다. 동 금융자산은 계약상 현금흐름이 원리금 지급만을 나타내지 않아 상각후원가로 분류되는 조건을 충족하지 못합니다. 동 재분류로 인해 당기초 현재 관련 기타포괄손익누계액 (-)10,735백만원은 이익잉여금으로 재분류되었습니다. 당분기 중 동 금융자산과 관련한 공정가치 변동은 없습니다.

② 금융자산의 손상

기업회계기준서 제1109호는 기업회계기준서 제1039호의 '발생손실'모형을 기대신용손실'모형으로 대체하였습니다. 새로운 손상모형은 상각후원가로 측정되는 금융자산, 계약자산 및 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 채무상품에 적용되지만, 지분상품 투자에는 적용되지 않습니다. 기업회계기준서 제1109호에서 신용손실은 기업회계기준서 제1039호보다 일찍 인식됩니다.

기대신용손실은 신용손실의 확률가중추정치입니다. 신용손실은 모든 현금부족액(즉, 계약에 따라 지급받기로 한 모든 계약상 현금흐름과 수취할 것으로 예상하는 모든 계약상 현금흐름의 차이)의 현재가치로 측정됩니다.

매 보고기간말에, 연결실체는 상각후원가로 측정되는 금융자산과 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 채무증권의 신용이 손상되었는지 평가합니다. 금융자산의 추정미래현금흐름에 악 영향을 미치는 하나 이상의 사건이 발생한 경우에 해당 금융자산은 신용이 손상된 것입니다. 연결실체는 기업회계기준서 제1109호의 도입으로 채무상품에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손상차손으로 인식하였습니다.

상각후원가로 측정하는 금융자산에 대한 손실충당금은 해당 자산의 장부금액에서 차감합니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대해서는 해당 자산의 장부금액을 감소시키는 대신에 손실충당금을 기타포괄손익에 인식합니다.

③ 위험회피회계

연결실체는 기업회계기준서 제1109호를 최초 적용하면서 동 기준서의 위험회피회계요구사항을 적용하기로 결정하였습니다. 당기초 현재 위험회피수단으로 지정된 파생상품은 없으며, 따라서 기업회계기준서 제1109호의 위험회피회계 요구사항의 적용에 따라 발생하는 회계정책 변경의 효과는 없습니다.

(2) 미적용 제·개정 기준서

제정·공표되었으나 2018년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 아니한 제·개정 기준서는 다음과 같습니다. 연결실체는 분기연결재무제표 작성시 다음의 제·개정 기준서를 조기적용하지 아니하였습니다.

- 기업회계기준서 제1116호 '리스'

연결실체는 기업회계기준서 제1116호를 2019년 1월 1일 시작되는 회계연도부터 적용할 예정입니다. 2018년 중 기업회계기준서 제1116호의 도입에 따른 재무영향을 분석하여 그 결과를 2018년 연차연결재무제표 주석에 공시할 예정입니다. 전기 연차 연결재무제표에서 설명한 일반적인 영향분석 이외의 당분기말 현재 동 기준서의 도입 준비와 관련한 중요한 변동사항은 없습니다.

4. 영업부문

연결실체는 반도체 제품의 제조 및 판매의 단일영업부문으로 구성되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업전략을 수립하는 과정에서 검토되는 보고정보에 반도체사업부문의 성과를 검토하고 있습니다.

(1) 당분기와 전분기 중 매출액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
제품의 판매	8,705,845	6,274,658
용역의 제공	13,846	14,860
합 계	8,719,691	6,289,518

(2) 당분기와 전분기 중 매출액의 품목별 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
DRAM	6,880,516	4,654,579
NAND Flash	1,693,838	1,501,592
기 타	145,337	133,347
합 계	8,719,691	6,289,518

(3) 당분기와 전분기 중 지역별(법인소재지 기준) 매출액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
국 내	308,041	377,515
중 국	3,258,755	2,200,494
대 만	759,068	592,449
아시아(중국, 대만제외)	990,082	694,762
미 국	2,995,086	2,091,887
유 럽	408,659	332,411
합 계	8,719,691	6,289,518

(4) 당분기말과 전기말 현재 지역별 비유동자산(금융상품, 기타수취채권, 관계기업 및 공동기업투자, 이연법인세자산 제외)의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
국 내	26,937,535	23,959,991
중 국	3,163,129	2,768,494
대 만	5,682	5,752
아시아(중국, 대만제외)	1,099	1,100
미 국	312,396	318,567
유 럽	8,732	8,560
합 계	30,428,573	27,062,464

(5) 당분기와 전분기 중 단일 외부고객으로부터의 매출액이 연결실체 전체 매출액의 10%를 상회하는 고객 (가)와 (나)로부터 발생한 매출액은 각각 1,007,856백만원(전분기: 657,196백만원), 918,074백만원(전분기: 711,108백만원)입니다.

5. 금융상품의 범주별 분류

(1) 당분기말과 전기말 현재 금융자산의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)			
구 분	당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산	상각후원가로 측정하는 금융자산	합 계
현금및현금성자산	-	3,477,358	3,477,358
단기금융상품	-	3,312,376	3,312,376
단기투자자산	1,476,079	-	1,476,079
매출채권	-	5,574,098	5,574,098
기타수취채권	-	99,698	99,698
기타금융자산	-	283	283
장기투자자산	56,120	-	56,120
합 계	1,532,199	12,463,813	13,996,012

② 전기말

(단위: 백만원)				
구 분	당기손익인식 금융자산	매도가능 금융자산	대여금및 수취채권	합 계
현금및현금성자산	-	-	2,949,991	2,949,991
단기금융상품	-	-	4,674,862	4,674,862
단기투자자산	929,801	-	-	929,801
매출채권	-	-	5,552,795	5,552,795
기타수취채권	-	-	80,023	80,023
기타금융자산	-	-	273	273
장기투자자산	-	43,226	-	43,226
합 계	929,801	43,226	13,257,944	14,230,971

(2) 당분기말과 전기말 현재 금융부채의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)	
구 분	상각후원가로 측정하는 금융부채
매입채무	779,527
미지급금	4,622,901
기타지급채무(*)	674,407
차입금	3,866,709
합 계	9,943,544

② 전기말

(단위: 백만원)	
구 분	상각후원가로 측정하는 금융부채
매입채무	758,578
미지급금	2,724,547
기타지급채무(*)	1,343,637
차입금	4,171,270
합 계	8,998,032

(*) 당분기말과 전기말 현재 기타지급채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
미지급비용	670,845	1,340,225
비유동:		
임대보증금	3,562	3,412
합 계	674,407	1,343,637

6. 금융위험관리

(1) 금융위험관리

연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환율변동위험, 이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 중간재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2017년 12월 31일의 연차재무제표를 참고하시기 바랍니다. 연결실체의 위험관리부서 및 기타 위험관리정책에는 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다.

① 시장위험

(가) 환율변동위험

연결실체는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화, 유로화 및 엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채 및 해외사업장에 대한 순투자가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생합니다.

당분기말 현재 연결실체의 화폐성 외화자산 및 외화부채의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 백만단위)				
구 분	자 산		부 채	
	현지통화	원화환산	현지통화	원화환산
USD	12,559	13,394,603	5,102	5,441,469
EUR	21	28,107	129	169,047
JPY	458	4,590	113,402	1,135,675

당분기말 현재 각 외화에 대한 환율 10% 변동을 가정한 화폐성 외화자산 및 외화부채의 환율변동위험은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	10% 상승시	10% 하락시
USD	795,313	(795,313)
EUR	(14,094)	14,094
JPY	(113,109)	113,109

(나) 이자율위험

연결실체의 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 차입금에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하고 있습니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결실체는 이자율위험에 노출되어 있으며 동 이자율위험의 일부는 변동이자부 현금성자산으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다.

연결실체는 당분기말 현재 이자율 변동에 따라 순이자비용이 변동할 위험에 일부 노출되어 있습니다. 당분기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 하락 또는 상승시 향후 3개월간 연결실체의 변동금리부 차입금 및 금융자산으로부터의 이자비용과 이자수익으로 인한 법인세비용차감전순이익은 3,813백만원 만큼 증가 또는 감소하였을 것입니다.

(다) 가격위험

연결실체는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 지분증권 및 채무증권에 투자하고 있습니다. 당분기말 현재 해당 지분증권 및 채무증권은 가격위험에 노출되어 있습니다.

② 신용위험

신용위험은 연결실체의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결실체는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.

(가) 매출채권 및 기타수취채권

연결실체는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결실체의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하고 담보물을 확보하는 등 매출채권 및 기타수취채권 잔액에 대한 지속적인 관리 업무를 수행하고 있습니다. 연결실체는 매출채권 및 기타수취채권에 대해 매 보고기간말에 개별적으로 손상여부를 검토하고 있으며, 해외 거래처에 대한 신용위험과 관련하여 신용보험계약을 체결하고 있습니다. 연결실체의 신용위험 노출정도는 거래상대방별 매출채권 등의 장부금액과 동일한 금액입니다.

(나) 기타의 자산

현금및현금성자산, 단기금융상품, 단기투자자산 및 장·단기대여금 등으로 구성되는 연결실체의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 연결실체의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결실체는 다수의 금융기관에 현금및현금성자산과 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.

③ 유동성위험

유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행하기 위한 필요자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결실체는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다.

연결실체는 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록

적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 이자부 당좌예금, 정기예금, 수시입출금식 예금 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다.

(2) 자본관리

연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.

자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결실체는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 차입금 조달 및 상환, 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 부채비율, 순차입금비율은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
부 채 (A)	12,746,637	11,597,545
자 본 (B)	36,378,486	33,820,919
현금및현금성자산 등 (C) (*1)	8,265,813	8,554,654
차입금 (D)	3,866,709	4,171,270
부채비율 (A/B)	35.04%	34.29%
순차입금비율 (D-C)/B (*2)	-	-

(*1) 현금및현금성자산, 단기금융상품 및 단기투자자산의 합계액입니다.

(*2) 당분기말과 전기말 현재 순차입금비율은 부(-)의 비율로 산출되어 표시하지 않았습니다.

(3) 공정가치

공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.

- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격
- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수
- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

공정가치 서열체계를 포함한 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)					
구 분	장부금액	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
공정가치로 측정되는 금융자산:					
단기투자자산	1,476,079	-	1,476,079	-	1,476,079
장기투자자산	56,120	-	-	56,120	56,120
소 계	1,532,199	-	1,476,079	56,120	1,532,199
공정가치로 측정되지 않는 금융자산:					
현금및현금성자산(*)	3,477,358	-	-	-	-
단기금융상품(*)	3,312,376	-	-	-	-
매출채권(*)	5,574,098	-	-	-	-
기타수취채권(*)	99,698	-	-	-	-
기타금융자산(*)	283	-	-	-	-
소 계	12,463,813	-	-	-	-
금융자산 합계	13,996,012	-	1,476,079	56,120	1,532,199
공정가치로 측정되지 않는 금융부채:					
매입채무(*)	779,527	-	-	-	-
미지급금(*)	4,622,901	-	-	-	-
기타지급채무(*)	674,407	-	-	-	-
차입금	3,866,709	-	3,858,757	-	3,858,757
금융부채 합계	9,943,544	-	3,858,757	-	3,858,757

② 전기말

(단위: 백만원)					
구 분	장부금액	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
공정가치로 측정되는 금융자산:					
단기투자자산	929,801	-	929,801	-	929,801
장기투자자산	43,226	-	-	43,226	43,226
소 계	973,027	-	929,801	43,226	973,027
공정가치로 측정되지 않는 금융자산:					
현금및현금성자산(*)	2,949,991	-	-	-	-
단기금융상품(*)	4,674,862	-	-	-	-
매출채권(*)	5,552,795	-	-	-	-
기타수취채권(*)	80,023	-	-	-	-
기타금융자산(*)	273	-	-	-	-
소 계	13,257,944	-	-	-	-
금융자산 합 계	14,230,971	-	929,801	43,226	973,027
공정가치로 측정되지 않는 금융부채:					
매입채무(*)	758,578	-	-	-	-
미지급금(*)	2,724,547	-	-	-	-
기타지급채무(*)	1,343,637	-	-	-	-
차입금	4,171,270	-	4,178,598	-	4,178,598
금융부채 합 계	8,998,032	-	4,178,598	-	4,178,598

(*) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은 금융자산 과 금융부채에 대한 공정가치는 포함하고 있지 않습니다.

③ 가치평가기법

수준 2의 공정가치 측정을 위해 사용된 평가기법은 전기말과 동일합니다.

④ 당분기 중 수준 1, 수준 2 및 수준 3간의 대체는 없으며, 수준 3 공정가치 측정으로 분류 되는 금융자산의 당분기 중 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)					
구 분	기 초	취 득	처 분	환율변동	기 말
장기투자자산	43,226	12,994	(309)	209	56,120

7. 사용제한 금융상품

당분기말과 전기말 현재 사용이 제한된 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
단기금융상품:		
중소기업지원관련 사용제한(상생펀드)	227,500	227,500
소비세 이연납부에 대한 예치금	6,009	5,695
기타	-	1,287
소 계	233,509	234,482
기타금융자산:		
당좌개설보증금	11	11
기타	272	262
소 계	283	273
합 계	233,792	234,755

8. 매출채권 및 기타수취채권

(1) 당분기말과 전기말 현재 기타수취채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
미수금	26,940	10,816
미수수익	21,421	22,308
단기대여금	3,604	2,886
단기보증금	1,162	1,603
소 계	53,127	37,613
비유동:		
장기미수금	55	56
장기대여금	10,921	11,098
보증금	35,422	31,109
기타	173	147
소 계	46,571	42,410
합 계	99,698	80,023

(2) 대손충당금의 내역

당분기말과 전기말 현재 대손충당금 차감전 총액 기준에 의한 매출채권 및 기타수취채권과 관련 대손충당금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)						
구 분	당분기말			전기말		
	채권액	대손충당금	장부금액	채권액	대손충당금	장부금액
매출채권	5,574,145	(47)	5,574,098	5,552,841	(46)	5,552,795
유동성 기타수취채권	54,455	(1,328)	53,127	38,940	(1,327)	37,613
비유동성 기타수취채권	47,654	(1,083)	46,571	43,497	(1,087)	42,410
합 계	5,676,254	(2,458)	5,673,796	5,635,278	(2,460)	5,632,818

(3) 당분기와 전분기 중 매출채권 및 기타수취채권의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)						
구 분	기 초	대손상각비	환 입	제 각	환율변동	기 말
매출채권	46	-	-	-	1	47
유동성 기타수취채권	1,327	-	(1)	-	2	1,328
비유동성 기타수취채권	1,087	-	-	-	(4)	1,083
합 계	2,460	-	(1)	-	(1)	2,458

② 전분기

(단위: 백만원)						
구 분	기 초	대손상각비	환 입	제 각	환율변동	기 말
매출채권	1,837	115	-	-	(47)	1,905
유동성 기타수취채권	1,371	168	-	-	-	1,539
비유동성 기타수취채권	1,476	2	-	-	(82)	1,396
합 계	4,684	285	-	-	(129)	4,840

9. 재고자산

당분기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)						
구 분	당분기말			전기말		
	취득원가	평가손실총당금	장부금액	취득원가	평가손실총당금	장부금액
제 품	729,856	(72,798)	657,058	544,978	(111,573)	433,405
재공품	1,797,898	(23,857)	1,774,041	1,653,778	(36,889)	1,616,889
원재료	331,393	(13,099)	318,294	322,283	(26,031)	296,252
저장품	337,778	(15,356)	322,422	278,422	(7,618)	270,804
미착품	31,327	-	31,327	23,089	-	23,089
합 계	3,228,252	(125,110)	3,103,142	2,822,550	(182,111)	2,640,439

10. 기타유동자산 및 기타비유동자산

당분기말과 전기말 현재 기타유동자산 및 기타비유동자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
선급금	50,103	34,887
선급비용	264,517	222,411
부가세대급금	301,606	263,287
계약자산	18,638	-
기타	1,413	3,053
소 계	636,277	523,638
비유동:		
장기선급금	163,277	183,489
장기선급비용	593,233	553,231
소 계	756,510	736,720
합 계	1,392,787	1,260,358

11. 관계기업 및 공동기업투자

(1) 당분기말과 전분기말 현재 관계기업 및 공동기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)								
구 분	회사명	소재지	주요 영업활동	당분기말			전분기말	
				지분율(%)	순자산 지분금액	장부금액	지분율(%)	장부금액
관계기업	Stratio, Inc.(*)	미 국	반도체 부품 개발 및 제조	9.12	105	2,106	9.12	2,105
	SK China Company Limited(SK China)(*)	중 국	부동산 투자업 등	11.87	192,989	245,339	11.87	244,912
	Gemini Partners Pte. Ltd. (Gemini)	싱가포르	컨설팅	20.00	2,358	4,052	20.00	4,003
	TCL Fund(*)	홍 콩	투자	11.06	2,723	2,723	11.06	2,634
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.(HITECH)	중 국	반도체 부품 제조	45.00	95,811	95,811	45.00	106,210
합 계						350,031		359,864

(*) 이사선임권을 통해 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 관계기업으로 분류하였습니다

(2) 당분기와 전분기 중 관계기업 및 공동기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)					
구 분	기 초	지분법손익	지분법자본변동	배당	기 말
Stratio, Inc.	2,105	1	-	-	2,106
SK China	244,912	1,387	(960)	-	245,339
Gemini	4,003	14	35	-	4,052
TCL Fund	2,634	(8)	97	-	2,723
HITECH	106,210	3,132	(411)	(13,120)	95,811
합 계	359,864	4,526	(1,239)	(13,120)	350,031

② 전분기

(단위: 백만원)					
구 분	기 초	지분법손익	지분법자본변동	배당	기 말
Stratio, Inc.	2,151	(1)	(11)	-	2,139
Gemini	5,199	(255)	(138)	-	4,806
TCL Fund	2,219	15	(142)	-	2,092
HITECH	121,447	14	(9,283)	(14,828)	97,350
합 계	131,016	(227)	(9,574)	(14,828)	106,387

(3) 당분기말과 전기말 현재 관계기업과 공동기업의 요약 재무상태표는 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)				
구 분	유동자산	비유동자산	유동부채	비유동부채
Stratio, Inc.	693	567	107	-
SK China	732,687	1,037,524	139,757	4,063
Gemini	6,304	6,012	527	-
TCL Fund	7,823	16,799	-	-
HITECH	266,834	334,694	148,420	240,195

② 전기말

(단위: 백만원)				
구 분	유동자산	비유동자산	유동부채	비유동부채
Stratio, Inc.	681	577	111	-
SK China	812,882	934,872	54,752	70,213
Gemini	6,227	5,314	2	-
TCL Fund	7,863	15,957	-	-
HITECH	192,905	334,678	79,725	211,835

(4) 당분기와 전분기 중 관계기업과 공동기업의 요약 포괄손익계산서는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	매출액	분기순손익	매출액	분기순손익
Stratio, Inc.	8	13	6	(8)
SK China	28,878	11,689	-	-
Gemini	-	68	-	(1,276)
TCL Fund	-	(74)	-	139
HITECH	148,958	6,610	142,210	31

12. 장기투자자산

당분기와 전분기 중 장기투자자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	43,226	147,779
취득	12,994	1,799
처분	(309)	(452)
환율변동	209	(220)
기말장부금액	56,120	148,906

13. 유형자산

(1) 당분기와 전분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	24,062,601	18,777,402
취득	4,521,120	2,357,636
처분 및 폐기	(3,086)	(4,815)
감가상각	(1,318,830)	(1,086,704)
환율변동	102,964	(187,515)
기말장부금액	27,364,769	19,856,004

(2) 당분기말 현재 연결실체의 일부 토지와 건물 등은 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다.(주석 31 참조)

(3) 금융리스와 운용리스 이용내역

당분기말 현재 연결실체는 HANSU TECHNICAL SERVICE LTD. 등으로부터 기계장치를 금융리스계약을 통하여 사용하고 있습니다.

당분기말 현재 금융리스 계약에 따른 기계장치 등의 장부금액은 77,638백만원(전기말: 79,161백만원)입니다. 동 기계장치 등은 관련 금융리스부채와 관련하여 담보로 제공되어 있습니다.

당분기말 현재 연결실체는 Macquarie Capital 등으로부터 기계장치를 운용리스계약에 의하여 사용하고 있으며, 기간별 리스료의 지급계획은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)	
구 분	리스료지급액
1년 이내	161,167
1년 초과	166,703
합 계	327,870

14. 무형자산

(1) 당분기와 전분기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	2,247,290	1,915,591
취득	192,226	194,297
처분 및 폐기	(1,659)	(1,792)
상각	(129,801)	(78,408)
손상차손	(3,463)	-
환율변동 등	259	(27,069)
기말장부금액	2,304,852	2,002,619

(2) 당분기 중 개발활동과 관련하여 발생한 비용 중 개발비 인식요건을 충족하는 132,545백만원(전분기: 140,624백만원)은 개발비로 자산화하였으며 연구활동과 관련하여 발생한 비용과 개발비 인식요건을 충족하지 못하는 개발활동 관련비용 512,389백만원(전분기: 451,231백만원)은 경상개발비로 비용인식하였습니다.

15. 투자부동산

(1) 당분기와 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	2,468	2,573
감가상각	(26)	(26)
기말장부금액	2,442	2,547

(2) 당분기 중 발생한 투자부동산의 감가상각비 26백만원(전분기: 26백만원)은 전액 매출원가에 포함되어 있습니다.

(3) 당분기 중 투자부동산과 관련하여 발생한 임대수익은 122백만원(전분기: 124백만원)입니다.

16. 차입금

당분기말과 전기말 현재 차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
단기차입금	74,688	192,686
유동성장기차입금	373,494	361,258
유동성사채	149,922	219,836
소 계	598,104	773,780
비유동:		
장기차입금	1,652,413	2,080,333
사 채	1,616,192	1,317,157
소 계	3,268,605	3,397,490
합 계	3,866,709	4,171,270

17. 기타유동부채 및 기타비유동부채

당분기말과 전기말 현재 기타유동부채 및 기타비유동부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
선수금	7,256	3,040
선수수익	57	81
예수금	46,955	39,862
보증예수금	1,033	989
계약부채	50,989	-
기타	3,021	7,804
소 계	109,311	51,776
비유동:		
기타장기종업원급여부채	64,445	63,960
장기선수금	4,900	4,900
소 계	69,345	68,860
합 계	178,656	120,636

18. 총당부채

(1) 당분기와 전분기 중 총당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)					
구 분	기 초	전 입	사 용	환율변동	기 말
판매보증총당부채	3,807	14	(268)	-	3,553
반품총당부채(*)	-	-	-	-	-
소송총당부채	9,460	-	(4,391)	264	5,333
배출부채	37,412	17,242	-	-	54,654
합 계	50,679	17,256	(4,659)	264	63,540

(*) 기업회계기준서 제1115호의 적용으로 인하여 고객의 반품권 행사로 장래에 지출될 것이 예상되는 금액과, 연결실체가 고객으로부터 제품을 회수할 권리를 각각 기타유동자산과 기타유동부채로 구분하여 표시하였습니다.

② 전분기

(단위: 백만원)					
구 분	기 초	전 입	사 용	환율변동	기 말
판매보증총당부채	2,997	756	(99)	-	3,654
반품총당부채	13,317	11,508	(7,549)	-	17,276
소송총당부채	400	-	-	(24)	376
배출부채	26,108	11,668	-	-	37,776
합 계	42,822	23,932	(7,648)	(24)	59,082

(2) 판매보증총당부채

연결실체는 무상 품질보증수리 등과 관련하여 장래에 지출될 것이 예상되는 금액을 과거 경험율 등을 기초로 추정하여 총당부채를 인식하고 있습니다.

(3) 반품충당부채

연결실체는 전기 중 판매 후 반품이 예상되는 매출액을 합리적으로 추정하여 매출액과 매출 원가에서 각각 차감하고 매출총이익에 해당하는 금액과 반품과 관련하여 발생할 것으로 예상되는 비용의 합계액을 충당부채로 인식하였습니다. 당분기 중 기업회계기준서 제1115호 도입으로 인하여 고객의 반품권 행사로 장래에 지출될 것이 예상되는 금액과, 연결실체가 고객으로부터 제품을 회수할 권리를 각각 기타유동자산과 기타유동부채로 재분류하였습니다.

(4) 소송충당부채

연결실체는 소송 혹은 분쟁 등과 관련하여 경제적 효익이 내재된 자원이 유출될 가능성이 높고 그 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 그 금액을 충당부채로 인식하고 있습니다.

(5) 배출부채

연결실체는 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률'에 따라 장래에 지출될 것이 예상되는 금액을 추정하여 충당부채로 인식하고 있습니다.

19. 종업원급여

(1) 당분기말과 전기말 현재 확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
확정급여채무의 현재가치	1,379,576	1,330,559
사외적립자산의 공정가치	(1,329,932)	(1,337,848)
순확정급여부채	49,644	(7,289)
확정급여부채	49,644	6,096
확정급여자산(*)	-	(13,385)

(*) 전기말 현재 지배기업의 확정급여제도의 초과적립액 13,385백만원을 종업원급여자산으로 표시하였습니다.

(2) 당분기말과 전기말 현재 보험수리적 평가를 위해 사용된 주요 추정치는 다음과 같습니다.

구 분	당분기말(%)	전기말(%)
할인율	3.81 ~ 4.35	3.81 ~ 4.35
미래임금상승률	2.20 ~ 5.46	2.20 ~ 5.46

(3) 당분기와 전분기 중 확정급여채무의 현재가치 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	1,330,559	1,195,047
당기근무원가	42,502	38,435
이자원가	14,117	11,752
관계사전출입액	1,024	4
퇴직급여지급액	(8,662)	(10,138)
기타	36	(38)
기말장부금액	1,379,576	1,235,062

(4) 당분기와 전분기 중 사외적립자산의 공정가치 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초잔액	1,337,848	888,559
이자수익	14,186	8,731
기여금납입액	-	-
관계사전출입액	1,016	(106)
퇴직급여지급액	(16,078)	(12,607)
재측정요소	(7,040)	(4,170)
기말금액	1,329,932	880,407

(5) 당분기와 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 손익으로 인식된 비용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
당기근무원가	42,502	38,435
순이자원가	(69)	3,021
합 계	42,433	41,456

(6) 당분기말과 전기말 현재 사외적립자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
예적금	1,328,623	1,336,484
기타	1,309	1,364
합 계	1,329,932	1,337,848

한편, 당분기와 전분기 중 사외적립자산의 실제수익은 각각 7,147백만원과 4,561백만원입니다.

(7) 당분기 중 확정기여형 연금제도와 관련하여 비용으로 인식한 금액은 44백만원(전분기: 16백만원)입니다.

20. 파생상품거래

(1) 당분기말과 전기말 현재 재무상태표에 인식된 파생상품은 없습니다.

(2) 당분기 중 파생상품 거래와 관련하여 금융수익 및 금융비용으로 인식한 평가손익 및 거래손익은 없으며, 전분기 중 인식한 평가손익 및 거래손익은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	평가이익	평가손실	거래이익	거래손실
이자율스왑	99	-	203	308

21. 자본금, 자본잉여금 및 기타자본

(1) 당분기말 현재 지배기업의 수권주식수는 9,000,000천주이고, 1주당 액면금액은 5,000원입니다. 한편, 당분기말과 전기말 현재 보통주 발행주식수, 보통주자본금, 자본잉여금 및 기타자본의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, 천주)		
구 분	당분기말	전기말
보통주 발행주식수(*)	731,530	731,530
보통주자본금	3,657,652	3,657,652
자본잉여금:		
주식발행초과금	3,625,797	3,625,797
기타	517,939	517,939
합 계	4,143,736	4,143,736
기타자본:		
자기주식	(771,913)	(771,913)
주식선택권	1,088	813
합 계	(770,825)	(771,100)
자기주식수	22,001	22,001

(*) 당분기말 현재 과거 이익소각의 영향으로 인하여 상장주식 총수 728,002천주와 발행주식 총수에 차이가 있습니다.

(2) 당분기와 전기 중 지배기업의 유통주식수는 706,002천주로 변동이 없습니다.

22. 기타포괄손익누계액

(1) 당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
(부의)지분법자본변동	(21,681)	(20,442)
장기투자자산평가손익	-	(10,735)
해외사업장외화환산차이	(320,787)	(471,087)
합 계	(342,468)	(502,264)

(2) 당분기와 전분기 중 기타포괄손익누계액의 변동내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)				
구 분	기 초	증 감	유의적인 회계 정책 변경효과	기 말
(부의)지분법자본변동	(20,442)	(1,239)	-	(21,681)
장기투자자산평가손익	(10,735)	-	10,735	-
해외사업장외화환산차이	(471,087)	150,300	-	(320,787)
합 계	(502,264)	149,061	10,735	(342,468)

② 전분기

(단위: 백만원)			
구 분	기 초	증 감	기 말
지분법자본변동	5,944	(9,574)	(3,630)
해외사업장환산외환차이	(85,047)	(315,274)	(400,321)
합 계	(79,103)	(324,848)	(403,951)

23. 이익잉여금

당분기말과 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
법정적립금(*1)	178,955	108,354
임의적립금(*2)	235,506	235,506
미처분이익잉여금(*3)	29,269,272	26,943,396
합 계	29,683,733	27,287,256

(*1) 지배기업은 상법의 규정에 따라, 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전에 사용가능합니다.

(*2) 임의적립금은 기술개발준비금으로 구성되어 있습니다.

(*3) 2018년 3월 28일자 주주총회에서 배당금 706,002백만원이 결의되었으며, 당분기말 현재 미지급배당금은 미지급금에 포함되어 있습니다.

24. 판매비와관리비

당분기와 전분기 중 발생한 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
급 여	135,533	126,021
퇴직급여	7,602	6,740
복리후생비	25,312	19,403
지급수수료	57,299	59,170
감가상각비	28,749	22,498
무형자산상각비	110,962	66,105
운반보관비	5,921	9,802
송무비	3,375	6,439
임차료	3,234	3,517
세금과공과	5,232	3,969
교육훈련비	7,064	4,773
광고선전비	10,042	7,836
수도광열비	3,591	7,927
소모품비	12,492	14,836
수선비	5,880	1,983
여비교통비	3,506	2,700
판매촉진비	16,875	13,108
판매수리비	5,691	756
기타	8,390	8,283
소 계	456,750	385,866
경상개발비 :		
연구개발비 총지출액	644,934	591,855
개발비 자산화	(132,545)	(140,624)
소 계	512,389	451,231
판매비와관리비 합계	969,139	837,097

25. 비용의 성격별 분류

당분기와 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기(*2)
제품 및 재공품의 변동	(380,804)	(29,351)
원재료 및 소모품 사용	1,204,220	920,567
종업원급여	843,171	813,531
감가상각 및 무형자산상각	1,417,526	1,135,215
기술료	55,544	56,170
지급수수료	354,797	256,589
동력 및 수도광열비	264,179	222,074
수선비	225,287	159,505
외주가공비	240,306	215,385
기 타	128,127	72,234
합 계(*1)	4,352,353	3,821,919

(*1) 분기연결포괄손익계산서 상의 매출원가와 판매비와관리비를 합산한 금액입니다.

(*2) 전분기의 비용은 당분기의 분류에 따라 재분류되었습니다.

26. 금융수익 및 금융비용

당분기와 전분기 중 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
금융수익:		
이자수익	27,282	9,513
배당금수익	346	-
외환차이	207,561	364,869
파생상품관련이익	-	302
단기투자자산평가이익(*)	1,104	434
단기투자자산처분이익(*)	3,594	2,731
장기투자자산처분이익	248	-
합 계	240,135	377,849
금융비용:		
이자비용	24,891	29,575
외환차이	288,387	437,366
파생상품관련손실	-	308
합 계	313,278	467,249
순금융손익	(73,143)	(89,400)

(*) 전분기의 단기투자자산 관련손익은 당분기의 분류에 따라 재분류 되었습니다.

27. 기타영업외수익과 기타영업외비용

(1) 당분기와 전분기 중 기타영업외수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
유형자산처분이익	5,768	2,000
기타	1,298	3,592
합 계	7,066	5,592

(2) 당분기와 전분기 중 기타영업외비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
유형자산처분손실	2,883	4,690
무형자산처분손실	1,659	1,792
무형자산손상차손	3,463	-
매출채권처분손실	2,235	2,094
기부금	1,047	1,912
기타	3,690	2,933
합 계	14,977	13,421

28. 법인세비용

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 경영진의 가중평균연간법인세율에 대한 최선의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 법인세비용에는 과거기간 당기법인세에 대하여 당기에 인식한 조정사항이 포함되어 있습니다.

29. 주당이익

주당이익은 보통주 및 희석성 잠재적 보통주 1주에 대한 지배기업 소유주지분순이익을 계산한 것으로 그 내역은 다음과 같습니다.

(1) 기본주당이익

(단위: 주, 백만원)		
구 분	당분기	전분기
지배기업소유주지분 분기순이익	3,120,254	1,897,969
가중평균유통보통주식수(*)	706,001,795	706,001,795
기본주당이익	4,420 원	2,688 원

(*) 주당이익을 계산하기 위한 가중평균유통보통주식수의 산출근거는 다음과 같습니다.

(단위: 주)		
구 분	당분기	전분기
발행주식수	728,002,365	728,002,365
자기주식 효과	(22,000,570)	(22,000,570)
가중평균유통보통주식수	706,001,795	706,001,795

(2) 희석주당이익

(단위: 백만원, 주)		
구 분	당분기	전분기
보통주희석분기순이익	3,120,254	1,897,969
가중평균희석유통보통주식수(*)	706,075,772	706,001,795
희석주당이익	4,419 원	2,688 원

(*) 희석주당이익을 계산하기 위한 가중평균희석유통보통주식수의 산출근거는 다음과 같습니다.

(단위: 주)		
구 분	당분기	전분기
가중평균유통보통주식수	706,001,795	706,001,795
주식선택권 효과	73,977	-
가중평균희석유통보통주식수	706,075,772	706,001,795

30. 특수관계자 및 대규모기업집단 소속회사와 거래

(1) 당분기말 현재 특수관계자의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	회사명
관계기업	Stratio, Inc., SK China Company Limited, Gemini Partners Pte. Ltd., TCL Fund
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.

기타특수관계자	연결실체에 유의적인 영향력을 행사하는 SK텔레콤(주) 및 그 종속기업과 SK텔레콤(주)의 지배기업인 SK(주)와 그 종속기업
---------	---

(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 주요거래 내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)					
구분	회사명	영업수익 등	영업비용 등	자산취득	배당금수취
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	2	148,740	-	13,120
기타특수관계자	SK텔레콤(주)(*1)	28	151,572	2,818	-
	SK(주)(*2)	274	43,336	46,096	-
	ESSENCORE Limited	253,637	-	-	-
	SK건설(주)	347	142	556,541	-
	SK에너지(주)	1,383	34,345	-	-
	SK네트웍스(주)	-	1,203	10,600	-
	에스케이씨솔믹스(주)	-	5,228	96	-
	충청에너지서비스(주)	-	8,639	-	-
	행복나래(주)	10	119,614	12,298	-
	SK머티리얼즈(주)	-	14,828	-	-
	SK실트론(주)	808	68,061	-	-
	기타	82	55,491	6,090	-
합계		256,571	651,199	634,539	13,120

(*1) 영업비용 등에는 배당금 146,100백만원이 포함되어 있습니다.

(*2) 당분기 중 발생한 SK브랜드 사용료는 8,808백만원입니다.

② 전분기

(단위: 백만원)					
구 분	회사명	영업수익 등	영업비용 등	자산취득	배당금수취
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	1,042	140,709	-	14,828
기타특수관계자	SK텔레콤(주)(*1)	100	90,035	1,534	-
	SK(주)(*2)	188	42,007	27,796	-
	ESSENCORE Limited	187,498	-	-	-
	SK건설(주)	5,949	123	122,695	-
	SK에너지(주)	1,262	20,707	-	-
	SK네트웍스(주)	-	911	-	-
	에스케이씨솔믹스(주)	-	11,206	265	-
	충청에너지서비스(주)	-	7,805	-	-
	행복나래(주)	9	66,728	4,603	-
	SK머티리얼즈(주)	-	10,906	-	-
	기 타	270	35,939	9,553	-
합 계		196,318	427,076	166,446	14,828

(*1) 영업비용 등에는 배당금 87,660백만원이 포함되어 있습니다.

(*2) 전분기 중 발생한 SK브랜드사용료는 9,472백만원입니다.

(3) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권·채무 내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)			
구 분	회사명	채 권	채 무
		매출채권 등	미지급금 등
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	13,066	100,243
기타특수관계자	SK텔레콤(주)	-	5,512
	SK(주)	5,515	132,104
	ESSENCORE Limited	91,790	-
	SK건설(주)	103	607,205
	SK에너지(주)	431	6,716
	SK네트웍스(주)	-	400
	에스케이씨솔믹스(주)	-	3,397
	충청에너지서비스(주)	-	1,653
	행복나래(주)	3	32,970
	SK머티리얼즈(주)	-	15,364
	SK실트론(주)(*)	150,409	31,546
기타	5	48,745	
합 계		261,322	985,855

② 전기말

(단위: 백만원)			
구 분	회사명	채 권	채 무
		매출채권 등	미지급금 등
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	-	90,782
기타특수관계자	SK텔레콤(주)	94	3,014
	SK(주)	5,530	108,038
	ESSEN CORE Limited	90,367	-
	SK건설(주)	7,327	946,517
	SK에너지(주)	500	10,505
	SK네트웍스(주)	-	1,395
	에스케이씨솔믹스(주)	-	3,393
	충청에너지서비스(주)	11	2,128
	행복나래(주)	3	55,126
	SK머티리얼즈(주)	-	11,692
	SK실트론(주)(*)	150,521	21,071
	기타	90	99,043
합 계		254,443	1,352,704

(*) 연결실체는 전기 중 Wafer 구매대금 150,000백만원을 선급하였습니다.(주석 31 참조)

(4) 주요 경영진에 대한 보상

연결실체의 주요 경영진은 지배기업의 이사(등기 및 비등기), 이사회 의 구성원, 재무책임자 및 내부감사책임자를 포함하고 있습니다. 종업원 용역의 대가로서 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
급 여	22,248	17,354
퇴직급여	2,709	2,227
주식보상비용	275	23
기타	4	3
합 계	25,236	19,607

(5) 당분기와 전분기 중 기업회계기준서 제1024호 '특수관계자 공시'에 따른 특수관계자 범위에 포함되지 않으나, 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)					
구 분	회사명	영업수익 등	영업비용 등	자산취득	배당금수익
대규모기업집단소속회사	SK케미칼㈜	-	299	-	-

② 전분기

(단위: 백만원)					
구 분	회사명	영업수익 등	영업비용 등	자산취득	배당금수익
대규모기업집단소속회사	SK케미칼㈜	-	249	-	-

(6) 당분기말과 전기말 현재 기업회계기준서 제1024호 '특수관계자 공시'에 따른 특수관계자 범위에 포함되지 않으나, 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사에 대한 채권·채무 내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)			
구 분	회사명	채 권	채 무
		매출채권 등	미지급금 등
대규모기업집단소속회사	SK케미칼㈜	-	334

② 전기말

(단위: 백만원)			
구 분	회사명	채 권	채 무
		매출채권 등	미지급금 등
대규모기업집단소속회사	SK디스커버리㈜	-	339
	SK케미칼㈜	-	38
합 계		-	377

31. 우발부채와 약정사항

(1) 당분기말 현재 연결실체와 관련하여 계류 중인 중요한 소송사건 및 클레임 등의 내역은 다음과 같습니다.

① Netlist, Inc.의 특허 침해 소송

Netlist, Inc.는 지배기업과 SK hynix America Inc. 등 지배기업의 종속기업들을 상대로 다수의 특허를 침해하였다는 소송을 2016년 8월 31일 및 2017년 6월 14일 미국 캘리포니아 중부지방법원에, 2016년 9월 1일 및 2017년 10월 31일 미국국제무역위원회에, 2017년 7월 11일 독일 뮌헨 지방법원 및 중국 베이징 지식재산법원에 각각 제기하였습니다. 당분기말 현재 미국 등 각 지역에서 진행 중인 Netlist, Inc.의 특허 침해 소송은 소송가액이 확정되지 않은 상태이며, 당분기말 현재 최종결과를 예측할 수 없습니다.

한편, 2016년 9월 1일 미국국제무역위원회에 제기되었던 특허 침해 소송은 2018년 1월 16일 지배기업 및 지배기업의 종속기업들이 Netlist, Inc.의 특허를 침해하지 않았다고 최종 결정되었습니다. 이에 대해 Netlist, Inc.는 2018년 3월 26일에 항소를 제기하였습니다.

② Hargens Berman의 가격 담합 집단소송

Hargens Berman(소송대리인)은 지배기업 및 종속기업인 SK hynix America Inc.를 상대로 가격 담합에 대한 집단소송을 2018년 4월 27일 미국 캘리포니아 북부지방법원에 제기하였습니다. 당분기말 현재 제기된 본 소송은 소송가액이 확정되지 않은 상태이며 당분기말 현재 최종결과를 예측할 수 없습니다.

③ 소송 및 특허 클레임 등

당분기말 현재 연결실체는 상기 소송 외에 지적재산권 등과 관련하여 여러 분쟁에 대응하고 있으며 향후 자원의 유출가능성이 높고 손실 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 동 금액을 부채로 인식하고 있습니다.

(2) 특허라이선스 계약

연결실체는 당분기말 현재 제품생산과 관련한 다수의 특허라이선스 계약을 체결하고 있습니다. 동 계약에 의한 Royalty는 Lump-sum royalty 및 Running royalty의 형식으로 지급되며, Lump-sum royalty 지급액은 특허라이선스 계약기간에 따라 정액으로 안분된 금액을 비용으로 처리하고 있습니다.

(3) 공업용수공급계약

연결실체는 베올리아워터산업개발(주) ("Veolia")와 공업용수를 공급받는 계약을 체결하고 있습니다. 기존 계약은 2018년 3월로 만료되었으며 2018년 5월까지 2개월 연장계약을 체결하였습니다. 계약내용은 기존 계약과 동일하며 동 계약에 의하면 연결실체는 계약기간 동안 Base Service Charge ("BSC")와 공급받는 공업용수 사용량에 일정액을 적용하여 계산된 Additional Service Charge ("ASC")를 Veolia에 지급해야 합니다.

(4) HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd. ("HITECH")와 후공정서비스계약

연결실체는 HITECH와 후공정서비스를 공급받는 계약을 체결하고 있으며 서비스 제공 범위는 Package, Package Test, Module 등 입니다. 연결실체는 동 계약에 따라 HITECH 장비 우선 사용권을 보유하고, 후공정서비스 대가로 HITECH에 일정액의 약정수익을 보장하는 가격을 지불하기로 하였습니다.

(5) 당분기말 현재 담보제공자산 등의 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)			
구 분(*)	장부금액	담보설정액	비 고
토 지	18,618	1,148,273	시설자금대출관련 등
건 물	53,804		
기계장치	843,400		
합 계	915,822	1,148,273	

(*) 상기 담보제공자산 이외에 연결실체의 금융리스자산은 해당 금융리스 계약에 의하여 관련 금융리스부채의 담보로 제공되어 있습니다.

(6) 당분기말 현재 연결실체가 금융기관과 체결하고 있는 여신한도 거래의 주요 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 백만단위)				
구 분	금융기관	약정사항	한도금액	
			통 화	금 액
지배기업	하나은행 등	Usance 등 수입금융약정	USD	265
		매입외환 등 수출금융약정	USD	250
		수입·수출 포괄한도약정	USD	960
		상환청구권이 없는 매출채권팩토링약정	KRW	140,000
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.(SKHYCL)	중국농업은행 등	Usance 등 수입금융약정	RMB	1,300
			USD	232
SK hynix America Inc. (SKHYA)등 판매법인	씨티은행 등	상환청구권이 없는 매출채권팩토링약정	USD	365
국내종속기업	하나은행 등	외상매출채권담보대출	KRW	20,000
		납품대금지급업무대행계약	KRW	17,500

(7) 당분기말 현재 연결실체가 타인에게 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	금 액	비 고
종업원	6	우리사주관련 금융기관 차입금 지급보증

(8) 당분기말 현재 기표되지 않은 유형자산에 대한 구매 약정액은 2,367,693백만원 (전기말: 661,588백만원)입니다.

(9) 도시바 반도체 사업 지분 투자

연결실체는 전기 중 도시바 반도체 사업의 지분투자와 관련하여 Bain Capital이 포함된 컨소시엄(이하 "Bain 컨소시엄")에 참여하였으며, 특수목적법인인 BCPE Pangea Intermediate Holdings Cayman, LP에 대한 JPY 266,000백만의 출자계약 및 BCPE Pangea Cayman2 Limited가 발행한 전환사채 JPY 129,000백만의 취득계약을 체결하였습니다.

한편, 전기 중 도시바 반도체 사업 지분 투자를 위한 Bain 컨소시엄과 도시바 간의 계약이 체결되었으며, 당분기말 현재 각국 정부기관의 심사절차가 진행 중입니다. 거래의 종결 등은 정부기관의 심의를 포함하여 계약에서 정한 선행조건 충족 여부에 따라변경될 수 있습니다.

(10) 원재료 장기매입 약정

연결실체는 Wafer 수급 안정성 확보를 위하여 SK실트론(주)와 2019년부터 2023년까지 Wafer 구매계약을 체결하였으며, 전기 중 구매대금 150,000백만원을 선급하였습니다. 한편, SK실트론(주)는 연결실체가 선급한 150,000백만원을 보증하기 위하여 투자자산 일부를 양도담보로 제공하기로 약정하였습니다.

32. 현금흐름표

(1) 당분기와 전분기 중 영업에서 창출된 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
분기순이익	3,121,329	1,898,678
조정항목:		
법인세비용	1,169,481	471,465
퇴직급여	42,433	41,456
유형자산상각비	1,318,830	1,086,704
투자부동산상각비	26	26
무형자산상각비	129,801	78,408
주식보상비용	275	23
유형자산처분손실	2,883	4,690
무형자산처분손실	1,659	1,792
무형자산손상차손	3,463	-
이자비용	24,891	29,575
외화환산손실	94,235	141,582
지분법손익	(4,526)	227
유형자산처분이익	(5,768)	(2,000)
단기투자자산평가이익	(1,104)	(435)
단기투자자산처분이익	(3,594)	(2,731)
장기투자자산처분이익	(248)	-
파생상품관련손익	-	6
이자수익	(27,282)	(9,513)
외화환산이익	(44,953)	(224,970)
기 타	1,889	2,373
운전자본의 변동:		
매출채권의 감소(증가)	(32,970)	(555,230)
기타수취채권의 감소(증가)	24,711	(17,111)
재고자산의 감소(증가)	(451,101)	(35,785)
기타자산의 감소(증가)	(130,886)	(8,886)
매입채무의 증가(감소)	9,057	235,050
미지급금의 증가(감소)	955,649	(66,564)
기타지급채무의 증가(감소)	(656,160)	(63,967)
총당부채의 증가(감소)	(18,079)	16,358
기타부채의 증가(감소)	58,594	(3,519)
퇴직금의 지급	(6,855)	(10,056)
영업으로부터 창출된 현금 합계	5,575,680	3,007,646

(2) 당분기와 전분기 중 유동성 대체를 제외한 중요한 현금의 유입·유출이 없는 거래는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
유형자산 취득 관련 미지급금 등 증가	199,780	337,544
배당금 관련 미지급금의 증가	706,002	423,601

(3) 당분기와 전분기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초	4,171,270	4,335,978
재무적 현금으로 인한 변동		
- 차입금의 차입	298,732	344,893
- 차입금의 상환	(599,737)	(167,358)
환율변동효과	(3,945)	(170,559)
상각(이자비용)	389	443
기말	3,866,709	4,343,397

33. 주식기준보상

(1) 연결실체는 당분기 중 연결실체의 주요 경영진에게 주식결제형 주식선택권을 부여하였으며, 당분기말 현재 주식선택권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주)								
구 분	총부여수량	소멸수량	행사수량	미행사수량	부여일	약정용역제공기간	행사가능기간	행사가격
1차	99,600	-	-	99,600	2017.03.24	2017.03.24 ~ 2019.03.24	2019.03.25 ~ 2022.03.24	48,400원
2차	99,600	-	-	99,600	2017.03.24	2017.03.24 ~ 2020.03.24	2020.03.25 ~ 2023.03.24	52,280원
3차	99,600	-	-	99,600	2017.03.24	2017.03.24 ~ 2021.03.24	2021.03.25 ~ 2024.03.24	56,460원
4차	7,747	-	-	7,747	2018.01.01	2018.01.01 ~ 2019.12.31	2020.01.01 ~ 2022.12.31	77,440원
5차	7,223	-	-	7,223	2018.03.28	2018.03.28 ~ 2020.03.28	2020.03.29 ~ 2023.03.28	83,060원
합 계	313,770	-	-	313,770				

(2) 공정가치 측정

이항모형을 적용하여 공정가액 접근법에 의한 보상원가를 산정하였으며, 주식결제형주식기준보상제도의 부여일 현재 공정가치를 측정하기 위하여 사용된 투입변수는 다음과 같습니다.

구 분	기대주가변동성	부여일 공정가치	배당수익률	무위험이자율 (국공채 수익률)
1차	23.23%	10,026원	1.20%	1.86%
2차	23.23%	9,613원	1.20%	1.95%
3차	23.23%	9,296원	1.20%	2.07%
4차	22.50%	16,687원	0.78%	2.38%
5차	25.30%	18,362원	1.23%	2.46%

(3) 연결실체가 당분기 중 인식한 주식보상비용은 275백만원(전분기: 23백만원) 입니다.

4. 재무제표

재무상태표

제 71 기 1분기말 2018.03.31 현재

제 70 기말 2017.12.31 현재

(단위 : 백만원)

	제 71 기 1분기말	제 70 기말
자산		
유동자산	15,459,529	15,338,930
현금및현금성자산	2,836,259	2,270,036

단기금융상품	3,163,900	4,528,880
단기투자자산	815,835	580,449
매출채권	5,436,158	5,259,052
기타수취채권	75,653	41,049
재고자산	2,605,151	2,224,740
기타유동자산	526,573	434,724
비유동자산	32,467,903	28,973,916
관계기업 및 공동기업투자	5,231,481	4,778,280
장기투자자산	46,064	37,593
기타수취채권	32,822	29,600
기타금융자산	11	11
유형자산	24,285,654	21,322,943
무형자산	1,977,835	1,918,259
투자부동산	2,442	2,468
이연법인세자산	136,291	136,291
기타비유동자산	755,303	748,471
자산총계	47,927,432	44,312,846
부채		
유동부채	9,295,372	8,076,214
매입채무	1,174,011	1,107,029
단기미지급금	4,377,114	2,642,022
기타지급채무	587,565	1,204,808
차입금	496,407	634,768
총당부채	71,254	103,099
당기법인세부채	2,470,592	2,354,425
기타유동부채	118,429	30,063
비유동부채	3,378,294	3,464,757
기타지급채무	4,443	4,406
장기차입금	3,266,118	3,394,588
확정급여부채	41,530	
기타비유동부채	66,203	65,763
부채총계	12,673,666	11,540,971
자본		
자본금	3,657,652	3,657,652
자본잉여금	4,183,564	4,183,564
기타자본	(770,825)	(771,100)
기타포괄손익누계액		(10,735)
이익잉여금	28,183,375	25,712,494
자본총계	35,253,766	32,771,875

자본과부채총계	47,927,432	44,312,846
---------	------------	------------

포괄손익계산서

제 71 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지

제 70 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 71 기 1분기		제 70 기 1분기	
	3개월	누적	3개월	누적
매출액	8,745,834	8,745,834	6,195,897	6,195,897
매출원가	3,499,128	3,499,128	3,032,583	3,032,583
매출총이익	5,246,706	5,246,706	3,163,314	3,163,314
판매비와관리비	881,643	881,643	775,312	775,312
영업이익	4,365,063	4,365,063	2,388,002	2,388,002
금융수익	198,853	198,853	354,480	354,480
금융비용	211,987	211,987	405,350	405,350
기타영업외수익	5,537	5,537	10,367	10,367
기타영업외비용	14,266	14,266	13,120	13,120
법인세비용차감전순이익	4,343,200	4,343,200	2,334,379	2,334,379
법인세비용	1,148,547	1,148,547	462,042	462,042
당기순이익	3,194,653	3,194,653	1,872,337	1,872,337
법인세차감후 기타포괄손익	(7,035)	(7,035)	(4,170)	(4,170)
후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 포괄손익				
확정급여제도의 재측정요소	(7,035)	(7,035)	(4,170)	(4,170)
총포괄이익	3,187,618	3,187,618	1,868,167	1,868,167
주당이익				
기본주당순이익 (단위 : 원)	4,525	4,525	2,652	2,652
희석주당순이익 (단위 : 원)	4,525	4,525	2,652	2,652

자본변동표

제 71 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지

제 70 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지

(단위 : 백만원)

	자본					
	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
2017.01.01 (기초자본)	3,657,652	4,183,564	(771,913)		16,022,210	23,091,513
당기순이익					1,872,337	1,872,337
확정급여제도의 재측정요소					(4,170)	(4,170)
배당금지급					(423,601)	(423,601)
주식선택권 부여			23			23

2017.03.31 (기말자본)	3,657,652	4,183,564	(771,890)		17,466,776	24,536,102
2018.01.01 (기초자본)	3,657,652	4,183,564	(771,100)		25,701,759	32,771,875
당기순이익					3,194,653	3,194,653
확정급여제도의 재측정요소					(7,035)	(7,035)
배당금지급					(706,002)	(706,002)
주식선택권 부여			275			275
2018.03.31 (기말자본)	3,657,652	4,183,564	(770,825)		28,183,375	35,253,766

현금흐름표

제 71 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지

제 70 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 71 기 1분기	제 70 기 1분기
영업활동현금흐름	4,399,945	2,311,727
영업으로부터 창출된 현금흐름	5,435,962	2,488,408
이자의 수취	25,077	1,996
이자의 지급	(29,059)	(28,760)
배당금의 수취	346	
법인세의 납부	(1,032,381)	(149,917)
투자활동현금흐름	(3,566,877)	(1,054,957)
단기금융상품의 순증감	1,354,040	130,000
단기투자자산의 순증감	(232,496)	131,686
기타수취채권의 감소	1,889	2,224
기타수취채권의 증가	(5,107)	(2,416)
장기투자자산의 처분	558	452
장기투자자산의 취득	(8,780)	(1,799)
기타금융자산의 감소		
기타금융자산의 증가		
파생상품거래로 인한 현금유입		203
파생상품거래로 인한 현금유출		(308)
유형자산의 처분	6,482	67,644
유형자산의 취득	(4,042,429)	(1,749,090)
무형자산의 처분		
무형자산의 취득	(190,134)	(190,542)
종속기업투자(MMT)의 순증감	(270,699)	556,989
종속기업투자의 취득	(180,201)	
재무활동현금흐름	(260,678)	204,616
차입금의 차입	298,732	342,830
차입금의 상환	(559,410)	(138,214)

배당금의 지급		
현금및현금성자산의 환율변동효과	(6,167)	(39,424)
현금및현금성자산의 순증감	566,223	1,421,962
기초 현금및현금성자산	2,270,036	476,917
기말 현금및현금성자산	2,836,259	1,898,879

5. 재무제표 주석

1. 회사의 개요

에스케이하이닉스 주식회사(이하 "당사")는 1996년에 주식을 한국거래소에 상장한 공개법인으로, 1949년 10월 15일에 설립되어 메모리반도체의 제조 및 판매업을 주업으로 하고 있습니다. 당사는 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091에 본사와 경기도 성남시 등에 사무소를 두고 있으며, 경기도 이천시와 충청북도 청주시에 생산공장을 설치·가동하고 있습니다.

한편, 2018년 3월 31일 현재 당사의 주주현황은 다음과 같습니다.

구 분	소유주식수(주)	지분율(%)
SK텔레콤주	146,100,000	20.07
국민연금공단 및 기타주주	559,901,795	76.91
자기주식	22,000,570	3.02
합 계	728,002,365	100.00

한편, 당분기말 현재 당사의 주식은 한국거래소가 개설하는 유가증권시장에, 주식예탁증서는 룩셈부르크 증권거래소에 상장되어 있습니다.

2. 재무제표 작성기준

(1) 회계기준의 적용

당사의 분기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약 중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차 보고기간말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.

당사의 분기재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거한 원가로 표시한 재무제표입니다.

당사의 분기재무제표에는 기업회계기준서 제1109호와 기업회계기준서 제1115호가 처음 적용되었으며, 유의적인 회계정책의 변경은 주석 3에서 설명하고 있습니다.

(2) 추정과 판단

① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성

한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.

분기재무제표에서 사용된 당사의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 주석 3에서 설명하고 있는 기업회계기준서 제1109호와 기업회계기준서 제1115호적용 관련 새로운 중요한 판단과 추정 불확실성의 주요 원천을 제외하고는, 2017년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

② 공정가치 측정

당사의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치 측정을 요구하고 있는 바, 당사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있습니다.

평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.

자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가방법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.

- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격
- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수
- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.

공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 금융위험관리 주석 등에 포함되어 있습니다.

3. 유의적인 회계정책

당사는 다음에서 설명하고 있는 사항을 제외하고 2017년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차재무제표를 작성할 때 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다. 다음에서 설명하고 있는 회계정책의 변경사항은 2018년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표에도 반영될 것입니다.

(1) 회계정책의 변경

당사는 2018년 1월 1일부터 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'과 제1109호 '금융상품'을 최초 적용하였습니다. 2018년 1월 1일 이후 적용되는 다른 기준서들은 당사의 재무제표에 미치는 유의적인 영향이 없습니다.

1) 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'

기업회계기준서 제1115호는 수익을 언제, 얼마나 인식할지를 결정하기 위한 포괄적인 체계입니다. 동 기준서는 현행 기업회계기준서 제1018호 '수익', 제1011호 '건설계약', 기업회계기준해석서 제2031호 '수익: 광고용역의 교환거래', 제2113호 '고객충성제도', 제2115호 '부동산건설약정', 제2118호 '고객으로부터의 자산이전'을 대체하였습니다.

당사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하였습니다. 개정기준서 도입으로 인하여 당사에 재무적 영향이 있는 항목은 다음과 같습니다.

① 반품권이 있는 판매 회계처리

당사는 고객에게 반도체 제품을 공급하는 계약에 있어 품질하자 등에 따른 반품을 허용하기 때문에 고객으로부터 수령하는 대가가 변동될 수 있습니다. 기업회계기준서 제1115호 적용시 당사는 고객으로부터 수령할 대가를 보다 적절하게 예측할 것으로 예상하는 기대값 방법을 사용하여 변동대가를 추정하고, 반품기한이 경과할 때 이미 인식한 누적 수익금액 중 유의적인 부분을 되돌리지 않을 가능성이 매우 높은 금액까지만 변동대가를 거래가격에 포함하여 수익을 인식합니다. 한편, 당사가 수령하였거나 수령할 대가 중 권리를 갖게 될 것으로 예상하지 않는 금액은 환불부채(계약부채)로 인식합니다.

② C조건 운송용역 회계처리

기업회계기준서 제1115호 적용시 고객과의 계약에서 제품판매와 제품운송의 수행의무가 식별되었으나 당사의 일반적인 거래형태인 도착지인도조건의 매출거래는 제품 운송이 완료된 후 제품의 통제가 이전되므로 두 개의 수행의무가 별도로 구별되지 않는 것으로 판단하였습니다. 하지만 고객이 운송료 또는 보험료를 부담하는 선적지인도조건(이하, "C조건")으로 체결된 수출거래의 경우에는 제품운송 수행의무가 제품에대한 통제가 고객에게 이전된 이후에 수행되므로 이를 별도의 수행의무로 식별하였으며, C조건 운송용역 매출과 관련된 운송비용을 매출원가로 인식하였습니다.

- 최초 적용일(당기초) 현재 재무상태표에 반영한 수정 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)			
계정과목	2017.12.31 수정전	조정	2018. 1. 1 수정후
I. 유동자산			
기타유동자산	434,724	26,183	460,907

기타	14,904,206	-	14,904,206
유동자산 계	15,338,930	26,183	15,365,113
II. 비유동자산	28,973,916	-	28,973,916
자 산 총 계	44,312,846	26,183	44,339,029
I. 유동부채			
총당부채	103,099	(45,148)	57,951
기타유동부채	30,063	71,331	101,394
기타	7,943,052	-	7,943,052
유동부채 계	8,076,214	26,183	8,102,397
II. 비유동부채	3,464,757	-	3,464,757
부 채 총 계	11,540,971	26,183	11,567,154
자 본 총 계	32,771,875	-	32,771,875
부 채 및 자 본 총 계	44,312,846	26,183	44,339,029

- 2018년 3월 31일 기준 당사의 분기재무상태표에서 기업회계기준서 제1115호 적용효과는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)			
계정과목	기업회계기준서 제1115호에 따른 금액	조정	기업회계기준서 제1018호에 따른 금액
I. 유동자산			
기타유동자산	526,573	(29,847)	496,726
기타	14,932,956	-	14,932,956
유동자산 계	15,459,529	(29,847)	15,429,682
II. 비유동자산	32,467,903	-	32,467,903
자 산 총 계	47,927,432	(29,847)	47,897,585
I. 유동부채			
총당부채	71,254	52,917	124,171
기타유동부채	118,429	(82,764)	35,665
기타	9,105,689	-	9,105,689
유동부채 계	9,295,372	(29,847)	9,265,525
II. 비유동부채	3,378,294	-	3,378,294
부 채 총 계	12,673,666	(29,847)	12,643,819
자 본 총 계	35,253,766	-	35,253,766
부 채 및 자 본 총 계	47,927,432	(29,847)	47,897,585

- 2018년 3월 31일 기준 당사의 분기포괄손익계산서에서 기업회계기준서 제1115호 적용효과는 다음과 같으며, 분기현금흐름표에 미치는 영향은 중요하지 않습니다.

(단위 : 백만원)			
계정과목	기업회계기준서 제1115호에 따른 금액	조정	기업회계기준서 제1018호에 따른 금액
I. 매출액	8,745,834	-	8,745,834
II. 매출원가	3,499,128	(5,454)	3,493,674
III. 매출총이익	5,246,706	5,454	5,252,160
판매비와관리비	881,643	5,454	887,097
IV. 영업이익	4,365,063	-	4,365,063
금융수익	198,853	-	198,853
금융비용	211,987	-	211,987
기타영업외수익	5,537	-	5,537
기타영업외비용	14,266	-	14,266
V. 법인세비용차감전순이익	4,343,200	-	4,343,200
법인세비용	1,148,547	-	1,148,547
VI. 분기순이익	3,194,653	-	3,194,653
VII. 법인세차감후 기타포괄손익	-7,035	-	-7,035
VIII. 총포괄이익	3,187,618	-	3,187,618

2) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'

기업회계기준서 제1109호는 금융자산, 금융부채 및 비금융항목을 매입하거나 매도할 수 있는 일부 계약의 인식과 측정을 규정합니다. 이 기준서는 기업회계기준서 제 1039호 '금융상품: 인식과 측정'을 대체합니다. 당사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1109호를 적용하였으며, 경과규정에 따라 전기 재무제표를 재작성하지 않았습니다.

금융상품의 분류와 측정으로 인해 변경된 기초 자본내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
조정내역	기타포괄손익누계액	이익잉여금
기업회계기준서 제1039호에 따른 기초 자본	(10,735)	25,712,494
매도가능금융자산에서 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 재분류	10,735	(10,735)
기업회계기준서 제1109호에 따른 기초 자본	-	25,701,759

① 금융자산과 금융부채의 분류

기업회계기준서 제1109호는 금융부채의 분류와 측정에 대한 기업회계기준서 제 1039호의 기존 요건을 대부분 유지하였습니다. 그러나 만기보유금융자산, 대여금 및수취채권과 매도가능금융자산의 금융자산 기존 분류를 삭제하였습니다.

기업회계기준서 제1109호에 의하면, 최초 적용 시에 금융자산은 상각후원가측정 금융자산, 기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품, 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품, 당기손익-공정가치 측정 범주로 분류됩니다. 기업회계기준서 제1109호에 따른 금융자산의 분류는 일반적으로 금융자산이 관리되는 방식인 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름의 특성에 근거하여 결정됩니다. 주계약이 이 기준서의 적용범위에 해당하는 금융자산인 계약에 내재된 파생상품은 분리되지 않습니다.

금융자산은 다음 두 가지 조건을 모두 충족하고, 당기손익-공정가치 측정 항목으로 지정되지 않은 경우 상각후원가로 측정됩니다.

- 계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이 목적인 사업모형 하에서 금융자산이 보유된다.
- 계약 조건에 따라 특정일에 이자와 원금 잔액에 대한 이자 지급만으로 구성되어 있는 현금흐름이 발생한다.

채무상품은 다음 두 가지 조건을 모두 충족하고 당기손익-공정가치 측정 항목으로 지정되지 않은 경우 기타포괄손익-공정가치로 측정됩니다.

- 계약상 현금흐름의 수취와 금융자산의 매도 둘 다를 통해 목적을 이루는 사업모형 하에서 금융자산이 보유된다.
- 계약 조건에 따라 특정일에 이자와 원금 잔액에 대한 이자 지급만으로 구성되어 있는 현금흐름이 발생한다.

단기매매항목이 아닌 지분상품의 최초 인식일에 당사는 그 투자지분의 후속적인 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 수 있으며, 그러한 선택을 취소할 수 없습니다. 이러한 선택은 금융상품 별로 이루어집니다.

위에서 설명된 상각후원가, 기타포괄손익-공정가치로 측정되지 않는 모든 금융상품은 모든 파생 금융자산을 포함하여 당기손익-공정가치로 측정됩니다. 당사는 상각후원가 또는 기타포괄손익-공정가치로 측정되어야 하는 금융자산을 회계불일치를 제거하거나 유의적으로 줄일 목적으로 해당 금융자산의 최초 인식시점에 당기손익-공정가치 측정 항목으로 지정할 수 있습니다. 다만, 이러한 지정은 취소할 수 없습니다.

최초에 거래가격으로 측정되는 유의적인 금융요소가 없는 매출채권이 아닌 금융자산은 당기손익-공정가치 측정 항목이 아니라면 최초에 공정가치에 취득에 직접 관련되는 거래원가를 가산하여 측정합니다.

다음 회계정책은 금융자산의 후속측정에 적용합니다.

당기손익-공정가치 측정 금융자산	이러한 자산은 후속적으로 공정가치로 측정합니다. 이자와 배당수익을 포함한 순손익은 당기손익으로 인식합니다.
상각후원가 측정 금융자산	이러한 자산은 후속적으로 유효이자율법을 사용하여 상각후원가로 측정합니다. 상각후원가는 손상손실에 의해 감소됩니다. 이자수익, 외화환산손익 및 손상은 당기손익으로 인식합니다. 제거에 따르는 손익도 당기손익으로 인식합니다.
기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품	이러한 자산은 후속적으로 공정가치로 측정합니다. 유효이자율법을 사용하여 계산된 이자수익, 외화환산손익과 손상은 당기손익으로 인식합니다. 다른 순손익은 기타포괄손익으로 인식합니다. 제거시에 기타포괄손익에 누적된손익은 당기손익으로 재분류합니다.
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품	이러한 자산은 후속적으로 공정가치로 측정합니다. 배당은 배당금이 명확하게 투자원가의 회수를 나타내지 않는다면 당기손익으로 인식합니다. 다른 순손익은 기타포괄손익으로 인식하고 절대로 당기손익으로 재분류되지 않습니다.

최초적용일인 2018년 1월 1일 현재 기업회계기준서 제1109호의 도입으로 인한 금융자산 범주의 재분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)					
구 분	측정범주		장부금액		
	도입 전	도입 후	도입 전	도입 후	차이
현금및현금성자산	대여금및수취채권	상각후원가	2,270,036	2,270,036	-
단기금융상품	대여금및수취채권	상각후원가	580,449	580,449	-
단기투자자산	당기손익인식금융자산	당기손익-공정가치	4,528,880	4,528,880	-
매출채권	대여금및수취채권	상각후원가	5,259,052	5,259,052	-
기타수취채권	대여금및수취채권	상각후원가	70,649	70,649	-
기타금융자산	대여금및수취채권	상각후원가	11	11	-
장기투자자산(*)	매도가능금융자산	당기손익-공정가치	37,593	37,593	-
금융자산 합계			12,746,670	12,746,670	-

(*) 당기초 현재 출자금 등을 포함한 37,593백만원은 매도가능금융자산에서 당기손익-공정가치측정 금융자산으로 재분류되었습니다. 동 금융자산은 계약상 현금흐름이 원리금 지급만을 나타내지 않아 상각후원가로 분류되는 조건을 충족하지 못합니다. 동 재분류로 인해 당기초 현재 관련 기타포괄손익누계액 (-)10,735백만원은 이익잉여금으로 재분류되었습니다. 당분기 중 동 금융자산과 관련한 공정가치 변동은 없습니다.

② 금융자산의 손상

기업회계기준서 제1109호는 기업회계기준서 제1039호의 '발생손실'모형을 기대신용손실'모형으로 대체하였습니다. 새로운 손상모형은 상각후원가로 측정되는 금융자산, 계약자산 및 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 채무상품에 적용되지만, 지분상품 투자에는 적용되지 않습니다. 기업회계기준서 제1109호에서 신용손실은 기업회계기준서 제1039호보다 일찍 인식됩니다.

기대신용손실은 신용손실의 확률가중추정치입니다. 신용손실은 모든 현금부족액(즉, 계약에 따라 지급받기로 한 모든 계약상 현금흐름과 수취할 것으로 예상하는 모든 계약상 현금흐름의 차이)의 현재가치로 측정됩니다.

매 보고기간말에, 당사는 상각후원가로 측정되는 금융자산과 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 채무증권의 신용이 손상되었는지 평가합니다. 금융자산의 추정미래현금흐름에 악영향을 미치는 하나 이상의 사건이 발생한 경우에 해당 금융자산은 신용이 손상된 것입니다. 당사는 기업회계기준서 제1109호의 도입으로 채무상품에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손상차손으로 인식하였습니다.

상각후원가로 측정하는 금융자산에 대한 손실충당금은 해당 자산의 장부금액에서 차감합니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대해서는 해당 자산의 장부금액을 감소시키는 대신에 손실충당금을 기타포괄손익에 인식합니다.

③ 위험회피회계

당사는 기업회계기준서 제1109호를 최초 적용하면서 동 기준서의 위험회피회계 요구사항을 적용하기로 결정하였습니다. 당기초 현재 위험회피수단으로 지정된 파생상품은 없으며, 따라서 기업회계기준서 제1109호의 위험회피회계 요구사항의 적용에 따라 발생하는 회계정책 변경의 효과는 없습니다.

(2) 미적용 제·개정 기준서

제정·공표되었으나 2018년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 아니한 제·개정 기준서는 다음과 같습니다. 당사는 분기재무제표 작성시 다음의 제·개정 기준서를 조기적용하지 아니하였습니다.

- 기업회계기준서 제1116호 '리스'

당사는 기업회계기준서 제1116호를 2019년 1월 1일 시작되는 회계연도부터 적용할 예정이며, 2018년 중 기업회계기준서 제1116호의 도입에 따른 재무영향을 분석하여 그 결과를 2018년 연차재무제표 주석에 공시할 예정입니다. 전기 연차 재무제표에서 설명한 일반적인 영향분석 이외의 당분기말 현재 동 기준서의 도입 준비와 관련한 중요한 변동사항은 없습니다.

4. 금융상품의 범주별 분류

(1) 당분기말과 전기말 현재 금융자산의 구분 내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)			
구 분	당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산	상각후원가로 측정하는 금융자산	합 계
현금및현금성자산	-	2,836,259	2,836,259
단기금융상품	-	3,163,900	3,163,900
단기투자자산	815,835	-	815,835
매출채권	-	5,436,158	5,436,158
기타수취채권	-	108,475	108,475
기타금융자산	-	11	11
장기투자자산	46,064	-	46,064
합 계	861,899	11,544,803	12,406,702

② 전기말

(단위: 백만원)				
구 분	당기손익인식 금융자산	매도가능 금융자산	대여금및 수취채권	합 계
현금및현금성자산	-	-	2,270,036	2,270,036
단기금융상품	-	-	4,528,880	4,528,880
단기투자자산	580,449	-	-	580,449
매출채권	-	-	5,259,052	5,259,052
기타수취채권	-	-	70,649	70,649
기타금융자산	-	-	11	11
장기투자자산	-	37,593	-	37,593
합 계	580,449	37,593	12,128,628	12,746,670

(2) 당분기말과 전기말 현재 금융부채의 구분내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)	
구 분	상각후원가로 측정하는 금융부채
매입채무	1,174,011
미지급금	4,377,114
기타지급채무(*)	592,008
차입금	3,762,525
합 계	9,905,658

② 전기말

(단위: 백만원)	
구 분	상각후원가로 측정하는 금융부채
매입채무	1,107,029
미지급금	2,642,022
기타지급채무(*)	1,209,214
차입금	4,029,356
합 계	8,987,621

(*) 당분기말과 전기말 현재 기타지급채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
미지급비용	587,565	1,204,808
비유동:		
임대보증금	4,443	4,406
합 계	592,008	1,209,214

5. 금융위험관리

(1) 금융위험관리

당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환율변동위험, 이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 중간재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2017년 12월 31일의 연차재무제표를 참고하시기 바랍니다. 당사의 위험관리부서 및 기타 위험관리정책에는 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다.

① 시장위험

(가) 환율변동위험

당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화, 유로화 및 엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생합니다.

당분기말 현재 당사의 화폐성 외화자산 및 외화부채의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 백만단위)				
구 분	자 산		부 채	
	현지통화	원화환산	현지통화	원화환산
USD	9,326	9,946,374	2,655	2,831,814
EUR	2	2,176	22	28,528
JPY	427	4,278	100,502	1,006,489

당분기말 현재 각 외화에 대한 환율 10% 변동을 가정한 화폐성 외화자산 및 외화부채의 환율변동위험은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	10% 상승시	10% 하락시
USD	711,456	(711,456)
EUR	(2,635)	2,635
JPY	(100,221)	100,221

(나) 이자율위험

당사의 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 차입금에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하고 있습니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 당사는 이자율위험에 노출되어 있으며 동 이자율위험의 일부는 변동이자부 현금성자산으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다.

당사는 당분기말 현재 이자율 변동에 따라 순이자비용이 변동할 위험에 일부 노출되어 있습니다. 당분기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 하락 또는 상승시, 향후 3개월 간 당사의 변동금리부 차입금 및 금융자산으로부터의 이자비용과 이자수익으로 인한 법인세비용차감전순이익은 3,559백만원만큼 증가 또는 감소할 것입니다.

(다) 가격위험

당사는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 지분증권 및 채무증권에 투자하고 있습니다. 당분기말 현재 해당 지분증권 및 채무증권은 가격위험에 노출되어 있습니다.

② 신용위험

신용위험은 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약 조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.

(가) 매출채권 및 기타수취채권

당사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하고 담보물을 확보하는 등 매출채권 및 기타수취채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 당사는 매출채권 및 기타수취채권에 대해 매 보고기간말에 개별적으로 손상여부를 검토하고 있으며, 해외 거래처에 대한 신용위험과 관련하여 신용보험계약을 체결하고 있습니다. 당사의 신용위험 노출정도는 거래상대방별 매출채권 등의 장부금액과 동일한 금액입니다.

(나) 기타의 자산

현금및현금성자산, 단기금융상품, 단기투자자산 및 장·단기대여금 등으로 구성되는당사의 기타의자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 당사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 당사는 다수의 금융기관에 현금및현금성자산과 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.

③ 유동성 위험

유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행하기 위한 필요자금을 조달하지 못할 위험입니다. 당사는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다.

당사는 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 이자부 당좌예금, 정기예금, 수시입출금식 예금 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다.

(2) 자본관리

당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.

자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 당사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 차입금 조달 및 상환, 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재의 부채비율과 순차입금비율은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
부 채 (A)	12,673,666	11,540,971
자 본 (B)	35,253,766	32,771,875
현금및현금성자산 등(C) (*1)	6,815,994	7,379,365
차입금 (D)	3,762,525	4,029,356
부채비율 (A/B)	35.95%	35.22%
순차입금비율 (D-C)/B (*2)	-	-

(*1) 현금및현금성자산, 단기금융상품 및 단기투자자산의 합계액입니다.

(*2) 당분기말과 전기말 현재 순차입금비율은 부(-)의 비율로 산출되어 표시하지 않았습니다

(3) 공정가치

공정가치는 다음과 같이 가치평가방법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.

- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격
- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수
- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

공정가치 서열체계를 포함한 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)					
구 분	장부금액	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
공정가치로 측정되는 금융자산:					
단기투자자산	815,835	-	815,835	-	815,835
장기투자자산	46,064	-	-	46,064	46,064
소 계	861,899	-	815,835	46,064	861,899
공정가치로 측정되지 않는 금융자산:					
현금및현금성자산(*)	2,836,259	-	-	-	-
단기금융상품(*)	3,163,900	-	-	-	-
매출채권(*)	5,436,158	-	-	-	-
기타수취채권(*)	108,475	-	-	-	-
기타금융자산(*)	11	-	-	-	-
소 계	11,544,803	-	-	-	-
금융자산 합계	12,406,702	-	815,835	46,064	861,899
공정가치로 측정되지 않는 금융부채:					
매입채무(*)	1,174,011	-	-	-	-
미지급금(*)	4,377,114	-	-	-	-
기타지급채무(*)	592,008	-	-	-	-
차입금	3,762,525	-	3,770,787	-	3,770,787
금융부채 합계	9,905,658	-	3,770,787	-	3,770,787

② 전기말

(단위: 백만원)					
구 분	장부금액	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
공정가치로 측정되는 금융자산:					
단기투자자산	580,449	-	580,449	-	580,449
장기투자자산	37,593	-	-	37,593	37,593
소 계	618,042	-	580,449	37,593	618,042
공정가치로 측정되지 않는 금융자산:					
현금및현금성자산(*)	2,270,036	-	-	-	-
단기금융상품(*)	4,528,880	-	-	-	-
매출채권(*)	5,259,052	-	-	-	-
기타수취채권(*)	70,649	-	-	-	-
기타금융자산(*)	11	-	-	-	-
소 계	12,128,628	-	-	-	-
금융자산 합계	12,746,670	-	580,449	37,593	618,042
공정가치로 측정되지 않는 금융부채:					
매입채무(*)	1,107,029	-	-	-	-
미지급금(*)	2,642,022	-	-	-	-
기타지급채무(*)	1,209,214	-	-	-	-
차입금	4,029,356	-	4,037,013	-	4,037,013
금융부채 합계	8,987,621	-	4,037,013	-	4,037,013

(*) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치는 포함하고 있지 않습니다.

③ 가치평가기법

수준 2 및 수준 3의 공정가치 측정을 위해 사용된 평가기법은 전기말과 동일합니다.

④ 당분기 중 수준 1, 수준 2 및 수준 3간의 대체는 없으며, 수준 3 공정가치 측정으로 분류되는 금융자산의 당기 중 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	기 초	취 득	처 분	분기말
장기투자자산	37,593	8,780	(309)	46,064

6. 사용제한 금융상품

당분기말과 전기말 현재 사용이 제한된 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
단기금융상품:		
중소기업지원관련 사용제한(상생펀드)	227,500	227,500
기타금융자산:		
당좌개설보증금	11	11
합 계	227,511	227,511

7. 매출채권 및 기타수취채권

(1) 당분기말과 전기말 현재 기타수취채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
미수금	51,100	15,348
미수수익	19,487	20,630
단기대여금	5,066	5,071
소 계	75,653	41,049
비유동:		
장기대여금	1,652	2,160
보증금	31,170	27,440
소 계	32,822	29,600
합 계	108,475	70,649

(2) 대손충당금의 내역

당분기말과 전기말 현재 대손충당금 차감전 총액 기준에 의한 매출채권 및 기타수취채권과 관련 대손충당금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)						
구 분	당분기말			전기말		
	채권액	대손충당금	장부금액	채권액	대손충당금	장부금액
매출채권	5,436,158	-	5,436,158	5,259,052	-	5,259,052
유동성 기타수취채권	76,938	(1,285)	75,653	42,335	(1,286)	41,049
비유동성 기타수취채권	32,924	(102)	32,822	29,702	(102)	29,600
합 계	5,546,020	(1,387)	5,544,633	5,331,089	(1,388)	5,329,701

(3) 당분기와 전분기 중 매출채권 및 기타수취채권의 대손충당금의 변동은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)					
구 분	기 초	대손상각비	환 입	제 각	기 말
매출채권	-	-	-	-	-
유동성 기타수취채권	1,286	-	(1)	-	1,285
비유동성 기타수취채권	102	-	-	-	102
합 계	1,388	-	(1)	-	1,387

② 전분기

(단위: 백만원)					
구 분	기 초	대손상각비	환 입	제 각	기 말
매출채권	1,069	169	-	-	1,238
유동성 기타수취채권	1,371	168	-	-	1,539
비유동성 기타수취채권	399	3	-	-	402
합 계	2,839	340	-	-	3,179

8. 재고자산

당분기말과 전기말 현재 재고자산 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)						
구 분	당분기말			전기말		
	취득원가	평가손실총당금	장부금액	취득원가	평가손실총당금	장부금액
제품	655,742	(66,208)	589,534	520,895	(105,601)	415,294
재공품	1,560,699	(23,207)	1,537,492	1,432,927	(29,096)	1,403,831
원재료	255,140	(12,966)	242,174	251,791	(25,960)	225,831
저장품	219,636	(7,116)	212,520	176,006	(7,040)	168,966
미착품	23,431	-	23,431	10,818	-	10,818
합 계	2,714,648	(109,497)	2,605,151	2,392,437	(167,697)	2,224,740

9. 기타유동자산 및 기타비유동자산

당분기말과 전기말 현재 기타유동자산 및 기타비유동자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
선급금	46,291	33,859
선급비용	251,570	205,823
부가세대급금	197,455	191,996
계약자산	29,847	-
기타	1,410	3,046
소 계	526,573	434,724
비유동:		
장기선급금	163,277	183,489
장기선급비용	592,026	551,597
소 계	755,303	735,086
합 계	1,281,876	1,169,810

10. 종속기업, 관계기업 및 공동기업

(1) 당분기말과 전기말 현재 종속기업, 관계기업 및 공동기업의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
종속기업	4,879,510	4,426,309
관계기업 및 공동기업	351,971	351,971
합 계	5,231,481	4,778,280

(2) 당분기말과 전기말 현재 종속기업의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)						
구 분	소재지	주요영업활동	당분기말		전기말	
			지분율(%)	장부금액	지분율(%)	장부금액
에스케이하이이엔지(주)	국 내	사업지원 및 서비스	100.00	7,521	100.00	7,521
에스케이하이시스템(주)	국 내	사업지원 및 공사 등	100.00	6,760	100.00	6,760
(주)실리콘화일(*1)	국 내	전자·전기부품 개발 및 제조	-	-	100.00	30,756
행복모아(주)	국 내	사업지원 및 제조	100.00	7,400	100.00	7,400
에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)(*1,2)	국 내	파운드리 사업	100.00	404,928	100.00	290,172
SK hynix America Inc.(SKHYA)	미 국	해외판매법인	97.74	31	97.74	31
SK hynix Deutschland GmbH(SKHYD)	독 일	해외판매법인	100.00	22,011	100.00	22,011
SK hynix Asia Pte. Ltd.(SKHYS)	싱가포르	해외판매법인	100.00	52,380	100.00	52,380
SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd.(SKHYH)	홍 콩	해외판매법인	100.00	32,623	100.00	32,623
SK hynix U.K. Ltd.(SKHYU)	영 국	해외판매법인	100.00	1,775	100.00	1,775
SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.(SKHYT)	대 만	해외판매법인	100.00	37,562	100.00	37,562
SK hynix Japan Inc.(SKHYJ)	일 본	해외판매법인	100.00	42,905	100.00	42,905
SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.(SKHYCS)	중 국	해외판매법인	100.00	4,938	100.00	4,938
SK hynix Semiconductor India Private Ltd.(SKHYIS)(*3)	인 도	해외판매법인	1.00	5	1.00	5
SK hynix(Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.(SKHYCW)	중 국	해외판매법인	100.00	237	100.00	237
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.(SKHYCL)	중 국	해외제조법인	90.26	2,847,911	90.26	2,847,911
SK hynix Semiconductor (Wuxi) Ltd.(SKHYMC)	중 국	해외제조법인	100.00	238,271	100.00	238,271
SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.(SKHYCQL)(*4)	중 국	해외제조법인	-	-	-	-
SK hynix Italy S.r.l.(SKHYIT)	이탈리아	해외연구개발법인	100.00	18	100.00	18
SK hynix memory solutions Inc.(SKHMS)	미 국	해외연구개발법인	100.00	311,283	100.00	311,283
SK hynix Flash Solution Taiwan(SKHYFST)	대 만	해외연구개발법인	100.00	7,819	100.00	7,819
Softeq Flash Solutions LLC.(SOFTEQ)	벨라루스	해외연구개발법인	99.93	14,579	99.93	14,579
SK APTECH Ltd.(SKAPTECH)(*5)	홍 콩	해외투자법인	100.00	262,500	100.00	166,299
SK hynix Ventures Hong Kong Ltd.(SKH Ventures)	홍 콩	해외투자법인	100.00	3,053	100.00	3,053
MMT(특정금전신탁)(*6)	국 내	특정금전신탁	100.00	573,000	100.00	300,000
합 계				4,879,510		4,426,309

(*1) 당분기 중 에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)가 (주)실리콘화일을 흡수합병하였습니다.

(*2) 당분기 중 유상증자로 인하여 84,000백만원의 추가취득이 발생하였습니다.

(*3) 종속기업인 SK hynix Asia Pte. Ltd.(SKHYS)의 종속기업입니다.

(*4) 종속기업인 SK APTECH Ltd.(SKAPTECH)의 종속기업입니다.

(*5) 당분기 중 유상증자로 인하여 96,201백만원의 추가취득이 발생하였습니다.

(*6) 당분기 중 MMT(특정금전신탁)을 전액 처분하고 신규 취득하였습니다.

(3) 당분기말과 전기말 현재 관계기업 및 공동기업의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)							
구 분	회사명	소재지	주요영업활동	당분기말		전기말	
				지분율(%)	장부금액	지분율(%)	장부금액
관계기업	Stratio, Inc. (*)	미 국	반도체 부품 개발 및 제조	9.12	2,194	9.12	2,194
	SK China Company Limited (*)	중 국	부동산 투자업 등	11.87	257,169	11.87	257,169
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.(HITECH)	중 국	반도체 부품 제조	45.00	92,608	45.00	92,608
합 계					351,971		351,971

(*) 이사선임권을 통해 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 관계기업으로 분류하였습니다.

11. 장기투자자산

당분기와 전분기 중 장기투자자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	37,593	143,590
취득	8,780	1,799
처분	(309)	(452)
기말장부금액	46,064	144,937

12. 유형자산

(1) 당분기와 전분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	21,322,943	16,071,281
취득	4,074,772	1,982,068
처분 및 폐기	(9,047)	(69,112)
감가상각	(1,103,014)	(871,397)
기말장부금액	24,285,654	17,112,840

(2) 당분기말 현재 당사의 일부 토지와 건물 등은 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다.(주석 30 참조)

(3) 금융리스와 운용리스 이용내역

당분기말 현재 당사는 HANSU TECHNICAL SERVICE LTD.으로부터 기계장치를 금융리스계약을 통하여 사용하고 있습니다.

당분기말 현재 금융리스 계약에 따른 기계장치 등의 장부금액은 76,000백만원(전기말: 77,434백만원)입니다. 동 기계장치 등은 금융리스부채와 관련하여 담보로 제공되어 있습니다.

당사는 보유중인 기계장치 중 일부에 대하여 에스케이하이이엔지(주) 등과 운용리스 계약을 체결하고 있으며, 당분기말 현재 동 운용리스로 제공된 자산의 장부금액은 220,108백만원(전기말: 35,244백만원)입니다.

당분기말 현재 당사는 Macquarie Capital로부터 기계장치를 운용리스계약에 의하여 사용하고 있으며, 기간별 리스료의 지급계획은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)	
구 분	리스료지급액
1년 이내	150,684
1년 초과	159,488
합 계	310,172

13. 무형자산

(1) 당분기와 전분기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	1,918,259	1,546,733
취득	190,134	190,542
처분 및 폐기	(1,624)	(1,792)
상각	(125,471)	(73,566)
손상차손	(3,463)	-
기말장부금액	1,977,835	1,661,917

(2) 당분기 중 개발활동과 관련하여 발생한 비용 중 개발비 인식요건을 충족하는 132,545백만원(전분기:140,624백만원)은 개발비로 자산화하였으며 연구활동과 관련하여 발생한 비용과 개발비 인식요건을 충족하지 못하는 개발활동 관련비용 512,468백만원(전분기:458,537백만원)은 경상개발비로 비용인식하였습니다.

14. 투자부동산

(1) 당분기와 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	2,468	2,573
감가상각	(26)	(26)
기말장부금액	2,442	2,547

(2) 당분기 중 발생한 투자부동산의 감가상각비 26백만원(전분기:26백만원)은 전액 매출원가에 포함되어 있습니다.

(3) 당분기 중 투자부동산과 관련하여 발생한 임대수익은 122백만원(전분기:124백만원)입니다.

15. 차입금

당분기말과 전기말 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
단기차입금	-	107,140
유동성장기차입금	346,485	307,792
유동성사채	149,922	219,836
소 계	496,407	634,768
비유동:		
장기차입금	1,649,926	2,077,431
사채	1,616,192	1,317,157
소 계	3,266,118	3,394,588
합 계	3,762,525	4,029,356

16. 기타유동부채 및 기타비유동부채

당분기말과 전기말 현재 기타유동부채 및 기타비유동부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
선수금	110	196
선수수익	57	81
예수금	35,498	29,767
보증예수금	-	19
계약부채	82,764	-
소 계	118,429	30,063
비유동:		
기타장기종업원급여부채	61,303	60,863
장기선수금	4,900	4,900
소 계	66,203	65,763
합 계	184,632	95,826

17. 총당부채

(1) 당분기와 전분기 중 총당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)						
구 분	기 초	전 입	사 용	환 입	환율변동	기 말
계약손실총당부채	7,316	429	-	-	-	7,745
판매보증총당부채	3,763	-	(25)	(216)	-	3,522
반품총당부채(*)	-	-	-	-	-	-
소송총당부채	9,460	-	(4,391)	-	264	5,333
배출부채	37,412	29,144	(11,902)	-	-	54,654
합 계	57,951	29,573	(16,318)	(216)	264	71,254

(*) 기업회계기준서 제1115호의 적용으로 인하여 고객의 반품권 행사로 장래에 지출될 것이 예상되는 금액과, 당사가 고객으로부터 제품을 회수할 권리를 각각 기타유동자산(계약자산)과 기타유동부채(계약부채)로 구분하여 표시하였습니다.

② 전분기

(단위: 백만원)					
구 분	기 초	전 입	사 용	환율변동	기 말
계약손실충당부채	163	848	-	-	1,011
판매보증충당부채	2,988	655	-	-	3,643
반품충당부채	16,346	11,047	(5,959)	-	21,434
소송충당부채	400	-	-	(24)	376
배출부채	26,108	11,669	-	-	37,777
합 계	46,005	24,219	(5,959)	(24)	64,241

(2) 계약손실충당부채

당사는 당사의 종속기업인 SK hynix Semiconductor (China) Ltd.로부터 Wafer반제품을 구매하고 있으며, 당분기말 현재 동 종속기업이 생산중인 재공품에 대해서 구매후 추가 가공하여 판매할 경우 예상되는 매출손실을 계약손실충당부채전입액으로 하여 매출원가에 가산하고 충당부채로 인식하고 있습니다.

(3) 판매보증충당부채

당사는 무상 품질보증수리 등과 관련하여 장래에 지출될 것이 예상되는 금액을 과거 경험을 등을 기초로 추정하여 충당부채로 인식하고 있습니다.

(4) 반품충당부채

당사는 전기 중 판매 후 반품이 예상되는 매출액을 합리적으로 추정하여 매출액과 매출원가에서 각각 차감하고 매출총이익에 해당하는 금액과 반품과 관련하여 발생할 것으로 예상되는 비용의 합계액을 충당부채로 인식하였습니다. 당기 중 기업회계기준서 제1115호 도입으로 인하여 고객의 반품권 행사로 장래에 지출될 것이 예상되는금액과, 당사가 고객으로부터 제품을 회수할 권리를 각각 기타유동자산과 기타유동부채로 재분류하였습니다.

(5) 소송충당부채

당사는 소송 혹은 분쟁 등과 관련하여 경제적 효익이 내재된 자원이 유출될 가능성이 높고 그 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 그 금액을 충당부채로 인식하고 있습니다.

(6) 배출부채

당사는 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률'에 따라 장래에 지출될 것이 예상되는 금액을 추정하여 충당부채로 인식하고 있습니다.

18. 종업원급여

(1) 당분기말과 전기말 현재 확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
확정급여채무의 현재가치	1,332,229	1,285,003
사외적립자산의 공정가치(*)	(1,290,699)	(1,298,388)
순확정급여부채	41,530	(13,385)
확정급여부채	41,530	-
확정급여자산(*)	-	13,385

(*) 전기말 현재 확정급여제도의 초과적립액 13,385백만원을 종업원급여자산으로 표시하였습니다.

(2) 당분기말과 전기말 현재 보험수리적 평가를 위해 사용된 주요 추정은 다음과 같습니다.

구 분	당분기말(%)	전기말(%)
할인율	4.31	4.31
미래임금상승률	5.46	5.46

(3) 당분기와 전분기 중 확정급여채무의 현재가치 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	1,285,003	1,157,053
당기근무원가	40,759	37,130
이자원가	13,646	11,400
관계사전출입액	743	4
퇴직급여지급액	(7,922)	(9,758)
기말장부금액	1,332,229	1,195,829

(4) 당분기와 전분기 중 사외적립자산의 공정가치 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	1,298,388	859,100
이자수익	13,777	8,460
관계사전출입액	852	(106)
퇴직급여지급액	(15,283)	(11,789)
재측정요소	(7,035)	(4,170)
기말장부금액	1,290,699	851,495

(5) 당분기와 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 손익으로 인식된 비용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
당기근무원가	40,759	37,130
순이자원가	(131)	2,940
합 계	40,628	40,070

(6) 당분기말과 전기말 현재 사외적립자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
예적금	1,289,391	1,297,024
기타	1,308	1,364
합 계	1,290,699	1,298,388

한편, 당분기와 전분기 중 사외적립자산의 실제수익은 각각 6,742백만원과 4,290백만원입니다.

(7) 당분기 중 확정기여형 퇴직연금제도와 관련하여 비용으로 인식된 금액은 44백만원(전분기: 16백만원)입니다.

19. 파생상품거래

(1) 당분기말과 전기말 현재 재무상태표에 인식된 파생상품은 없습니다.

(2) 전분기 중 파생상품 거래와 관련하여 금융수익 및 금융비용으로 인식한 평가손익 및 거래손익은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	평가이익	평가손실	거래이익	거래손실
이자율스왑	99	-	203	308

20. 자본금, 자본잉여금 및 기타자본

(1) 당분기말 현재 당사의 수권주식수는 9,000,000천주이고, 1주당 액면금액은 5,000원입니다. 한편, 당분기말과 전기말 현재 보통주 발행주식수, 보통주자본금, 자본잉여금 및 기타자본의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, 천주)		
구 분	당분기말	전기말
보통주 발행주식수(*)	731,530	731,530
보통주자본금	3,657,652	3,657,652
자본잉여금:		
주식발행초과금	3,625,797	3,625,797
기타	557,767	557,767
소 계	4,183,564	4,183,564
기타자본:		
자기주식 취득금액	(771,913)	(771,913)
주식선택권	1,088	813
소 계	(770,825)	(771,100)
자기주식수	22,001	22,001

(*) 당분기말 현재 과거 이익소각의 영향으로 인하여 상장주식 총수 728,002천주와 발행주식 총수에 차이가 있습니다.

(2) 당분기와 전기 중 당사의 유통주식수는 706,002천주로 변동이 없습니다.

21. 기타포괄손익누계액

당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
매도가능금융자산평가손익(*)	-	(10,735)

(*) 기업회계기준서 제1109호의 적용으로 인하여 매도가능금융자산에서 당기손익-공정가치측정 금융자산으로 재분류 됨에 따라, 당기 초 현재 관련 기타포괄손익누계액 (-)10,735백만원은 이익잉여금으로 재분류되었습니다.

22. 이익잉여금

당분기말과 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
법정적립금(*1)	178,955	108,354
임의적립금(*2)	235,506	235,506
미처분이익잉여금(*3)	27,768,914	25,368,634
합 계	28,183,375	25,712,494

(*1) 당사는 상법의 규정에 따라, 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전에 사용가능합니다.

(*2) 임의적립금은 기술개발준비금으로 구성되어 있습니다.

(*3) 2018년 3월 28일자 주주총회에서 배당금 706,002백만원이 결의되었으며, 당분기말 현재 미지급배당금은 미지급금에 포함되어 있습니다.

23. 판매비와관리비

당분기와 전분기 중 발생한 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
급 여	97,888	95,576
퇴직급여	7,256	6,499
복리후생비	17,644	14,007
지급수수료	51,407	55,159
감가상각비	25,247	19,120
무형자산상각비	109,558	64,498
운반보관비	2,860	7,224
송무비	3,082	6,174
임차료	620	1,064
세금과공과	1,576	1,669
교육훈련비	6,644	4,487
광고선전비	10,022	7,816
수도광열비	2,631	7,141
소모품비	11,081	14,034
수선비	5,251	1,677
여비교통비	2,283	1,827
판매촉진비	1,842	1,169
판매수리비	5,434	654
기타	6,849	6,980
소 계	369,175	316,775
경상개발비:		
연구개발비 총지출액	645,013	599,161
개발비 자산화	(132,545)	(140,624)
소 계	512,468	458,537
판매비와관리비 합계	881,643	775,312

24. 비용의 성격별 분류

당분기와 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
제품 및 재공품의 변동	(307,901)	(27,040)
원재료 및 소모품 사용	1,636,693	1,224,103
종업원급여	715,299	670,150
유형자산, 투자부동산, 무형자산 상각	1,198,021	915,948
기술료	55,544	56,170
지급수수료	285,752	233,539
동력 및 수도광열비	214,384	187,787
수선비	171,788	123,804
외주가공비	301,489	291,366
기타	109,702	132,068
합 계(*)	4,380,771	3,807,895

(*) 분기포괄손익계산서상의 매출원가와 판매비와관리비를 합산한 금액입니다.

25. 금융수익 및 금융비용

당분기와 전분기 중 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
금융수익 :		
이자수익	23,936	8,812
배당금수익	35,966	14,828
외환차이	135,813	329,068
파생상품관련이익	-	302
단기투자자산평가이익(*)	835	226
단기투자자산처분이익(*)	2,055	1,244
장기투자자산처분이익	248	-
소 계	198,853	354,480
금융비용 :		
이자비용	23,782	28,438
외환차이	188,205	376,604
파생상품관련손실	-	308
소 계	211,987	405,350
순금융손익	(13,134)	(50,870)

(*) 전분기의 단기투자자산 관련손익은 당분기의 분류에 따라 재분류 되었습니다.

26. 기타영업외수익과 기타영업외비용

(1) 당분기와 전분기 중 기타영업외수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
유형자산처분이익	2,374	5,261
종속기업및관계기업투자처분이익	2,301	1,989
기타	862	3,117
합 계	5,537	10,367

(2) 당분기와 전분기 중 기타영업외비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
유형자산처분손실	4,939	6,729
무형자산처분손실	1,624	1,792
무형자산손상차손	3,463	-
매출채권처분손실	669	655
기부금	1,029	1,907
기타	2,542	2,037
합 계	14,266	13,120

27. 법인세비용

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 경영진의 가중평균연간법인세율에 대한 최선의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 법인세비용에는 과거기간 당기법인세에 대하여 당분기에 인식한 조정사항이 포함되어 있습니다.

28. 주당이익

주당이익은 보통주 및 희석성 잠재적 보통주 1주에 대한 순이익을 계산한 것으로 그 내역은 다음과 같습니다.

(1) 기본주당이익

(단위: 백만원, 주)		
구 분	당분기	전분기
보통주분기순이익	3,194,653	1,872,337
가중평균유통보통주식수(*)	706,001,795	706,001,795
기본주당이익	4,525 원	2,652 원

(*) 주당이익을 계산하기 위한 가중평균유통보통주식수의 산출근거는 다음과 같습니다.

(단위: 주)		
구 분	당분기	전분기
발행주식수	728,002,365	728,002,365
자기주식 효과	(22,000,570)	(22,000,570)
가중평균유통보통주식수	706,001,795	706,001,795

(2) 희석주당이익

(단위: 백만원, 주)		
구 분	당분기	전분기
보통주희석분기순이익	3,194,653	1,872,337
가중평균희석유통보통주식수(*)	706,075,772	706,001,795
희석주당이익	4,525 원	2,652 원

(*) 희석주당이익을 계산하기 위한 가중평균희석유통보통주식수의 산출근거는 다음과 같습니다.

(단위: 주)		
구 분	당분기	전분기
가중평균유통보통주식수	706,001,795	706,001,795
주식선택권 효과	73,977	-
가중평균희석유통보통주식수	706,075,772	706,001,795

29. 특수관계자 및 대규모기업집단 소속회사와 거래

(1) 당분기말 현재 특수관계자의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	회사명
종속기업	SKHYA외 22사 (*)
관계기업	Stratio, Inc., SK China Company Limited, Gemini Partners Pte. Ltd., TCL Fund
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co.,Ltd.
기타특수관계자	당사에 유의적인 영향력을 행사하는 SK텔레콤(주) 및 그 종속기업과 SK텔레콤(주)의 지배기업인 SK(주)와 그 종속기업

(*) 종속기업인 MMT(특정금전신탁)는 제외하였습니다.

(2) 당분기말 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

회 사 명	지배기업	비 고
에스케이하이이엔지(주)	당사	국내종속기업
에스케이하이텍(주)	당사	국내종속기업
행복모아(주)	당사	국내종속기업
에스케이하이닉스 시스템아이씨(주) (SKHYSI)	당사	국내종속기업
SK hynix America Inc.(SKHYA)	당사	해외판매법인
SK hynix Deutschland GmbH(SKHYD)	당사	해외판매법인
SK hynix Asia Pte. Ltd.(SKHYS)	당사	해외판매법인
SK hynix Semiconductor HongKong Ltd.(SKHYH)	당사	해외판매법인
SK hynix U.K. Ltd.(SKHYU)	당사	해외판매법인
SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.(SKHYT)	당사	해외판매법인
SK hynix Japan Inc.(SKHYJ)	당사	해외판매법인
SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co.,Ltd.(SKHYCS)	당사	해외판매법인
SK hynix Semiconductor India Pvt Ltd.(SKHYIS)	SKHYS	해외판매법인
SK hynix(Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.(SKHYCW)	당사	해외판매법인
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.(SKHYCL)	당사	해외제조법인
SK hynix Semiconductor (Wuxi) Ltd.(SKHYMC)	당사	해외제조법인
SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.(SKHYCQL)	SKAPTECH	해외제조법인
SK hynix Italy S.r.l(SKHYIT)	당사	해외연구개발법인
SK hynix memory solutions Inc.(SKHMS)	당사	해외연구개발법인
SK hynix Flash Solution Taiwan(SKHYFST)	당사	해외연구개발법인
Softeq Flash Solutions LLC.(SOFTEQ)	당사	해외연구개발법인
SK APTECH Ltd.(SKAPTECH)	당사	해외투자법인
SK hynix Ventures Hong Kong Ltd.(SKH Ventures)	당사	해외투자법인

(3) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)					
구분	회사명	영업수익 등	영업비용 등	자산취득	배당금수익
종속기업	국내종속기업	63,090	151,652	33,148	22,500
	해외판매법인	8,473,030	50,000	859,058	-
	해외제조법인(*1)	6,855	620,124	77,799	-
	해외연구개발법인	25	52,499	-	-
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co.,Ltd.	-	148,740	-	13,120
	기타특수관계자				
	SK텔레콤㈜(*2)	28	151,060	2,455	-
	SK㈜(*3)	46	41,386	45,765	-
	SK건설㈜	76	31	547,553	-
	SK에너지㈜	400	34,306	-	-
	SK네트웍스㈜	-	135	10,600	-
	에스케이씨솔믹스㈜	-	1,349	96	-
	충청에너지서비스㈜	-	8,583	-	-
	행복나래㈜	6	99,520	11,311	-
	SK머티리얼즈㈜	-	12,133	-	-
	SK실트론㈜	608	37,625	-	-
	기타	4	46,806	3,251	-
	합계	8,544,168	1,455,949	1,591,036	35,620

(*1) 해외제조법인에 대한 누적 영업수익 등에는 자산 처분액 5,636백만원이 포함되어 있습니다.

(*2) 영업비용 등에는 배당금 146,100백만원이 포함되어 있습니다.

(*3) 당분기 중 발생한 SK브랜드 사용료는 8,457백만원입니다.

② 전분기

(단위: 백만원)					
구 분	회사명	영업수익 등	영업비용 등	자산취득	배당금수익
종속기업	국내종속기업	4,102	69,566	16,977	-
	해외판매법인	5,826,287	37,335	425,938	-
	해외제조법인(*1)	67,038	553,754	1,262	-
	해외연구개발법인	24	45,281	-	-
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	1,042	140,709	-	14,828
기타특수관계자	SK텔레콤㈜(*2)	32	89,986	1,534	-
	SK㈜(*3)	51	31,230	25,216	-
	SK건설㈜	70	-	116,659	-
	SK에너지㈜	401	20,690	-	-
	SK네트웍스㈜	-	123	-	-
	에스케이씨솔믹스㈜	-	7,668	170	-
	충청에너지서비스㈜	-	7,805	-	-
	행복나래㈜	5	55,913	4,448	-
	SK머티리얼즈㈜	-	8,152	-	-
	기타	25	37,106	2,148	-
합 계		5,899,077	1,105,318	594,352	14,828

(*1) 해외제조법인에 대한 영업수익 등에는 자산 처분액 65,875백만원이 포함되어 있습니다

(*2) 영업비용 등에는 배당금 87,660백만원이 포함되어 있습니다.

(*3) 전분기 중 발생한 SK브랜드 사용료는 9,293백만원입니다.

(4) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권·채무 내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)				
구 분	회사명	채 권		채 무
		매출채권 등	대여금	미지급금 등
종속기업	국내종속기업	60,523	4,920	135,740
	해외판매법인	5,235,178	-	888,804
	해외제조법인	93,024	-	521,575
	연구개발법인	1,343	-	18,347
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co.,Ltd.	13,065	-	100,243
기타특수관계자	SK텔레콤(주)	-	-	4,794
	SK(주)	5,366	-	129,879
	SK건설(주)	28	-	603,453
	SK에너지(주)	56	-	6,716
	SK네트웍스(주)	-	-	21
	에스케이씨솔믹스(주)	-	-	2,025
	충청에너지서비스(주)	-	-	1,652
	행복나래(주)	2	-	25,755
	SK머티리얼즈(주)	-	-	14,068
	SK실트론(주)	150,263	-	15,735
	기타	2	-	40,483
합 계		5,558,850	4,920	2,509,290

② 전기말

(단위: 백만원)				
구 분	회사명	채 권		채 무
		매출채권 등	대여금	미지급금 등
총속기업	국내총속기업(*1)	37,293	4,920	174,644
	해외판매법인	5,081,829	-	466,164
	해외제조법인	32,850	-	438,892
	해외연구개발법인	22	-	28,511
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co.,Ltd.	-	-	90,782
기타특수관계자	SK텔레콤(주)	94	-	2,803
	SK(주)	5,365	-	105,960
	SK건설(주)	21	-	941,843
	SK에너지(주)	93	-	10,505
	SK네트웍스(주)	-	-	1,033
	에스케이씨솔믹스(주)	-	-	1,576
	충청에너지서비스(주)	11	-	2,127
	행복나래(주)	2	-	46,406
	SK머티리얼즈(주)	-	-	9,889
	SK실트론(주)(*2)	150,384	-	10,429
	기타	2	-	90,279
합 계		5,307,966	4,920	2,421,843

(*1) 전기 중 행복모아(주)에 4,920백만원을 대여하였습니다.

(*2) 당사는 전기 중 Wafer 구매대금 150,000백만원을 선급하였습니다.(주석 30 참조)

(5) 주요 경영진에 대한 보상

당사의 주요 경영진은 이사(등기 및 비등기), 이사회 구성원, 재무책임자 및 내부감사책임자를 포함하고 있습니다. 종업원 용역의 대가로서 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
급여	22,248	17,354
퇴직급여	2,709	2,227
주식보상비용	275	23
기타	4	3
합 계	25,236	19,607

(6) 당분기와 전분기 중 기업회계기준서 제1024호 '특수관계자 공시'에 따른 특수관계자 범위에 포함되지 않으나, 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)					
구 분	회사명	영업수익 등	영업비용 등	자산취득	배당금수익
대규모기업집단소속회사	SK케미칼주	-	296	-	-

② 전분기

(단위: 백만원)					
구 분	회사명	영업수익 등	영업비용 등	자산취득	배당금수익
대규모기업집단소속회사	SK케미칼주	-	238	-	-

(7) 당분기말과 전기말 현재 기업회계기준서 제1024호 '특수관계자 공시'에 따른 특수관계자 범위에 포함되지 않으나, 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사에 대한 채권·채무 내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)			
구 분	회사명	채 권	채 무
		매출채권 등	미지급금 등
대규모기업집단소속회사	SK케미칼(주)	-	333

② 전기말

(단위: 백만원)			
구 분	회사명	채 권	채 무
		매출채권 등	미지급금 등
대규모기업집단소속회사	SK디스크버리(주)	-	228
	SK케미칼(주)	-	38
합 계		-	266

30. 우발부채와 약정사항

(1) 당분기말 현재 당사와 관련하여 계류 중인 중요한 소송사건 및 클레임 등의 내역은 다음과 같습니다.

① Netlist, Inc.의 특허 침해 소송

Netlist, Inc.는 당사와 SK hynix America Inc. 등 당사의 종속기업들을 상대로 다수의 특허를 침해하였다는 소송을 2016년 8월 31일 및 2017년 6월 14일 미국 캘리포니아 중부지방법원에, 2016년 9월 1일 및 2017년 10월31일 미국국제무역위원회에, 2017년 7월 11일 독일 뮌헨 지방법원 및 중국 베이징 지식재산법원에 각각 제기하였습니다. 당분기말 현재 미국 등 각 지역에서 제기된 Netlist, Inc.의 특허 침해 소송은 소송가액이 확정되지 않은 상태이며, 당분기말 현재 최종결과를 예측할 수 없습니다.

한편, 2016년 9월 1일 미국국제무역위원회에 제기되었던 특허 침해 소송은 2018년 1월 16일 당사 및 당사의 종속기업들이 Netlist, Inc.의 특허를 침해하지 않았다고 최종 결정되었습니다. 이에 대해 Netlist, Inc.는 2018년 3월 26일에 항소를 제기하였습니다.

② Hargens Berman의 가격 담합 집단소송

Hargens Berman(소송대리인)은 당사 및 당사의 종속기업인 SK hynix America Inc.를 상대로 가격 담합에 대한 집단소송을 2018년 4월 27일 미국 캘리포니아 북부지방법원에 제기하였습니다. 당분기말 현재 제기된 본 소송은 소송가액이 확정되지 않은 상태이며 당분기말 현재 최종결과를 예측할 수 없습니다.

③ 소송 및 특허 클레임 등

당분기말 현재 당사는 상기 소송 외에 지적재산권 등과 관련하여 여러 분쟁에 대응하고 있으며 향후 자원의 유출가능성이 높고 손실 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 동 금액을 부채로 인식하고 있습니다.

(2) 특허라이선스 계약

당사는 당분기말 현재 제품생산과 관련한 다수의 특허라이선스 계약을 체결하고 있습니다. 동 계약에 의한 Royalty는 Lump-sum royalty 및 Running royalty의 형식으로 지급되며, Lump-sum royalty 지급액은 특허라이선스 계약기간에 따라 정액으로 안분된 금액을 비용으로 처리하고 있습니다.

(3) 공업용수공급계약

당사는 베올리아워터산업개발주 ("Veolia")와 공업용수를 공급받는 계약을 체결하고 있습니다. 기존 계약은 2018년 3월로 만료되었으며 2018년 5월까지 2개월 연장계약을 체결하였습니다. 계약내용은 기존 계약과 동일하며 동 계약에 의하면 당사는 계약기간 동안 Base Service Charge ("BSC")와 공급받는 공업용수 사용량에 일정액을 적용하여 계산된 Additional Service Charge ("ASC")를 Veolia에 지급해야 합니다.

(4) HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd. ("HITECH")와 후공정서비스계약

당사는 HITECH와 후공정서비스를 공급받는 계약을 체결하고 있으며 서비스 제공 범위는 Package, Package Test, Module 등 입니다. 당사는 동 계약에 따라 HITECH 장비 우선 사용권을 보유하고, 후공정서비스 대가로 HITECH에 일정액의 약정수익을 보장하는 금액을 지급하고 있습니다.

(5) 당분기말 현재 담보제공자산 등의 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)			
구 분(*)	장부금액	담보설정액	비 고
기계장치	755,985	919,950	시설자금대출 관련

(*) 상기 담보제공자산 이외에 당사의 금융리스자산은 해당 금융리스계약에 의하여 관련 금융리스부채의 담보로 제공되어 있습니다.

(6) 당분기말 현재 당사가 금융기관과 체결하고 있는 여신한도 거래의 주요 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 백만단위)			
금융기관	약정사항	한도금액	
		통 화	금 액
하나은행 등	Usance 등 수입금융약정	USD	265
	매입외환 등 수출금융약정	USD	250
	수입·수출 포괄한도 약정	USD	960
	상환청구권이 없는 매출채권팩토링약정	KRW	140,000

(7) 당분기말 현재 당사가 타인에게 제공한 지급보증 등의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	금 액	비 고
종업원	6	우리사주관련 금융기관 차입금 지급보증

(8) 당분기말 현재 기표되지 않은 유형자산에 대한 구매 약정액은 2,236,688백만원 (전기말: 557,400백만원)입니다.

(9) 도시바 반도체 사업지분 투자

당사는 전기 중 도시바 반도체 사업의 지분투자자와 관련하여 Bain Capital이 포함된 컨소시엄 (이하 "Bain 컨소시엄")에 참여하였으며, 특수목적법인인 BCPE Pangea In-termediate Holdings Cayman, LP에 대한 JPY 266,000백만의 출자계약 및 BCPE Pangea Cayman2 Limited가 발행한 전환사채 JPY 129,000백만의 취득계약을 체결하였습니다.

한편, 전기 중 도시바 반도체 사업 지분 투자를 위한 Bain 컨소시엄과 도시바 간의 계약이 체결되었으며, 당분기말 현재 각국 정부기관의 심사절차가 진행 중입니다. 거래의종결 등은 정부기관의 심의를 포함하여 계약에서 정한 선행조건 충족 여부에 따라 변경될 수 있습니다.

(10) 원재료 장기매입 약정

당사는 Wafer 수급 안정성 확보를 위하여 SK실트론(주)와 2019년부터 2023년까지 Wafer 구매계약을 체결하였으며, 전기 중 구매대금 150,000백만원을 선급하였습니다. 한편, SK실트론(주)는 당사가 선급한 150,000백만원을 보증하기 위하여 투자자산 일부를 양도담보로 제공하기로 약정하였습니다.

(11) 에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)와의 약정

당사는 종속기업인 에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)와 Foundry 공급계약을 체결하여 관련 서비스를 제공받고 있으며 또한, 동 회사와 업무위탁계약 및 Shared Ser-vice 계약을 체결하고, 제품 생산, 장비 운영, 개발 및 경영지원 등의 서비스를 제공하고 있습니다.

31. 현금흐름표

(1) 당분기와 전분기 중 영업으로부터 창출된 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
분기순이익	3,194,653	1,872,337
조정항목:		
법인세비용	1,148,547	462,042
이자비용	23,782	28,438
이자수익	(23,936)	(8,812)
유형자산상각비	1,103,014	871,397
투자부동산상각비	26	26
무형자산상각비	125,471	73,566
유형자산처분손실	4,939	6,729
무형자산처분손실	1,624	1,792
무형자산손상차손	3,463	-
퇴직급여	40,628	40,070
주식보상비용	275	-
외화환산손실	72,574	116,762
파생상품관련손익	-	6
유형자산처분이익	(2,374)	(5,261)
외화환산이익	(26,379)	(213,555)
장기투자자산처분이익	(248)	-
종속기업및관계기업투자처분이익	(2,301)	(1,989)
단기투자자산평가이익	(835)	(226)
단기투자자산처분이익	(2,055)	(1,244)
배당금수익	(35,966)	(14,828)
기타	1,097	1,009
운전자본의 변동:		
매출채권의 감소(증가)	(211,748)	(316,225)
기타수취채권의 감소(증가)	(200)	5,866
재고자산의 감소(증가)	(380,411)	(25,488)
기타자산의 감소(증가)	(113,558)	21,069
매입채무의 증가(감소)	69,465	(276,935)
미지급금의 증가(감소)	998,815	(103,739)
기타지급채무의 증가(감소)	(601,884)	(45,559)
총당부채의 증가(감소)	(32,537)	18,260
기타부채의 증가(감소)	88,734	(7,122)
퇴직금의 지급	(6,713)	(9,978)

영업으로부터 창출된 현금	5,435,962	2,488,408
---------------	-----------	-----------

(2) 당분기와 전분기 중 유동성 대체를 제외한 중요한 현금의 유입·유출이 없는 거래는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
유형자산 취득 관련 미지급금의 증가	28,226	231,355
미지급배당금 관련 미지급금의 증가	706,002	423,601

(3) 당분기와 전분기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초	4,029,356	4,215,787
재무적 현금으로 인한 변동		
- 차입금의 차입	298,732	342,830
- 차입금의 상환	(559,410)	(138,214)
환율변동효과	(6,542)	(163,412)
상각(이자비용)	389	443
기말	3,762,525	4,257,434

32. 주식기준보상

(1) 당사는 당분기 중 당사의 주요 경영진에게 주식결제형 주식선택권을 부여하였으며, 당분기말 현재 주식선택권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주)								
구 분	총부여수량	소멸수량	행사수량	미행사수량	부여일	약정응역제공기간	행사가능기간	행사가격
1차	99,600	-	-	99,600	2017.03.24	2017.03.24 ~ 2019.03.24	2019.03.25 ~ 2022.03.24	48,400원
2차	99,600	-	-	99,600	2017.03.24	2017.03.24 ~ 2020.03.24	2020.03.25 ~ 2023.03.24	52,280원
3차	99,600	-	-	99,600	2017.03.24	2017.03.24 ~ 2021.03.24	2021.03.25 ~ 2024.03.24	56,460원
4차	7,747	-	-	7,747	2018.01.01	2018.01.01 ~ 2019.12.31	2020.01.01 ~ 2022.12.31	77,440원
5차	7,223	-	-	7,223	2018.03.28	2018.03.28 ~ 2020.03.28	2020.03.29 ~ 2023.03.28	83,060원
합 계	313,770	-	-	313,770				

(2) 공정가치 측정

이항모형을 적용하여 공정가액 접근법에 의한 보상원가를 산정하였으며, 주식결제형주식기준보상제도의 부여일 현재 공정가치를 측정하기 위하여 사용된 투입변수는 다음과 같습니다

구 분	기대주가변동성	부여일 공정가치	배당수익률	무위험이자율 (국공채 수익률)
1차	23.23%	10,026원	1.20%	1.86%
2차	23.23%	9,613원	1.20%	1.95%
3차	23.23%	9,296원	1.20%	2.07%
4차	22.50%	16,687원	0.78%	2.38%
5차	25.30%	18,362원	1.23%	2.46%

(3) 당사가 당분기 중 인식한 주식보상비용은 275백만원(전분기: 23백만원)입니다.

6. 기타 재무에 관한 사항

가. 부문별 연결재무정보

(1) 사업부문별 연결재무정보

당사는 반도체제조업부문의 매출액과 자산총액이 전체부문의 90%를 초과하여 지배적 단일사업부문으로써 부문별 기재를 생략합니다.

(2) 지역별 재무 정보

(단위 : 백만원)

구 분	제 71기 1분기	제 70기	제 69기
본국(대한민국)			
1. 매출액			
외부매출액	308,041	1,207,464	1,099,426
지역간내부매출액	8,699,448	29,311,067	16,061,704
계	9,007,488	30,518,531	17,161,131
2. 영업이익	4,380,435	13,366,065	3,020,730
3. 자산	48,585,591	44,910,780	31,527,834
중국			
1. 매출액			
외부매출액	3,258,755	10,074,686	5,960,235
지역간내부매출액	681,124	2,555,178	2,482,175
계	3,939,879	12,629,864	8,442,411
2. 영업이익	(310)	146,098	129,972
3. 자산	7,109,318	6,338,929	5,242,887
아시아			
1. 매출액			
외부매출액	1,749,150	6,201,365	3,897,774
지역간내부매출액	4,462	21,078	23,131
계	1,753,612	6,222,443	3,920,906
2. 영업이익	(417)	14,239	9,771
3. 자산	2,380,332	1,847,516	911,664
미국			
1. 매출액			
외부매출액	2,995,086	11,063,504	5,397,943
지역간내부매출액	33,060	158,153	124,781
계	3,028,146	11,221,657	5,522,725
2. 영업이익	49,073	52,994	38,260
3. 자산	2,572,769	2,619,480	1,656,389
유럽			
1. 매출액			
외부매출액	408,659	1,562,416	842,595
지역간내부매출액	8,897	19,660	26,101
계	417,556	1,582,076	868,697
2. 영업이익	(2,337)	5,393	2,213
3. 자산	451,405	442,627	237,834

합계			
1. 매출액			
외부매출액	8,719,691	30,109,434	17,197,975
지역간내부매출액	9,426,991	32,065,137	18,717,894
계	18,146,681	62,174,571	35,915,868
2. 영업이익			
연결조정	(59,107)	136,537	75,799
계	4,367,338	13,721,326	3,276,746
3. 자산			
연결조정	(11,974,292)	(10,740,868)	(7,360,582)
계	49,125,123	45,418,464	32,216,026

나. 대손충당금 설정현황

(1) 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금 설정비율
제71기 1분기	매출채권	5,574,145	47	0.00%
	장·단기 대여금	14,525	0	0.00%
	장·단기 미수금	28,323	1,328	4.69%
	장·단기 미수수익	21,421	0	0.00%
	장·단기 보증금	36,685	102	0.28%
	장기성 외상매출금	0	0	
	장단기성 예치금	1,154	981	85.03%
	계	5,676,254	2,458	0.04%
제70기 연간	매출채권	5,552,841	46	0.00%
	장·단기 대여금	13,984	0	0.00%
	장·단기 미수금	12,199	1,327	10.88%
	장·단기 미수수익	22,308	0	0.00%
	장·단기 보증금	32,814	102	0.31%
	장기성 외상매출금	0	0	
	장단기성 예치금	1,132	985	87.00%
	계	5,635,278	2,460	0.04%
제69기 연간	매출채권	3,253,489	1,837	0.06%
	장·단기 대여금	9,163	10	0.11%
	장·단기 미수금	13,003	1,371	10.55%
	장·단기 미수수익	9,732	0	0.00%

	장·단기 보증금	34,812	389	1.12%
	장기성 외상매출금	0	0	-
	장단기성 예치금	1,238	1,077	86.96%
	계	3,321,437	4,684	0.14%

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

(2) 대손충당금 변동현황

(단위 : 백만원)

구 분	제71기 1분기	제70기	제69기
1. 기초 대손충당금 잔액합계	2,460	4,684	10,550
2. 순대손처리액(① - ② ± ③)	0	0	306
① 대손처리액(상각채권액)	0	0	306
② 상각채권회수액	0	0	0
③ 기타증감액	0	0	0
3. 대손상각비 계상(환입)액	(2)	(2,224)	(5,560)
4. 기말 대손충당금 잔액합계	2,458	2,460	4,684

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

- 거래선별 실제 회수가능성을 검토하여 개별 설정

구분	설정 기준	
매출채권	1)정상채권	-.과거 경험률을 바탕으로 설정
	2)장기채권	-.거래선별 실제 회수가능성을 검토하여 개별 설정 -.담보 설정금액 有 => 회수가능성이 불확실한 경우 담보 미설정 부분 100% 설정 -.담보 설정금액 無 => 회수가능성이 불확실한 경우 100% 설정

* 연결대상회사 매출채권 충당금 설정 제외

(4) 당 보고기간말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		6월 이하	6월 초과 1년 이하	1년 초과 3년 이하	3년 초과	계
금 액	일반	5,574,141	0	0	4	5,574,145
	특수관계자	0	0	0	0	0
	계	5,574,141	0	0	4	5,574,145
구성비율		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%

다. 재고자산 현황 등

(1) 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 백만원)

사업부문	계정과목	제71기 1분기	제70기	제69기	비고
반도체	제품	657,057	433,405	391,503	-
	재공품	1,774,041	1,616,889	1,130,494	-
	원재료	318,294	296,252	260,677	-
	저장품	322,423	270,804	194,678	-
	미착품	31,327	23,089	48,847	-
	합 계	3,103,142	2,640,439	2,026,198	-
총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산÷기말자산총계×100]		6.3%	5.8%	6.3%	-
재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고 + 기말재고)÷2}]		4.7회	5.4회	5.5회	-

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

(2) 재고자산의 실사내역

실사내역	실사 일자	입회자	비고
제품	2018-01-01	삼정회계법인	-
FAB재공, B/E재공, MODULE재공,외주업체			-
원부자재			-
제품	2017-01-01	삼정회계법인	-
FAB재공, B/E재공, MODULE재공,외주업체			-
원부자재			-
제품	2016-01-01	삼정회계법인	-
FAB재공, B/E재공, MODULE재공,외주업체			-
원부자재			-

(3) 장기체화재고 등 내역

재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 저가법을 사용하여 재고자산의 재무상태표가액을 결정하고 있으며, 2018년 1분기말 현재 재고자산에 대한 평가 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

계정과목	취득원가	보유금액	평가총당금	당기말잔액	비고
제품	729,856	729,856	72,798	657,058	-

재공품	1,797,898	1,797,898	23,857	1,774,041	-
원재료	331,393	331,393	13,099	318,294	-
저장품	337,778	337,778	15,356	322,422	-
미착품	31,327	31,327	-	31,327	-
합 계	3,228,252	3,228,252	125,110	3,103,142	-

라. 공정가치

(1) 공정가치 평가방법

공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.

- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격
- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수
- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

(2) 공정가치 평가내역

공정가치 서열체계를 포함한 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)					
구 분	장부금액	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
공정가치로 측정되는 금융자산:					
단기투자자산	1,476,079	-	1,476,079	-	1,476,079
장기투자자산	56,120	-	-	56,120	56,120
소 계	1,532,199	-	1,476,079	56,120	1,532,199
공정가치로 측정되지 않는 금융자산:					
현금및현금성자산(*)	3,477,358	-	-	-	-
단기금융상품(*)	3,312,376	-	-	-	-
매출채권(*)	5,574,098	-	-	-	-
기타수취채권(*)	99,698	-	-	-	-
기타금융자산(*)	283	-	-	-	-
소 계	12,463,813	-	-	-	-
금융자산 합계	13,996,012	-	1,476,079	56,120	1,532,199
공정가치로 측정되지 않는 금융부채:					
매입채무(*)	779,527	-	-	-	-
미지급금(*)	4,622,901	-	-	-	-

기타지급채무(*)	674,407	-	-	-	-
차입금	3,866,709	-	3,858,757	-	3,858,757
금융부채 합계	9,943,544	-	3,858,757	-	3,858,757

② 전기말

(단위: 백만원)					
구 분	장부금액	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
공정가치로 측정되는 금융자산:					
단기투자자산	929,801	-	929,801	-	929,801
장기투자자산	43,226	-	-	43,226	43,226
소 계	973,027	-	929,801	43,226	973,027
공정가치로 측정되지 않는 금융자산:					
현금및현금성자산(*)	2,949,991	-	-	-	-
단기금융상품(*)	4,674,862	-	-	-	-
매출채권(*)	5,552,795	-	-	-	-
기타수취채권(*)	80,023	-	-	-	-
기타금융자산(*)	273	-	-	-	-
소 계	13,257,944	-	-	-	-
금융자산 합 계	14,230,971	-	929,801	43,226	973,027
공정가치로 측정되지 않는 금융부채:					
매입채무(*)	758,578	-	-	-	-
미지급금(*)	2,724,547	-	-	-	-
기타지급채무(*)	1,343,637	-	-	-	-
차입금	4,171,270	-	4,178,598	-	4,178,598
금융부채 합 계	8,998,032	-	4,178,598	-	4,178,598

(*) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치는 포함하고 있지 않습니다.

③ 가치평가기법

수준 2의 공정가치 측정을 위해 사용된 평가기법은 전기말과 동일합니다.

④ 당분기 중 수준 1, 수준 2 및 수준 3간의 대체는 없으며, 수준 3 공정가치 측정으로 분류되는 금융자산의 당분기 중 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)					
구 분	기 초	취 득	처 분	환율변동	기 말
장기투자자산	43,226	12,994	(309)	209	56,120

마. 채무증권 발행실적 등

[연결 기준이며, 개별 기준은 연결 기준과 동일]

(1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2018년 03월 31일)

(단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면 총액	이자율	평가등급 (평가기관)	만기일	상환 여부	주관회사
------	------	------	------	----------	-----	----------------	-----	----------	------

SK하이닉스(주)	회사채	사모	2012년 05월 30일	550,000	5.35	A (한신평)	2019년 05월 30일	일부상환	삼성증권
SK하이닉스(주)	회사채	공모	2015년 08월 26일	210,000	2.27	AA- (NICE신평/한기평/한신평)	2020년 08월 26일	미상환	한국투자증권, 케이비투자증권
SK하이닉스(주)	회사채	공모	2015년 08월 26일	140,000	2.63	AA- (NICE신평/한기평/한신평)	2022년 08월 26일	미상환	한국투자증권, 케이비투자증권
SK하이닉스(주)	회사채	공모	2015년 11월 25일	70,000	2.26	AA- (NICE신평/한기평/한신평)	2018년 11월 25일	미상환	한국투자증권, 케이비투자증권
SK하이닉스(주)	회사채	공모	2015년 11월 25일	100,000	2.56	AA- (NICE신평/한기평/한신평)	2020년 11월 25일	미상환	한국투자증권, 케이비투자증권
SK하이닉스(주)	회사채	공모	2015년 11월 25일	10,000	2.75	AA- (NICE신평/한기평/한신평)	2022년 11월 25일	미상환	한국투자증권, 케이비투자증권
SK하이닉스(주)	회사채	공모	2016년 02월 19일	180,000	2.22	AA- (NICE신평/한기평/한신평)	2021년 02월 19일	미상환	엔에이치투자증권, 케이비투자증권
SK하이닉스(주)	회사채	공모	2016년 02월 19일	80,000	2.53	AA- (NICE신평/한기평/한신평)	2023년 02월 19일	미상환	엔에이치투자증권, 케이비투자증권
SK하이닉스(주)	회사채	공모	2016년 05월 27일	80,000	1.73	AA- (NICE신평/한기평/한신평)	2018년 05월 27일	미상환	엔에이치투자증권
SK하이닉스(주)	회사채	공모	2016년 05월 27일	150,000	2.30	AA- (NICE신평/한기평/한신평)	2021년 05월 27일	미상환	엔에이치투자증권
SK하이닉스(주)	회사채	공모	2016년 03월 14일	300,000	3.01	AA- (NICE신평/한기평/한신평)	2023년 03월 14일	미상환	엔에이치투자증권
합 계	-	-	-	1,870,000	-	-	-	-	-

(2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2018년 03월 31일)

(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사
제214-1회 무보증원화 공모사채	2015년 08월 26일	2020년 08월 26일	210,000	2015년 08월 13일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)
제214-2회 무보증원화 공모사채	2015년 08월 26일	2022년 08월 26일	140,000	2015년 08월 13일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2018년 03월 31일)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지
	이행현황	이행(35.2%)
담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 100% 이하
	이행현황	이행(3.8%)
자산처분 제한현황	계약내용	자산총액 2조원에 해당하는 금액 이상의 자산 처분 금지
	이행현황	이행(0.4조원)
지배구조변경 제한현황	계약내용	-
	이행현황	-
이행상황보고서 제출현황	이행현황	2018. 4월 제출

(작성기준일 : 2018년 03월 31일)

(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사
제215-1회 무보증원화 공모사채	2015년 11월 25일	2018년 11월 25일	70,000	2015년 11월 13일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)
제215-2회 무보증원화 공모사채	2015년 11월 25일	2020년 11월 25일	100,000	2015년 11월 13일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)
제215-3회 무보증원화 공모사채	2015년 11월 25일	2022년 11월 25일	10,000	2015년 11월 13일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2018년 03월 31일)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지
	이행현황	이행(35.2%)
담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 100% 이하
	이행현황	이행(3.8%)
자산처분 제한현황	계약내용	자산총액 2조원에 해당하는 금액 이상의 자산 처분 금지
	이행현황	이행(0.4조원)
지배구조변경 제한현황	계약내용	-
	이행현황	-
이행상황보고서 제출현황	이행현황	2018. 4월 제출

(작성기준일 : 2018년 03월 31일)

(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사
제216-2회 무보증원화 공모사채	2016년 02월 19일	2021년 02월 19일	180,000	2016년 02월 04일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)
제216-3회 무보증원화 공모사채	2016년 02월 19일	2023년 02월 19일	80,000	2016년 02월 04일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2018년 03월 31일)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지
	이행현황	이행(35.2%)
담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 100% 이하
	이행현황	이행(3.8%)
자산처분 제한현황	계약내용	자산총액 2조원에 해당하는 금액 이상의 자산 처분 금지
	이행현황	이행(0.4조원)
지배구조변경 제한현황	계약내용	-
	이행현황	-
이행상황보고서 제출현황	이행현황	2018. 4월 제출

(작성기준일 : 2018년 03월 31일)

(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사
제217-1회 무보증원화 공모사채	2016년 05월 27일	2018년 05월 27일	80,000	2016년 05월 17일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)
제217-2회 무보증원화 공모사채	2016년 05월 27일	2021년 05월 27일	150,000	2016년 05월 17일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2018년 03월 31일)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지
	이행현황	이행(35.2%)
담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 100% 이하
	이행현황	이행(3.8%)
자산처분 제한현황	계약내용	자산총액 2조원에 해당하는 금액 이상의 자산 처분 금지
	이행현황	이행(0.4조원)
지배구조변경 제한현황	계약내용	-
	이행현황	-
이행상황보고서 제출현황	이행현황	2018. 4월 제출

※ 동 사채에 대한 재무비율, 담보권설정 제한현황, 자산처분 제한현황, 이행상황보고서 제출현황은 반기 주기로 제출되는 이행상황보고서와 동일함.

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2018년 03월 31일)

(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사
제218회 무보증원화 공모사채	2016년 05월 27일	2018년 05월 27일	80,000	2016년 05월 17일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2018년 03월 31일)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지
	이행현황	이행(35.2%)
담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 250% 이하
	이행현황	이행(3.8%)
자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 70% 이상의 자산 처분 금지
	이행현황	이행(0.4조원)
지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 발생 금지
	이행현황	발생 없음
이행상황보고서 제출현황	이행현황	보고기한 미 도래

(3) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년 초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(4) 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	150,000	-	490,000	150,000	530,000	-	-	1,320,000
	사모	-	450,000	-	-	-	-	-	450,000
	합계	150,000	450,000	490,000	150,000	530,000	0	0	1,770,000

(6) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 15년이하	15년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(7) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

잔액	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계 감사인의 명칭 및 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항
제71기 1분기(당기)	삼정회계법인	-	-
제70기(전기)	삼정회계법인	적정	-
제69기(전전기)	삼정회계법인	적정	-

나. 감사용역 체결현황

(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간
제71기 1분기(당기)	삼정회계법인	분반기 검토 개별재무제표감사 연결재무제표감사 영문재무제표 검토 및 기타 감사업무	950	1,065 (주)
제70기(전기)	삼정회계법인	분반기 검토 개별재무제표감사 연결재무제표감사 영문재무제표 검토 및 기타 감사업무	950	10,644
제69기(전전기)	삼정회계법인	분반기 검토 개별재무제표감사 연결재무제표감사 영문재무제표 검토 및 기타 감사업무	705	10,256

(주) 표기의 시간은 제71기 1분기에 해당하는 소요 시간임.

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고
제71기 1분기(당기)	2018.02.27	지속경영 프로그램 자문 용역	2018.02~2018.07	300	-
제70기(당기)	2017.08.03	이전가격 문서화 용역	2017.08~2018.12	150	-
	2017.07.19	지속경영 프로그램 자문 용역	2017.07~2017.08	100	-
제69기(전기)	2016.04.25	세무 자문 용역	2016.04~2017.03	170	-

	2016.03.31	이전가격 문서화 용역	2016.03~2017.03	60	-
	2016.02.02	세무 자문 용역	2016.02~2016.12	20	-

2. 회계 감사인의 변경

☞ 해당사항 없음

3. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제유효성 감사

감사위원회는 2017년 제70기 사업연도에 대한 회사의 회계 및 업무에 관한 감사를 수행하였으며 그 결과 당사의 내부통제는 효과적으로 운영되고 있는 것으로 판단됩니다.

나. 내부회계관리제도

내부회계관리자는 2017년 내부회계 관리제도 운영실태를 평가하였으며, 내부회계관리제도 모범기준에 근거하여 볼 때 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 하였습니다. 외부감사인은 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 2017년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범기준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범기준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.

V. 이사의 경영진단 및 분석의견

※ 기업공시 작성기준에 따라 분/반기보고서에 본 항목은 기재하지 않습니다.

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요

본 보고서 작성일 현재 당사의 이사회는 2인의 사내이사, 1인의 기타비상무이사, 5인의 사외이사 등 총 8인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 지속경영위원회 3개의 소위원회가 있습니다.

(1) 이사회 권한 내용

당사의 이사회는 법령과 회사 정관에서 정한 사항 및 회사의 업무집행에 관한 중요한 사항을 결의하며, 또한 이사 및 경영진의 직무집행을 감독할 수 있는 권한이 있습니다.

1. 상법상의 결의사항

- (1) 주주총회의 소집
- (2) 영업보고서의 승인
- (3) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 및 그 부속명세서 승인
- (4) 대표이사의 선임 및 해임
- (5) 공동대표의 결정
- (6) 지점의 설치, 이전 또는 폐지
- (7) 신주의 발행
- (8) 사채의 모집
- (9) 준비금의 자본전입
- (10) 전환사채, 교환사채, 신주인수권부사채의 발행
- (11) 이사의 경업 및 이사와 회사간의 거래의 승인
- (12) 위원회의 설치 및 폐지와 그 위원의 선임 및 해임
- (13) 주식매수선택권의 부여 및 취소
- (14) 감사위원회를 제외한 위원회의 결의에 대한 수정 결의
- (15) 소규모 주식교환
- (16) 소규모합병 및 소규모분할합병
- (17) 회사 자산 및 매출액의 10분의 1 이하 규모의 영업양도의 결정
- (18) 회사의 최대주주(그의 특수관계인 포함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에서의 보고
- (19) 지배인의 선임 및 해임

2. 회사 경영에 관한 중요사항

- (1) 주주총회에 부의할 의안
- (2) 사업의 계획과 운영에 관한 사항
- (3) 회사의 예산·결산
- (4) 회사 자기자본 1.5%에 해당하는 금액 또는 1,000억원 중 많은 금액 이상의 신규투자 계획, 차입(1년 이내

의 단기 차입 제외), 채무의 보증, 출자, 자산의 취득 및 처분과 관리에 관한 사항 (단, 자기 자본이라 함은 유

가증권

시장 공시규정상 자기자본을 의미함)

- (5)<삭제 2012.3.5>
- (6) 해외증권의 발행
- (7) <삭제1999.4.9>
- (8) 각 위원회 규정 및 대표이사 위임사항의 제정, 개정 및 폐지
- (9)<삭제 2012.3.5>
- (10) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 이사회 승인사항으로 정한 자본금 또는 자본 총계 중 큰 금액의 5%

이상이거나 50억원 이상에 해당하는 다음의 행위

단, 감사위원회에 3인 이상의 사외이사가 포함되고 사외이사 수가 위원 총수의 3분의 2 이상인 경우 감사위원회에 그 의결을 위임함

가. 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인 을 위하여 자금, 유가증권, 자산을 제공 또는 거래

나. 분기 거래 합계액을 기준으로 동일인 및 동일인 친족이 20% 이상을 출자한 회사 또는 그 자회사를 상대방으로 하거나 동 회사를 위하여 상품·용역을 제공 또는 거래

(11) 회사 경영기본이념의 실행을 위한 회사 경영관리 체계의 정립 및 수정

(12) 10억원 이상의 기부. 단, 지속경영 및 사회적 가치 창출 등에 대해 전문적으로 심의하는 위원회가 있는 경우

해당 위원회에서 사전 심의함. 그러나, 태풍, 홍수, 화재, 지진 등 천재지변으로 인한 긴급구호와 “사회 복지

공동모금회법”에 따른 기부는 선집행후 사후보고 할 수 있음

3. 기타 법령 또는 정관, 주주총회에서 위임된 사항 및 대표이사 또는 이사회 의장이 회사 운영상 중요하다고 판단하여 이사회에 부의하는 사항

(2) 사외이사 현황

(성명, 학력 및 경력, 최대주주등과의 이해관계, 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 등)

[기준일 : 2018년 3월 31일]

성명	주요 경력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비고
최종원	서울대 경제학 학사 서울대 행정대학원 행정학 석사 미국 미시간대 정책학 박사 KDI연구위원 공정거래위원회 비상임위원 기재부 공공기관 경영평가단 단장 서울대 행정대학원장 서울대 행정대학원 교수 (現)	해당사항 없음		2017. 3. 24 재선임
신창환	고려대 전기전자전파공학 학사 캘리포니아대학교 버클리캠퍼스 박사 IBM 마이크로일렉트로닉스 자이링스(Xilinx) 서울시립대 공과대 전자전기컴퓨터공학부 교수 (現)	해당사항 없음		2017. 3. 24 선임

송호근	서울대 사회학 미국 하버드대 대학원 사회학 박사 한림대 부교수 서울대 사회발전연구소 소장 감사원 자문위원 서울대 대외협력본부장 사회통합위원회 위원 헌법재판소 정책자문위원 중앙일보 칼럼니스트 중앙일보 기명칼럼니스트 (現) 서울대 사회과학대 교수 (現) 포스코청암재단 감사위원 (現) 서울대 석좌교수 (現)	해당사항 없음		2018. 3. 28 선임
조현재	한국외국어대 서반어학 매일경제신문 편집국장 매경닷컴 대표이사 겸 뉴미디어담당 매일경제TV 대표이사 MBN 보도본부 본부장 MBN 대표이사 한국법무보호복지공단 비상임이사 (現) 광주대 초빙교수 (現)	해당사항 없음		2018. 3. 28 선임
윤태화	연세대 경영학 연세대 대학원 경영학 박사 안권 회계법인 공인회계사 한국금융연수원 교수 국무총리 조세심판원 비상임심판관 한국세무학회 제24대 회장 한국회계정보학회 제25대 회장 한국고용정보원 비상임감사 (現) 한국자산관리공사 감사자문위원회 위원 (現) 가천대 경영학과 교수 (現)	해당사항 없음		2018. 3. 28 선임

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 이사회사무국 (담당자 :노형구 수석 ☎ 031-8093-4315)

(3) 이사회 운영규정의 주요내용

구 성	주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성함	
개최시기	정기 이사회	매분기 종료 후 45일 이내에 개최함
	임시 이사회	필요에 따라 수시로 개최함
소집권자	이사회 의장	
소집절차	회의일 2일전까지 각 이사에게 개최 시기, 장소 및 안건을 통지함. 단, 긴급을 요하는 경우에는 회의일 전일까지 통지할 수 있다.	
결의방법	이사 과반수의 출석과 과반수의 찬성으로 함. 그러나, 법령 또는 정관으로 그 비율을 높게 정한 경우에는 법령 또는 정관의 규정을 따름	
부의사항	상법, 정관 및 이사회 규정에서 정하는 회사에 관한 중요사항	

위 임	다음 각호의 사항을 제외하고는 그 권한을 이사회내 위원회에 위임할 수 있음 1. 주주총회 승인을 요하는 사항의 제안 2. 대표이사의 선임 및 해임 3. 위원회 설치 및 폐지와 그 위원의 선임 및 해임 4. 정관에서 위원회에 위임할 수 없음을 명시한 사항 전항에 의하여 이사회가 이사회내 위원회에 위임할 사항은 해당 위원회 규정에서 정한다.
의 사 록	이사회 의사에 관하여 의사록을 작성함 (의사록에는 안건, 경과요령과 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명함)

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사 참석									
				김두경 (출석률: 100%)	박영준 (출석률: 100%)	김대일 (출석률: 100%)	이창양 (출석률: 100%)	최종원 (출석률: 100%)	신창환 (출석률: 100%)	송호근 (출석률: 100%)	조현재 (출석률: 100%)	윤태화 (출석률: 100%)	
1	'18.01.24	1. 제70기(2017년) 재무제표(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-
		2. 제70기(2017년) 영업보고서(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-
		3. 2018년 경영계획(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-
2	'18.02.28	1. 제70기 정기주주총회 소집(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-
		2. 2018년 상반기 원화 사채 발행 위임(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-
		3. 외화 자금 차입(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-
3	'18.03.28	1. 이사회 의장 선임의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. 대표이사 선임의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		3. 이사회규정 개정(안)	수정가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		4. 선임사외이사 선임의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		5. 지속경영위원회 설치(안) 및 각 위원회 위원 선임의 건	수정가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
4	'18.04.25	1. 한국고등교육재단 등에 대한 기부금 출연(안)	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. SK 건설과의 거래(안)	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		3. SK 에어가스와의 거래(안)	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 김두경, 박영준, 김대일, 이창양 사외이사의 경우, 제70기 정기 주주총회(17.03.28) 일자로 임기 만료됨.

※ 송호근, 조현재, 윤태화 사외이사의 경우, 제70기 정기 주주총회(17.03.28)에서 신규 선임됨.

다. 이사회내 위원회

(1) 이사회내의 위원회 구성현황

[2018년 3월 31일 현재]

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
감사위원회	사외이사 3명	최종원 윤태화 신창환	"2. 가. 감사위원회"에 관한 사항 참조	-

사외이사후보 추천위원회	사외이사 2명 사내이사 1명	최종원 조현재 박성욱	"라. (2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황" 참조	-
지속경영 위원회	사외이사 2명 사내이사 1명	송호근 조현재 이석희	[권한사항] 1. 10억원 이상의 기부 심의. 단, 대풍, 흉수, 화재, 지진 등 천재지변으로 인한 긴급 구호와 "사회복지공동모금회법"에 따른 기부는 선집행후 사후보고 할 수 있음 2. 회사의 지속가능경영과 관련한 다음 사항들에 대한 심의 (1) 지속경영 및 사회적 가치 창출 전략 및 성과 (2) 주요 CSR(Corporate Social Responsibility) 활동 (3) 주요 ESG(Environmental, Social, Governance) 현황 및 대응 (4) 기타 위원회에서 지속경영과 관련하여 심의할 필요가 있다고 판단하여 위원회에 부의한 사항	-

(2) 이사회내의 위원회 활동내역

(가) 감사위원회

"2. 가. 감사위원회"에 관한 사항 참조

(나) 사외이사후보추천위원회

"라. (2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황" 참조

(다) 지속경영위원회

개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사의 성명	
			송호근	조현재
			찬 반 여부	
-	-	-	-	-

라. 이사의 독립성

당사의 이사는 총 8인으로 구성되어 있으며, 이 중 사외이사는 5명입니다. 사외이사 선임에 있어 상법 및 관계법상의 자격 기준과 이사직무수행 적합성을 위한 전문성 및 독립성 등에 기반하여 투명하고 공정한 사외이사 후보추천위원회의 엄격한 심사와 추천을 통해 주주총회에서 선임하고 있습니다. 또한, 사외이사 회의를 주재하고 사외이사들의 의견을 집약하기 위하여 선임사외이사를 선임하였습니다.

(1) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 경영참고사항 비치·공시 시(2018. 02. 28) 이사 후보에 대한 인적사항 공시

[2018년 3월 31일 현재]

성명 (생년월일)	주요 약력	추천인	회사와의 거래내역	비고
박성욱 (1958.01.08)	하이닉스반도체 HSA담당 이사 상무 하이닉스반도체 메모리 연구소장 전무 SK하이닉스 부사장 SK하이닉스 사장 SK하이닉스 대표이사 부회장 (現)	이사회	없음	이사회 의장/ 사외이사후보 추천위원회 위원
이석희 (1965.06.23)	Intel 근무 KAIST 교수 SK하이닉스 미래기술연구원장 SK하이닉스 DRAM개발부문장/부사장 SK하이닉스 사업총괄/경영지원총괄 사장 (現)	이사회	없음	지속경영위원회 위원
박정호 (1963.05.17)	SK텔레콤(주) 사업개발부문장 SK C&C(주) 대표이사 사장 SK(주) 대표이사 사장 SK텔레콤(주) 대표이사 사장 (現)	이사회	없음	
최종원 (1958.10.28)	서울대 경제학 학사 서울대 행정대학원 행정학 석사 미국 미시간대 정책학 박사 KDI 연구위원 공정거래위원회 비상임위원 기획재정부 공공기관 경영평가단 단장 서울대 행정대학원장 서울대 행정대학원 교수(現)	사외이사 후보추천 위원회	없음	감사위원회 위원/ 사외이사후보추천 위원회 위원/ 선임사외이사
신창환 (1979.11.23)	고려대 전기전자전파공학 학사 캘리포니아대학교 버클리캠퍼스 박사 IBM 마이크로일렉트로닉스 근무 Xilinx 근무 서울시립대 공과대 전자전기컴퓨터공학부 교수 (現)	사외이사 후보추천 위원회	없음	감사위원회 위원
송호근 (1956.01.04)	서울대 사회학 미국 하버드대 대학원 사회학 박사 한림대 부교수 서울대 사회발전연구소 소장 감사원 자문위원 서울대 대외협력본부장 사회통합위원회 위원 헌법재판소 정책자문위원 중앙일보 칼럼니스트 중앙일보 기명칼럼니스트 (現) 서울대 사회과학대 교수 (現) 포스코청암재단 감사위원 (現) 서울대 석좌교수 (現)	사외이사 후보추천 위원회	없음	지속경영위원회 위원

조현재 (1958.01.21)	한국외국어대 서반어학 매일경제신문 편집국장 매경닷컴 대표이사 겸 뉴미디어담당 매일경제TV 대표이사 MBN 보도본부 본부장 MBN 대표이사 한국법무보호복지공단 비상임이사 (現) 광주대 초빙교수 (現)	사외이사 후보추천 위원회	없음	지속경영위원회 위원 사외이사후보추천 위원회 위원
윤태화 (1960.10.27)	연세대 경영학 연세대 대학원 경영학 박사 안권 회계법인 공인회계사 한국금융연수원 교수 국무총리 조세심판원 비상임심판관 한국세무학회 제24대 회장 한국회계정보학회 제25대 회장 한국고용정보원 비상임감사 (現) 한국자산관리공사 감사자문위원회 위원 (現) 가천대 경영학과 교수 (現)	사외이사 후보추천 위원회	없음	감사위원회 위원

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

(가) 사외이사후보추천위원회 설치목적 및 권한사항

[설치목적]

관계법령, 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하고 심사함.

[권한]

- ① 사외이사 후보의 추천, 심사, 선정

(나) 사외이사후보추천위원회 구성 현황

[2018년 3월 31일 현재]

성 명	사외이사 여부	비 고
최종원	○	- 사외이사 과반수 충족 (상법 제542조의8항 충족)
조현재	○	
박성욱	X	

(다) 사외이사후보추천위원회 활동내역

개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사의 성명	
			박영준(출 석률: 100%)	최종원 (출석률: 100%)
			찬 반 여부	

18.02.26	1. 제70기 정기주주총회에 대한 사외이사 후보추천(안)	가결	찬성	찬성
----------	---------------------------------	----	----	----

마. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 지원조직의 현황

지원조직	구성	주요담당업무
이사회사무국	직원 3명 (팀장 1명 포함)	- 이사회 및 소위원회 지원 - 이사직무활동 지원

(2) 사외이사 교육실적

교육일시	교육내용	교육주체
-	-	-

2. 감사제도에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하여 운영하고 있으며, 주주총회의 결의에 의하여 선임된 감사위원이 되는 사외이사 3인(최종원, 신창환, 윤태화)으로 구성되어 있습니다.

가. 감사위원회 설치여부, 구성방법 등

- 설치 여부 : 감사에 갈음하는 이사회내 위원회로서 감사위원회를 설치(정관 제48조)
- 권한과 책임 : 회계 및 업무에 대한 감사, 외부감사인의 선임 등
- 구성 방법 : 3인 이상의 이사로 구성(단 위원 총수의 2/3 이상을 사외이사로 구성)
위원장은 호선에 의하여 선임
- 회의 : 정기 위원회(매 분기 종료 후 45일 이내) 및 임시 위원회(필요에 따라 수시로)

나. 감사위원회의 인적사항

[2018년 3월 31일 현재]

성명	주요경력	결격요건 여부	비고
최종원	서울대 경제학 학사 서울대 행정대학원 행정학 석사 미국 미시간대 정책학 박사 KDI 연구위원 공정거래위원회 비상임위원 기획재정부 공공기관 경영평가단 단장 서울대 행정대학원장 서울대 행정대학원 교수(現)	해당사항 없음	

신 창 환	고려대 전기전자전파공학 학사 캘리포니아대학교 버클리캠퍼스 박사 IBM 마이크로일렉트로닉스 근무 Xilinx 근무 서울시립대 공과대 전자전기컴퓨터공학부 교수 (現)	해당사항 없음	
윤 태 화	연세대 경영학 연세대 대학원 경영학 박사 안권 회계법인 공인회계사 한국금융연수원 교수 국무총리 조세심판원 비상임심판관 한국세무학회 제24대 회장 한국회계정보학회 제25대 회장 한국고용정보원 비상임감사 (現) 한국자산관리공사 감사자문위원회 위원 (現) 가천대 경영학과 교수 (現)	해당사항 없음	-

다. 감사위원회의 위원의 독립성

본 보고서 제출일 현재 당사는 감사위원회 3인 전원을 사외이사로 구성하고 있으며, 3인 중 최소 1인 이상의 회계 또는 재무전문가를 선임하는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위한 내부장치를 아래와 같이 마련하고 있습니다.

- 감사위원회 규정 제3조

- ③ 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있다.
- ④ 위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

- 감사위원회 규정 제12조(부의사항)

3. 감사에 관한 사항

- (1) 업무·재산 조사
- (2) 자회사의 조사
- (3) 이사의 보고 수령

(7) 감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고 수령

- (8) 감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고 수령

- 감사위원회 규정 제13조 (관계인의 출석)

- ① 위원회는 업무수행을 위하여 필요한 경우 경영진, 재무담당임원, 내부감사부서의 장 및 외부감사인 등을 회의에 참석하도록 요구할 수 있다.
- ② 위원회는 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있다.

- 감사위원회 규정 제14조의7 (의견교환)

위원회는 감사인과 긴밀한 협조관계를 유지하며 감사인과 회사의 내부통제제도 및 회사 재무제표의 정확성 등에 관하여 의견을 교환할 수 있다.

- 감사위원회 규정 제16조 (내부감사부서의 설치)

- ① 위원회는 효율적인 업무수행을 위하여 위원회를 보조하는 전담 지원부서를 설치 운영하거나 회사의 내부감사부서를 활용할 수 있다.
- ② 전담 지원부서 또는 내부감사부서의 장은 위원회의 명을 받아 회사 또는 자회사의 업무 또는 재산상태 등을 조사할 수 있다.

라. 감사위원회의 주요활동내역

회사	일자	의안	가결여부	사외이사의 성명					
				김두경 (출석률 :100%)	김대일 (출석률 :83%)	이창양 (출석률 :100%)	최종원 (출석률 :100%)	신창환 (출석률 :100%)	윤태화 (출석률 :100%)
				찬반여부					
1	18.01.22	1. '17년 내부회계관리제도 운영 실태	보고	-	-	-	-	-	-
		2. '17년 내부감사실적 및 '18년 업무 계획	보고	-	-	-	-	-	-
		3. 내부감사부서책임자 임명에 대한 동의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
2	18.02.26	1. 2017년 회계연도 회계감사 결과	보고	-	-	-	-	-	-
		2. 계열금융회사(SK증권)와의 거래(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		3. SK네트웍스와의 거래(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		4. 2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
3	18.03.19	1. 계열회사(SK증권) 대상 내부거래 한도(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		2. 제70기 정기주주총회에 제출할 의안 및 서류의 적법성 조사의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		3. 감사보고서(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		4. 내부감시장치에 대한 의견서(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		5. SK(주)와의 거래(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
4	18.04.23	1. 2018년 1분기 윤리경영 및 경영진단 실적	보고	-	-	-	-	-	-
		2. 위원장 선임의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성
		3. SK이노베이션과의 거래(안)	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성

* 김두경, 김대일, 이창양 사외이사의 경우, 제70기 정기 주주총회(17.03.28) 일자로 임기 만료됨.

* 윤태화 사외이사의 경우, 제70기 정기 주주총회(17.03.28)에서 신규 선임됨.

마. 준법지원인의 인적사항 및 주요경력

구분	상세
성명	신승국 (전무)
생년월일	1962년 11월 3일
학력사항	- 연세대학교 대학원 상법학 석사 (1985년~1987년) - 미국 밴더빌트대 법과대학원 법학박사 (J.D.)
주요경력	- 2017년 1월~ : SK하이닉스 지속경영본부장(現) - 2014년 1월~ : SK하이닉스 대외협력본부장 - 2006년 2월 ~ : SK에너지 법무실장 / CR전략실장 - 2000년 8월 ~ : SK텔레콤 법무팀장 / 법무실장 - 1988년 7월 ~ : SK(舊유공) 법무부 입사

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 정관에 의해 주주의 의결권을 1주마다 1개로 정하고 있으며, 집중투표제나 서면투표제, 전자투표제는 채택하고 있지 않습니다. 또한 본 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.

VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일)

(단위 : 주, %)

성명	관계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말		
			주식수	지분율	주식수	지분율	
에스케이텔레콤(주)	최대주주	보통주	146,100,000	20.07	146,100,000	20.07	유상증자 참여/구주지분 인수
박성욱	특별관계자	보통주	1,502	0.00	1,502	0.00	-
박정호	특별관계자	보통주	1,090	0.00	1,090	0.00	-
이석희	특별관계자	보통주	42	0.00	42	0.00	-
계		보통주	146,102,634	20.07	146,102,634	20.07	-
		우선주	-	-	-	-	-

나. 최대주주 상세

(1) 최대주주 및 지분율

당사 최대주주는 SK텔레콤주식회사 (영문명 : SK Telecom Co., Ltd.)이며, 그 소유주식수는 146,100,000주(20.07%)입니다.

(2) 최대주주(법인)의 기본정보

가) 대표자

[기준일 : 2018년 3월 31일]

성명	직위	상근여부	출생년도
박정호	대표이사/사장	상근	1963년

나) 기본정보

[기준일 : 2018년 3월 31일]

명칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)	
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
SK텔레콤 주식회사	55,352	박정호	0.00	-	-	SK(주)	25.22
		-	-	-	-	-	-

(3) 최대주주(법인)의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)	
	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
2017.03.24	박정호	-	-	-	-	-
2017.03.28	박정호	0.00	-	-	-	-
2017.03.30	박정호	0.00	-	-	-	-

※ 박정호 대표이사는 '17년 3월 24일 주주총회 및 이사회를 통해 대표이사로 선임되었으며, '17년 3월 28일과 30일 각각 500주의 주식을 취득함

(4) 최대주주(법인)의 최근 결산기 재무현황

[기준일 : 2018년 3월 31일]

(단위 : 백만원)

구 분	
자산총계	36,134,388
부채총계	16,146,565
자본총계	19,987,823
매출액	4,181,537
영업이익	325,476
당기순이익	693,372

(5) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사 최대주주인 에스케이텔레콤 주식회사는 1984년 3월 19일에 한국이동통신서비스주식회사로 설립되었으며, 1989년 10월 유가증권시장에 최초 상장되었습니다. 이후 1997년 1월 선경그룹 계열사로 편입되었으며, 이후 3월에 SK텔레콤(주)로 사명이 변경되었습니다.

보고서 작성 기준일 현재, 영위하고 있는 주요 사업은 (가) 이동전화, 무선데이터, 정보통신사업 등의 무선통신사업, (나) 전화, 초고속인터넷, 데이터 및 통신망 임대서비스 등을 포함한 유선통신사업과 (다) 커머스사업, 플랫폼 서비스, 인터넷포털 서비스 등의 기타사업입니다.

(6) 최대주주(법인)의 최대주주(법인) 기본 정보

가) 대표자

[기준일 : 2018년 3월 31일]

성명	직위	상근여부	출생년도
최태원	대표이사/회장	상근	1960년
장동현	대표이사/사장	상근	1963년

나) 기본 정보

[기준일 : 2018년 3월 31일]

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)	
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
SK(주)	24,992	최태원	23.40	-	-	최태원	23.40
		장동현	-	-	-	-	-

* 대표이사와 최대주주는 동일인이며, 지분율은 보통주 기준으로 기재하였음

(7) 최대주주(법인)의 최대주주(법인) 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)	
	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
2017.03.24	장동현	-	-	-	-	-

* 박정호 전 대표이사는 '17년 3월 23일 부로 대표이사 및 사내이사직 사임

* 조대식 전 대표이사는 '17년 3월 24일 부로 대표이사직 사임 (사내이사직 유지)

(8) 최대주주(법인)의 최대주주(법인) 최근 결산기 재무현황

[기준일 : 2018년 3월 31일]

(단위 : 백만원)

구 분	
자산총계	112,329,353
부채총계	64,362,740
자본총계	47,966,613
매출액	24,615,108
영업이익	1,581,424
당기순이익	1,555,342

다. 최대주주 변동내역

최대주주 변동내역

(기준일 : 2018년 03월 31일)

(단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고
-	(주)한국외환은행	37,742,000	8.2	-
2009년 01월 17일	(주)한국외환은행	37,742,000	7.3	일반 공모증자에 의한 당사 발행주식 증가로 보유주식수에는 변동이 없으나 보유 지분율은 변동함.
2009년 05월 19일	(주)한국외환은행	37,742,000	6.4	일반 공모증자에 의한 당사 발행주식 증가로 보유주식수에는 변동이 없으나 보유 지분율은 변동함.
2010년 03월 16일	한국정책금융공사	32,412,935	5.5	변경 전 최대주주의 지분매각
2010년 03월 19일	미래에셋자산운용투자자문(주)	35,362,056	6.0	장내 매수/매도

2010년 05월 04일	미래에셋자산운용투자자문(주)	44,041,030	7.46	장내 매수/매도
2010년 08월 03일	한국정책금융공사	32,412,935	5.50	변경 전 최대주주의 지분매각
2010년 10월 11일	국민연금공단	35,894,454	6.08	장내 매수/매도
2011년 01월 10일	국민연금공단	47,786,668	8.10	장내 매수/매도
2011년 04월 11일	국민연금공단	53,774,325	9.11	장내 매수/매도
2011년 07월 08일	국민연금공단	47,838,426	8.08	장내 매수/매도
2011년 10월 07일	국민연금공단	54,202,391	9.15	장내 매수/매도
2012년 02월 15일	에스케이텔레콤(주)	146,100,000	21.05	유상증자 참여 및 구주 지분 인수
2012년 02월 23일	에스케이텔레콤(주)	146,105,000	21.05	특별관계자 추가
2012년 04월 02일	에스케이텔레콤(주)	146,119,894	21.05	계열편입에 따른 특별관계자추가
2012년 06월 22일	에스케이텔레콤(주)	146,127,934	21.05	특별관계자 추가
2013년 05월 09일	에스케이텔레콤(주)	146,115,374	20.57	특별관계자 제외 및 추가
2014년 01월 06일	에스케이텔레콤(주)	146,119,374	20.57	장내 매수
2014년 03월 27일	에스케이텔레콤(주)	146,124,334	20.57	특별관계자 제외 및 추가
2015년 02월 24일	에스케이텔레콤(주)	146,126,442	20.07	장내 매수
2016년 03월 28일	에스케이텔레콤(주)	146,127,532	20.07	특별관계자 추가
2017년 03월 24일	에스케이텔레콤(주)	146,122,574	20.07	특별관계자 제외 및 추가
2017년 07월 05일	에스케이텔레콤(주)	146,111,574	20.07	특별관계자 제외
2017년 08월 30일	에스케이텔레콤(주)	146,102,634	20.07	특별관계자 제외

2. 주식의 분포

가. 5% 이상 주주의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일)

(단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고
5% 이상 주주	에스케이텔레콤(주)	146,102,634	20.07	(주1)
	국민연금공단	72,342,363	9.94	-
우리사주조합		-	-	-

(주1) 상기 에스케이텔레콤(주)의 보유내역은 주식관리협회의 구주지분 44,250,000주 인수 및 제3자배정 유상증자 참여 주식 101,850,000주와 특별관계자의 보유주식 2,634주를 합산한 것임. (최대주주인 에스케이텔레콤(주)이 별도 공시한 의결권 귀속 지분과는 상이함.)

소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일)

(단위 : 주)

구분	주주		보유주식		비고
	주주수	비율	주식수	비율	
소액주주	312,929	99.99	458,742,455	63.01	발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 보유한 주주

3. 주식사무

	제10조 (주식의 발행 및 배정) < 개정 2017.3.24 >
--	-------------------------------------

정관상
신주인수권의 내용

- ① 회사가 이사회 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
 2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제 1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식. 본 제 2호에 의한 신주 발행은 아래 각 목의 경우를 포함하되 이에 한정되지 아니함.
 - 가. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
 - 나. 자금조달, 기술도입 기타 경영상 필요로 국내외 금융기관(여기서 '금융기관'이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제5항의 전문투자자를 의미하되, 동항 제4호의 주권상장법인, 동법 시행령 제10조 제3항 제16호 및 제17호의 법인, 단체 또는 개인은 포함하지 아니한다), 제휴법인, 전략적 투자자 또는 외국인 투자자에게 신주를 발행하는 경우
 - 다. 현물출자에 대하여 신주를 발행하는 경우
 - 라. 회사가 "경영상 필요로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제11조 제1항 제2호 가목 내지 다목의 자"에게 신주를 발행하는 경우
 - 마. 은행 등 금융기관의 출자전환에 의한 자본참여로 신주를 발행하는 경우
 3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
- ② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
- ③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
- ④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.
- ⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
- ⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회 결의로

	로 정한다. ⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권 증서를 발행하여야 한다.		
결산일	12월 31일	정기주주총회	3월 중
주주명부폐쇄시기	1월 1일 부터 1월 31일 까지		
주권의 종류	일,오,일십,오십,일백,오백,일천,일만주권 (8종)		
명의개서대리인	하나은행 증권대행부 (서울특별시 영등포구 여의도동 43-2)		
주주의 특전	해당사항 없음	공고방법	홈페이지게재<개정 2012.03.23>

4. 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장

(단위 : 원, 천주)

종류		'18년 3월	'18년 2월	'18년 1월	'17년 12월	'17년 11월	'17년 10월
보통주	최고주가	90,700	78,700	79,300	80,200	86,800	89,100
	최저주가	77,400	70,200	71,100	74,000	76,800	78,400
	평균주가	84,738	75,017	74,700	77,284	83,109	83,031
거래량	최고일거래량	8,776	7,814	9,124	6,782	11,214	9,071
	최저일거래량	2,673	1,879	2,015	2,493	2,074	3,914
	월간거래량	4,764	3,916	4,563	4,189	4,137	6,551

※ 주가는 일별 종가 기준임.

나. 해외증권시장

[증권거래소명 : 록셈부르그]

(단위 : USD, DR)

종류			'18년 3월	'18년 2월	'18년 1월	'17년 12월	'17년 11월	'17년 10월
주가 (종가 기준)	최고	USD	85.50	73.50	74.50	74.25	79.77	78.75
		원화환산	91,186	78,719	79,827	79,551	86,343	88,594
	최저	USD	71.00	64.50	66.50	69.54	70.72	69.63
		원화환산	75,722	69,080	71,255	74,505	76,547	78,334
거래량	최고(일)		-	-	-	-	-	56
	최저(일)		-	-	-	-	-	-
	월간평균		-	-	-	-	-	3.5
환율			1,066.50	1,071.00	1,071.50	1,071.40	1,082.40	1,125.00

※ 환율의 경우 매월 말 고시기준율을 기준으로 하였음.

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일)

(단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원 여부	상근 여부	담당 업무	주요경력	소유주식수		재직기간	임기 만료일
								의결권 있는 주식	의결권 없는 주식		
박성욱	남	1958년 01월	부회장	등기임원	상근	대표이사 사외이사후보 추천위원회 위원	한국과학기술원(KAIST) 재료공학 박사 하이닉스반도체 메모리 연구소장 전무 SK하이닉스 부사장 SK하이닉스 사장 SK하이닉스 대표이사 부회장(現)	1,502	-	선임(09.03.26) 중임(12.02.14, 15.03.20, 18.03.28)	-
이석희	남	1965년 06월	사장	등기임원	상근	사내이사 사업총괄 지속경영위원회 위원	스탠포드대 재료공학 박사 Intel 근무 KAIST 교수 SK하이닉스 미래기술연구원장 SK하이닉스 DRAM개발부문장 SK하이닉스 사업총괄 (現)	42	-	선임(17.03.24)	-
박정호	남	1963년 05월	이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	조지워싱턴대 경영학 석사 SK텔레콤(주) 사업개발부문장 SK C&C(주) 대표이사 / 사장 SK(주) 대표이사 / 사장 SK텔레콤(주) 대표이사 / 사장(現)	1,090	-	선임(17.03.24)	-
최종원	남	1958년 10월	이사	등기임원	비상근	사외이사 감사위원회 위원 사외이사후보 추천위원회 위원 선임사외이사	서울대 경제학 학사 서울대 행정대학원 행정학 석사 미국 미시간대 정책학 박사 KDI 연구위원 공정거래위원회 비상임위원 기획재정부 공공기관 경영평가단 단장 서울대 행정대학원장 서울대 행정대학원 교수(現)	-	-	선임(14.03.21) 중임(17.03.24)	-
신창환	남	1979년 11월	이사	등기임원	비상근	사외이사 감사위원회 위원	고려대 전기전자전파공학 학사 캘리포니아대학교 버클러캠퍼스 박사 IBM 마이크로일렉트로닉스 근무 Xilinx 근무 서울시립대 공과대 전자전기컴퓨터공학부 교수 (現)	-	-	선임(17.03.24)	-

송호근	남	1956년 01월	이사	등기임원	비상근	사외이사 지속경영위원회 위원	서울대 사회학 미국 하버드대 대학원 사회학 박사 한림대 부교수 서울대 사회발전연구소 소장 감사원 자문위원 서울대 대외협력본부장 사회통합위원회 위원 헌법재판소 정책자문위원 중앙일보 칼럼니스트 중앙일보 기명칼럼니스트 (現) 서울대 사회과학대 교수 (現) 포스코청암재단 감사위원 (現) 서울대 석좌교수 (現)	-	-	선임(18.03.28)	-
조현재	남	1958년 01월	이사	등기임원	비상근	사외이사 지속경영위원회 위원 사외이사후보추천 위원회 위원	한국외국어대 서반어학 매일경제신문 편집국장 매경닷컴 대표이사 겸 뉴미디어담당 매일경제TV 대표이사 MBN 보도본부 본부장 MBN 대표이사 한국법무보호복지공단 비상임이사 (現) 광주대 초빙교수 (現)	-	-	선임(18.03.28)	-
윤태화	남	1960년 10월	이사	등기임원	비상근	사외이사 감사위원회 위원	연세대 경영학 연세대 대학원 경영학 박사 안권 회계법인 공인회계사 한국금융연수원 교수 국무총리 조세심판관 비상임심판관 한국세무학회 제24대 회장 한국회계정보학회 제25대 회장 한국고용정보원 비상임감사 (現) 한국자산관리공사 감사자문위원회 위원 (現) 가천대 경영학과 교수 (現)	-	-	선임(18.03.28)	-

* 김준호 이사는 2018년 3월 27일자로 퇴임함.

* 임기 만료일은 취임 후 개최되는 제3차 정기주주총회 종료시임.

(2) 등기임원의 겸직 현황

[기준일: 2018년 3월 31일]

겸직임원		겸직회사		비고
성명	직위	회사명	직위	
박성욱	대표이사	SK hynix Semiconductor China Ltd.	대표이사	-
		SK hynix memory solutions Inc.	이사	-
박정호	기타비상무이사	SK 텔레콤	대표이사	-
최종원	사외이사	두산건설(주)	사외이사	-
송호근	사외이사	두산엔진(주)	사외이사	-

(3) 미등기 임원 현황

[기준일: 2018년 3월 31일]

직위 (상근여부)	등기임원 여부	성명	성별	생년월일	담당업무	약력	학력	소유주식수		비고
								보통주	우선주	
회장 (상근)	미등기임원	최태원	남	1960.12	회장	회장	Univ. of Chicago	-	-	-
사장 (상근)	미등기임원	정태성	남	1960.11	NAND개발사업총괄 담당	NAND개발사업부문장	Univ. of Wisconsin - Madison	-	-	-
부사장 (상근)	미등기임원	Tony Yoon	남	1963.04	NAND개발사업총괄 담당 원	NAND개발사업부문 담당 원	UC Berkeley	-	-	-
부사장 (상근)	미등기임원	김진국	남	1964.07	미래기술연구원 담당	DRAM개발사업부문장	연세대	2,000	-	-
부사장 (상근)	미등기임원	송현중	남	1965.11	마케팅/영업 담당	마케팅부문장	Massachusetts Institute of Technology	3,000	-	-
부사장 (상근)	미등기임원	이명영	남	1962.02	경영지원 담당	경영지원총괄 담당임원	연세대	-	-	-
부사장 (상근)	미등기임원	이상선	남	1961.09	제조/기술 담당	제조/기술부문장	고려대	4,000	-	-
부사장 (상근)	미등기임원	진교원	남	1962.09	품질보증 담당	품질보증부문장	서울대	112	-	-
부사장 (상근)	미등기임원	현순엽	남	1963.10	기업문화 담당	경영지원총괄 담당임원	서울대(碩士)	3,520	-	-
부사장 (상근)	미등기임원	홍성주	남	1962.11	CIS Business 담당	미래기술연구원장	한국과학기술원	6,842	-	-
전무 (상근)	미등기임원	AndrewChon g	남	1965.09	NAND개발사업총괄 담당 원	NAND개발사업부문 담당 원	UC Berkeley	-	-	-
전무 (상근)	미등기임원	곽노정	남	1965.11	제조/기술 담당임원	제조/기술부문 담당임원	고려대	1,103	-	-
전무 (상근)	미등기임원	길병송	남	1963.06	기업문화 담당임원	경영지원총괄 담당임원	경찰대	-	-	-
전무 (상근)	미등기임원	김광록	남	1962.08	경영지원 담당임원	경영지원총괄 담당임원	경북대	-	-	-
전무 (상근)	미등기임원	김남석	남	1967.02	P&T 담당임원	P&T담당임원	서울대	-	-	-
전무 (상근)	미등기임원	박성계	남	1967.06	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원 담당임원	한국과학기술원	-	-	-
전무 (상근)	미등기임원	박정식	남	1963.12	P&T 담당	P&T부문장	충익대	112	-	-
전무 (상근)	미등기임원	송창록	남	1969.01	사업총괄 담당임원	정보화본부장	서울대	-	-	-
전무 (상근)	미등기임원	신승국	남	1962.11	경영지원 담당임원	경영지원총괄 담당임원	Vanderbilt University	-	-	-
전무 (상근)	미등기임원	안근욱	남	1959.08	NAND개발사업총괄 담당 원	제조/기술부문 담당임원	단국대	-	-	-
전무 (상근)	미등기임원	안현	남	1967.06	NAND개발사업총괄 담당 원	경영지원총괄 담당임원	서울대(博士)	-	-	-

전무 (상근)	미등기임원	오기영	남	1960.05	사업총괄 담당임원	Tech혁신센터 담당임원	SOPHIA UNIVERSITY(博士)	-	-	-
전무 (상근)	미등기임원	오종훈	남	1964.08	DRAM개발사업 담당	DRAM개발사업부문 담당임원	서울대	-	-	-
전무 (상근)	미등기임원	이상래	남	1965.07	경영지원 담당임원	경영지원총괄 담당임원	Boston University(碩士)	2	-	-
전무 (상근)	미등기임원	이재성	남	1966.09	NAND개발사업총괄 담당임원	NAND개발사업부문 담당임원	연세대	-	-	-
전무 (상근)	미등기임원	이재형	남	1965.09	마케팅/영업 담당임원	NAND개발사업부문 담당임원	서강대	-	-	-
전무 (상근)	미등기임원	임동규	남	1964.04	사업총괄 담당임원	미래기술연구원 담당임원	서울대(博士)	-	-	-
전무 (상근)	미등기임원	임종필	남	1960.11	기업문화 담당임원	경영지원총괄 담당임원	고려대	-	-	-
전무 (상근)	미등기임원	임종혁	남	1964.08	윤리경영 담당	윤리경영 담당	서울대(碩士)	-	-	-
전무 (상근)	미등기임원	전준현	남	1966.05	DRAM개발사업 담당임원	DRAM개발사업부문 담당임원	경북대	-	-	-
전무 (상근)	미등기임원	최근민	남	1960.09	SHE 담당	Tech혁신센터장	Tohoku University(博士)	-	-	-
전무 (상근)	미등기임원	최정달	남	1964.07	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원 담당임원	경북대	-	-	-
전무 (상근)	미등기임원	피승호	남	1966.04	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원 담당임원	한국과학기술원(博士)	569	-	-
전무 (상근)	미등기임원	한우중	남	1959.01	NAND개발사업총괄 담당임원	메모리시스템연구소장	고려대(博士)	400	-	-
상무 (상근)	미등기임원	강상권	남	1968.10	P&T 담당임원	P&T 담당임원	한양대	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	강선국	남	1969.02	마케팅/영업 담당임원	마케팅부문 담당임원	인하대	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	강유홍	남	1970.12	경영지원 담당임원	경영지원총괄 담당임원	Vanderbilt University(碩士)	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	강진수	남	1967.07	마케팅/영업 담당임원	마케팅/영업 담당임원	한국과학기술원	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	권원택	남	1962.10	제조/기술 담당임원	제조/기술부문 담당임원	광운대	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	권재순	남	1969.12	제조/기술 담당임원	제조/기술부문 담당임원	충북대(碩士)	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김기현	남	1968.10	마케팅/영업 담당임원	마케팅/영업 담당임원	University of Phoenix(碩士)	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김대영	남	1962.09	기업문화 담당임원	경영지원총괄 담당임원	부산대	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김도근	남	1964.03	NAND개발사업총괄 담당임원	NAND개발사업부문 담당임원	한국과학기술원(碩士)	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김상근	남	1962.01	제조/기술 담당임원	제조/기술부문 담당임원	동아대	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김상덕	남	1968.02	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원 담당임원	서울대(博士)	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김석	남	1970.11	마케팅/영업 담당임원	마케팅부문 담당임원	연세대(博士)	-	-	-

상무 (상근)	미등기임원	김선경	남	1969.04	경영지원 담당임원	경영지원 담당임원	Purdue University West Lafayette(碩士)	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김선순	남	1970.06	DRAM개발사업 담당임원	DRAM개발사업 담당임원	연세대(碩士)	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김성한	남	1968.12	경영지원 담당임원	제조/기술부문 담당임원	서울대(碩士)	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김영식	남	1967.12	제조/기술 담당임원	제조/기술부문 담당임원	연세대	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김영일	남	1965.10	현장경영 담당	윤리경영실장	Univ. of Denver(碩士)	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김용주	남	1968.10	DRAM개발사업 담당임원	DRAM개발사업부문 담당임원	한양대(博士)	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김정수	남	1972.01	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원 담당임원	청주대	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김정기	남	1964.01	경영지원 담당임원	경영지원총괄 담당임원	서강대(碩士)	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김정태	남	1969.07	마케팅/영업 담당임원	마케팅/영업 담당임원	한국과학기술원(碩士)	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김종호	남	1967.01	마케팅/영업 담당임원	마케팅부문 담당임원	고려대	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김종환	남	1972.09	DRAM개발사업 담당임원	미래기술연구원 담당임원	서울대(碩士)	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김주선	남	1966.06	마케팅/영업 담당임원	마케팅부문 담당임원	성균관대	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김춘환	남	1967.04	제조/기술 담당임원	제조/기술 담당임원	서울대(博士)	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김태찬	남	1963.06	CIS Business 담당임원	CIS사업부 담당임원	고려대(博士)	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김태훈	남	1963.02	제조/기술 담당임원	제조/기술부문 담당임원	경북대	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김태훈	남	1970.02	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원 담당임원	Arizona State University(博士)	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김현근	남	1962.07	DRAM개발사업 담당임원	DRAM개발사업부문 담당임원	한국과학기술원(博士)	9	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김형수	남	1965.02	기업문화 담당임원	경영지원총괄 담당임원	한국과학기술원(博士)	1,000	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김형환	남	1970.03	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원 담당임원	서울대(博士)	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	마금선	남	1968.11	경영지원 담당임원	경영지원총괄 담당임원	Indiana State University(碩士)	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	문승훈	남	1969.08	제조/기술 담당임원	제조/기술 담당임원	서울시립대	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	문유진	남	1967.05	기업문화 담당임원	경영지원총괄 담당임원	한양대	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	민경현	남	1966.01	경영지원 담당임원	경영지원총괄 담당임원	New York University(碩士)	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	박근우	남	1966.04	NAND개발사업총괄 담당임원	NAND개발사업부문 담당임원	한국과학기술원(碩士)	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	박일	남	1971.01	DRAM개발사업 담당임원	메모리시스템연구소 담당임원	Purdue University(博士)	-	-	-

상무 (상근)	미등기임원	박재광	남	1966.04	Global Networking 담당	Global Networking 담당	Harvard University(碩士)	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	박진규	남	1968.06	P&T 담당임원	P&T 담당임원	영남대	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	박찬진	남	1970.05	사업총괄 담당임원	정보화본부 담당임원	서울대(博士)	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	박찬하	남	1969.01	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원 담당임원	포항공대(碩士)	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	박철규	남	1966.06	DRAM개발사업 담당임원	품질보증본부 담당임원	경북대	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	박현	남	1969.06	경영지원 담당임원	경영지원 담당임원	중앙대	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	사택진	남	1961.11	경영지원 담당임원	경영지원총괄 담당임원	고려대(碩士)	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	손석우	남	1968.01	제조/기술 담당임원	제조/기술 담당임원	영남대	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	신동원	남	1967.11	CIS Business 담당임원	CIS Business 담당임원	고려대(碩士)	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	심대용	남	1969.06	DRAM개발사업 담당임원	DRAM개발사업부문 담당임원	서울대(博士)	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	안규옥	남	1962.09	경영지원 담당임원	경영지원총괄 담당임원	중앙대(碩士)	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	안영규	남	1968.10	제조/기술 담당임원	제조/기술부문 담당임원	한국과학기술원(博士)	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	양중섭	남	1964.12	NAND개발사업총괄 담당임원	NAND개발사업부문 담당임원	한국과학기술원(碩士)	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	오종진	남	1965.02	경영지원 담당임원	경영지원총괄 담당임원	경희대(국제캠퍼스)(碩士)	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	원국	남	1966.12	마케팅/영업 담당임원	마케팅부문 담당임원	Univ. of Helsinki(碩士)	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	위보령	남	1964.06	DRAM개발사업 담당임원	DRAM개발사업부문 담당임원	한국과학기술원(博士)	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	윤석훈	남	1966.11	제조/기술 담당임원	제조/기술부문 담당임원	충남대(碩士)	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	이기정	남	1965.10	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원 담당임원	아주대(博士)	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	이기화	남	1968.12	P&T 담당임원	P&T담당임원	충북대	119	-	-
상무 (상근)	미등기임원	이동호	남	1968.06	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원 담당임원	한양대(博士)	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	이두희	남	1967.07	기업문화 담당임원	경영지원총괄 담당임원	연세대	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	이민형	남	1968.10	제조/기술 담당임원	제조/기술 담당임원	명지대	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	이병기	남	1972.02	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원 담당임원	한국과학기술원(博士)	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	이상철	남	1965.02	사업총괄 담당임원	정보화본부 담당임원	아주대(碩士)	50	-	-
상무 (상근)	미등기임원	이상화	남	1968.10	제조/기술 담당임원	제조/기술 담당임원	경북대(碩士)	-	-	-

상무 (상근)	미등기임원	이석규	남	1963.12	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원 담당임원	서울대(博士)	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	이성동	남	1965.03	P&T 담당임원	P&T담당임원	서강대	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	이성재	남	1969.07	DRAM개발사업 담당임원	DRAM개발사업 담당임원	연세대(碩士)	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	이승범	남	1964.07	CIS Business 담당임원	CIS사업부 담당임원	동국대	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	이정훈	남	1964.06	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원 담당임원	연세대(碩士)	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	이창수	남	1967.02	품질보증 담당임원	DRAM개발사업부문 담당임원	Tohoku University(碩士)	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	이한주	남	1965.11	사업총괄 담당임원	정보화본부 담당임원	성균관대	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	이호석	남	1969.09	NAND개발사업총괄 담당임원	NAND개발사업총괄 담당임원	성균관대	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	이희기	남	1964.07	품질보증 담당임원	품질보증본부 담당임원	인하대	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	임성빈	남	1963.06	제조/기술 담당임원	제조/기술부문 담당임원	울산대	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	장승호	남	1970.11	NAND개발사업총괄 담당임원	NAND개발사업부문 담당임원	서강대(碩士)	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	장종대	남	1964.10	기업문화 담당임원	경영지원총괄 담당임원	고려대(碩士)	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	장혁준	남	1967.06	경영지원 담당임원	경영지원총괄 담당임원	Indiana University – Bloomington(碩士)	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	장희현	남	1963.01	NAND개발사업총괄 담당임원	NAND개발사업부문 담당임원	연세대	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	전영호	남	1961.04	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원 담당임원	광운대	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	전용주	남	1962.10	NAND개발사업총괄 담당임원	NAND개발사업부문 담당임원	전북대(碩士)	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	전윤석	남	1964.12	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원 담당임원	University of Utah(博士)	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	정상규	남	1967.12	NAND개발사업총괄 담당임원	NAND개발사업부문 담당임원	연세대(碩士)	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	정성용	남	1972.12	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원 담당임원	Ohio State University(博士)	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	정의삼	남	1965.03	제조/기술 담당임원	제조/기술부문 담당임원	고려대	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	정종호	남	1964.03	제조/기술 담당임원	DRAM개발사업부문 담당임원	광운대	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	정진수	남	1970.10	품질보증 담당임원	품질보증 담당임원	충남대	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	정진욱	남	1970.04	제조/기술 담당임원	제조/기술부문 담당임원	경북대	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	정철우	남	1965.04	경영지원 담당임원	DRAM개발사업부문 담당임원	성균관대	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	정태우	남	1965.05	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원 담당임원	연세대(碩士)	-	-	-

상무 (상근)	미등기임원	조영만	남	1968.09	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원 담당임원	한양대	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	조주환	남	1968.01	DRAM개발사업 담당임원	DRAM개발사업부문 담당임원	광운대	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	조호진	남	1968.11	DRAM개발사업 담당임원	DRAM개발사업 담당임원	서울대(博士)	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	차선용	남	1967.08	미래기술연구원 담당임원	DRAM개발사업부문 담당임원	한국과학기술원(博士)	400	-	-
상무 (상근)	미등기임원	천영일	남	1966.10	제조/기술 담당임원	제조/기술 담당임원	고려대(碩士)	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	최광문	남	1968.01	기업문화 담당임원	기업문화 담당임원	연세대(碩士)	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	최봉호	남	1962.09	DRAM개발사업 담당임원	미래기술연구원 담당임원	연세대(碩士)	9	-	-
상무 (상근)	미등기임원	최석문	남	1966.04	사업총괄 담당임원	정보화본부 담당임원	Univ. of MichiganAnn Arbor(碩士)	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	최용수	남	1969.02	품질보증 담당임원	품질보증 담당임원	인하대	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	최정산	남	1967.01	품질보증 담당임원	품질보증본부 담당임원	연세대(碩士)	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	최준기	남	1968.02	제조/기술 담당임원	제조/기술부문 담당임원	숭실대	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	최준배	남	1969.01	경영지원 담당임원	경영지원총괄 담당임원	Fairleigh Dickinson University(碩士)	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	최홍석	남	1968.11	NAND개발사업총괄 담당임원	NAND개발사업총괄 담당임원	한국과학기술원(碩士)	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	한영수	남	1969.11	NAND개발사업총괄 담당임원	NAND개발사업부문 담당임원	아주대(碩士)	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	홍권	남	1965.11	경영지원 담당임원	경영지원총괄 담당임원	고려대(博士)	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	홍상후	남	1963.02	NAND개발사업총괄 담당임원	NAND개발사업부문 담당임원	성균관대	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	홍성권	남	1967.07	CIS Business 담당임원	CIS사업부 담당임원	한국과학기술원(博士)	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	황신용	남	1969.12	경영지원 담당임원	경영지원총괄 담당임원	고려대(碩士)	-	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	김성동	남	1967.03	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원 담당임원	서울대(博士)	-	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	김중호	남	1969.02	DRAM개발사업 담당임원	DRAM개발사업부문 담당임원	Georgia Institute of Technology(博士)	-	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	김태현	남	1970.03	CIS Business 담당임원	CIS Business 담당임원	Georgia Institute of Technology(博士)	-	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	나한주	남	1963.05	NAND개발사업총괄 담당임원	NAND개발사업부문 담당임원	서강대	-	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	박경	남	1968.07	NAND개발사업총괄 담당임원	메모리시스템연구소 담당임원	고려대(博士)	-	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	박종민	남	1968.08	NAND개발사업총괄 담당임원	NAND개발사업부문 담당임원	한국과학기술원	180	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	설광수	남	1970.01	제조/기술 담당임원	제조/기술 담당임원	Waseda University(博士)	-	-	-

연구위원 (상근)	미등기임원	양지철	남	1973.07	제조/기술 담당임원	제조/기술부문 담당임원	성균관대(博士)	-		
연구위원 (상근)	미등기임원	오훈상	남	1969.07	CIS Business 담당임원	CIS Business 담당임원	서울대(博士)	-		
연구위원 (상근)	미등기임원	유승건	남	1963.06	NAND개발사업총괄 담당임원	NAND개발사업부문 담당임원	성균관대	-		
연구위원 (상근)	미등기임원	이동준	남	1964.03	제조/기술 담당임원	제조/기술부문 담당임원	인하대	-		
연구위원 (상근)	미등기임원	이병호	남	1970.05	미래기술연구원 담당임원	제조/기술부문 담당임원	한국과학기술원(博士)	-		
연구위원 (상근)	미등기임원	이승철	남	1968.12	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원 담당임원	중앙대(碩士)	-		
연구위원 (상근)	미등기임원	이창렬	남	1967.02	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원 담당임원	한국과학기술원(博士)	-		
연구위원 (상근)	미등기임원	임의철	남	1969.08	NAND개발사업총괄 담당임원	메모리시스템연구소 담당임원	성균관대(博士)	-		
연구위원 (상근)	미등기임원	임찬	남	1966.01	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원 담당임원	연세대(碩士)	-		
연구위원 (상근)	미등기임원	임창문	남	1966.06	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원 담당임원	한국과학기술원(博士)	6,000		
연구위원 (상근)	미등기임원	장경식	남	1967.07	DRAM개발사업 담당임원	DRAM개발사업부문 담당임원	포항공과대(碩士)	-		
연구위원 (상근)	미등기임원	장세억	남	1966.03	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원 담당임원	포항공과대(碩士)	-		
연구위원 (상근)	미등기임원	정성웅	남	1967.08	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원 담당임원	한국과학기술원(博士)	242		
연구위원 (상근)	미등기임원	조명관	남	1966.05	NAND개발사업총괄 담당임원	NAND개발사업부문 담당임원	포항공과대(博士)	-		
연구위원 (상근)	미등기임원	진일섭	남	1971.05	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원 담당임원	University of California - Los Angeles(博士)	-		
연구위원 (상근)	미등기임원	채동혁	남	1973.10	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원 담당임원	서울대(博士)	-		
연구위원 (상근)	미등기임원	현창석	남	1967.02	DRAM개발사업 담당임원	미래기술연구원 담당임원	연세대	-		

(나) 미등기 임원의 변동

[기준일: 제출일 현재]

구분	직명 (상근여부)	등기임원 여부	성명	성별	생년월일	약력	담당업무	소유주식수		비고
								보통주	우선주	
퇴임	전무 (상근)	미등기임원	조광보	남	1966.12	CIS사업부장	CIS사업 담당	-	-	-
입사	상무 (상근)	미등기임원	김영희	남	1972.01	SUPEX추구협의회	NAND개발사업총괄 담당	-	-	-
	연구위원 (상근)	미등기임원	이문환	남	1967.09	경력 입사	미래기술연구원 담당	-	-	-

나. 직원의 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일)

(단위 : 천원)

사업부문	성별	직원 수				합 계	평균 근속연수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고
		기간의 정함이 없는 근로자		기간제 근로자						
		전체	(단시간 근로자)	전체	(단시간 근로자)					
-	남	15,252	-	64	-	15,316	10.12	849,542,430	57,804	-
-	여	9,361	-	48	3	9,409	11.62	372,137,370	40,162	-
합 계		24,613	-	112	3	24,725	10.69	1,221,679,800	50,982	-

※ '직원수'는 기준일 현재 본사 재직자(휴직자 포함) 기준이며, 사내이사/사외이사/기타비상무이사 제외 기준임.

※ '연간급여총액'은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준임.

※ '1인당 평균급여액'은 당기 평균인원(23,963명)을 기준으로 계산함.

다. 노동조합의 현황

(기준일: 2018년 3월 31일)

구 분	관 련 내 용	비 고
가입대상	이천 7,417명 / 청주 4,861명	-
가입인원	이천 7,272명 / 청주 4,838명	-
근로시간 면제자	이천 10명 / 청주 6명	-
소속된 연합단체	한국노총 금속노련	-
기 타	-	-

2. 임원의 보수 등

가. 이사·감사 전체의 보수 현황

(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고
등기임원	8	12,000	-

(2) 이사·감사 전체 지급금액

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고
-----	------	-----------	----

8	4,062	451	-
---	-------	-----	---

※ 인원수는 1분기말 기준임

※ 보수총액은 대상기간내 지급된 총액이며, 1인당 평균보수액은 보수총액을 기간 평균 인원수로 나누어 산출함.

(3) 유형별 지급금액

(단위 : 백만원)

구분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고
등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	3,945	1,315	-
사외이사 (감사위원회 위원 제외)	2	20	19	-
감사위원회 위원	3	98	20	-
감사	-	-	-	-

※ 인원수는 1분기말 기준임

※ 보수총액은 대상기간내 지급된 총액이며, 1인당 평균보수액은 보수총액을 기간 평균 인원수로 나누어 산출함.

나. 이사·감사의 개인별 보수 현황

※ 자본시장법 개정으로 인해 임원등의 보수 기재 회수가 연 2회로 축소함에 따라, 분기보고서에는 관련 내용을 기재하지 않는 것으로 함. (제159조 제2항 및 제160조).

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(단위 : 백만원)

구분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고
등기이사	2	259	-
사외이사	-	-	-
감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-
계	2	259	-

※ 주식매수선택권의 공정가치는 당해 사업연도(분·반기) 손익계산서(포괄손익 계산서)에 주식매수선택권과 관련하여 비용으로 계상된 부분을 기재하였으며, 공정가치 산출 방법 등 자세한 사항은 연결 감사보고서 주석 '33. 주식기준보상' 항목을 참조

(기준일 : 2018년 03월 31일)

(단위 : 원, 주)

부여 받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의 종류	변동수량			미행사 수량	행사기간	행사 가격
					부여	행사	취소			
박성욱	등기임원	2017년 03월 24일	자기주식교부	보통주	99,600	-	-	99,600	2019년 3월 25일부터 2022년 3월 24일 까지	48,400
박성욱	등기임원	2017년 03월 24일	자기주식교부	보통주	99,600	-	-	99,600	2020년 3월 25일부터 2023년 3월 24일 까지	52,280
박성욱	등기임원	2017년 03월 24일	자기주식교부	보통주	99,600	-	-	99,600	2021년 3월 25일부터 2024년 3월 24일 까지	56,460
정태성	미등기임원	2018년 01월 01일	자기주식교부	보통주	7,747	-	-	7,747	2020년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지	77,440
이석희	등기임원	2018년 03월 28일	자기주식교부	보통주	7,223	-	-	7,223	2020년 3월 29일부터 2023년 3월 28일 까지	83,060

IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

가. 기업집단의 개요

- 명칭 : 에스케이 (독점규제 및 공정거래에 관한 법률)

나. 관련법령상의 규제내용 등

- "독점규제 및 공정거래에 관한 법률" 상 상호출자제한 및 채무보증제한기업 집단

○ 지정시기 : 1987년

○ 규제내용 요약

- 상호출자의 금지 및 계열사 채무보증 금지 등
- 대규모내부거래 이사회 결의 및 공시
- 기업집단 현황 등에 관한 공시
- 비상장사의 중요사항 공시

다. 기업집단에 소속된 회사 (2018.3.31 기준 계열사 : 100개사)

상장 여부	회사명	법인등록번호
상장사 (18)	SK네트웍스(주)	130111-0005199
	SK디스커버리(주)	130111-0005727
	SKC(주)	130111-0001585
	SK가스(주)	110111-0413247
	SK(주)	110111-0769583
	SK증권(주)	110111-0037112
	SK텔레콤(주)	110111-0371346
	(주)부산도시가스	180111-0039495
	SK디앤디(주)	110111-3001685
	SK이노베이션(주)	110111-3710385
	SKC솔믹스(주)	134711-0014631
	SK하이닉스(주)	134411-0001387
	(주)아이리버	110111-1637383
	SK바이오랜드(주)	110111-1192981
	SK머티리얼즈(주)	190111-0006971
	(주)에스엠코어	110111-0128680
	(주)나노엔텍	110111-0550502
	SK케미칼(주)	131111-0501021
비상장사 (82)	SK건설(주)	110111-0038805
	영남에너지서비스(주)	175311-0001570
	충청에너지서비스(주)	150111-0006200

엔티스(주)	130111-0021658
코원에너지서비스(주)	110111-0235617
SK텔링크(주)	110111-1533599
SK E&S(주)	110111-1632979
강원도시가스(주)	140111-0002010
전남도시가스(주)	201311-0000503
전북에너지서비스(주)	214911-0004699
SK엠앤서비스(주)	110111-1873432
SK와이번스(주)	120111-0217366
SK인포섹(주)	110111-2007858
행복나래(주)	110111-2016940
SK텔레시스(주)	110111-1405897
에프앤유신용정보(주)	135311-0003300
(주)대한송유관공사	110111-0671522
(주)에이앤티에스	110111-3066861
내트릭(주)	110111-3222570
SK유화(주)	135811-0120906
SK모바일에너지(주)	161511-0076070
SK커뮤니케이션즈(주)	110111-1322885
SK에어가스(주)	230111-0134111
SK네트웍스서비스(주)	135811-0141788
SK브로드밴드(주)	110111-1466659
제주유나이티드FC(주)	224111-0015012
비앤엠개발(주)	110111-5848712
피에스앤마케팅(주)	110111-4072338
SK임업(주)	134811-0174045
SK루브리컨츠(주)	110111-4191815
SK신택(주)	131411-0232597
대전맑은물(주)	110111-4273960
SK더블유(주)	154311-0026200
네트웍오앤에스(주)	110111-4370708
서비스에이스(주)	110111-4368688
서비스탑(주)	160111-0281090
SK핑크스(주)	224111-0003760
유베이스매뉴팩처링아시아(주)	230111-0168673
SK에너지(주)	110111-4505967
SK종합화학(주)	110111-4505975
울산아로마틱스(주)	110111-4499954
SK바이오팜(주)	110111-4570720

파주에너지서비스(주)	110111-4629501
SK플래닛(주)	110111-4699794
SK렌터카서비스(주)	160111-0306525
SK하이텍(주)	134411-0037746
SK하이이엔지(주)	134411-0017540
위례에너지서비스(주)	110111-4926006
나래에너지서비스(주)	135711-0092181
SK배터리시스템즈(주)	160111-0337801
지허브(주)	230111-0205996
SK인천석유화학(주)	120111-0666464
SK트레이딩인터내셔널(주)	110111-5171064
보령LNG터미널(주)	164511-0021527
이니츠(주)	230111-0212074
(주)엔에스오케이	110111-3913187
SK어드밴스드(주)	230111-0227982
당진에코파워(주)	165011-0035072
미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄(주)	230111-0233880
SK바이오텍(주)	160111-0395453
SK플라즈마(주)	131111-0401875
한국빅슬렌(유)	230114-0003328
SKC인프라서비스(주)	134111-0414065
SK티엔에스(주)	110111-5833250
금호미쓰이화학(주)	110111-0612980
SK테크엑스(주)	110111-5990547
원스토어(주)	131111-0439131
SK트리캠(주)	164711-0060753
에프에스케이엘앤에스(주)	131111-0462520
행복모아(주)	150111-0226204
SK매직(주)	110111-5125962
SK매직서비스(주)	134811-0039752
(주)헬로네이처	110111-4867898
목감휴게소서비스(주)	110111-6257954
(주)포인트코드	110111-1888548
SK쇼와덴코(주)	175611-0018553
SK하이닉스시스템IC(주)	150111-0235586
SK해운(주)	110111-6364212
홀앤서비스(주)	110111-6420460
SKC하이테크앤마케팅(주)	161511-0225312
SK스토아(주)	110111-6585884

	SK실트론(주)	175311-0001348
--	----------	----------------

(*) 사명 변경 : SK(주) (舊 SK C&C(주)), 엔티스(주) (舊 SK사이텍(주)), SK인포섹(주) (舊 인포섹(주)), SK배터리시스템 (주) (舊 SK컨티넨탈이모션코리아(주)), 나래에너지서비스(주) (舊 하남에너지서비스(주)), 비앤엠개발(주) (舊 엠 케이에스개런티(유)), 미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄(주) (舊 에스엠피씨(주)), SK에어가스(주) (舊 SK C에어가스(주)), SK바이오랜드(주) (舊 (주)바이오랜드), 파주에너지서비스(주) (舊 피엠피(주)), SK엠앤서비스(주) (舊 엠앤서비스(주)), SK매직서비스(주) (舊 매직서비스(주)), (주)엔에스오케이 (舊 (주)네오에스네트웍스), SK디스 커버리(주) (舊 SK케미칼(주)), SKC하이테크앤마켓팅(주) (舊 SKC하이테크앤마켓팅(유)), SK렌터카서비스(주) (舊 카라이프서비스(주))

라. 계열회사간 출자현황

[2018년 3월 31일 기준]

(보통주 기준)

피투자회사 \ 투자회사	SK이노베이션	대한송유관공사	SK모바일 에너지	행복나라	SK배터리 시스템즈	SK에너지	내트럭	제주유나이티드 FC	SK종합화학	울산 아로마틱스
SK(주)	33.4%									
SK이노베이션		41.0%	100.0%	45.0%	100.0%	100.0%			100.0%	
SK에너지							100.0%	100.0%		
SK종합화학										50.0%
SK루브리컨츠										
SK텔레콤				45.0%						
SK브로드밴드										
SK텔링크										
SK플래닛										
SK하이닉스										
SK E&S										
SKC										
SK텔레시스										
SK네트웍스										
SK매직										
SK건설										
SK디스커버리										
SK신타										
SK가스				5.0%						
SK디앤디										
SK케미칼										
SK머티리얼즈										
에스엠코어										
계열사 계	33.4%	41.0%	100.0%	95.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	50.0%

피투자회사 \ 투자회사	SK루브리컨츠	유베이스매뉴 팩처링아시아	SK인천 석유화학	SK트레이딩 인터내셔널	SK텔레콤	SK커뮤니 케이션즈	SK와이브스	에프앤유 신용정보	PS&마케팅	네트웍 오앤에스
SK(주)					25.2%					
SK이노베이션	100.0%		100.0%	100.0%						
SK에너지										
SK종합화학										
SK루브리컨츠		70.0%								
SK텔레콤						100.0%	100.0%	50.0%	100.0%	100.0%
SK브로드밴드										
SK텔링크										
SK플래닛										
SK하이닉스										
SK E&S										
SKC										
SK텔레시스										
SK네트웍스										
SK매직										
SK건설										
SK디스커버리										
SK신텍										
SK가스										
SK디앤디										
SK케미칼										
SK머티리얼즈										
에스엠코어										
계열사 계	100.0%	70.0%	100.0%	100.0%	25.2%	100.0%	100.0%	50.0%	100.0%	100.0%

피투자회사 \ 투자회사	서비스에이스	서비스탑	아이리버	SK테크엑스	원스토어	나노엔텍	FSK L&S	SK브로드밴드	홈서비스	SK스토아
SK(주)										
SK이노베이션										
SK에너지										
SK종합화학										
SK루브리컨츠										
SK텔레콤	100.0%	100.0%	45.9%	100.0%	65.5%	27.1%	60.0%	100.0%		
SK브로드밴드									100.0%	100.0%
SK텔링크										
SK플래닛										
SK하이닉스										
SK E&S										
SKC										
SK텔레시스										
SK네트웍스										
SK매직										
SK건설										
SK디스커버리										
SK신텍										
SK가스										
SK디앤디										
SK케미칼										
SK머티리얼즈										
에스엠코어										
계열사 계	100.0%	100.0%	45.9%	100.0%	65.5%	27.1%	60.0%	100.0%	100.0%	100.0%

피투자회사 \ 투자회사	SK텔링크	엔에스오케이	SK플래닛	SK엠앤서비스	헬로네이처	SK하이닉스	SK하이텍	SK하이이엔지	행복모아	SK하이닉스 시스템IC
SK(주)										
SK이노베이션										
SK에너지										
SK종합화학										
SK루브리컨츠										
SK텔레콤	100.0%		98.1%			20.1%				
SK브로드밴드										
SK텔링크		100.0%								
SK플래닛				100.0%	100.0%					
SK하이닉스							100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
SK E&S										
SKC										
SK텔레시스										
SK네트웍스										
SK매직										
SK건설										
SK디스커버리										
SK신텍										
SK가스										
SK디앤디										
SK케미칼										
SK머티리얼즈										
에스엠코어										
계열사 계	100.0%	100.0%	98.1%	100.0%	100.0%	20.1%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

피투자회사 \ 투자회사	SK E&S	부산도시가스	충청에너지 서비스	영남에너지 서비스	전남도시가스	전북에너지 서비스	강원도시가스	위례에너지 서비스	파주에너지 서비스	보령LNG 터미널
SK(주)	90.0%									
SK이노베이션										
SK에너지										
SK종합화학										
SK루브리컨츠										
SK텔레콤										
SK브로드밴드										
SK텔링크										
SK플래닛										
SK하이닉스										
SK E&S		67.3%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	95.2%	100.0%	50.0%
SKC										
SK텔레시스										
SK네트웍스										
SK매직										
SK건설										
SK디스커버리										
SK신텍										
SK가스										
SK디앤디										
SK케미칼										
SK머티리얼즈										
에스엠코어										
계열사 계	90.0%	67.3%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	95.2%	100.0%	50.0%

피투자회사 \ 투자회사	코원에너지 서비스	나래에너지 서비스	SKC	SKC솔믹스	SK더블유	SK바이오랜드	SKC하이테크 엔마케팅	SK텔레시스	SKC인프라 서비스	미쓰이케미칼앤드 SKC폴리우레탄
SK(주)			41.0%							
SK이노베이션										
SK에너지										
SK종합화학										
SK루브리컨츠										
SK텔레콤										
SK브로드밴드										
SK텔링크										
SK플래닛										
SK하이닉스										
SK E&S	100.0%	100.0%								
SKC				57.7%	100.0%	27.9%	100.0%	79.4%		50.0%
SK텔레시스									100.0%	
SK네트웍스										
SK매직										
SK건설										
SK디스커버리										
SK신텍										
SK가스										
SK디앤디										
SK케미칼										
SK머티리얼즈										
에스엠코어										
계열사 계	100.0%	100.0%	41.0%	57.7%	100.0%	27.9%	100.0%	79.4%	100.0%	50.0%

피투자회사 \ 투자회사	SK네트웍스	SK네트웍스 서비스	SK핀크스	SK렌터카 서비스	목감휴게소 서비스	SK매직	SK매직서비스	SK건설	대전맑은물	SK티앤에스
SK(주)	39.1%							44.5%		
SK이노베이션										
SK에너지										
SK종합화학										
SK루브리컨츠										
SK텔레콤										
SK브로드밴드										
SK텔링크										
SK플래닛										
SK하이닉스										
SK E&S										
SKC										
SK텔레시스										
SK네트웍스		86.5%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
SK매직							100.0%			
SK건설									32.0%	100.0%
SK디스커버리	0.02%							28.3%		
SK신텍										
SK가스										
SK디앤디										
SK케이칼										
SK머티리얼즈										
에스엠코어										
계열사 계	39.1%	86.5%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	72.8%	32.0%	100.0%

피투자회사 \ 투자회사	SK해운	SK증권	SK플라즈마	SK신텍	SK가스	SK디앤디	비엔엠개발	지허브	SK어드밴스드	당진에코파워
SK(주)	57.2%	10.0%								
SK이노베이션										
SK에너지										
SK종합화학										
SK루브리컨츠										
SK텔레콤										
SK브로드밴드										
SK텔링크										
SK플래닛										
SK하이닉스										
SK E&S										
SKC										
SK텔레시스										
SK네트웍스										
SK매직										
SK건설										
SK디스커버리			100.0%	100.0%	45.6%					
SK신텍					10.0%					
SK가스						31.0%		100.0%	45.0%	51.0%
SK디앤디							100.0%			
SK케미칼										
SK머티리얼즈										
에스엠코어										
계열사 계	57.2%	10.0%	100.0%	100.0%	55.6%	31.0%	100.0%	100.0%	45.0%	51.0%

피투자회사 \ 투자회사	엔티스	이니츠	SK유화	SK바이오팜	SK바이오텍	SK임업	SK실트론	SK인포섹	SK머티리얼즈	SK에어가스
SK(주)				100.0%	100.0%	100.0%	51.0%	100.0%	49.1%	
SK이노베이션										
SK에너지										
SK종합화학										
SK루브리컨츠										
SK텔레콤										
SK브로드밴드										
SK텔링크										
SK플래닛										
SK하이닉스										
SK E&S										
SKC										
SK텔레시스										
SK네트웍스										
SK매직										
SK건설										
SK디스커버리										
SK신텍										
SK가스										
SK디앤디										
SK케미칼	50.0%	66.0%	100.0%							
SK머티리얼즈										80.0%
에스엠코어										
계열사 계	50.0%	66.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	51.0%	100.0%	49.1%	80.0%

피투자회사 \ 투자회사	SK트리켄	SK쇼와덴코	에스엠코어	포인트코드
SK(주)			26.7%	
SK이노베이션				
SK에너지				
SK종합화학				
SK루브리컨츠				
SK텔레콤				
SK브로드밴드				
SK텔링크				
SK플래닛				
SK하이닉스				
SK E&S				
SKC				
SK텔레시스				
SK네트웍스				
SK매직				
SK건설				
SK디스커버리				
SK신탉				
SK가스				
SK디앤디				
SK케미칼				
SK머티리얼즈	65.0%	51.0%		
에스엠코어				68.9%
계열사 계	65.0%	51.0%	26.7%	68.9%

마. 해외계열사 현황

(2018년 3월 31일 기준)

No.	해외계열사명
1	SK Gas America Ltd.
2	SK Gas International Pte. Ltd.
3	SK Gas USA Inc.
4	SK Gas Trading LLC
5	Avrasya Tuneli Isletme Insaat Ve Yatirim A.S.
6	SK Holdco PTE. LTD.
7	BT RE Investments, LLC

8	Hi Vico Construction Company Limited
9	Irunex Construction and Management Co., Ltd.
10	Jurong Aromatics Corporation Pte. Ltd.
11	Mesa Verde RE Ventures, LLC
12	SBC General Trading & Contracting Co. W.L.L.
13	SK E&C BETEK Corp.
14	SK E&C Consultores Ecuador S.A.
15	SK E&C India Private Ltd.
16	SK E&C Jurong Investment Pte. Ltd.
17	SK E&C Saudi Company Limited
18	SK Engineering&Construction(Nanjing)Co.,Ltd.
19	SK International Investment Singapore Pte. Ltd.
20	SKEC Anadolu LLC
21	SKEC(Thai) Limited
22	Sunlake Co., Ltd.
23	Thai Woo Ree Engineering Co., Ltd
24	SK Networks (Liaoning) Logistics Co., Ltd
25	Daiyang-SK Networks Metal SAN. VE TIC. Ltd. STI.
26	Dandong Lijiang Estate Management co.,LTD
27	SK Networks(Dandong) Energy Co.,Ltd.
28	Liaoning SK Industrial Real Estate Development Co., Ltd.
29	Novoko B.V.
30	P.T. SK Networks Indonesia
31	POSK(Pinghu) Steel Processing Center Co.,Ltd.
32	Shenyang SK Bus Terminal Co., Ltd.
33	Shenyang SK Networks Energy Co., Ltd.
34	SK (Guangzhou) Metal Co., Ltd.
35	SK (GZ Freezone) Co.,Ltd.
36	SK BRASIL LTDA
37	SK Networks (Xiamen) Steel Processing Center Co., Ltd.
38	SK Networks Deutschland GmbH
39	SK Networks HongKong Ltd.
40	SK Networks Japan Co., Ltd.
41	SK Networks Middle East FZE
42	SK Networks Resources Australia (Wyong) Pty Ltd.
43	SK Networks Resources Australia Pty Ltd.
44	SK Networks Resources Pty Ltd.
45	SK Networks Trading Malaysia Sdn Bhd
46	SK Networks(Shanghai) Co.,Ltd.

47	SK Networks(China) Holdings Co.,Ltd.
48	Springvale SK Kores Pty Ltd.
49	IBERIAN LUBE BASE OILS COMPANY, S.A.
50	PT. Patra SK
51	SK Energy Lubricants (Tianjin) Co., Ltd.
52	SK Lubricants & Oils India Pvt. Ltd.
53	SK Lubricants Americas, Inc.
54	SK Lubricants Europe B.V.
55	SK Lubricants Japan Co., Ltd.
56	SK Lubricants Rus Limited Liability Company
57	SK Life Science, Inc.
58	SK Bio-pharm Tech(Shanghai) Co., Ltd
59	Solmics Shanghai International Trading Co., Ltd.
60	Solmics Taiwan Co., Ltd.
61	SKC (Jiangsu) High Tech Plastics
62	SKC Europe GmbH
63	SKC International Shanghai Trading Co., Ltd.
64	SKC, Inc.
65	SKC PU Specialty Co., Ltd.
66	SKC (Nantong) PU Specialty Co., Ltd.
67	SKC-ENF Electronic Materials Ltd.
68	SKC (Nantong) Semiconductor Materials Technology Co., Ltd.
69	SKC Hi-Tech&Marketing(Suzhou) Co., Ltd.
70	SKC Hi-Tech&Marketing Taiwan Co., Ltd.
71	SKC Hi-Tech&Marketing Japan Co., Ltd.
72	SKC Hi-Tech&Marketing Polska SP.Z O.O.
73	SKC Hi-Tech&Marketing USA LLC
74	Asia Bitumen Trading Pte., Ltd.
75	Chongqing SK Asphalt Co., Ltd.
76	Hefei SK Baoying Asphalt Co., Ltd.
77	Netruck Franz Co., Ltd.
78	Ningbo SK Baoying Asphalt Storage Co., Ltd.
79	Shandong SK Hightech Oil Co., Ltd.
80	SK Shanghai Asphalt Co., Ltd.
81	SK Energy Hong Kong Co., Ltd.
82	SK Energy Road Investment Co., Ltd.
83	SK Energy Road Investment(HK) Co., Ltd.
84	SK E&P America, Inc.
85	SK E&P Company

86	SK Innovation Insurance (Bermuda), Ltd.
87	SK Permian, LLC
88	SK Plymouth, LLC
89	SK USA, Inc.
90	SK Battery Hungary Kft.
91	SK Battery China Holdings Co.,Ltd
92	CAILIP Gas Marketing, LLC
93	China Gas-SK E&S LNG Trading Ltd.
94	DewBlaine Energy, LLC
95	PT SK E&S Nusantara
96	SK E&S Americas, Inc.
97	SK E&S Australia Pty Ltd.
98	SK E&S Hong Kong Co., Ltd
99	SK E&S LNG, LLC
100	Fajar Energy International Pte., Ltd
101	Prism Energy International Pte., Ltd.
102	Prism Energy International Hong Kong Limited
103	SK E&S Dominicana S.R.L.
104	Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.
105	SABIC SK Nexlene Company Pte.Ltd.
106	Shanghai-GaoQiao SK Solvent Co., Ltd.
107	SK GC Americas, Inc.
108	SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd.
109	SK Global Chemical International Trading (Shanghai) Co., Ltd.
110	SK Global Chemical International Trading (Guangzhou) Co., Ltd.
111	SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd.
112	SK Global Chemical Japan Co., Ltd.
113	SK Global Chemical Singapore Pte.Ltd.
114	SK Golden Tide Plastics (Yantai) Co., Ltd.
115	SK Hualun Specialty Chemical Co., Ltd.
116	SK-SVW (Chongqing) Chemical Co., Ltd.
117	Zhejiang Shenxin SK Packaging Co., Ltd.
118	Huizhou SK TCL Taidong Chemical Co.,Ltd.
119	SK Primacor Americas LLC
120	SK Primacor Europe, S.L.U.
121	SK Saran Americas LLC
122	SK S.E. Asia Pte. Ltd.
123	ESSENCORE Limited
124	Essencore Microelectronics (ShenZhen) Limited

125	SK C&C India Pvt., Ltd.
126	SK C&C Beijing Co., Ltd.
127	SK C&C Chengdu Co., Ltd
128	ShangHai YunFeng Encar Used Car Sales Service Ltd.
129	S&G Technology
130	SK computer and communication L.L.C.
131	SK GI Management
132	Saturn Agriculture Investment Co., Limited
133	SOCAR MOBILITY MALAYSIA SDN. BHD.
134	Plutus Capital NY, Inc.
135	Hudson Energy NY, LLC
136	Gemini Partners Pte. Ltd
137	Solaris Partners Pte. Ltd
138	Beijing SK Magellan Capital Advisors Co., Ltd.
139	CFC-SK El Dorado Capital Partners, Ltd.
140	CFC-SK El Dorado Management Company, Ltd.
141	CFC-SK El Dorado Latam Fund, L.P.
142	Dogus SK Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.S.
143	Prostar Capital Ltd.
144	Prostar Capital Management Ltd.
145	Solaris GEIF Investment
146	Prostar Asia Pacific Energy Infrastructure SK Fund L.P.
147	Hermed Capital
148	Hermed Capital Health Care GP Ltd
149	Hermed Capital Health Care (RMB) GP Limited
150	Hermed Equity Investment Management (Shanghai) Co., Ltd.
151	Hermed Capital Health Care Fund L.P.
152	Shanghai Hermed Equity Investment Fund Enterprise
153	Hermeda Industrial Co.
154	Plutus Fashion NY, Inc
155	Wonderland NY, LLC
156	SK Investment Management Co., Limited.
157	SK China Company, Ltd.
158	SK China(Beijing) Co.,Ltd.
159	SK BeiJing Investment Management Limited
160	Sky Yunjian Investment Management Limited
161	SKY Property Mgmt(Beijing) Co.Ltd.
162	SK Auto Service Hong Kong Ltd.
163	SK (Beijing) Auto Rental Co.,Ltd

164	SK (Shenyang) Auto Rental Co.,Ltd
165	SK (Qingdao) Auto Rental Co.,Ltd
166	SK (Suzhou) Auto Rental Co.,Ltd
167	SK (Guangzhou) Auto Rental Co.,Ltd
168	SK (Shenzhen) Auto Rental Co.,Ltd
169	Skyline Auto Financial Leasing Co, Ltd.
170	SK Financial Leasing Co, Ltd.
171	SK Bio Energy HongKong Co.,Limited
172	SK China Investment Management Company Limited
173	SK International Agro-Products Logistics Development Co., Ltd.
174	SK International Agro-Sideline Products Park Co.,Ltd.
175	SK Property Investment Management Company Limited
176	SK Industrial Development China Co., Ltd.
177	Shanghai SKY Real Estate Development Co.,Ltd.
178	SKY Property Mgmt. Ltd.
179	SK China Real Estate Co., Limited
180	SK China Creative Industry Development Co., Ltd
181	SKY Investment Co., Ltd
182	FSK L&S (Shanghai) Co., Ltd.
183	PT Sinar Timuran Green Energi
184	SK Chemicals America, Inc.
185	SK Chemicals GmbH
186	SK Chemicals (Suzhou) Co., Ltd
187	SK Chemicals (Qingdao) Co., Ltd.
188	ST Green Energy Pte, Ltd
189	SE(Jiangsu) Electronic Materials Co., LTD
190	SK Telesys Corp.
191	TechDream Co. Limited
192	Atlas Investment Ltd.
193	Axess II Holdings
194	CYWORLD China Holdings
195	Global Opportunities Breakaway Fund
196	Global opportunities Fund
197	Harbinger China Dragon Fund
198	SK Global Healthcare Business Group Ltd.
199	SK Healthcare China Holding Co.
200	SK Healthcare Co.,Ltd.
201	SK Latin America Investment S.A.
202	SK MENA Investment B.V.

203	SK Technology Innovation Company
204	SK Telecom (China) Holding Co.,Ltd.
205	SK Telecom Americas, Inc.
206	SK Telecom China Fund 1 L.P.
207	SK Telecom Smart City Management Co., Ltd
208	SK Telecom Venture Capital, LLC
209	SK Telecom Vietnam PTE.,Ltd.
210	SKCREGC(Sichuan)Smart City Management Co.
211	SKTA Innopartners, LLC
212	Tianlong-Suzhou
213	Tianlong-Xian
214	ULand Company Limited
215	Westly Capital Partners Fund II
216	YTK Investment Ltd.
217	SK Healthcare(Wuxi) Co., Limited
218	SK Telecom Innovation Fund, L.P.
219	Fitech Global Opportunities Limited
220	Immersive Capital, L.P.
221	Magic Tech Network Co., Ltd.
222	12CM Global PTE. LTD.
223	SK telecom Japan Inc.
224	AI ALLIANCE, LLC
225	Celcom Planet Sdn Bhd
226	Dogus Planet Inc.
227	11street (Thailand) Co., Ltd.
228	Shopkick GmbH
229	Shopkick, Inc.
230	Shopkick Management Company, Inc.
231	SK Planet Global Holdings Pte. Ltd.
232	SK Planet Global Pte. Ltd.
233	SK Planet, Inc.
234	SK Planet Japan K.K.
235	SKP America, LLC
236	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
237	SK APTECH Ltd.
238	SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.
239	SK hynix America Inc.
240	SK hynix Asia Pte. Ltd.
241	SK hynix Deutschland GmbH

242	SK hynix Flash Solution Taiwan Ltd.
243	SK hynix Italy S.r.l
244	SK hynix Japan Inc.
245	SK hynix memory solutions Inc.
246	SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.
247	SK hynix Semiconductor (Wuxi) Ltd.
248	SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd.
249	SK hynix Semiconductor India Private Ltd.
250	SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.
251	SK hynix Semiconductor(China) Ltd.
252	SK hynix Semiconductor(Shanghai) Co., Ltd.
253	SK hynix U.K Ltd.
254	SK hynix Ventures Hong Kong Limited
255	Softeq Flash Solutions LLC.
256	Great Shale LNG Transport S.A.
257	MILESTONE LNG TRANSPORT S.A.
258	OCEAN MARITIME HONGKONG LIMITED
259	S&Y Shipping S.A.
260	SK B&T PTE. LTD.
261	SK shipping Europe Plc.
262	SK shipping Hongkong Ltd.
263	SK shipping Japan Co., Ltd.
264	SK shipping Singapore Pte. Ltd.
265	Dalian Sea Oil Petroleum Chemicals Co.,Ltd
266	HBNG Logitics Co., Ltd.
267	SUZHOU HAPPYNARAE Co., Ltd.
268	Chongqing Happynarae Co., Ltd.
269	SK Energy International Pte, Ltd.
270	SK Energy Americas Inc.
271	SK Energy Europe, Ltd.
272	SK Terminal B.V.
273	Iriver Enterprise Ltd.
274	Iriver China Co., Ltd.
275	Dongguan Iriver Electronics Co., Ltd.
276	Iriver Inc.
277	groovers Japan Co., Ltd.
278	S.M. LIFE DESIGN COMPANY JAPAN INC.
279	SM Mobile Communications Japan Inc.
280	Bioland Biotec Co.,Ltd

281	Bioland Haimen Co.,Ltd
282	Beijing Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Co., Ltd.
283	Foshan Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Co., Ltd.
284	MCNS Polyurethanes Europe Sp. zo.o.
285	MCNS Polyurethanes India Pvt. Ltd.
286	MCNS Polyurethanes Malaysia Sdn Bhd
287	MCNS Polyurethanes Mexico, S. de R.L. de C.V
288	MCNS Polyurethanes USA Inc.
289	Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Inc.
290	PT. MCNS Polyurethanes Indonesia
291	SMART Technology Polyurethanes P.J.S. Co.
292	Thai Mitsui Specialty Chemicals Co., Ltd.
293	Tianjin Cosmo Polyurethanes Co., Ltd.
294	SK Materials (Jiangsu) Co., Ltd.
295	SK Materials (Xian) Co., Ltd.
296	SK Materials Japan Co., Ltd.
297	SK Materials Taiwan Co., Ltd.
298	SK Securities Investment Asia Limited
299	SMC US, INC
300	SK TNS Myanmar Co.,Ltd
301	SK BIOTEK IRELAND LIMITED
302	SK Biotek USA, Inc.
303	Nanoentek USA Inc.
304	SK Siltron America, Inc.
305	SK Siltron Japan, Inc.

바. 계열회사 등 관리조직 현황

[SK하이이엔지, SK하이스택, SK하이닉스시스템아이씨, 행복모아]

당사는 상기 계열회사들과 특별약정을 체결하고 있으며, 경영기획실에서 당사를 대표하여 대주주로서의 역할을 담당하고 있습니다. 각 계열회사의 경영상 의사결정은 자체적인 이사회 의결을 원칙으로 하되, 경영계획, 이사 및 경영진 임면 등 주요 경영 사항과 관련해서는 특별약정에 의거하여 당사와 사전 협의하도록 하고 있습니다. 당사의 경영기획실은 회사를 대표하여 이들 계열회사들에 상기 특별약정에 의거한 대주주로서의 의사표시를 하고 있습니다. 한편, 당사와 동 계열회사간의 용역 서비스 계약 및 도급 계약은 다른 일반 계약과 상이하지 않게 진행하고 있습니다.

[SKHYA(미주), SKHYCS(상해), SKHYT(대만), SKHYD(독일), SKHYU(영국), SKHYJ(일본), SKHYS(싱가폴), SKHYIS(인도), SKHYH(홍콩), SKHYCW(우시)]

당사의 상기 판매법인들은 "Distribution Agreement"에 의해 당사의 해외 법인으로서 판매행위를 대행하며, 이에 법인 운영에 필요한 운영전반에 대해 본사의 지원을 보장 받습니다. 판매법인은 본사 조직으로 구성, 운영되며 각 기능상의 소속본부에서 각 업무를 관장합니다.

사. 회사와 계열사간 임원 겸직 현황

[기준일: 2018년 3월 31일]

겸직임원		겸직 계열회사		비고
성명	직위	회사명	상근여부	
박성욱	대표이사	SK hynix Semiconductor China Ltd.	비상근	-
		SK hynix memory solutions Inc.	비상근	-
박정호	이사	SK텔레콤	상근	-

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일)

(단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자 목적	최초취득금액	기초잔액			증기(감소)			기말잔액			최근사업연도 재무현황	
				수량	지분율	장부 가액	취득(처분)		평가 손익	수량	지분율	장부 가액	총자산	당기 순손익
							수량	금액						
에스케이하이엔지 주식회사	2001년 07월 05일	경영참가	7,399	500,689	100.00	7,521	-	-	-	500,689	100.00	7,521	128,339	25,139
에스케이하이시텍 주식회사	2008년 03월 15일	경영참가	5,840	277,203	100.00	6,760	-	-	-	277,203	100.00	6,760	59,534	6,343
(주)살리콘하이일	2008년 06월 12일	경영참가	76,904	8,444,276	100.00	30,756	-8,444,276	-30,756	-	-	-	-	33,322	-1,270
행복모아 주식회사	2016년 10월 12일	경영참가	7,400	1,480,000	100.00	7,400	-	-	-	1,480,000	100.00	7,400	16,486	-816
에스케이하이닉스 시스템어미씨	2017년 05월 11일	경영참가	343,295	20,000,000	100.00	290,172	4,823,982	114,756	-	24,823,982	100.00	404,928	360,254	-7,716
SK hynix Semiconductor America Inc.(SKHYA)	1983년 03월 15일	경영참가	1,231,196	6,285,587	97.74	31	-	-	-	6,285,587	97.74	31	2,522,348	-7,243
SK hynix Semiconductor Deutschland GmbH(SKHYD)	1989년 03월 01일	경영참가	80,956	-	100.00	22,011	-	-	-	-	100.00	22,011	108,470	-120
SK hynix UK Ltd.(SKHYU)	2013년 11월 05일	경영참가	1,775	186,240,200	100.00	1,775	-	-	-	186,240,200	100.00	1,775	325,434	953
SK hynix Semiconductor Asia Pte.Ltd.(SKHYS)	1991년 09월 12일	경영참가	137,532	196,303,500	100.00	52,380	-	-	-	196,303,500	100.00	52,380	636,286	2,872
SK hynix Semiconductor HongKong Ltd.(SKHYH)	1995년 04월 27일	경영참가	223,233	170,693,661	100.00	32,623	-	-	-	170,693,661	100.00	32,623	1,043,889	19,456
SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co.,Ltd.(SKHYCS)	2006년 06월 29일	경영참가	6,357	-	100.00	4,938	-	-	-	-	100.00	4,938	414,850	8,230
SK hynix Semiconductor Japan Inc.(SKHYJ)	1996년 09월 16일	경영참가	81,587	20,000	100.00	42,905	-	-	-	20,000	100.00	42,905	632,590	1,761
SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.(SKHYT)	1996년 09월 16일	경영참가	13,330	35,725,000	100.00	37,562	-	-	-	35,725,000	100.00	37,562	566,155	12,446
SK hynix Semiconductor Indian Subcontinent Private Ltd. (SKHYIS)	2007년 03월 29일	경영참가	5	270	1.00	5	-	-	-	270	1.00	5	903	7
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.(SKHYCL)	2005년 06월 30일	경영참가	1,966,060	-	91.50	2,847,911	-	-	-	-	91.50	2,847,911	4,043,100	338,969
SK hynix Semiconductor (Wuxi) Ltd.(SKHYMC)	2006년 04월 17일	경영참가	47,384	-	100.00	238,271	-	-	-	-	100.00	238,271	269,183	-706

Hitech Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.(HITECH)	2009년 11월 17일	경영참가	90,150	-	45,00	92,608	-	-	-	-	45,00	92,608	534,020	32
SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.(SKHYCW)	2010년 07월 29일	경영참가	237	-	100.00	237	-	-	-	-	100.00	237	13,347	92
SK hynix Italy(SKHYIT)	2012년 05월 11일	경영참가	18	-	100.00	18	-	-	-	-	100.00	18	3,462	254
SKHMS (SK Hynix Memory Solutions Inc.)	2012년 08월 20일	경영참가	311,284	128	100.00	311,284	-	-	0	128	100.00	311,284	97,132	28,484
SK hynix Semiconductor Flash Solution Taiwan (SKHYFST)	2013년 08월 29일	경영참가	7,819	-	100.00	7,819	-	-	0	-	100.00	7,819	8,626	247
SK APtech	2013년 09월 02일	경영참가	166,299	157,000,000	100.00	166,299	90,000,000	96,201	-	247,000,000	100.00	262,500	166,528	-9
Softed Flash Solutions LLC.	2014년 06월 03일	경영참가	14,579	-	99.93	14,579	-	-	-	-	99.93	14,579	5,261	975
STRATIO,INC.	2015년 02월 12일	투자	2,194	1,136,013	9.12	2,194	-	-	-	1,136,013	9.12	2,194	1,267	1,194
SK CHINA	2017년 08월 18일	경영참가	257,169	4,754,868	11.87	257,169	-	-	-	4,754,868	11.87	257,169	2,083,035	6,013
Keyssa, Inc.	2016년 02월 25일	투자	6,174	1,521,838	2.29	832	-	-	-	1,521,838	2.29	832	19,074	-18,145
Exnodes, Inc.	2016년 03월 17일	투자	716	-	-	716	-	-	-	-	-	716	365	-960
SK hynix Ventures Hong Kong Limited	2016년 03월 09일	투자	2,512	2,600,000	100.00	3,053	-	-	-	2,600,000	100.00	3,053	2,957	-13
NetSpeed Systems, Inc.	2016년 05월 26일	투자	3,083	2,893,071	6.07	558	-	-	-	2,893,071	6.07	558	9,627	-1,018
MEMS DRIVE, INC.	2016년 10월 20일	투자	2,246	188,451	2.94	844	-	-	-	188,451	2.94	844	4,528	-5,776
RENO SUB-SYSTEM, INC.	2017년 09월 01일	투자	2,246	1,190,476	2.68	204	-	-	-	1,190,476	2.68	204	12,328	-6,661
특정금전신탁(ProMOS)	2008년 11월 17일	투자	21,847	201,600,000	7.93	0	-201,203,689	0	0	396,311	0.88	0	1,405,327	-470,296
인발렉추얼디스커버리	2011년 05월 13일	투자	4,000	800,000	7.05	1,699	-	-	-	800,000	7.05	1,699	37,234	-1,416
합계				-	-	4,483,132	-	180,202	0	-	-	4,663,334	-	-

* 최근 사업년도 재무현황은 2017년말 실적이며 특정금전신탁은 가장 최근 자료인 2012년 9월말 기준 재무제표상 금액을 반영함

* '출자증서' 및 '전환사채'의 형태로 출자된 타법인의 경우 수량을 '-'으로 표기함

* 당사는 사업역량 강화 및 경영효율성 제고를 목적으로 2018년 1분기 중 에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)의 (주)실리콘화일 흡수합병을 완료함.

* ProMOS 회생절차에 따른 감자로 2018년 1분기 중 보유주식수 감소함.

X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

(단위 : 백만원)

성명 (법인명)	관계	계정과목	변 동 내 역				미수 이자	비고
			기초	증가	감소	기말		
행복모아(주)	자회사	단기 대여금	-	4,920	-	4,920	-	- 거래기간: 2017.09.28 ~ 2018.09.28 - 이자율: 4.6%

2. 대주주와의 자산양수도 등

가. 자산양수도 내역

(단위 : 백만원)

성명 (법인명)	관계	거래일자	거래일자 기준	거래금액	거래손익	거래내용	비고
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	2018년 1월	매각일자	1,154	841	매각	생산 효율화 목적
SK hynix Semiconductor(CHONGQING) Ltd.	해외법인	2018년 1월	매각일자	1,630	-1,553	매각	생산 효율화 목적
SK hynix Semiconductor(CHONGQING) Ltd.	해외법인	2018년 2월	매각일자	1,101	-1,390	매각	생산 효율화 목적
SK hynix Semiconductor(CHONGQING) Ltd.	해외법인	2018년 3월	매각일자	1,751	-9	매각	생산 효율화 목적
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	2018년 1월	매입일자	39,399	-37,370	매입	생산 효율화 목적
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	2018년 2월	매입일자	2,972	231	매입	생산 효율화 목적
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	2018년 3월	매입일자	36,334	-36,570	매입	생산 효율화 목적

※ SK hynix Semiconductor(China) Ltd. 처분손익은 분기말 환율 적용 : 1분기 169.68

※ 법인간 매매금액 산정 기준

- FMV (공정거래가격) : 구매실에서 중고장비거래 업체에 시장가 문의
- 부대비용 / 운송비 / 보험료 등은 당사 구매조직에서 산정

나. 출자 및 출자지분 처분 내역

(단위 : 백만원)

계약 상대방	관계	거래일자	출자 및 출자지분 처분 내역				비고	
			출자지분의 종류	거래내역				
				기초	증가	감소		기말
에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)	국내계열사	2018.02.12	보통주식	290,172	114,756	-	404,928	유상증자 84십억 및 살리권회일 흡수합병에 따른 장부가 31십억 증가
(주)살리권회일	국내계열사	2018.03.01	보통주식	30,756	-	-30,756	-	에스케이하이닉스시스템아이씨(주)로 합병
SK APtech	해외계열사	2017.08.17	보통주식	166,299	96,201	-	262,500	유상증자 \$90M

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행 · 변경사항 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행 · 변경사항

신고일자	제 목	신고 내용 / 신고사항의 진행사항
2015.08.25	장래사업 경영계획 (공정공시)	2014년 이후 10년간 금일 준공하는 이천 M14를 포함하여 신규 공장 세 개 건설함. 이천 M14 건설 및 장비투자에 총 15조원 투자할 계획임. 향후 이천/청주에 각각 1개씩 신규공장건설 및 장비투자에 추가로 31조 원 투자할 계획이며, 상당기간이 소요되는 부지조성 및 인프라 확보에 우선 착수하고 fab 건설 및 장비투자 시기는 향후 시장 및 수요상황을 고려하여 결정할 예정임.
2016.12.22	신규 시설투자 등	2015년 8월 25일 공시한 장래사업 경영계획(공정공시)에 따라, 청주에 신규 클린룸 건설을 통한 증장기 경쟁력 강화 목적으로 2017년 8월부터 2019년 6월까지 2.2조 원을 투자할 계획임
2016.12.22	신규 시설투자 등 (자율공시)	공정 미세화에 따른 공정수 증가 및 장비 대형화에 따라 공정 전환을 위해 지속적인 공간 확보 필요성이 대두되어, 우시FAB의 증장기 경쟁력 유지를 위한 클린룸 확장 투자를 2017년 7월부터 2019년 4월까지 약 9,500억 원을 집행할 계획임
2017.9.27	타법인 주식 및 출자 증권 취득결정	지난 6월 21일 도시바 반도체 사업 지분 인수 관련 자율공시 이후, 해당 사업의 지분 인수를 위한 특수목적법인(SPC)인 BCPE Pangea Intermediate Holdings Cayman, LP 에 대한 투자를 결의하였으며 Bain Capital 이 조성할 펀드에 JPY 266,000,000,000 을 Limited Partner 자격으로 투자 예정
2017.9.27	타법인 주식 및 출자 증권 취득결정	상기 공시와는 별개의 투자 관련 사항으로, 도시바 반도체 사업 관련하여 또 다른 특수목적법인(SPC)인 BCPE Pangea Cayman2 Limited 가 발행할 JPY 129,000,000,000 의 전환사채를 인수할 예정이며, 향후 적법한 절차를 거쳐 전환시 최종적으로 도시바 반도체 사업 지분의 15% 확보가 가능함

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고
제 70기 정기주주총회 (2018.03.28)	제70기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-
	사내이사 선임의 건(후보:박성욱)	원안대로 승인	
	사외이사 선임의 건(후보:송호근)	원안대로 승인	
	사외이사 선임의 건(후보:조현재)	원안대로 승인	
	사외이사 선임의 건(후보:윤태화)	원안대로 승인	
	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보:윤태화)	원안대로 승인	
	이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	
	주식매수선택권 부여 승인의 건	원안대로 승인	
	주식매수선택권 부여분 승인의 건	원안대로 승인	

제 69기 정기주주총회 (2017.03.24)	제69기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-
	정관 변경의 건	원안대로 승인	
	사내이사 선임의 건(후보:이석희)	원안대로 승인	
	기타비상무이사 선임의 건(후보:박정호)	원안대로 승인	
	사외이사 선임의 건(후보:최종원)	원안대로 승인	
	사외이사 선임의 건(후보:신창환)	원안대로 승인	
	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보:최종원)	원안대로 승인	
	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보:신창환)	원안대로 승인	
	이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	
	주식매수선택권 부여 승인의 건	원안대로 승인	
제 68기 정기주주총회 (2016.03.18)	제68기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-
	사내이사 선임의 건 (후보: 김준호)	원안대로 승인	
	사내이사 선임의 건 (후보: 박정호)	원안대로 승인	
	이사보수 한도 승인의 건	원안대로 승인	
제 67기 정기주주총회 (2015.03.20)	제67기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-
	사내이사 선임의 건	원안대로 승인	
	사외이사 선임의 건	원안대로 승인	
	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	원안대로 승인	
제 66기 정기주주총회 (2014.03.21)	제66기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-
	사내이사 선임의 건(후보: 임형규)	원안대로 승인	
	사외이사 선임의 건(후보: 최종원)	원안대로 승인	
	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 최종원)	원안대로 승인	
	이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 (이사보수한도 : 120억원)	
	임원 퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건	원안대로 승인	

2. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건

(1) Netlist, Inc.("Netlist") 특허권 침해 소송

Netlist, Inc.는 지배기업과 SK hynix America Inc. 등 지배기업의 종속기업들을 상대로 다수의 특허를 침해하였다는 소송을 2016년 8월 31일 및 2017년 6월 14일 미국 캘리포니아 중부지방법원에, 2016년 9월 1일 및 2017년 10월 31일 미국국제무역위원회에, 2017년 7월 11일 독일 뮌헨 지방법원 및 중국 베이징 지식재산법원에 각각 제기하였습니다. 당분기 말 현재 미국 등 각 지역에서 진행 중인 Netlist, Inc.의 특허 침해 소송은 소송가액이 확정되지 않은 상태이며, 당분기 말 현재 최종결과를 예측할 수 없습니다.

한편, 2016년 9월 1일 미국국제무역위원회에 제기되었던 특허 침해 소송은 2018년 1월

16일 지배기업 및 지배기업의 종속기업들이 Netlist, Inc.의 특허를 침해하지 않았다고 최종 결정되었습니다. 이에 대해 Netlist, Inc.는 2018년 3월 26일에 항소를 제기하였습니다.

(2) Hargens Berman의 가격 담합 소송

Hargens Berman(소송대리인)은 지배기업 및 종속기업인 SK hynix America Inc.를 상대로 가격 담합에 대한 집단소송을 2018년 4월 27일 미국 캘리포니아 북부지방법원에 제기하였습니다. 당분기말 현재 제기된 본 소송은 소송가액이 확정되지 않은 상태이며 당분기말 현재 최종결과를 예측할 수 없습니다.

(3) 기타의 소송 및 특허 클레임 등

상기 소송 외에, 당사는 지식재산권 등과 관련하여 여러 분쟁에 대응하고 있으며 향후 자원의 유출가능성이 높고 손실 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 동 금액을 부채로 계상하고 있습니다.

나. 채무보증 현황

당기말 현재 당사가 타인에게 제공한 지급보증 등의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구분	금액	비고
종업원	6	우리사주 관련 금융기관 차입금 지급보증

3. 제재현황 등 그 밖의 사항

가. 제재현황

제재조치일		조치기관	조치대상자	조치내용		사유 및 근거 법령		조치에 대한 이행현황	제발방지를 위한대책
연도	날짜			내용	금액(만원)	사유	근거법령		
2015	5/18~29	고용노동부	사업주	벌금	1,000	M10 경찰합동단속 실시	산안법 제23조, 24조 등	안전 및 보건상의 조치에 따른 시설 및 체계 개선 완료	타시설 횡전개 실시
	6/12	고용노동부	사업주	과태료	240	M10 경찰합동단속 실시 (공정안전보고서 작성 미이행)	산안법 제49조의2	공정안전보고서 작성 관련 업무 개선	교육 강화
	6/13	고용노동부/안전보건공단	사업주	과태료	18,133	M14 특별감독 실시	산안법 제13조, 14조, 30조, 48조	안전 및 보건상의 조치에 따른 시설 및 체계 개선 완료	타시설 횡전개 실시
	6/15	검찰총청	사업주	과태료	55,638	M10 경찰합동단속 실시	산안법 제23조, 24조 등	안전 및 보건상의 조치에 따른 시설 및 체계 개선 완료	타시설 횡전개 실시
	6/23	한강유역환경청	사업주	과태료	480	신규지정 유독물 수입세부 실적 미보고	화학물질관리법 제49조	수입실적보고 완료	수입신고 청구일원화(이전), 사업장별 Cross Check 실시
	7/22	한강유역환경청	사업주	과태료	32,280	화학물질 수입확인	화학물질관리법 제9조	국제배송차단, 수입시스템	시스템2차 개선추진, 구성원교육,홍

						증명서 미신고 (x 193건)		1차 개선.구성원교육 및 홍보	보
	7/27	한강유역환경청	사업주	과태료	9,600	유해화학물질 시설공사 및 관리 용역 발주 도급신고 미이행 (x 16건)	화학물질관리법 제31조	도급신고 완료	신규 계약 사전알람시스템을 통한 도급신고 대상여부 사전 파악
2016	3/30	고용노동부	사업주	과태료	320	관리책임자 업무수행(위험성평가) 총괄관리 미실시	산안법 제13조	안전보건관리책임자 직무 (경기위험성평가 보고/결재) 자료 제출	위험성평가 결재/보고 실시
	7/6	고용노동부	사업주	과태료	16	15년도 관리감독자 4명 교육 미실시	산안법 제31조 제1항	관리감독자 교육 미이수자 대상 교육 이수 완료	교육 미이수자 대상 교육 재실시
	9/19	고용노동부	사업주	과태료	400	PSM 이행상태 점검 (공정안전보고서 내용 미이행 7건)	산안법 제49조의 2 제7항	미이행 7개 항목 개선완료 후 자료 제출	PSM 자체감사 강화
	11/15	고용노동부	사업주	과태료	800	M14 Phase2 공사 발주 시 안전관리비 미계상	산안법 제30조의 제1항	발주서에 안전관리비 포함 및 과태료 납부	발주서에 안전관리비 포함
2017	3/8	수원지방법원	사업주	벌금	500	산업안전보건법 위반	산안법 제29조	벌금 납부	법령에 따른 안전관리 강화
	6/13	중대산업사고 예방센터 (총청권)	사업주	과태료	96	공정안전보고서 내용 (규칙/지침)이행 불일치	산안법 제49조	시정지시 조치결과서 제출 및 과태료 납부	법규/지침 이행여부 관리 강화
	11/13	충청북도청	사업주	과태료	80	대기배출원정보 입력 미실시 ('13.1.17 방지 시설 운영정보)	대기환경보전법 제31조 제2항	과태료 납부	대기배출원정보 입력/검증 강화

당사는 국제기준에 걸맞은 공정경쟁을 도모하기 위하여 관련 임직원 교육을 지속적으로 시행하고 있으며 임직원 준법 강화를 위해 여러 프로그램들을 운영 중에 있습니다. 또한 당사는 환경안전 관련 법규 준수를 위해 내부 관리 기준을 강화하고 임직원에게 대한 교육을 시행하고 있습니다.

5. 합병 등의 사후 정보

가. 에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)의 (주)실리콘화일 흡수합병

(1) 거래내역 : 에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)가 (주)실리콘화일을 흡수합병

(2) 합병 비율 : 에스케이하이닉스시스템아이씨 주식회사 : (주)실리콘화일 = 1.0000000 : 0.0000000

- 신주발행 및 합병교부금 지급이 없으므로 합병비율을 1.0000000 : 0.0000000 으로 산출

(3) 목적 : 사업역량 강화 및 경영효율성 제고 에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)가 (주)실리콘화일을 흡수합병

(4) 진행 내역 :

- 합병기일 : 2018년 3월 1일

(5) 최근 사업연도 재무내용

[에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)]

(단위 : 백만원)

자산총계	360,254	자본금	100,000
부채총계	77,958	매출액	231,537
자본총계	282,296	당기순이익	-7,716

[(주)실리콘화일]

(단위 : 백만원)

자산총계	34,438	자본금	4,222
부채총계	1,243	매출액	982
자본총계	33,195	당기순이익	1,710

※ 에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)와 (주)실리콘화일은 에스케이하이닉스 주식회사의 100% 출자 자회사임.

* 상세한 내용은 2018년 1월 12일에 공시된 회사합병결정에 대한 공시를 참고하시기 바랍니다.

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

2. 전문가와의 이해관계